

Automation PC 510

Anwenderhandbuch

Version: **1.15 (Februar 2014)**
Bestellnr.: **MAAPC510-GER**

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. der Drucklegung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Kapitel 1 Allgemeines.....	9
1 Handbuchhistorie.....	9
2 Sicherheitshinweise.....	10
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	10
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen.....	10
2.2.1 Verpackung.....	10
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung.....	10
2.3 Vorschriften und Maßnahmen.....	10
2.4 Transport und Lagerung.....	11
2.5 Montage.....	11
2.6 Betrieb.....	11
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile.....	11
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase.....	11
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme.....	12
2.7 Umweltgerechte Entsorgung.....	12
2.7.1 Werkstofftrennung.....	12
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen.....	13
4 Richtlinien.....	13
5 Übersicht.....	14
Kapitel 2 Technische Daten.....	16
1 Einleitung.....	16
1.1 Features.....	16
1.2 Aufbau / Konfiguration.....	17
1.2.1 Konfiguration Grundsystem.....	17
1.2.2 Konfiguration Software, Zubehör.....	18
2 Gesamtgerät.....	19
2.1 Temperaturangaben.....	19
2.1.1 Temperaturüberwachung.....	19
2.1.2 Temperatursensorpositionen.....	19
2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben.....	20
2.3 Leistungshaushalt.....	21
2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung.....	21
2.4 Geräteschnittstellen und Einschübe.....	22
2.4.1 Geräteschnittstellen Übersicht.....	22
2.4.2 Spannungsversorgung +24 VDC.....	23
2.4.3 Serielle Schnittstelle COM1.....	24
2.4.4 Ethernet (ETH).....	24
2.4.5 USB Schnittstellen (USB1, 2).....	25
2.4.6 Batterie.....	26
2.4.7 CompactFlash Slot.....	27
2.4.8 SD Memory Card Slot.....	27
2.4.9 Power Taster.....	28
2.4.10 Reset Taster.....	28
2.4.11 Status LEDs.....	29
2.4.12 Interface Board Einschub.....	30
3 Einzelkomponenten.....	31
3.1 Systemeinheiten.....	31
3.1.1 5PC510.SX01-00.....	31
3.2 CPU Boards US15W.....	36
3.2.1 Allgemeines.....	36
3.2.2 Bestelldaten.....	36
3.2.3 Technische Daten.....	36
3.3 Hauptspeicher.....	38
3.3.1 Bestelldaten.....	38
3.3.2 Technische Daten.....	38
3.4 Interface Boards.....	39

3.4.1 5PP5IF.CETH-00.....	39
3.4.2 5PP5IF.CHDA-00.....	41
3.4.3 5PP5IF.FETH-00.....	43
3.4.4 5PP5IF.FPLM-00.....	45
3.4.5 5PP5IF.FCAN-00.....	49
3.4.6 5PP5IF.FX2X-00.....	51
3.4.7 5PP5IF.FXCM-00.....	53
3.5 I/O Boards.....	55
3.5.1 5PP5IO.GMAC-00.....	55
3.6 Laufwerke.....	62
3.6.1 5MMHDD.0250-00.....	62
3.6.2 5MMHDD.0500-00.....	65
3.6.3 5MMSSD.0060-00.....	68
3.6.4 5MMSSD.0060-01.....	70
3.6.5 5MMSSD.0128-01.....	72
3.6.6 5MMSSD.0180-00.....	75
3.6.7 5MMSSD.0256-00.....	77
Kapitel 3 Inbetriebnahme.....	79
1 Montage.....	79
1.1 Vorgehensweise.....	79
1.2 Wichtige Informationen zur Montage.....	79
1.3 Einbaulagen.....	80
1.3.1 Einbaulage 0°.....	80
1.3.2 Einbaulage 90°.....	80
1.3.3 Einbaulage 180°.....	81
1.4 Luftzirkulationsabstände.....	82
2 Anschluss von Kabeln.....	83
3 Erdungskonzept.....	84
4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests.....	85
4.1 Vorgehensweise.....	85
4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen.....	85
4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center.....	85
4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark.....	86
4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen.....	88
4.4 Auswertung der Messergebnisse.....	88
5 Anschlussbeispiele.....	89
5.1 Auswahl der Displayeinheiten.....	89
5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard.....	90
5.2.1 Linkbaugruppe.....	90
5.2.2 Kabel.....	90
5.2.3 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen.....	91
5.2.4 BIOS Einstellungen.....	91
5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard.....	92
5.3.1 Linkbaugruppe.....	92
5.3.2 Kabel.....	92
5.3.3 BIOS Einstellungen.....	93
5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard.....	94
5.4.1 Kabel.....	94
5.4.2 BIOS Einstellungen.....	94
5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard.....	96
5.5.1 Linkbaugruppe.....	96
5.5.2 Kabel.....	96
5.5.3 BIOS Einstellungen.....	96
5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard.....	97
5.6.1 Linkbaugruppen.....	97
5.6.2 Kabel.....	97

5.6.3 BIOS Einstellungen.....	98
6 Anschluss von USB Peripheriegeräten.....	99
6.1 Lokal am APC510.....	99
6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI.....	100
6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL.....	100
7 Bekannte Probleme / Eigenheiten.....	101

Kapitel 4 Software..... 102

1 BIOS Optionen.....	102
1.1 Allgemeines.....	102
1.2 BIOS Setup und Startvorgang.....	102
1.2.1 BIOS Setup Tasten.....	104
1.3 Main.....	105
1.4 OEM Features.....	106
1.4.1 CPU Board Features.....	107
1.4.2 System Unit Features.....	112
1.4.3 I/O Board Features.....	116
1.4.4 IF Board Features.....	121
1.4.5 Memory Module Features.....	123
1.5 Advanced.....	124
1.5.1 RAM Configuration.....	125
1.5.2 Boot Configuration.....	126
1.5.3 Peripheral Configuration.....	127
1.5.4 IDE Configuration.....	128
1.5.5 Video Configuration.....	131
1.5.6 USB Configuration.....	132
1.5.7 SDIO Configuration.....	133
1.5.8 ACPI Table/Features Control.....	134
1.5.9 PCI Express Root Port 1.....	134
1.5.10 PCI Express Root Port 2.....	137
1.5.11 Console Redirection.....	139
1.6 Security.....	141
1.6.1 Set Supervisor Password.....	142
1.6.2 Set User Password.....	143
1.7 Power.....	144
1.7.1 Advanced CPU Control.....	145
1.7.2 Platform Power Management.....	148
1.8 Boot.....	149
1.8.1 Legacy.....	150
1.9 Exit.....	154
1.10 BIOS Defaulteinstellungen.....	155
1.10.1 Main.....	155
1.10.2 OEM Features.....	155
1.10.3 Advanced.....	157
1.10.4 Power.....	159
1.10.5 Boot.....	160
1.11 Ressourcenaufteilung.....	161
1.11.1 RAM-Adressbelegung.....	161
1.11.2 I/O-Adressbelegung.....	161
1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode.....	161
1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode.....	162
2 Upgradeinformationen.....	163
2.1 BIOS Upgrade.....	163
2.1.1 Was muss ich wissen?.....	163
2.1.2 Vorgangsweise mit dem Control Center.....	164
2.2 Firmwareupgrade.....	165
2.2.1 Vorgangsweise.....	165

2.3 Upgradeprobleme.....	165
3 Windows 7.....	166
3.1 Allgemeines.....	166
3.2 Bestelldaten.....	166
3.3 Übersicht.....	166
3.4 Installation.....	167
3.5 Treiber.....	167
3.6 Eigenheiten, Einschränkungen.....	167
4 Windows Embedded Standard 7.....	168
4.1 Allgemeines.....	168
4.2 Bestelldaten.....	168
4.3 Übersicht.....	168
4.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7).....	169
4.5 Installation.....	169
4.6 Treiber.....	169
4.6.1 Touch Screen Treiber.....	169
5 Windows XP Professional.....	171
5.1 Allgemeines.....	171
5.2 Bestelldaten.....	171
5.3 Übersicht.....	171
5.4 Installation.....	171
5.5 Treiber.....	172
6 Windows Embedded Standard 2009.....	173
6.1 Allgemeines.....	173
6.2 Bestelldaten.....	173
6.3 Übersicht.....	173
6.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009).....	173
6.5 Installation.....	174
6.6 Treiber.....	174
6.6.1 Touch Screen Treiber.....	174
7 Windows CE.....	175
7.1 Allgemeines.....	175
7.2 Bestelldaten.....	175
7.3 Übersicht.....	175
7.4 Features Windows CE 6.0.....	175
7.5 Was wird benötigt.....	176
7.6 Installation.....	176
7.7 B&R Embedded OS Installer.....	176
8 Automation Runtime.....	177
8.1 Allgemeines.....	177
8.2 Bestelldaten.....	177
8.3 Automation Runtime Windows (ARwin).....	177
8.4 Automation Runtime Embedded (ARemb).....	177
9 Debian (GNU/Linux).....	178
9.1 Allgemeines.....	178
9.2 Bestelldaten.....	178
9.3 Übersicht.....	178
9.4 Features.....	178
9.5 Installation / Treiber.....	179
10 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center.....	180
10.1 Funktionen.....	180
10.2 Installation.....	181
11 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit.....	182
12 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK.....	184
13 B&R Key Editor.....	186

Kapitel 5 Normen und Zulassungen.....	188
1 Richtlinien und Erklärungen.....	188
1.1 CE- Kennzeichnung.....	188
1.2 EMV-Richtlinie.....	188
1.3 Niederspannungsrichtlinie.....	188
2 Zulassungen.....	189
2.1 UL Zulassung.....	189
2.2 GOST-R.....	189
Kapitel 6 Zubehör.....	190
1 Ersatz CMOS Batterien.....	190
1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000.....	190
1.1.1 Allgemeines.....	190
1.1.2 Bestelldaten.....	190
1.1.3 Technische Daten.....	190
2 Spannungsversorgungsstecker.....	192
2.1 0TB103.9x.....	192
2.1.1 Allgemeines.....	192
2.1.2 Bestelldaten.....	192
2.1.3 Technische Daten.....	192
3 Interface Board Stecker.....	193
3.1 0TB1208.3100.....	193
3.1.1 Allgemeines.....	193
3.1.2 Bestelldaten.....	193
3.1.3 Technische Daten.....	193
4 CompactFlash Karten.....	194
4.1 Allgemeines.....	194
4.2 Grundlagen.....	194
4.2.1 Flashtechnologie.....	194
4.2.2 Wear Leveling.....	194
4.2.3 Fehlerkorrektur ECC.....	194
4.2.4 S.M.A.R.T. -Support.....	195
4.2.5 Maximale Zuverlässigkeit.....	195
4.3 5CFCRD.xxxx-06.....	196
4.3.1 Allgemeines.....	196
4.3.2 Bestelldaten.....	196
4.3.3 Technische Daten.....	196
4.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	198
4.3.5 Abmessungen.....	198
4.3.6 Benchmark.....	199
4.4 5CFCRD.xxxx-03.....	200
4.4.1 Allgemeines.....	200
4.4.2 Bestelldaten.....	200
4.4.3 Technische Daten.....	200
4.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	202
4.4.5 Abmessungen.....	202
4.5 Bekannte Probleme / Eigenheiten.....	203
5 USB Media Drive.....	204
5.1 5MD900.USB2-02.....	204
5.1.1 Allgemeines.....	204
5.1.2 Bestelldaten.....	204
5.1.3 Schnittstellen.....	204
5.1.4 Technische Daten.....	204
5.1.5 Abmessungen.....	206
5.1.6 Abmessungen mit Frontklappe.....	206
5.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche.....	207
5.1.8 Lieferumfang.....	207

5.1.9 Montage.....	207
5.2 5A5003.03.....	208
5.2.1 Allgemeines.....	208
5.2.2 Bestelldaten.....	208
5.2.3 Technische Daten.....	208
5.2.4 Abmessungen.....	208
5.2.5 Lieferumfang.....	208
5.2.6 Montage.....	209
6 USB Memory Sticks.....	210
6.1 5MMUSB.xxxx-01.....	210
6.1.1 Allgemeines.....	210
6.1.2 Bestelldaten.....	210
6.1.3 Technische Daten.....	210
6.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	211
7 Kabel.....	212
7.1 DVI Kabel.....	212
7.1.1 5CADVI.0xxx-00.....	212
7.2 SDL Kabel.....	215
7.2.1 5CASDL.0xxx-00.....	215
7.3 SDL Kabel mit 45° Stecker.....	218
7.3.1 5CASDL.0xxx-01.....	218
7.4 SDL Kabel flex.....	221
7.4.1 5CASDL.0xxx-03.....	221
7.5 SDL Kabel flex mit Extender.....	224
7.5.1 5CASDL.0xx0-13.....	224
7.6 USB Kabel.....	228
7.6.1 5CAUSB.00xx-00.....	228
7.7 RS232 Kabel.....	229
7.7.1 9A0014.xx.....	229
8 HMI Drivers & Utilities DVD.....	231
8.1 5SWHMI.0000-00.....	231
8.1.1 Allgemeines.....	231
8.1.2 Bestelldaten.....	231
8.1.3 Inhalt (V2.20).....	231
Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung.....	234
1 Batteriewechsel.....	234
1.1 Batteriestatusermittlung.....	234
1.2 Vorgangsweise.....	234
2 CompactFlash Tausch.....	236
Anhang A	237
1 Maintenance Controller Extended (MTCX).....	237
2 Abkürzungen.....	238
3 Glossar.....	239

Kapitel 1 • Allgemeines

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Änderung
0.10 Preliminary	26.08.2011	Erste Version
1.00	08.05.2012	- Das 4 "Software" wurde ergänzt. - Das 7 "Wartung / Instandhaltung" wurde ergänzt. - Die Feldklemme 0TB1208.3100 (Interface Board Stecker) wurde im 6 "Zubehör" ergänzt. - Neue CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 wurden im 6 "Zubehör" ergänzt - die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04 wurden abgekündigt. - Das Interface Board 5PP5IF.FETH-00 wurde auf Seite 5PP5IF.FETH-00 ergänzt. - Die Hard Disk 5MMHDD.0250-00 wurde auf Seite 5MMHDD.0250-00 ergänzt. - Die Abschnitte "Temperaturangaben" auf Seite 19, "Luftfeuchtigkeitsangaben" auf Seite 20 und "Leistungshaushalt" auf Seite 21 wurden im 2 "Technische Daten" ergänzt. - Der Abschnitt "Einbaulagen" auf Seite 80 wurde im 3 "Inbetriebnahme" ergänzt.
1.01	18.06.2012	Der Abschnitt "Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung" auf Seite 56 wurde ergänzt.
1.05	10.04.2013	- Der Abschnitt "Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests" auf Seite 85 wurde ergänzt. - Der Abschnitt "Gestaltung von Sicherheitshinweisen" auf Seite 13 wurde geändert - der Beschreibungstext für "Vorsicht" und "Warnung" wurde ausgetauscht. - Windows 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows 7" auf Seite 166). - Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1 wurde ergänzt (siehe "Windows Embedded Standard 7" auf Seite 168). - Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 180 wurde aktualisiert. - Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 182 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. - Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 184 wurde auf Version 1.80 aktualisiert. - Der "B&R Key Editor" auf Seite 186 wurde auf Version 3.30 aktualisiert. - Die Technischen Daten der CPU Boards wurden aktualisiert - siehe "CPU Boards US15W" auf Seite 36. - Der Abschnitt "Maintenance Controller Extended (MTCX)" auf Seite 237 wurde ergänzt. - Die CompactFlash Karte 5CFCRD.032G-06 wurde ergänzt, siehe Abschnitt "5CFCRD.xxxx-06" auf Seite 196. - Die Laufwerke "5MMHDD.0500-00" auf Seite 65, "5MMSSD.0060-00" auf Seite 68 und "5MMSSD.0180-00" auf Seite 75 wurden ergänzt. - Das "USB Media Drive" auf Seite 204 wurde hinzugefügt. - Die allgemeinen Informationen sowie die Technischen Daten des I/O Boards "5PP5IO.GMAC-00" auf Seite 55 wurden überarbeitet. - Die "Anschlussbeispiele" auf Seite 89 wurden hinzugefügt. - Der Abschnitt "HMI Drivers & Utilities DVD" auf Seite 231 wurde hinzugefügt. - Sämtliche technischen Daten wurden aktualisiert.
1.10	14.08.2013	- Der USB Memory Stick 5MMUSB.4096-01 wurde ergänzt, siehe "USB Memory Sticks" auf Seite 210. - Die Slide-in compact Laufwerke "5MMSSD.0060-01" auf Seite 70 und "5MMSSD.0128-01" auf Seite 72 wurden ergänzt. - Das Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben im Abschnitt "Kabel" auf Seite 212 wurde ergänzt. - Die Abschnitte "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 182 sowie "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 184 wurden aktualisiert.
1.15	17.02.2014	- Die GOST-R Zertifizierung wurde bei den Technischen Daten ergänzt. - Der Abschnitt "GOST-R" auf Seite 189 wurde ergänzt. - Das Slide-in compact Laufwerk "5MMSSD.0256-00" auf Seite 77 wurde ergänzt. - Die technischen Daten sowie die Temperatur-Luftfeuchtediagramme der SSD "5MMSSD.0128-01" auf Seite 72 wurde erweitert. - Die Information zur Abkündigung für den Support des Betriebssystems "Windows XP Professional" auf Seite 171 wurde hinzugefügt. - Das "B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center" auf Seite 180 wurde aktualisiert. - Das "B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit" auf Seite 182 wurde aktualisiert. - Das "B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK" auf Seite 184 wurde aktualisiert. - Der "B&R Key Editor" auf Seite 186 wurde auf Version 3.40 aktualisiert. - Das Betriebssystem "Debian (GNU/Linux)" auf Seite 178 wurde hinzugefügt. - Der Abschnitt "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 101 wurde hinzugefügt.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- **Elektrische Baugruppen mit Gehäuse**
... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- **Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse**
... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Aus etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedien- und Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubbiederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 1: Umweltgerechte Werkstofftrennung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

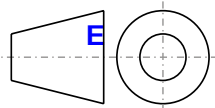
3 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Handbuch wie folgt gestaltet:

Sicherheitshinweis	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht Todesgefahr.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
Information:	Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 2: Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	$\pm 0,1$ mm
über 6 bis 30 mm	$\pm 0,2$ mm
über 30 bis 120 mm	$\pm 0,3$ mm
über 120 bis 400 mm	$\pm 0,5$ mm
über 400 bis 1000 mm	$\pm 0,8$ mm

Tabelle 3: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
Automation Runtime		
1A4600.10-5	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber	177
1A4601.06-5	B&R Automation Runtime AREmb, inkl. Lizenzaufkleber	177
1A4601.06-T	B&R Automation Runtime AREmb Terminal, inkl. Lizenzaufkleber	177
Batterien		
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	190
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	190
CPU Boards		
5PP5CP.US15-00	CPU Board Intel Atom Z510 1,1 GHz - Single Core - Chipset US15W	36
5PP5CP.US15-01	CPU Board Intel Atom Z520 1,33 GHz - Single Core - Chipset US15W	36
5PP5CP.US15-02	CPU Board Intel Atom Z530 1,6 GHz - Single Core - Chipset US15W	36
CompactFlash		
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	196
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	196
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	196
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	196
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	196
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	196
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	200
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	196
DVI Kabel		
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	212
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	212
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	212
Debian 6.0		
5SWLIN.0137-MUL	Debian 6.0 32-Bit, Multilanguage, für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 4 GByte).	178
Feldklemmen		
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	192
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	192
0TB1208.3100	Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch.	193
Hauptspeicher		
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	38
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	38
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	38
I/O Board		
5PP5IO.GMAC-00	Interface Board - 2 USB2.0 - 1 RS232/422/485 - 1 HDA Sound - 1 SDL/DVI-D - Für APC 510	55
Interface Boards		
5PP5IF.CETH-00	Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000	39
5PP5IF.CHDA-00	Audio Interface Karte - 1 HDA	41
5PP5IF.FCAN-00	CAN Interface Karte - 1 CAN Master	49
5PP5IF.FETH-00	Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 - SRAM 512 kByte	43
5PP5IF.FPLM-00	Interface Karte Powerlink - 2 Powerlink Managing Node - SRAM 512 kByte	45
5PP5IF.FX2X-00	X2X Link Interface Karte - 1 X2X Link Master - SRAM 512 kByte	51
5PP5IF.FXCM-00	CAN Interface Karte - 1 CAN Master - 1 X2X Master - 512 kByte SRAM - einbaufähig in PP500, APC510, APC511	53
Laufwerke		
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	62
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	65
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	68
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	70
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	72
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	75
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	77
RS232 Kabel		
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	229
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	229
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	229

Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung	auf Seite
SDL Kabel		
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	215
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	215
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	215
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	215
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	215
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	215
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	215
SDL Kabel 45° Anschluss		
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	218
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	218
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	218
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	218
SDL Kabel flex		
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	221
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	221
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	221
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	221
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	221
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	221
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	221
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	224
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	224
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	224
Sonstiges		
5SWHMI.0000-00	HMI Drivers & Utilities DVD	231
Systemeinheiten		
5PC510.SX01-00	APC510 Systemeinheit Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; I/O Board (5PP5IO.GMAC-00) und 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	31
USB Kabel		
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	228
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	228
USB Zubehör		
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	208
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	204
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	210
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	210
Windows 7 Professional/Ultimate		
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	166
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	166
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	166
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	166
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	166
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	166
Windows CE 6.0		
5SWWCE.0837-ENG	Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).	175
Windows Embedded Standard 2009		
5SWWXP.0737-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).	173
Windows Embedded Standard 7		
5SWWI7.0537-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	168
5SWWI7.0737-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	168
5SWWI7.1537-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	168
5SWWI7.1737-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	168
Windows XP Professional		
5SWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	171
5SWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	171
5SWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	171

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

Für alle Anwendungen, bei denen gute Performance mit besonders kompakten Abmessungen im Vordergrund steht, sind die APC510 und APC511 die erste Wahl. Sie basieren auf Intel Atom Prozessoren, die auf minimale Verlustleistung hin optimiert sind. Im Consumer Bereich stehen dabei möglichst lange Akku-Laufzeiten von Netbooks im Vordergrund, für industriellen Einsatz spielen die Atomprozessoren ihre Stärke durch einen weiten Temperaturbereich nach oben aus, der ohne den Einsatz von Lüftern erreicht wird. B&R kann hier auf viele Jahre Erfahrung im Bereich des Wärmehaushalts zurückgreifen, der sogar lüfterlosen Betrieb ausgewählter Core2 Duo Prozessoren ermöglicht. Bei APC510 und APC511 standen möglichst kleine Abmessungen im Vordergrund, so dass der sonst für Lüfter notwendige Raum entfallen kann. Ein weiterer Schritt zur kompakten Bauform war der Verzicht auf Steckplätze für PCI und PCI Express Karten, sowie auf Standard Laufwerke wie z.B. DVD. Trotzdem bieten die Automation PCs eine weit reichende Modularität und Flexibilität in Sachen Ausstattung. Eine Gigabit Ethernet Schnittstelle, USB 2.0 Interfaces, serielle Schnittstellen gehören ebenso zur Basisausstattung wie Sound Ausgabe (High Definition Audio) und eine von außen tauschbare CompactFlash Karte.

Der APC510 greift die bewährte Bauform der Automation PC Baureihen auf. Die Buchform benötigt bei minimalem Footprint nur sehr wenig des kostbaren Platzes im Schaltschrank. Hinter der Frontklappe befinden sich optimal zugänglich der CompactFlash Slot, die CMOS Batterie sowie Power und Reset Taster.

1.1 Features

- Intel® Atom™ Z510, Z520 oder Z530 Prozessor
- Bis zu 2 GB SDRAM
- 2x USB 2.0
- 1x RS232
- 1x Ethernet 10/100/1000 MBit/s
- Optionale Interface Boards
- 1 CompactFlash Steckplatz (Typ I)
- 24 VDC Versorgungsspannung
- Lüfter- und kühlkörperloser Betrieb
- BIOS (Insyde)
- Echtzeituhr, RTC (batteriegepuffert)

1.2 Aufbau / Konfiguration

Es ist möglich das APC510 System individuell, je nach Einsatzbedingungen und Anforderungen zusammenzustellen.

Für den Betrieb sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Systemeinheit
- CPU Board
- Hauptspeicher
- I/O Board
- Laufwerk (Massenspeicher wie z.B. CompactFlash Karte) für das Betriebssystem
- Spannungsversorgungsstecker (Feldklemme)

1.2.1 Konfiguration Grundsystem

Konfiguration - Grundsystem	
Systemeinheit	
Eine Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Basisboard.	 5PC510.SX01-00
CPU Board - Hauptspeicher	
CPU Board	1 auswählen
	5PP5CP.US15-00 - 1100 MHz 5PP5CP.US15-01 - 1330 MHz 5PP5CP.US15-02 - 1600 MHz
Hauptspeicher	1 auswählen
	5MMDDR.0512-01 5MMDDR.1024-01 5MMDDR.2048-01
I/O Board	1 auswählen
	5PP5IO.GMAC-00

Abbildung 1: Konfiguration - Grundsystem

1.2.2 Konfiguration Software, Zubehör

Konfiguration - Software, Zubehör	
Systemeinheit	
Eine Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Basisboard.	 5PC510.SX01-00
optionale Laufwerke	1 auswählen
	5MMSSD.0060-01 - SATA-SSD 60 GByte 5MMSSD.0128-01 - SATA-SSD 128 GByte 5MMSSD.0256-00 - SATA-SSD 256 GByte 5MMHDD.0500-00 - SATA-HDD 500 GByte
Interface Board	1 auswählen
	5PP5IF.CETH-00 - 1x ETH 10/100/100 5PP5IF.CHDA-00 - 1x HDA Sound 5PP5IF.FETH-00 - 1x ETH 10/100/100, SRAM 5PP5IF.FPLM-00 - 2x POWERLINK, SRAM 5PP5IF.FCAN-00 - 1x CAN, SRAM 5PP5IF.FX2X-00 - 1x X2X, SRAM 5PP5IF.FXCM-00 - 1x CAN, 1x X2X, SRAM
CompactFlash	1 auswählen
	5CFCRD.0512-06 5CFCRD.1024-06 5CFCRD.2048-06 5CFCRD.4096-06 5CFCRD.8192-06 5CFCRD.016G-06 5CFCRD.032G-06
USB Zubehör	1 auswählen
	5MMUSB.2048-01 5MMUSB.4096-01
Software	1 auswählen
 Microsoft Windows xp  Windows 7  Automation Runtime  Windows Embedded Standard 2009  Windows Embedded Standard 7  Windows CE  debian	Windows XP 5SWWXP.0600-ENG 5SWWXP.0600-GER 5SWWXP.0600-MUL Windows 7 5SWWI7.1100-ENG 5SWWI7.1100-GER 5SWWI7.1300-MUL Automation Runtime 1A4600.10-5 1A4601.06-5 1A4601.06-T Windows Embedded Standard 2009 5SWWXP.0737-ENG Windows Embedded Standard 7 5SWWI7.1537-ENG 5SWWI7.1737-MUL Windows CE 6.0 5SWWCE.0837-ENG Debian 6.0 (GNU/Linux) 5SWLIN.0137-MUL
Feldklemmen	je 1 auswählen
	Spannungsversorgungsstecker 0TB103.9 0TB103.91 Interface Board Stecker 0TB1208.3100

Abbildung 2: Konfiguration - Software, Zubehör

2 Gesamtgerät

2.1 Temperaturangaben

Bei den Temperaturangaben ist auf den erlaubten Temperaturbereich der Systemeinheit sowie der verbauten Komponenten zu achten. Informationen dazu sind den Technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

Zusätzlich ist auf zulässige Temperaturbereiche in Abhängigkeit von der Einbauart zu achten, nähere Informationen dazu sind im Abschnitt "Einbaulagen" auf Seite 80 zu entnehmen.

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT V2.02) von Intel zur Simulation von 100% Prozessorauslastung
- BurnIn Testtool (BurnIn V4.0 Pro von Passmark Software) zur Simulation der 100%igen Schnittstellenauslastung mittels Loopback Adaptern (Serielle Schnittstellen, USB Schnittstellen)
- Maximaler Ausbau und Leistungsverbrauch des Systems

2.1.1 Temperaturüberwachung

Sensoren überwachen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (CPU, Schnittstellen, Interface Board, I/O Board) im APC510. Die Position der Temperatursensoren ist der Abbildung "Temperatursensorpositionen" auf Seite 19 zu entnehmen. Der angegebene Wert in der Tabelle stellt die definierte maximale Temperatur bei dieser Messstelle¹⁾ dar. Beim Überschreiten der Temperatur wird kein Alarm ausgelöst. Die Temperaturen können im BIOS oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen und Automation Runtime mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

2.1.2 Temperatursensorpositionen

Sensoren zeigen Temperaturwerte in verschiedensten Bereichen (USB Schnittstellen, Hauptspeicher) im APC510 an. Die Temperaturen²⁾ können unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center³⁾, unter Automation Runtime mit Automation Studio über Datenpunkte ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

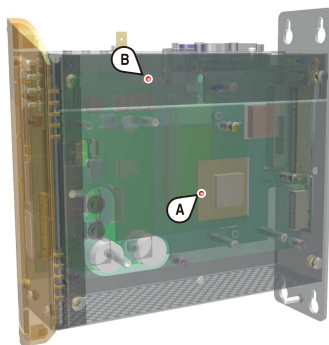


Abbildung 3: Temperatursensorpositionen

Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
A	CPU	Temperatur des Prozessors (Sensor integriert im Prozessor).	100°C: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01 90°C: 5PP5CP.US15-02
A	Hauptspeicher	Umgebungstemperatur des Hauptspeichers (Sensor integriert im Prozessor).	80°C
B	Schnittstellen	Temperatur der Schnittstellen (Sensor integriert neben USB Anschlüssen).	80°C
	Interface Board	Temperatur eines Interface Boards (Sensor ist auf dem Interface Board integriert).	abhängig vom Board
	I/O Board	Temperatur eines I/O Boards (Sensor ist auf dem I/O Board integriert).	abhängig vom Board

Tabelle 4: Temperatursensorpositionen

¹⁾ Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

²⁾ Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

³⁾ Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2 Luftfeuchtigkeitsangaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Komponente		Betrieb ¹⁾	Lagerung / Transport ¹⁾
Systemeinheiten		5 bis 90%	5 bis 95%
CPU Boards US15W		5 bis 90%	5 bis 95%
Hauptspeicher für CPU Boards		10 bis 90%	5 bis 95%
Interface Boards	5PP5IF.CETH-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.CHDA-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.FETH-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.FPLM-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.FCAN-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.FETH-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.FX2X-00	5 bis 90%	5 bis 95%
	5PP5IF.FXCM-00	5 bis 90%	5 bis 95%
I/O Boards	5PP5IO.GMAC-00	5 bis 90%	5 bis 95%
Laufwerke	5MMHDD.0250-00	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMHDD.0500-00	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMSSD.0060-00	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMSSD.0060-01	8 bis 95%	8 bis 95%
	5MMSSD.0128-01	8 bis 95%	8 bis 95%
	5MMSSD.0180-00	5 bis 95%	5 bis 95%
	5MMSSD.0256-00	8 bis 95%	8 bis 95%
Zubehör	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-04	85%	85%
	CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03	8 bis 95%	8 bis 95%
	Memory Stick 5MMUSB.2048-01	10 bis 90%	5 bis 90%
	Memory Stick 5MMUSB.4096-01	85%	85%

Tabelle 5: Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten

1) Die Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.

Die aufgelisteten Angaben entsprechen der relativen Luftfeuchtigkeit bei einer Umgebungstemperatur von 30°C. Genauere Informationen zur spezifizierten Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit der Temperatur ist den technischen Daten der Einzelkomponenten zu entnehmen.

2.3 Leistungshaushalt

2.3.1 Blockschaltbild Spannungsversorgung

Das nachfolgende Blockschaltbild stellt den vereinfachten Aufbau der Spannungsversorgung für die Systemeinheiten dar.

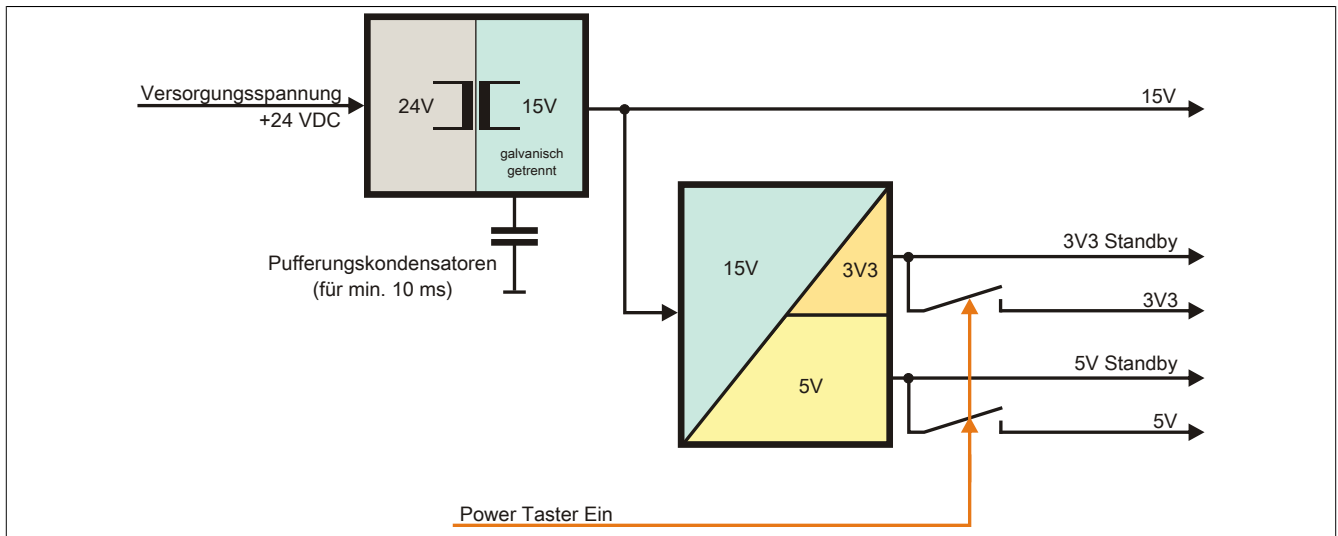


Abbildung 4: Spannungsversorgung für Systemeinheiten

Erläuterung

Aus der Versorgungsspannung werden durch einen DC/DC Wandler 15 V generiert. Diese galvanisch getrennten 15 V speisen weitere DC/DC Wandler, welche die restlichen Spannungen generieren.

Nach dem Einschalten des Systems (z.B. durch den Power Taster) werden die Spannungen 3V3 und 5 V am System aktiv.

2.4 Geräteschnittstellen und Einschübe

2.4.1 Geräteschnittstellen Übersicht

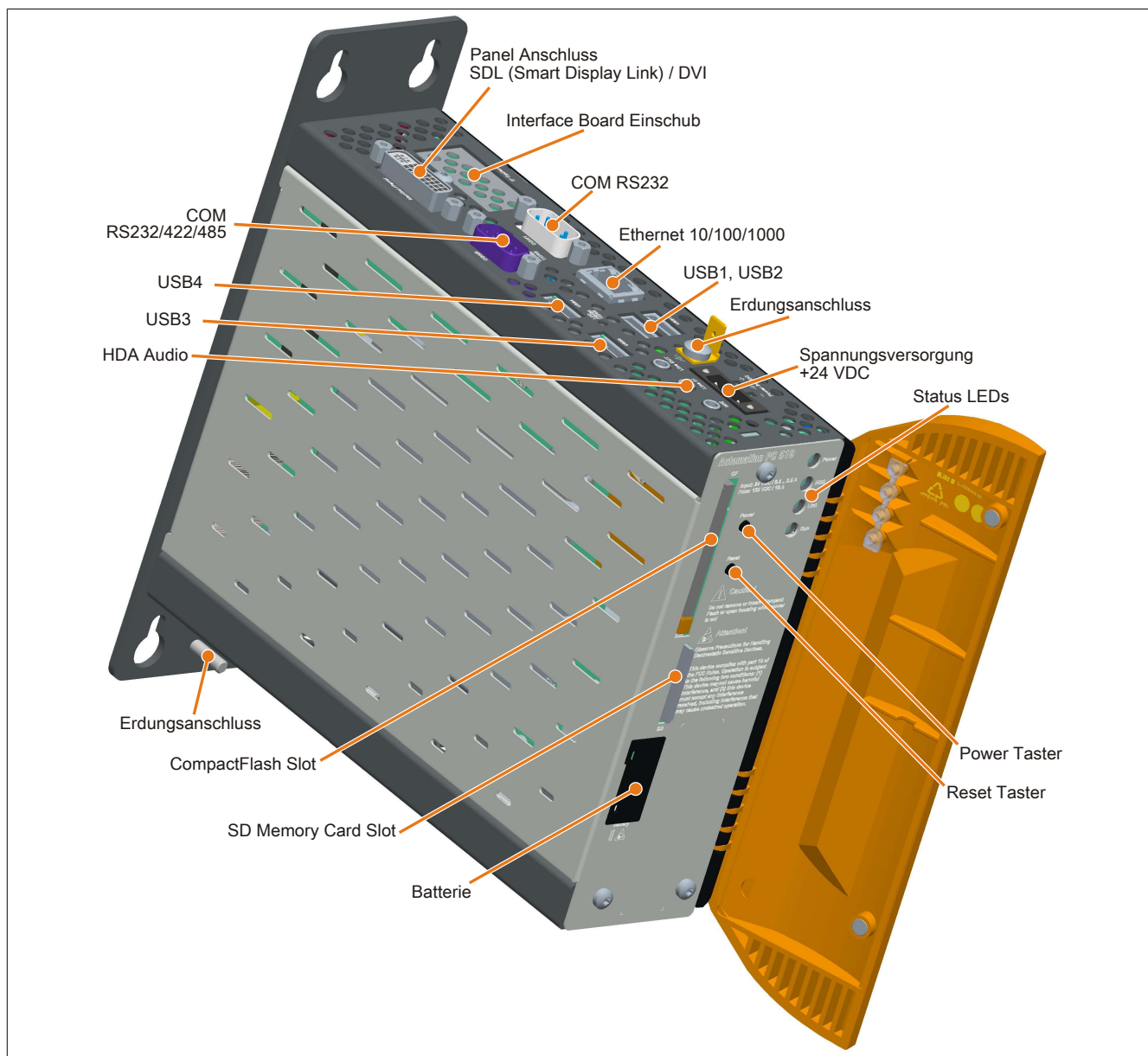


Abbildung 5: Schnittstellen Übersicht mit gestecktem I/O Board

2.4.2 Spannungsversorgung +24 VDC

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist entweder der folgenden Tabelle oder dem Aufdruck auf dem APC510 Gehäuse zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (10A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

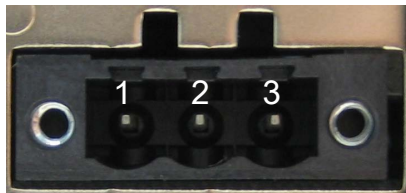
Spannungsversorgung		3-polig, male
verpolungssicher		
Pin	Beschreibung	
1	+	
2	Funktionserde	
3	-	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	

Tabelle 6: Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC

2.4.2.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Pin 2) ist möglichst kurz mit Erde (z.B. Schaltschrank) zu verbinden. Dabei ist zu empfehlen, den größt möglichen zugelassenen Leiterquerschnitt beim Versorgungsstecker zu verwenden.

Die APC510 Systeme besitzen auf der Unterseite einen Erdungsanschluss.

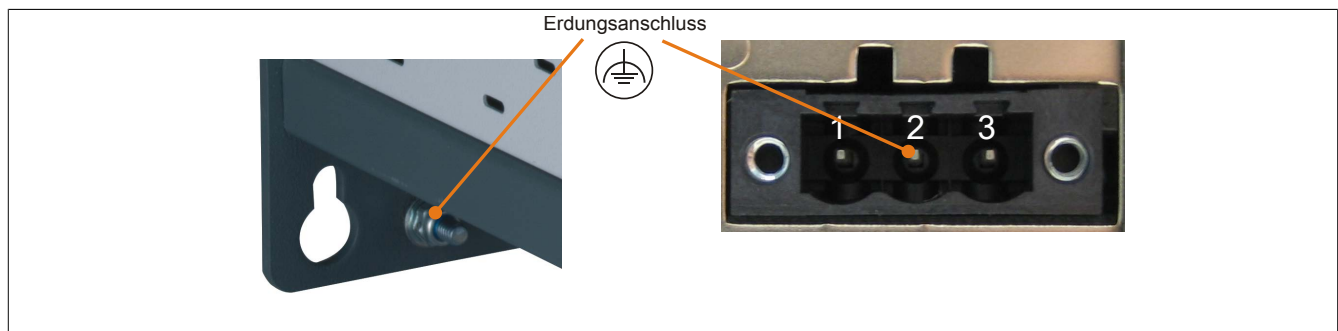


Abbildung 6: Erdungsanschluss

Mit der M4 Sicherheitsmutter kann z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschranks oder der Anlage in der der APC510 eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.4.3 Serielle Schnittstelle COM1

Serielle Schnittstelle COM1	
	RS232
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBaud
Kabellänge	max. 15 Meter
Pin	Belegung
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

9-poliger DSUB Stecker

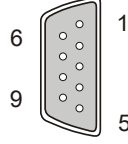


Tabelle 7: Pinbelegung COM1

2.4.4 Ethernet (ETH)

Dieser Ethernet Controller ist im CPU Board integriert und wird über das CPU Board nach außen geführt.

Ethernet Anschluss (ETH)		
Controller	Intel 82574	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ¹⁾	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ²⁾
Orange	1000 MBit/s	-
Link LED	Ein	Aus
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (Blinkt) (Daten werden übertragen)

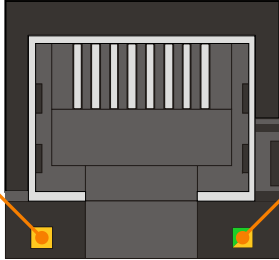
RJ45 Twisted Pair (10BaseT/100BaseT), female
 1


Tabelle 8: Ethernet Anschluss (ETH)

1) Umschaltung erfolgt automatisch.

2) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.4.5 USB Schnittstellen (USB1, 2)

Die APC510 Geräte verfügen über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 2 USB Schnittstellen nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1, 2

Universal Serial Bus (USB1, USB2) ¹⁾		
Typ	USB 2.0	2x USB Typ A, female 
Ausführung	Typ A	
Übertragungsgeschwindigkeit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
Strombelastbarkeit ²⁾ USB1, USB2	max. 1 A	
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)	

Tabelle 9: USB1, USB2 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 500 mA bzw. 1 A) abgesichert.

2.4.6 Batterie

Die Lithiumbatterie (3 V, 950 mAh) stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und bei Interface Karten mit SRAM die Daten des SRAM sicher und befindet sich hinter der schwarzen Abdeckung. Die Pufferdauer der Batterie beträgt mindestens 4 Jahre (bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%; ist ein Interface Board mit SRAM eingebaut, so beträgt die Lebensdauer 2½ Jahre.). Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und sollte regelmäßig (mindestens nach der angegebenen Lebensdauer) per Batteriewechsel erneuert werden.

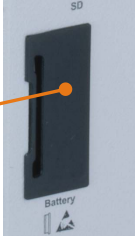
Batterie		
Batterie Typ Tauschbar Lebensdauer	Renata 950 mAh Ja, von außen zugänglich 4 Jahre ¹⁾	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
4A0006.00-000	Lithium Batterie 1 Stück, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 10: Batterie

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist ein Interface Board mit SRAM eingebaut, so beträgt die Lebensdauer 2½ Jahre.

Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter OEM Features - CPU Board Features - CPU Board Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 11: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

2.4.7 CompactFlash Slot

Dieser CompactFlash Slot ist intern über IDE PATA mit dem Chipset verbunden. Es können CompactFlash Karten des Types I gesteckt werden.

CompactFlash Slot	
Anschluss	PATA Master
CompactFlash Typ	Typ I
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
CompactFlash	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1024 MByte B&R
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2048 MByte B&R
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4096 MByte B&R
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8192 MByte B&R
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R

CompactFlash Slot



Tabelle 12: CompactFlash Slot

Warnung!

An- und Abstecken der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.4.8 SD Memory Card Slot

Der SD Memory Card Slot wird nur für SD Memory Karten, nicht für SDHC Karten unterstützt. Weiters dürfen SD Memory Karten nur als Massenspeicher betrieben werden, ein Booten von SD Memory Karten ist nicht möglich!

SD Memory Card Slot	

SD Memory Card Slot

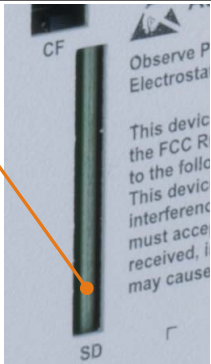


Tabelle 13: SD Memory Card Slot

2.4.9 Power Taster

Auf Grund der vollen ATX Netzteilunterstützung besitzt der Power Taster verschiedenste Funktionalitäten.

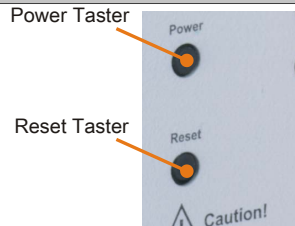
Power Taster	
Der Power Taster verhält sich wie z.B. der Netzschalter bei aktuellen Desktop PCs mit ATX Netzteil: kurzes Drücken ... APC510 einschalten bzw. Betriebssystem herunterfahren und APC510 ausschalten. langes Drücken ... ATX Netzteil schaltet ohne herunterfahren den APC510 aus (Datenverlust möglich!). Beim Drücken des Power Tasters wird der MTCX Prozessor nicht resettiert.	

Tabelle 14: Power Taster

2.4.10 Reset Taster

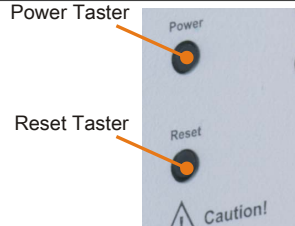
Reset Taster	
Wenn der Reset Taster betätigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelöst. Der APC510 startet neu (Kaltstart). Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resettiert.	

Tabelle 15: Reset Taster

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.4.12 Interface Board Einschub

Interface Board Einschub	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Interface Boards
5PP5IF.CETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000
5PP5IF.CHDA-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x MIC, 1x Line IN, 1x Line OUT
5PP5IF.FETH-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x Ethernet 10/100/1000, 512 kByte SRAM
5PP5IF.FPLM-00	PP500 Interface Board; Anschlüsse für 2x POWERLINK
5PP5IF.FCAN-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x CAN Master, 512 kByte SRAM
5PP5IF.FX2X-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x X2X Master, 512 kByte SRAM
5PP5IF.FXCM-00	PP500 Interface Board; Anschluss für 1x CAN Master, 1x X2X Master, 512 kByte SRAM

Interface Board Einschub



Tabelle 17: Interface Board Einschub

Information:

Interface Boards können NUR im Werk B&R eingebaut und getauscht werden.

3 Einzelkomponenten

3.1 Systemeinheiten

3.1.1 5PC510.SX01-00

3.1.1.1 Allgemeines

- Intel® Atom™ Technologie
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Interface Board
- Kompakte Größe für wenig Platz im Schaltschrank

3.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PC510.SX01-00	APC510 Systemeinheit Anschlüsse für 1x RS232, 2x USB 2.0, 1x Ethernet 10/100/1000; erweiterbar mit einem Interface Board; I/O Board (5PP5IO.GMAC-00) und 24 VDC Stecker für Spannungsversorgung gesondert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9; Federzugklemme: 0TB103.91).	
	Erforderliches Zubehör	
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	CPU Board Intel Atom Z510 1,1 GHz - Single Core - Chipset US15W	
5PP5CP.US15-01	CPU Board Intel Atom Z520 1,33 GHz - Single Core - Chipset US15W	
5PP5CP.US15-02	CPU Board Intel Atom Z530 1,6 GHz - Single Core - Chipset US15W	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	
	Optionales Zubehör	
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
	I/O Board	
5PP5IO.GMAC-00	Interface Board - 2 USB2.0 - 1 RS232/422/485 - 1 HDA Sound - 1 SDL/DVI-D - Für APC 510	
	Interface Boards	
5PP5IF.CETH-00	Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000	
5PP5IF.CHDA-00	Audio Interface Karte - 1 HDA	
5PP5IF.FCAN-00	CAN Interface Karte - 1 CAN Master	
5PP5IF.FETH-00	Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 - SRAM 512 kByte	
5PP5IF.FPLM-00	Interface Karte Powerlink - 2 Powerlink Managing Node - SRAM 512 kByte	
5PP5IF.FX2X-00	X2X Link Interface Karte - 1 X2X Link Master - SRAM 512 kByte	
5PP5IF.FXCM-00	CAN Interface Karte - 1 CAN Master - 1 X2X Master - 512 kByte SRAM - einbaufähig in PP500, APC510, APC511	
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	

Tabelle 18: 5PC510.SX01-00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC510.SX01-00
Allgemeines	
Kühlung	Lüfterlos
LEDs	Power, CF, Link, Run
B&R ID-Code	\$C645
Batterie	
Typ	Renata 950 mAh
Lebensdauer	4 Jahre ¹⁾
tauschbar	Ja, von außen zugänglich
Ausführung	Lithium Ionen
Power-Taster	Ja
Reset-Taster	Ja
Summer	Ja
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Controller	
Boot-Loader	BIOS
Watchdog	MTCX
Power Fail Logik	
Controller	MTCX ²⁾
Pufferzeit	10 ms
Grafik	
Controller	Intel® Graphics Media Accelerator 500
Speicher	
Typ	DDR2 SDRAM
Größe	max. 2 GByte
Schnittstellen	
COM1 ³⁾	
Typ	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
CompactFlash Slot 1	
Anzahl	1
Typ	Typ I
SD Memory Card Slot	
Typ	SD Card
USB	
Anzahl	2
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	je Anschluss max. 1 A
Ethernet	
Anzahl	1
Controller	Intel 82574
Ausführung	geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Einschübe	
Interface Board	Ja
I/O Board	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%
Nennstrom	1,5 A ⁴⁾
Einschaltstrom	typ. 3 A, max. 50 A für <300 µs
Leistungsaufnahme	35 W ⁵⁾
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP20 (nur mit gesteckter CF- und SD-Karte, gestecktem IF Board oder mit einer optionalen IF Abdeckung)
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 50°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 19: 5PC510.SX01-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PC510.SX01-00
Vibration	
Betrieb (dauerhaft)	2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich)	2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock	
Betrieb	15 g, 11 ms
Lagerung	30 g, 15 ms
Transport	30 g, 15 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3000 m (komponentenabhängig) ⁶⁾
Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	
Material	verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung	eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung	hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen	
Breite	58 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	202,4 mm
Gewicht	1600 g

Tabelle 19: 5PC510.SX01-00 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%. Ist ein Interface Board mit SRAM eingebaut, so beträgt die Lebensdauer 2½ Jahre.
- 2) Maintenance Controller Extended
- 3) Die COM1 Schnittstelle ist im BIOS als COMA Schnittstelle gekennzeichnet.
- 4) Der angegebene Wert ist für eine nominale Nennspannung von 24 VDC gültig.
- 5) Der angegebene Wert ist für eine Systemeinheit mit CPU Board und I/O Board, aber ohne Interface Board, gültig.
- 6) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

3.1.1.4 Abmessungen

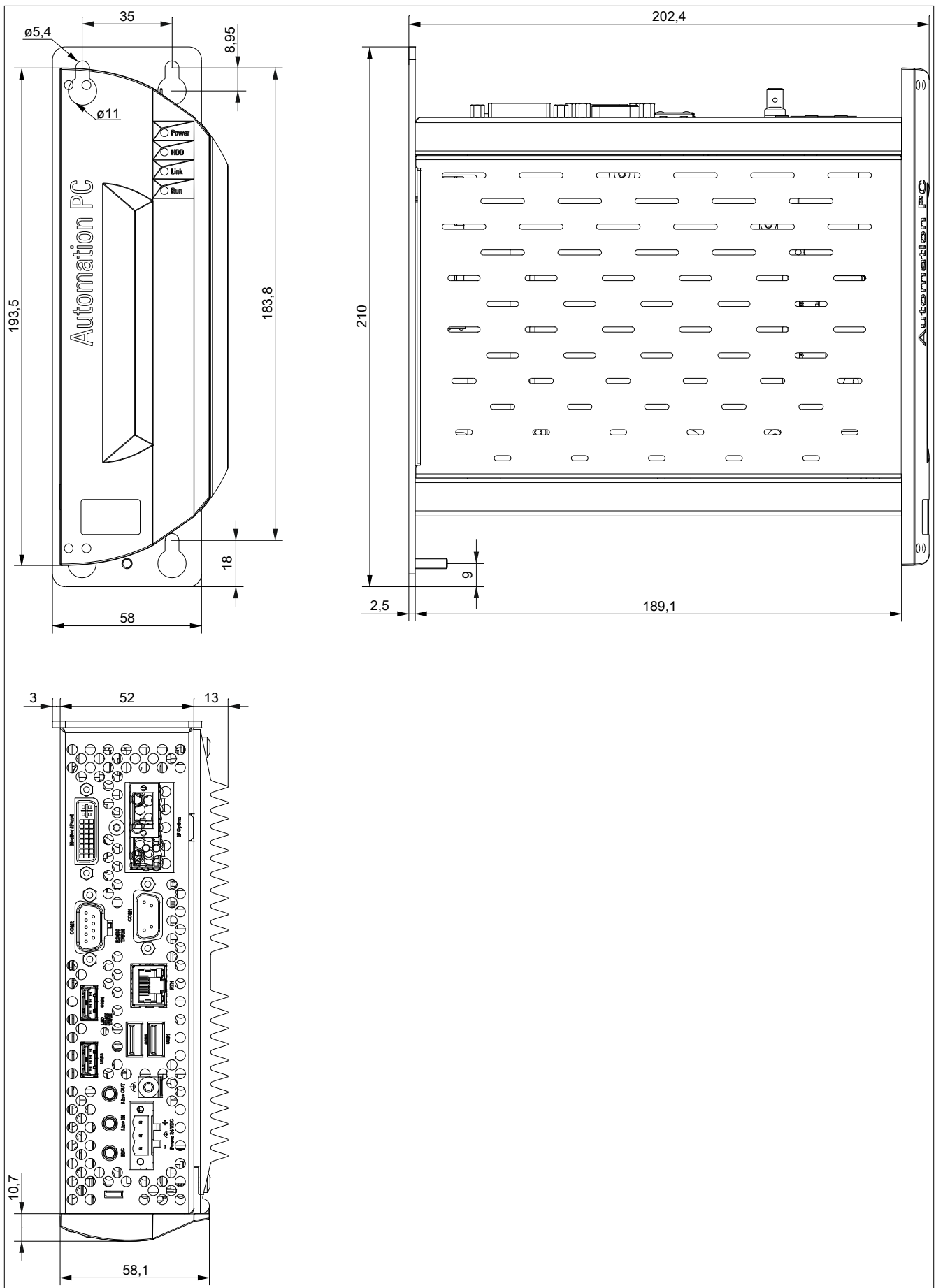


Abbildung 7: 5PC510.SX01-00 - Abmessungen

3.1.1.5 Bohrschablone

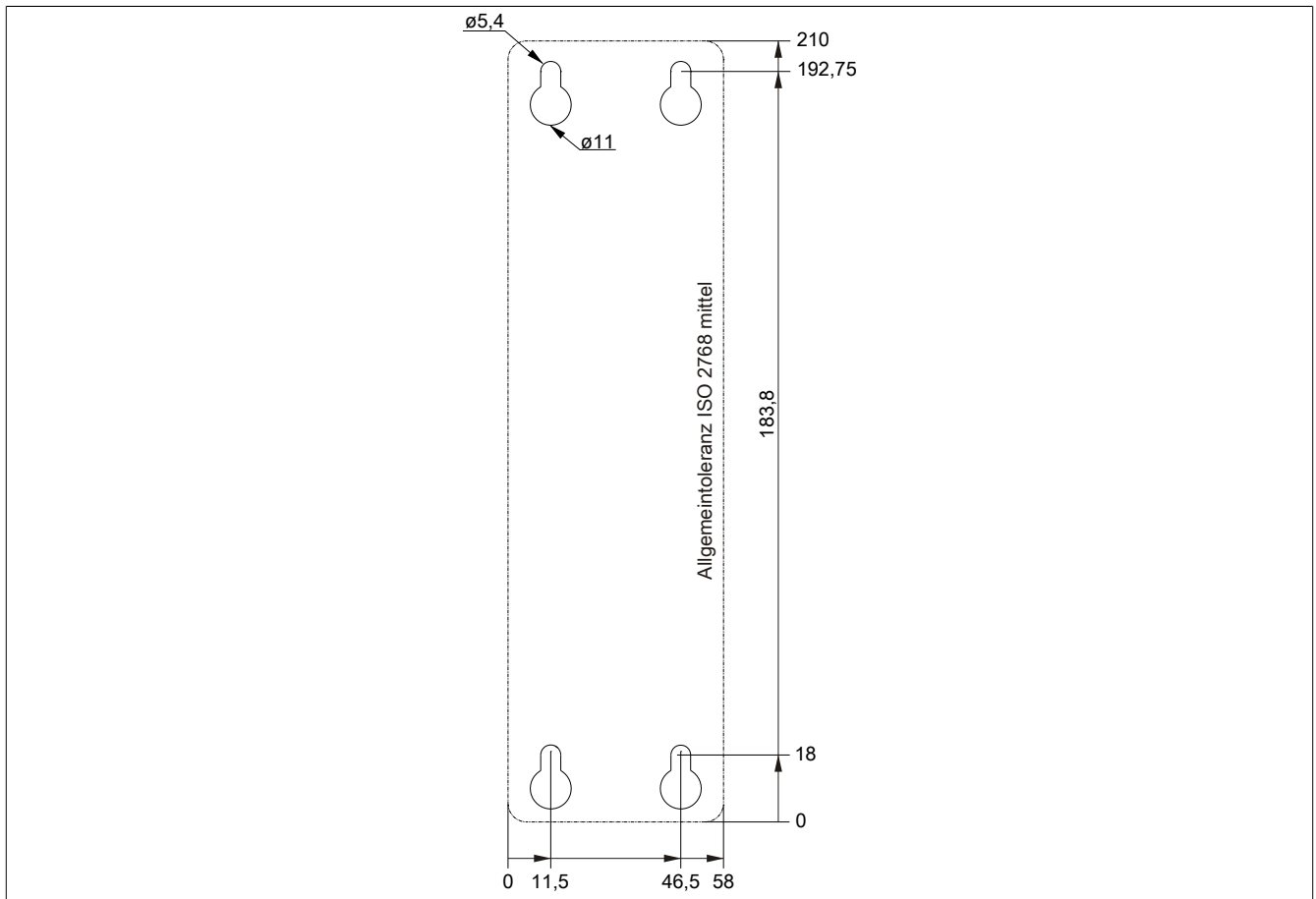


Abbildung 8: 5PC510.SX01-00 - Bohrschablone

3.2 CPU Boards US15W

3.2.1 Allgemeines

Die CPU Boards basieren auf dem Intel® US15W Chipsatz und verfügen über einen DDR2 Speichersockel für maximal 2 GByte. Desweiteren ist der Intel® GMA 500 mit 128 MByte Speicher integriert.

- Intel® Atom™ Technologie
- Intel® US15W Chipsatz
- 1x DDR2 Speichersockel
- Intel® GMA 500
- Insyde BIOS

3.2.2 Bestelldaten

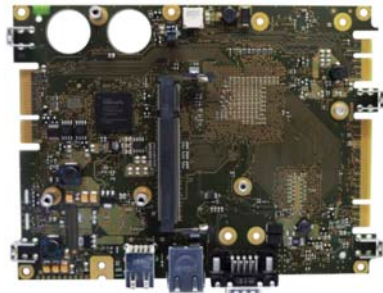
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CPU Boards	
5PP5CP.US15-00	CPU Board Intel Atom Z510 1,1 GHz - Single Core - Chipset US15W	
5PP5CP.US15-01	CPU Board Intel Atom Z520 1,33 GHz - Single Core - Chipset US15W	
5PP5CP.US15-02	CPU Board Intel Atom Z530 1,6 GHz - Single Core - Chipset US15W	
	Erforderliches Zubehör	
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 20: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten

3.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5CP.US15-00		5PP5CP.US15-01	5PP5CP.US15-02
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
cULus	Ja			
GOST-R	Ja			
GL	Ja			
Controller				
Boot-Loader	BIOS Insyde			
Prozessor				
Typ	Intel® Atom™ Z510PT	Intel® Atom™ Z520PT	Intel® Atom™ Z530P	
Taktfrequenz	1100 MHz	1330 MHz	1600 MHz	
Anzahl der Kerne	1			
Architektur	45 nm			
L1 Cache	32 kByte			
L2 Cache	512 kByte			
Externer Bus	400 MHz	533 MHz	533 MHz	
Intel® 64 Architecture	Nein			
Intel® Hyper-Threading Technology	Ja			
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Nein	Ja	Ja	
Enhanced Intel SpeedStep® Technology	Ja			
Erweiterter Befehlssatz	SSE2, SSE3, SSSE3			
Chipsatz	Intel® US15WPT	Intel® US15WPT	Intel® US15WP	
Echtzeituhr				
Genauigkeit	bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag ¹⁾			
batteriegepuffert	Ja			
Speichersockel				
Anzahl der Speicherkanäle	1			
Typ	DDR2			
Größe	max. 2 GByte			

Tabelle 21: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5CP.US15-00	5PP5CP.US15-01	5PP5CP.US15-02
Grafik	Intel® Graphics Media Accelerator 500 bis zu 256 MByte ²⁾ max. 32 Bit abhängig von der verwendeten Systemeinheit ³⁾		
Controller			
Speicher			
Farbtiefe			
Auflösung			
Power Management	ACPI 3.0		

Tabelle 21: 5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten

- 1) Bei 50°C, 8,5 µA der zu versorgenden Komponenten und einer Selbstentladung von 40%.
- 2) Wird im Hauptspeicher allokiert.
- 3) Für PP500: die maximale Auflösung ergibt sich automatisch durch die Auswahl der PP500 Systemeinheit.

3.3 Hauptspeicher

3.3.1 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Hauptspeicher	
5MMDDR.0512-01	SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300	
5MMDDR.1024-01	SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300	
5MMDDR.2048-01	SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300	

Tabelle 22: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten

3.3.2 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMDDR.0512-01	5MMDDR.1024-01	5MMDDR.2048-01
Allgemeines			
Typ	SO-DIMM DDR2 SDRAM		
Speichergröße	512 MByte	1 GByte	2 GByte
Bauart	200 Pin		
Organisation	64M x 64 Bit	128M x 64 Bit	256M x 64 Bit
Geschwindigkeit	DDR2-667 (PC2-5300)		
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja ¹⁾		

Tabelle 23: 5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

Information:

Ein Hauptspeichertausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.4 Interface Boards

Information:

Interface Boards können NUR im Werk B&R eingebaut und getauscht werden.

3.4.1 5PP5IF.CETH-00

3.4.1.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.CETH-00 verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Power Panel 500, Automation PC 510 und Automation PC 511 betrieben werden.

- 1 Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit/s)
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann unter Automation Runtime ab Automation Studio 3.0.90.18 und Automation Runtime D4.01 betrieben werden.

3.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.CETH-00	Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000	

Tabelle 24: 5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten

3.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.CETH-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4D5
Diagnose Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen CE cULus GOST-R GL	Ja Ja Ja Ja
Schnittstellen	
Ethernet Anzahl Controller Ausführung Übertragungsrate Leitungslänge	1 Intel 82574 geschirmter RJ45 Port 10/100/1000 MBit/s max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	2 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur Betrieb Lagerung Transport	0 bis 55°C -20 bis 60°C -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 25: 5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten

3.4.1.3.1 Ethernet Schnittstelle (ETH)

Ethernet Anschluss		
Controller	Intel 82574	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ¹⁾	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ²⁾
Orange	1000 MBit/s	-
Link LED	Ein	Aus
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)

1

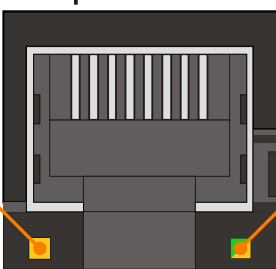


Tabelle 26: 5PP5IF.CETH-00 - Ethernet Anschluss

1) Umschaltung erfolgt automatisch.

2) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die IF-Slot Link LED aktiv ist.

Zum Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.4.2 5PP5IF.CHDA-00

3.4.2.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.CHDA-00 verfügt über einen HDA Soundchip bei dem die Kanäle MIC, Line IN und Line OUT von außen zugänglich sind.

- 1x MIC
- 1x Line IN
- 1x Line OUT
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann unter Automation Runtime ab Automation Studio 3.0.90.18 und Automation Runtime A4.01 betrieben werden.

3.4.2.2 Bestelldaten

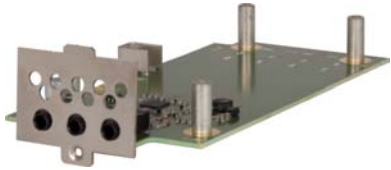
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.CHDA-00	Audio Interface Karte - 1 HDA	

Tabelle 27: 5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten

3.4.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.CHDA-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4D6
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Schnittstellen	
Audio	
Typ	HDA Sound
Controller	Realtek ALC 662
Eingänge	Mikrofon, Line In
Ausgänge	Line Out
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	2 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 28: 5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten

3.4.2.3.1 MIC, Line IN, Line OUT

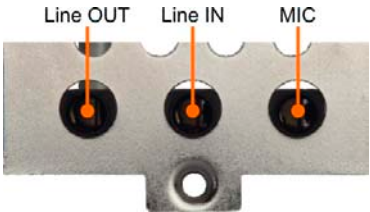
MIC, Line IN, Line OUT		
Controller	Realtek ALC 662	3,5 mm Klinkenanschluss, female 
MIC	Anschluss eines Mono Mikrofon über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line IN	Einspeisung eines Stereo Line In Signals über 3,5 mm Klinkenstecker.	
Line OUT	Anschluss eines Stereo Wiedergabegerätes (z.B. Verstärker) über einen 3,5 mm Klinkenstecker.	

Tabelle 29: MIC, Line IN, Line OUT

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.4.3 5PP5IF.FETH-00

3.4.3.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.FETH-00 verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Netzwerkanschluss sowie 512 kByte SRAM und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Power Panel 500, Automation PC 510 und Automation PC 511 betrieben werden.

- 1 Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit/s)
- 512 kByte SRAM
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann nur unter Automation Runtime (ab Automation Studio 3.0.90.18 und Automation Runtime D4.01) betrieben werden.

3.4.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.FETH-00	Interface Karte Ethernet - 1 Ethernet 10/100/1000 - SRAM 512 kByte	

Tabelle 30: 5PP5IF.FETH-00 - Bestelldaten

3.4.3.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.FETH-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B7C4
Diagnose Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen CE cULus GOST-R GL	Ja Ja Ja Ja
Controller	
SRAM Größe batteriegepuffert Remanente Variablen im Power Fail Mode	512 kByte Ja 256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe) ¹⁾
Schnittstellen	
Ethernet Anzahl Controller Ausführung Übertragungsrate Leitungslänge	1 Intel 82574 geschirmter RJ45 Port 10/100/1000 MBit/s max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	4 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur Betrieb Lagerung Transport	0 bis 50°C -20 bis 60°C -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 31: 5PP5IF.FETH-00 - Technische Daten

1) bei optimierten Zugriff mittels Write Combining.

3.4.3.3.1 Ethernet Schnittstelle (ETH)

Ethernet Anschluss		
Controller	Intel 82574	
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s ¹⁾	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus
Grün	100 MBit/s	10 MBit/s ²⁾
Orange	1000 MBit/s	-
Link LED	Ein	Aus
Orange	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)

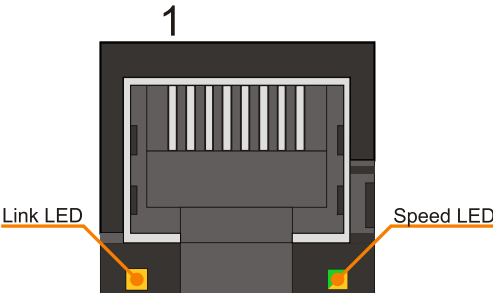


Tabelle 32: 5PP5IF.FETH-00 - Ethernet Anschluss

1) Umschaltung erfolgt automatisch.

2) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit / Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die IF-Slot Link LED aktiv ist.

Zum Betrieb des Intel Ethernet-Controllers 82574 ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.4.4 5PP5IF.FPLM-00

3.4.4.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.FPLM-00 verfügt über zwei POWERLINK-Anschlüsse und 512 kByte SRAM.

Mit dem integrierten Hub lässt sich eine einfache Baumstruktur oder wahlweise eine Ring-Redundanz ohne Zusatzaufwand einfachst realisieren.

Das Modul bietet mit Poll-Response Chaining eine Lösung für höchste Ansprüche an Reaktionszeit und kürzeste Taktzeiten. Speziell bei zentralen Regelungsaufgaben zeigt PollResponse Chaining in Verbindung mit dem B&R Steuerungssystem eine ideale Leistung.

- 2x POWERLINK V1/V2 Anschlüsse
- 512 kByte SRAM
- Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
- Ringredundanz konfigurierbar
- PollResponse Chaining
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann nur unter Automation Runtime betrieben werden.

3.4.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.FPLM-00	Interface Karte Powerlink - 2 Powerlink Managing Node - SRAM 512 kByte	

Tabelle 33: 5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten

3.4.4.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.FPLM-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4D8
Diagnose Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen CE cULus GOST-R GL	Ja Ja Ja Ja
Controller	
SRAM Größe batteriegepuffert Remanente Variablen im Power Fail Mode	512 kByte Ja 256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe) ¹⁾
Schnittstellen	
POWERLINK Anzahl Übertragung Typ Ausführung Übertragungsrate Leitungslänge	2 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3) Typ 4 Interner 2fach Hub, 2x geschirmter RJ45 Port 100 MBit/s max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	3 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur Betrieb Lagerung Transport	0 bis 55°C -20 bis 60°C -20 bis 60°C

Tabelle 34: 5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.FPLM-00
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

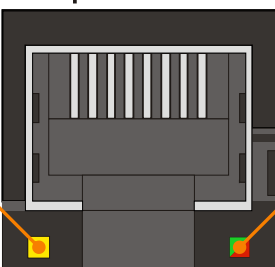
Tabelle 34: 5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten

1) bei optimierten Zugriff mittels Write Combining.

3.4.4.3.1 POWERLINK Schnittstelle

POWERLINK Interface Board 2 Anschlüsse		
Verkabelung	S/STP (Cat5e)	
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)	
Speed LED	Ein	Aus
Grün / Rot	siehe Status/Error LED	
Link LED	Ein	Aus
Gelb	Link (Eine Verbindung zu einem POWERLINK Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)

1



Link LED

Speed LED

Tabelle 35: POWERLINK Interface Board 2port Anschluss

3.4.4.3.2 LED STATUS

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Stati eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet TCP/IP Modus

Die Schnittstelle kann als reine Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrieben werden.

Farbe grün - Status	Beschreibung
Ein	Die POWERLINK Schnittstelle wird als reine Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrieben.

Tabelle 36: Status/Error LED - Betriebsmodus Ethernet TCP/IP

POWERLINK V1

Status LED		Zustand, in dem sich die POWERLINK Station befindet
Grün	Rot	
Ein	Aus	Die POWERLINK Station läuft fehlerfrei.
Aus	Ein	Ein fataler Systemfehler ist aufgetreten. Die Art des Fehlers kann über das SPS Logbuch ausgelesen werden. Es handelt sich um ein nicht reparables Problem. Das System kann seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen. Dieser Zustand kann nur durch einen Reset des Moduls verlassen werden.
Abwechselnd blinkend		Der POWERLINK Managing Node ist ausgefallen. Dieser Fehlercode kann nur im Betrieb als Controlled Node auftreten.
Aus	Blinkend	System Stopp. Die rot blinkende LED zeigt durch den Blinkcode einen bestimmten Fehler an (siehe Abschnitt "System Stopp Fehlercodes" auf Seite 48).

Tabelle 37: Status/Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V1

POWERLINK V2

Farbe Rot - Error	Beschreibung
Ein	Die POWERLINK Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlagert: - BASIC_ETHERNET - PRE_OPERATIONAL_1 - PRE_OPERATIONAL_2 - READY_TO_OPERATE

Tabelle 38: Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V2

Farbe Grün - Status	Beschreibung
Aus NOT_ACTIVE	Managing Node (MN) Der Bus wird auf POWERLINK Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entsprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand BASIC_ETHERNET über (flackernd). Controlled Node (CN) Der Bus wird auf POWERLINK Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entsprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
grün flackernd (ca. 10 Hz) BASIC_ETHERNET	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als reine Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrieben. Managing Node (MN) Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden. Controlled Node (CN) Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Single Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_1	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1. Managing Node (MN) Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Am Bus dürfen Kollisionen auftreten. Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt. Controlled Node (CN) Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash).
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2. Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert. Controlled Node (CN) In diesem Zustand wird die Schnittstelle üblicherweise vom Manager konfiguriert. Danach wird per Kommando in den Zustand PRE_OPERATIONAL_3 weitergeschaltet (Tripple Flash).
Tripple Flash (ca. 1 Hz) READY_TO_OPERATE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE. Managing Node (MN) Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO Daten werden ignoriert. Controlled Node (CN) Die Konfiguration der Schnittstelle ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die gesendeten PDO Daten entsprechen dem PDO Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet.
Ein OPERATIONAL	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL.
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED. Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich. Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Zustand kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom Manager erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 39: Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK

System Stopp Fehlercodes

Ein System Stopp Fehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Legende:

- ... 150 ms
- ... 600 ms
- Pause ... 2 s Pausenzeit

Fehlerbeschreibung	Fehlercode durch rote Status LED									
RAM Fehler	•	•	•	–	Pause	•	•	•	–	Pause
Hardwarefehler	–	•	•	–	Pause	–	•	•	–	Pause

Tabelle 40: Status/Error LED als Error LED - System Stopp Fehlercodes

3.4.4.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Online Hilfe "Projekt Management - Automation Studio Upgrade").

3.4.5 5PP5IF.FCAN-00

3.4.5.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.FCAN-00 verfügt über eine CAN Master Schnittstelle und 512 kByte SRAM.

- 1x CAN Master Schnittstelle
- 512 kByte SRAM
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann nur unter Automation Runtime betrieben werden.

3.4.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.FCAN-00	CAN Interface Karte - 1 CAN Master	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1208.3100	Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationschutz durch Schraubflansch.	

Tabelle 41: 5PP5IF.FCAN-00 - Bestelldaten

3.4.5.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.FCAN-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4DA
Diagnose	
Modulstatus	Ja, per Status LED
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Abschlusswiderstand	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja
Controller	
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe) ¹⁾
Schnittstellen	
CAN	
Anzahl	1
Ausführung	8-polige Steckerleiste
Übertragungsrate	max. 500 kBit/s
Abschlusswiderstand	
Typ	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung	deaktiviert
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	3 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 42: 5PP5IF.FCAN-00 - Technische Daten

1) bei optimierten Zugriff mittels Write Combining.

3.4.5.3.1 CAN Schnittstelle

CAN Bus	
Die potenzialgetrennte CAN Bus Schnittstelle ist als 8-polige Steckerleiste ausgeführt.	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 500 kBit/s
Kabellänge	max. 1000 Meter
Pin	CAN Bus
1	-
2	-
3	-
4	CAN _⊥ (CAN Ground)
5	SHLD (Shield - Schirm)
6	SHLD (Shield - Schirm)
7	CAN _L (CAN Low)
8	CAN _H (CAN High)

8-polige Steckerleiste

Tabelle 43: 5PP5IF.FCAN-00 - CAN Schnittstelle

3.4.5.3.2 Status LEDs

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
CAN	Gelb	Ein	Daten senden
		Aus	Daten empfangen
Status LED	Grün	Ein	Schnittstellenmodul ist aktiv
	Rot	Ein	CPU läuft hoch
LED TERM	Gelb	Ein	Der Abschlusswiderstand ist zugeschaltet
		Aus	Der Abschlusswiderstand ist abgeschaltet

Tabelle 44: 5PP5IF.FCAN-00 - Status LEDs

3.4.5.3.3 CAN Terminierungsschalter

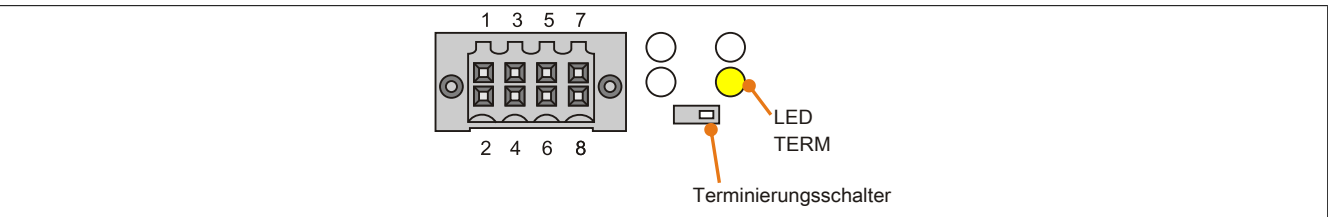


Abbildung 9: CAN Terminierungsschalter

Am Interface Board ist ein CAN Abschlusswiderstand integriert. Mit einem Schalter an der Frontseite wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet. Ein aktivierter Abschlusswiderstand wird durch die LED TERM angezeigt.

3.4.5.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht. Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Online Hilfe "Projekt Management - Automation Studio Upgrade").

3.4.6 5PP5IF.FX2X-00

3.4.6.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.FX2X-00 verfügt über eine X2X Link Master Schnittstelle und 512 kByte SRAM.

- 1x X2X Link Master Schnittstelle
- 512 kByte SRAM
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann nur unter Automation Runtime betrieben werden.

3.4.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.FX2X-00	X2X Link Interface Karte - 1 X2X Link Master - SRAM 512 kByte	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1208.3100	Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationschutz durch Schraubflansch.	

Tabelle 45: 5PP5IF.FX2X-00 - Bestelldaten

3.4.6.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.FX2X-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$B4D9
Diagnose	
Modulstatus	Ja, per Status LED
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja
Controller	
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe) ¹⁾
Schnittstellen	
X2X	
Typ	X2X Link Master
Anzahl	1
Ausführung	8-polige Steckerleiste
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	3 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 46: 5PP5IF.FX2X-00 - Technische Daten

1) bei optimierten Zugriff mittels Write Combining.

3.4.6.3.1 X2X Schnittstelle

X2X Link Master Anschluss	
Die potenzialgetrennte X2X Link Schnittstelle ist als 8-polige Steckerleiste ausgeführt.	
Pin	X2X Link
1	X2X\
2	X2X
3	X2X⊥
4	-
5	SHLD (Shield - Schirm)
6	SHLD (Shield - Schirm)
7	-
8	-

8-polige Steckerleiste

Tabelle 47: 5PP5IF.FX2X-00 - X2X Schnittstelle

3.4.6.3.2 Status LEDs

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
X2X	Gelb	Ein	Daten senden
		Aus	Daten empfangen
Status LED	Grün	Ein	Schnittstellenmodul ist aktiv
	Rot	Ein	CPU läuft hoch

Tabelle 48: 5PP5IF.FX2X-00 - Status LEDs

3.4.6.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Online Hilfe "Projekt Management - Automation Studio Upgrade").

3.4.7 5PP5IF.FXCM-00

3.4.7.1 Allgemeines

Das Interface Board 5PP5IF.FXCM-00 verfügt über eine kombinierte CAN Master und eine X2X Link Master Schnittstelle sowie 512 kByte SRAM.

- 1x CAN Master Schnittstelle
- 1x X2X Master Schnittstelle
- 512 kByte SRAM
- einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511

Das Interface Board kann nur unter Automation Runtime betrieben werden.

3.4.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Boards	
5PP5IF.FXCM-00	CAN Interface Karte - 1 CAN Master - 1 X2X Master - 512 kByte SRAM - einbaukompatibel in PP500, APC510, APC511	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1208.3100	Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm², Vibrationschutz durch Schraubflansch.	

Tabelle 49: 5PP5IF.FXCM-00 - Bestelldaten

3.4.7.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IF.FXCM-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$BB9D
Diagnose	
Modulstatus	Ja, per Status LED
Datenübertragung	Ja, per Status LED
Abschlusswiderstand	Ja, per Status LED
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
GL	Ja
Controller	
SRAM	
Größe	512 kByte
batteriegepuffert	Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode	256 kByte (z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe) ¹⁾
Schnittstellen	
CAN	
Anzahl	1
Ausführung	8-polige Steckerleiste
Übertragungsrate	max. 500 kBit/s
Abschlusswiderstand	
Typ	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung	deaktiviert
X2X	
Typ	X2X Link Master
Anzahl	1
Ausführung	8-polige Steckerleiste
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	3 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 50: 5PP5IF.FXCM-00 - Technische Daten

1) bei optimierten Zugriff mittels Write Combining.

3.4.7.3.1 CAN Schnittstelle

CAN Bus	
Die potenzialgetrennte CAN Bus Schnittstelle ist als 8-polige Steckerleiste ausgeführt.	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 500 kBit/s
Kabellänge	max. 1000 Meter
Pin	CAN Bus
1	-
2	-
3	-
4	CAN _⊥ (CAN Ground)
5	SHLD (Shield - Schirm)
6	SHLD (Shield - Schirm)
7	CAN _L (CAN Low)
8	CAN _H (CAN High)

8-polige Steckerleiste

Tabelle 51: 5PP5IF.FCAN-00 - CAN Schnittstelle

3.4.7.3.2 X2X Schnittstelle

X2X Link Master Anschluss	
Die potenzialgetrennte X2X Link Schnittstelle ist als 8-polige Steckerleiste ausgeführt.	
Pin	X2X Link
1	X2X\
2	X2X
3	X2X _⊥
4	-
5	SHLD (Shield - Schirm)
6	SHLD (Shield - Schirm)
7	-
8	-

8-polige Steckerleiste

Tabelle 52: 5PP5IF.FX2X-00 - X2X Schnittstelle

3.4.7.3.3 Status LEDs

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
X2X	Gelb	Ein	Daten senden
		Aus	Daten empfangen
CAN	Gelb	Ein	Daten senden
		Aus	Daten empfangen
Status LED	Grün	Ein	Schnittstellenmodul ist aktiv
	Rot	Ein	CPU läuft hoch
LED TERM	Gelb	Ein	Der Abschlusswiderstand ist zugeschaltet
		Aus	Der Abschlusswiderstand ist abgeschaltet

Tabelle 53: 5PP5IF.FXCM-00 - Status LEDs

3.4.7.3.4 CAN Terminierungsschalter

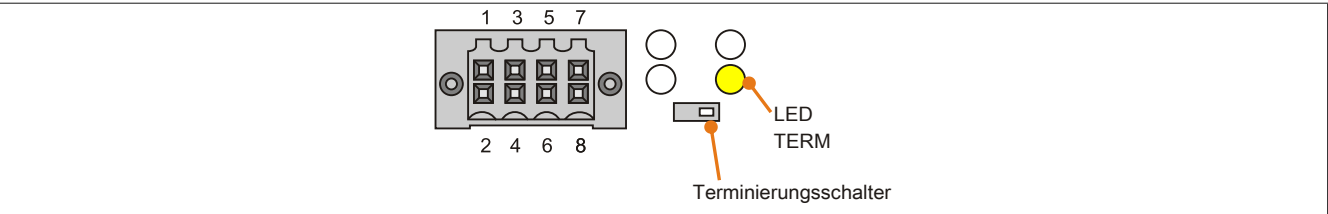


Abbildung 10: CAN Terminierungsschalter

Am Interface Board ist ein CAN Abschlusswiderstand integriert. Mit einem Schalter an der Frontseite wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet. Ein aktivierter Abschlusswiderstand wird durch die LED TERM angezeigt.

3.4.7.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht. Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Online Hilfe "Projekt Management - Automation Studio Upgrade").

3.5 I/O Boards

Information:

I/O Boards können NUR im Werk B&R eingebaut und getauscht werden.

3.5.1 5PP5IO.GMAC-00

3.5.1.1 Allgemeines

Das APC510 I/O Board 5PP5IO.GMAC-00 verfügt über 1x RS232/422/485 Schnittstelle, 2x USB 2.0 Anschluss, 1x HDA Sound Anschluss sowie 1x Smart Display Link/DVI Buchse. Optional kann eine Hard Disk oder Solid State Disk verbaut werden. Das I/O Board kann mit Automation PC 510 Geräten betrieben werden.

- 2x USB 2.0
- 1x RS232/422/485
- 1x HDA Sound
- 1x Smart Display Link/DVI
- optionale SATA Schnittstelle für HDD (Hard Disk Drive) oder SSD (Solid State Drive)
- einbaufähig in APC510

3.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	I/O Board	
5PP5IO.GMAC-00	Interface Board - 2 USB2.0 - 1 RS232/422/485 - 1 HDA Sound - 1 SDL/DVI-D - Für APC 510	
	Optionales Zubehör	
	Laufwerke	
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 54: 5PP5IO.GMAC-00 - Bestelldaten

3.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IO.GMAC-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$CB0B
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Schnittstellen	
COM2 ¹⁾	
Typ	RS232/422/485, galvanisch getrennt
Ausführung	9-poliger DSUB Stecker
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
USB	
Anzahl	2
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Panel / Monitor Schnittstelle	
Ausführung	DVI-I Buchse
Typ	SDL/DVI

Tabelle 55: 5PP5IO.GMAC-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5PP5IO.GMAC-00
Audio Typ Eingänge Ausgänge	HDA Sound Mikrofon, Line In Line Out
Optionale SATA	PATA to SATA Bridge (SATA I)
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	12 W
Umgebungsbedingungen	
Temperatur Betrieb Lagerung Transport	0 bis 50°C -20 bis 60°C -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	5 bis 90%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend

Tabelle 55: 5PP5IO.GMAC-00 - Technische Daten

1) Die COM2 Schnittstelle ist im BIOS als COMD Schnittstelle gekennzeichnet.

3.5.1.3.1 Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI

Panel Anschluss - SDL (Smart Display Link) / DVI		
Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosignale beim Panel Ausgang. Details siehe Technische Daten des verwendeten CPU Boards.		
CPU Board	Videosignale mit allen Systemeinheitenvarianten	
5PP5CP.US15-00	DVI, SDL	
5PP5CP.US15-01	DVI, SDL	
5PP5CP.US15-02	DVI, SDL	

Tabelle 56: Panel Anschluss - DVI, SDL

Information:

An den Panel Anschluss können nur digitale Panels, keine analogen Monitore, angeschlossen werden.

Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	n.c.	not connected
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	n.c.	not connected
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	n.c.	not connected
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	n.c.	not connected
14	+5 V Power ¹⁾	+5V Power Supply	C5	n.c.	not connected
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground			

DVI 24-polig, female

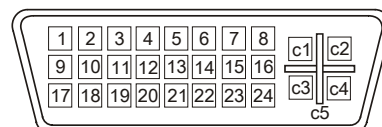


Tabelle 57: Pinbelegung DVI Anschluss

1) Wird intern durch eine Multifuse abgesichert.

Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 58: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI Kabels:

DVI Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00	5CADVI.0018-00
5	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0050-00

Tabelle 59: Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung

Die maximale Kabellänge bei der DVI Übertragung ist aufgrund der USB Spezifikation auf 5 m begrenzt.

3.5.1.3.2 Serielle Schnittstelle COM2

Serielle Schnittstelle COM2		
	RS232	RS422/485
Typ	RS232 nicht modemfähig; galvanisch getrennt	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 115 kBit/s	
Buslänge	max. 15 m	max. 1200 m
Pin	Belegung RS232	Belegung RS422
1	n.c.	TXD\
2	RXD	n.c.
3	TXD	n.c.
4	n.c.	TXD
5	GND	GND
6	n.c.	RXD\
7	RTS	n.c.
8	CTS	n.c.
9	n.c.	RXD

9-polige DSUB Buchse

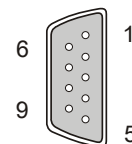


Tabelle 60: Pinbelegung COM2

3.5.1.3.3 I/O Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Weitere Einstellmöglichkeiten
I/O Adresse	2E8h	238h, 2F8h, 328h, 338h, 3E8h, 3F8h ¹⁾
IRQ	10	3, 4, 5, 6, 11, 12 ¹⁾

Tabelle 61: RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ

1) Falls diese Einstellungen im System nicht bereits verwendet werden.

3.5.1.3.4 Buslänge und Kabeltyp RS232

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 15 m	typ. 64 kBit/s
≤ 10 m	typ. 115 kBit/s
≤ 5 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 62: RS232 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS232 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,16 mm ² (26AWG), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 63: RS232 Kabel Anforderungen

3.5.1.3.5 Buslänge und Kabeltyp RS422

Die RTS- Leitung muss eingeschaltet werden um den Sender aktiv zu schalten.

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
1200 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 64: RS422 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS422 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 65: RS422 Kabel Anforderungen

3.5.1.3.6 Buslänge und Kabeltyp RS485

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
1200 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 66: RS485 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterquerschnitt	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 67: RS485 Kabel Anforderungen

3.5.1.3.7 Betrieb als RS485-Schnittstelle

Für den Betrieb sind die Pins der RS422 Defaultschnittstelle (1, 4, 6 und 9) zu verwenden. Dazu sind die Pins wie abgebildet zu verbinden.

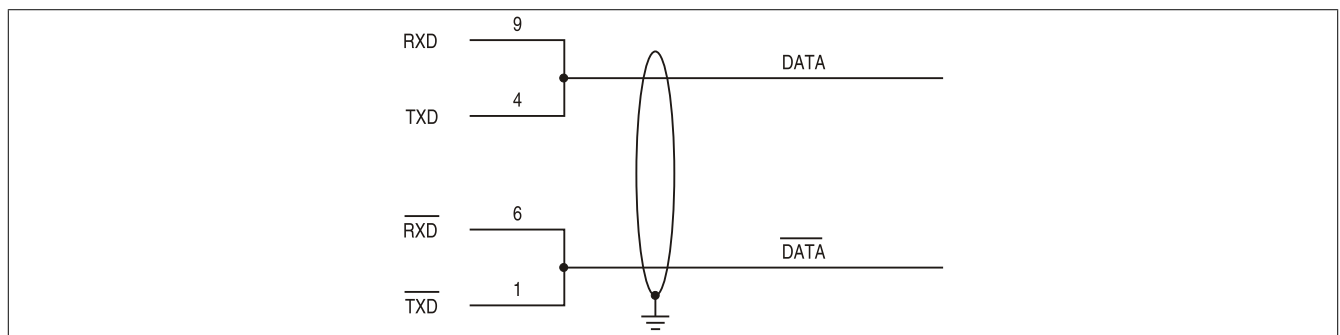


Abbildung 11: RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus

Das Schalten der RTS Leitung muss für jedes Senden wie auch Empfangen vom Treiber durchgeführt werden, es gibt keine automatische Rückschaltung. Dies kann nicht in Windows konfiguriert werden.

Bei großen Leitungslängen kann es durch den Spannungsabfall zu größeren Potentialdifferenzen zwischen den Busteilnehmern kommen, die die Kommunikation behindern. Dies kann durch mitführen der Masseleitung verbessert werden.

3.5.1.3.8 Buslänge und Kabeltyp RS485

Die maximale Übertragungsrate von 115 kBit/s ist von der Kabellänge und vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

Ausdehnung	Übertragungsrate
1200 m	typ. 115 kBit/s

Tabelle 68: RS485 Buslänge und Übertragungsrate

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

RS485 Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt	4x 0,25 mm ² (24AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0,34 mm ² (22AWG/19), verzinnnte Cu-Litze
Aderisolation	PE
Leiterquerschnitt	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PUR Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnnten Cu-Drähten

Tabelle 69: RS485 Kabel Anforderungen

3.5.1.3.9 Abschlusswiderstand

Am I/O Board ist bereits ein Abschlusswiderstand RS485 TERM für die Serielle Schnittstelle COM2 integriert. Mit einem Schalter zwischen Serieller Schnittstelle COM2 und Serieller Schnittstelle COM1 wird der Abschlusswiderstand zu- oder abgeschaltet. Ein aktivierter Abschlusswiderstand wird durch eine gelb leuchtende LED RS485 TERM angezeigt.

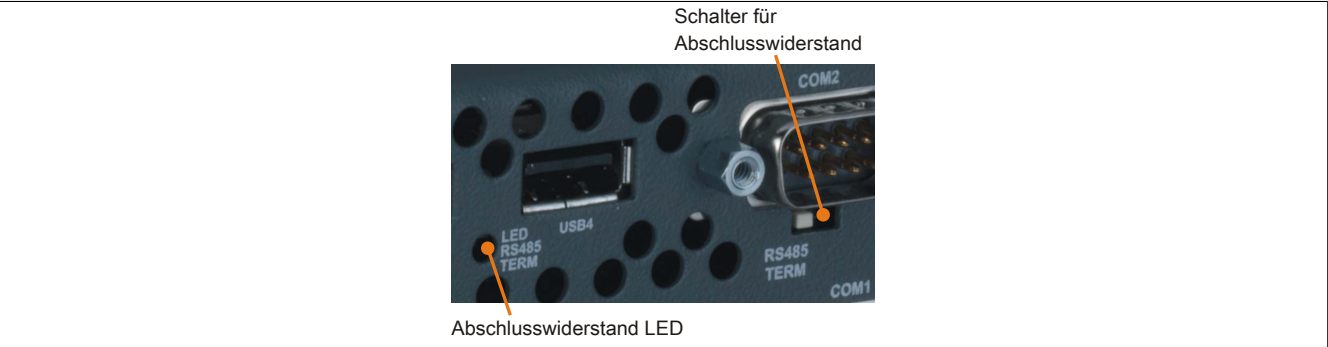


Abbildung 12: Serielle Schnittstelle COM Abschlusswiderstand

3.5.1.3.10 USB Schnittstellen (USB3, 4)

Das APC510 I/O Board verfügt über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 2 USB Schnittstellen nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC- Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB3, 4

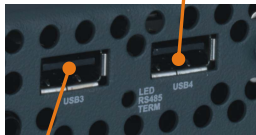
Universal Serial Bus (USB3, USB4) ¹⁾		
Typ	USB 2.0	2x USB Typ A, female 

Tabelle 70: USB3, USB4 Anschluss

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Jeder USB Port wird durch einen wartungsfreien „USB Strombegrenzungsschalter“ (max. 1 A) abgesichert.

3.5.1.3.11 MIC, Line IN, Line OUT

MIC, Line IN, Line OUT		
Controller	Realtek ALC 662	3,5 mm Klinkenanschluss, female 

Tabelle 71: MIC, Line IN, Line OUT

Für den Betrieb des Audio Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.5.1.3.12 Optionaler SATA Anschluss

Der optionale SATA Anschluss ist intern über eine PATA to SATA Bridge mit dem Chipset verbunden.

Optionaler SATA Anschluss	
Anschluss	SATA
Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Optionales Zubehör
	Laufwerke
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5MMHDD.0500-00	500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.

Tabelle 72: Optionaler SATA Anschluss

3.6 Laufwerke

3.6.1 5MMHDD.0250-00

3.6.1.1 Allgemeines

Diese 250 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- 250 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-03 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-05
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Information:

Ein Laufwerkseinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung Laufwerke	Abbildung
5MMHDD.0250-00	250 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-03 und 5ACPCI.RAIC-05; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 73: 5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten

3.6.1.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	250 GByte
Anzahl der Köpfe	1
Anzahl der Sektoren	488.397.168
Bytes pro Sektor	512
Cache	8 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 0,2\%$
Hochlaufzeit	typ. 3,6 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)
MTBF	550.000 POH ¹⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,56 ms

Tabelle 74: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0250-00
unterstützte Transfermodi	SATA 1.0, Serial ATA Revision 2.6 PIO Modus 0-4, Multiword DMA Modus 0-2, UDMA Modus 0-6
Datentransferate intern zum / vom Host	max. 1175 MBit/s max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit minimal (Spur zu Spur) nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	1 ms 14 ms 30 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ²⁾ Betrieb ³⁾ Betrieb - 24 Stunden ⁴⁾ Lagerung Transport	0 bis 60°C 0 bis 60°C -40 bis 70°C -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ⁵⁾ Betrieb Lagerung Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration Betrieb Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock Betrieb Lagerung Transport	350 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 800 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 1 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 600 g und 0,5 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe Betrieb Lagerung	-300 bis 3048 m -300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	9,5 mm 69 mm 100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Seagate
Herstellerbezeichnung	ST9250315AS

Tabelle 74: 5MMHDD.0250-00 - Technische Daten

- 1) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 2) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 3) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 4) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 30% pro Stunde.

3.6.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

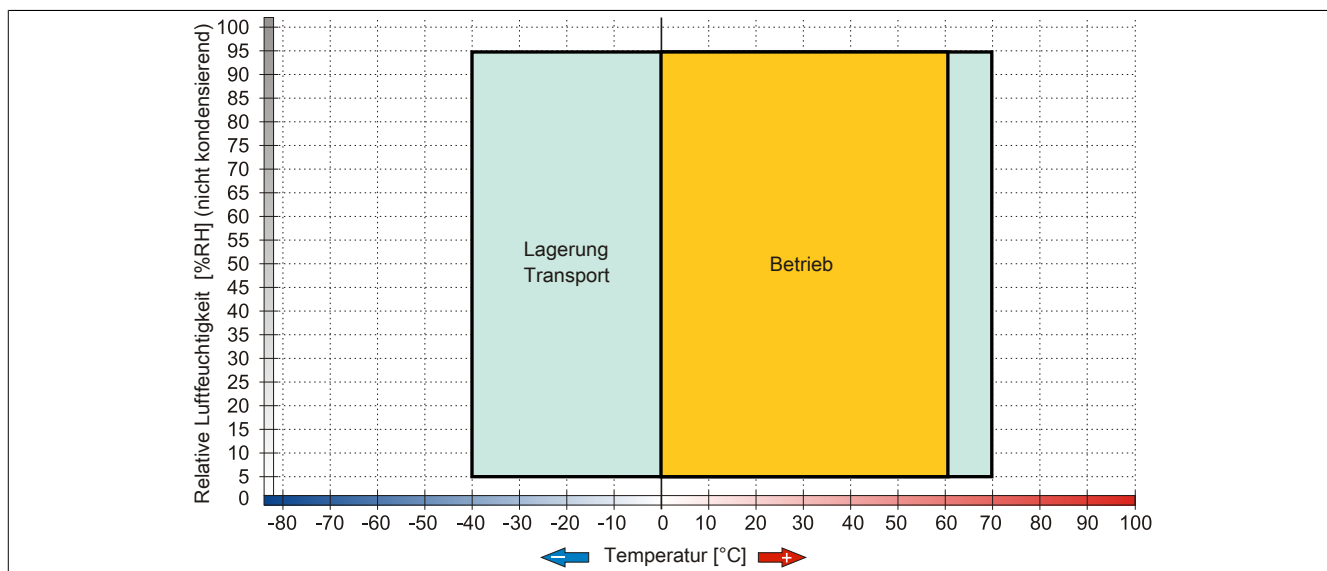


Abbildung 13: 5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.2 5MMHDD.0500-00

3.6.2.1 Allgemeines

Diese 500 GByte Hard Disk kann als Ersatzteil oder als Zubehörteil verwendet werden.

- 500 GByte Hard Disk
- Ersatz Hard Disk für die Hard Disk 5AC801.HDDI-04 bzw. 5AC901.CHDD-01 oder für den RAID Controller 5ACPCI.RAIC-06
- Zubehör für APC510 (optionale Hard Disk für I/O-Board)
- für 24 Stunden Betrieb spezifiziert
- S.M.A.R.T. Support

Information:

Ein Laufwerkseinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5MMHDD.0500-00	Laufwerke 500 GByte SATA Hard Disk Ersatzteil für 5AC801.HDDI-04, 5AC901.CHDD-01 und 5ACPCI.RAIC-06; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.	

Tabelle 75: 5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten

3.6.2.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Hard Disk	
Kapazität	500 GByte
Anzahl der Köpfe	2
Anzahl der Sektoren	976.773.168
Bytes pro Sektor	512 (logical) / 4096 (physical)
Cache	16 MByte
Drehzahl	5400 rpm $\pm 0,2\%$
Hochlaufzeit	typ. 3,5 s (von 0 rpm auf Lesezugriff)

Tabelle 76: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMHDD.0500-00
Lebensdauer	5 Jahre
MTBF	1.000.000 POH ²⁾
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Zugriffszeit	5,5 ms
unterstützte Transfermodi	SATA II
Datentransferrate intern zum / vom Host	max. 147 MByte/s max. 150 MByte/s (SATA I), max. 300 MByte/s (SATA II)
Positionierzeit nominal (Lesezugriff) maximal (Lesezugriff)	11 ms 21 ms
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ³⁾ Betrieb ⁴⁾ Betrieb - 24 Stunden ⁵⁾ Lagerung Transport	0 bis 60°C 0 bis 60°C -40 bis 70°C -40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit ⁶⁾ Betrieb Lagerung Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend 5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration Betrieb (dauerhaft) Betrieb (gelegentlich) Lagerung Transport	5 bis 500 Hz: 0,25 g; keine nicht behebbaren Fehler 5 bis 500 Hz: 0,5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler 10 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
Schock Betrieb Lagerung Transport	400 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler 1000 g und 2 ms Dauer; keine nicht behebbaren Fehler
Meereshöhe Betrieb Lagerung	-305 bis 3048 m -305 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen Breite Höhe Tiefe	7 mm 69 mm 100 mm
Gewicht	100 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Western Digital
Herstellerbezeichnung	WD5000LUCT

Tabelle 76: 5MMHDD.0500-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) Bei 8760 POH (Power On Hours) pro Jahr und 25°C Oberflächentemperatur.
- 3) Temperaturangaben bei 305 Meter Meereshöhe. Die Temperaturspezifikation muss linear alle 305 Meter um 1°C verringert werden. Die Temperatur Zu- und Abnahme darf pro Stunde maximal 20°C betragen.
- 4) Standardbetrieb bedeutet 333 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 5) 24 Stundenbetrieb bedeutet 732 POH (Power On Hours) pro Monat.
- 6) Luftfeuchtigkeitsgradient: Maximal 20% pro Stunde.

3.6.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

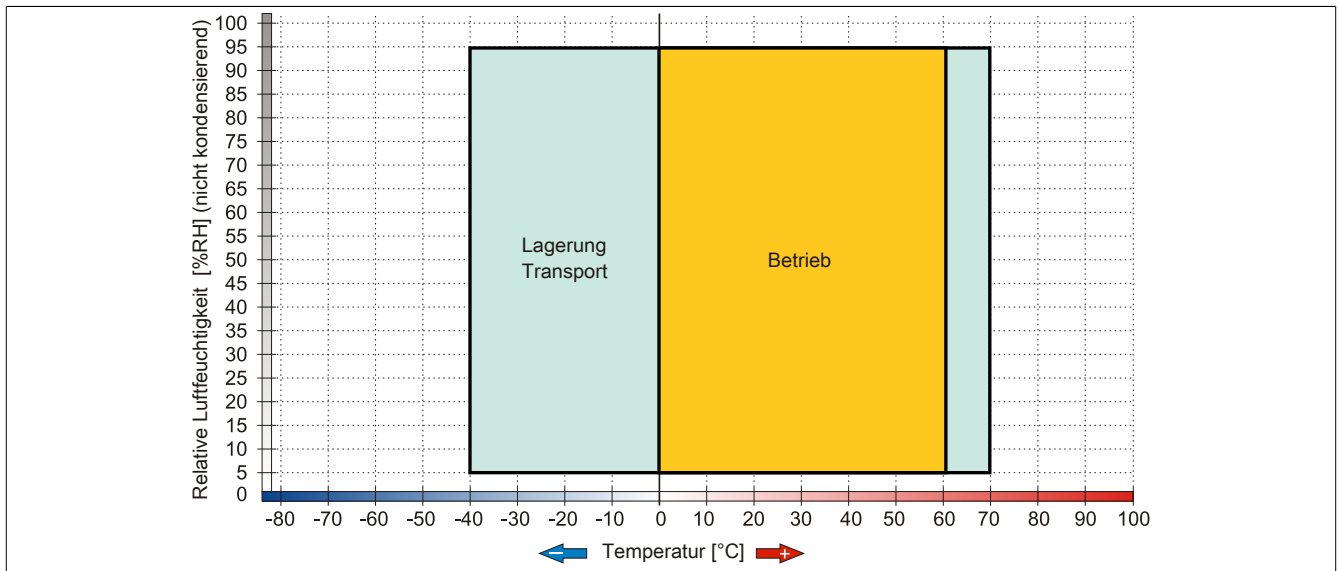


Abbildung 14: 5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.3 5MMSSD.0060-00

3.6.3.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-01 bzw. 5AC901.CSSD-01
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Information:

Ein Laufwerkseinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-00	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-01 und 5AC901.CSSD-01; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 77: 5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten

3.6.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 475 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 245 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	15.000
4k schreiben	
typisch	23.000
maximal	80.000

Tabelle 78: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-00
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW060A3

Tabelle 78: 5MMSSD.0060-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.6.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

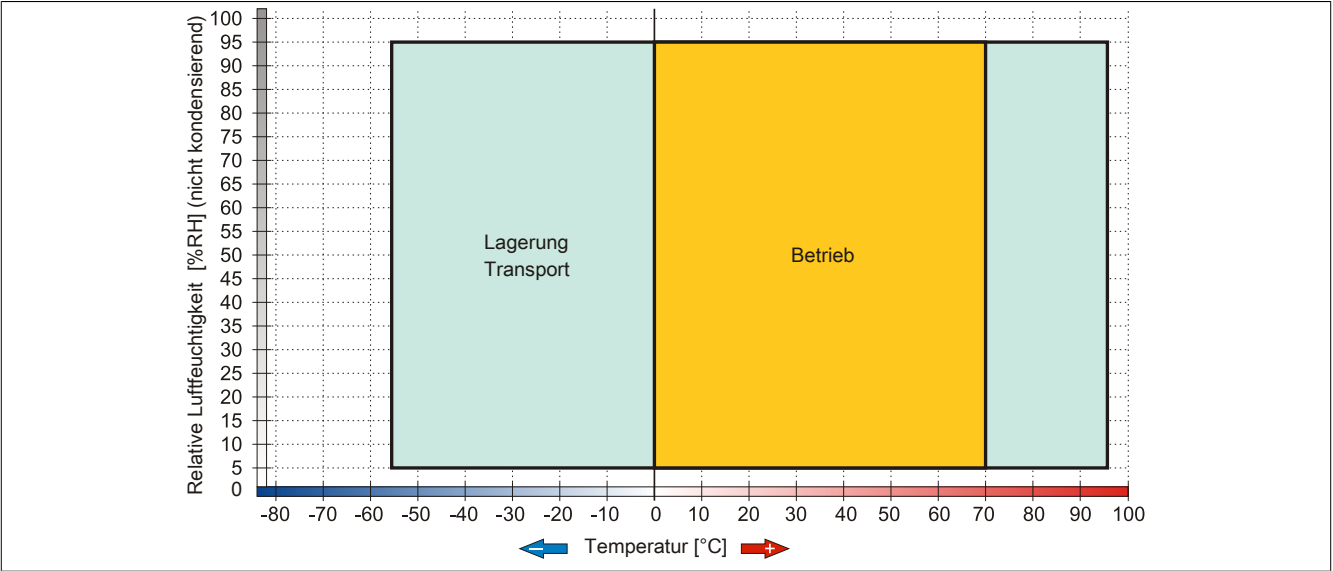


Abbildung 15: 5MMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.4 5MMSSD.0060-01

3.6.4.1 Allgemeines

Dieses 60 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-03 bzw. 5AC901.CSSD-03
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Information:

Ein Laufwerkseinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0060-01	60 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-03 und 5AC901.CSSD-03; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 79: 5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten

3.6.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	60 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 430 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 55.000 (random)
4k schreiben	max. 25.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	35 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando

Tabelle 80: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0060-01
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-40 bis 95°C
Transport	-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Toshiba
Herstellerbezeichnung	THNSNH060GBST

Tabelle 80: 5MMSSD.0060-01 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written

3.6.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

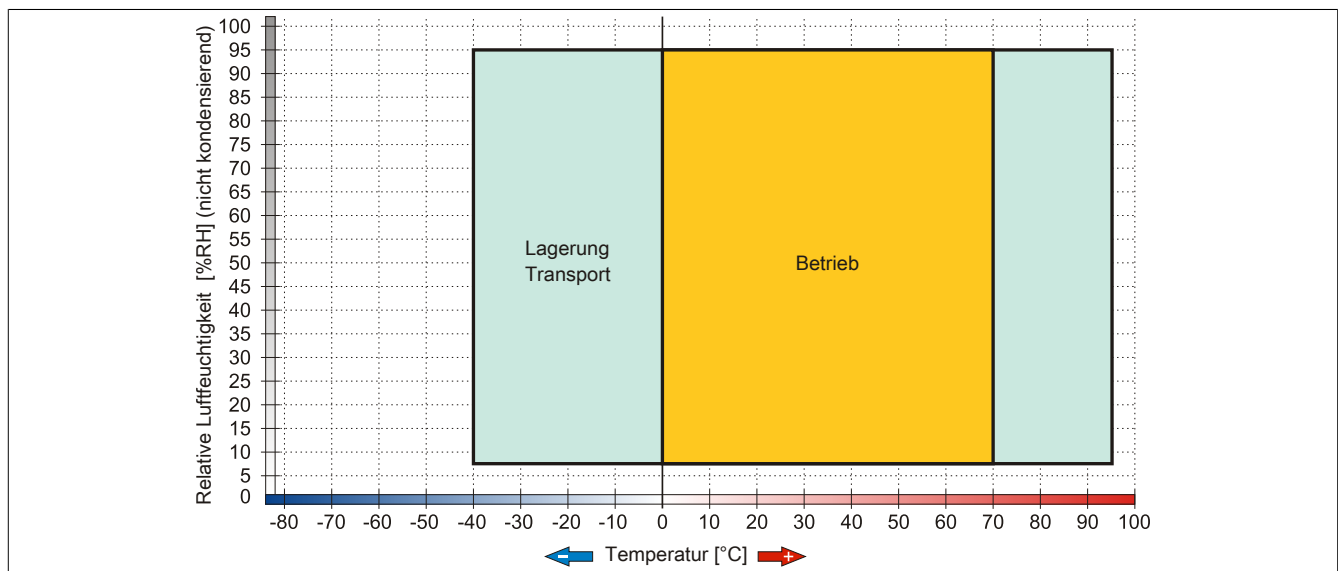


Abbildung 16: 5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.5 5MMSSD.0128-01

3.6.5.1 Allgemeines

Dieses 128 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-04 bzw. 5AC901.CSSD-04
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Information:

Ein Laufwerkeinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0128-01	128 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-04 und 5AC901.CSSD-04; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 81: 5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten

3.6.5.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0128-01	
Revision	C0	D0
Allgemeines		
Zertifizierungen		
CE		Ja
cULus		Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2		Ja ¹⁾
GOST-R		Ja
Solid State Drive		
Kapazität		128 GByte
Datenverlässlichkeit		< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF		1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support		Ja
Schnittstelle		SATA
Wartung		keine
kontinuierliches Lesen		max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben		max. 450 MByte/s
IOPS ²⁾		
4k lesen		max. 85.000 (random)
4k schreiben		max. 35.000 (random)
Endurance		
garantierte Datenmenge garantiert		74 TBW ³⁾

Tabelle 82: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5MMSSD.0128-01	
MLC-Flash	Ja		
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	0 bis 70°C		-30 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 95°C	
Transport		-40 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Lagerung	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend		
Vibration			
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g		
Schock			
Betrieb	1500 g, 0,5 ms		
Lagerung	1500 g, 0,5 ms		
Transport	1500 g, 0,5 ms		
Meereshöhe			
Betrieb	-300 bis 12.192 m		
Lagerung	-300 bis 12.192 m		
Transport	-300 bis 12.192 m		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Breite	9,5 mm		7 mm
Höhe		69 mm	
Tiefe		100 mm	
Gewicht	78 g		
Herstellerinformation			
Hersteller	Toshiba		
Herstellerbezeichnung	THNSNH128GBST		THNSNJ128WCST

Tabelle 82: 5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written

3.6.5.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

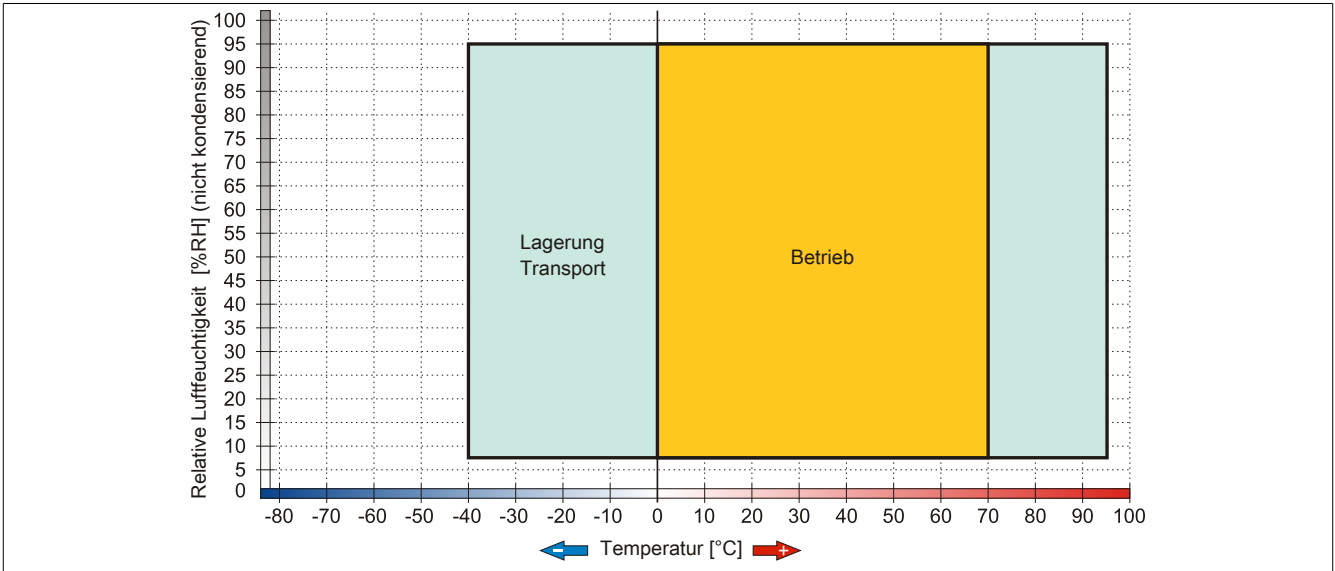


Abbildung 17: 5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≤ C0

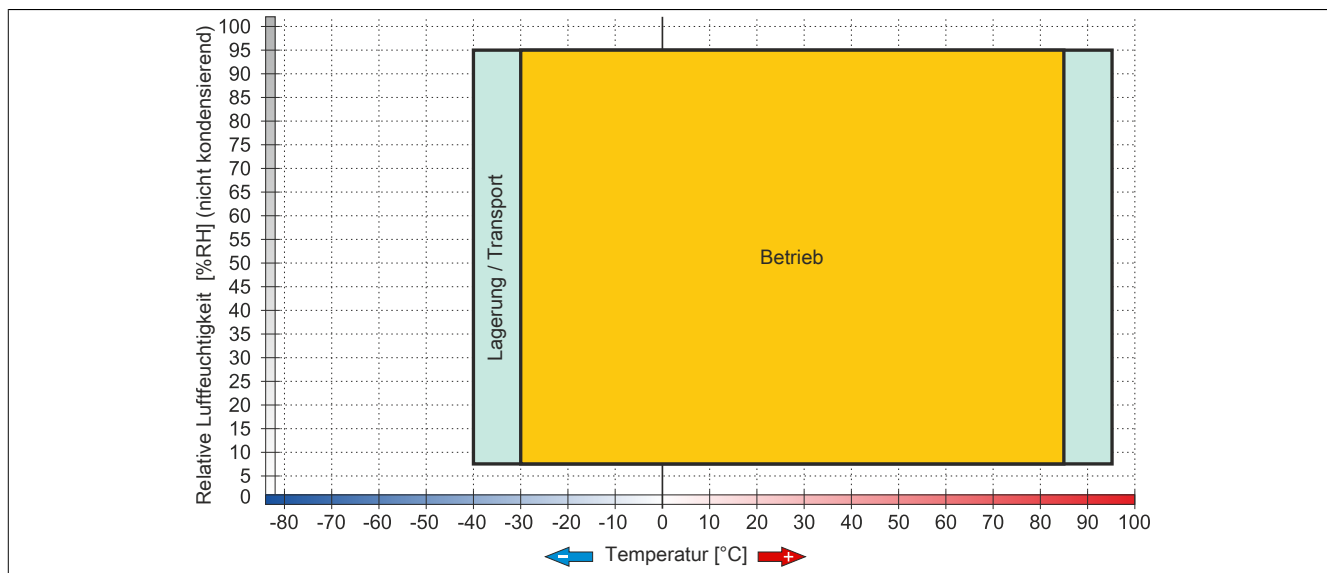


Abbildung 18: 5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≥ D0

3.6.6 5MMSSD.0180-00

3.6.6.1 Allgemeines

Dieses 180 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-02 bzw. 5AC901.CSSD-02
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Information:

Ein Laufwerkeinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0180-00	180 GByte SATA SSD (MLC); Ersatzteil für 5AC801.SSDI-02; und 5AC901.CSSD-02; SSD für 5PP5IO.GMAC-00; Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der SSD.	

Tabelle 83: 5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten

3.6.6.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
GOST-R	Ja
Solid State Drive	
Kapazität	180 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁶ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.200.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 550 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 280 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
kontinuierliches Schreiben	max. 520 MByte/s bei SATA 6 GBit/s max. 260 MByte/s bei SATA 3 GBit/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	50.000
4k schreiben	
typisch	60.000
maximal	80.000

Tabelle 84: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMSSD.0180-00
Endurance	
MLC-Flash	Ja
Kompatibilität	SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	0 bis 70°C
Lagerung	-55 bis 95°C
Transport	-55 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration	
Betrieb	5 bis 700 Hz: 2,17 g
Lagerung	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Transport	5 bis 800 Hz: 3,13 g
Schock	
Betrieb	1500 g, 0,5 ms
Lagerung	1500 g, 0,5 ms
Transport	1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	-300 bis 12.192 m
Lagerung	-300 bis 12.192 m
Transport	-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	9,5 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	78 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Intel
Herstellerbezeichnung	SSDSC2CW180A3

Tabelle 84: 5MMSSD.0180-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second

3.6.6.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

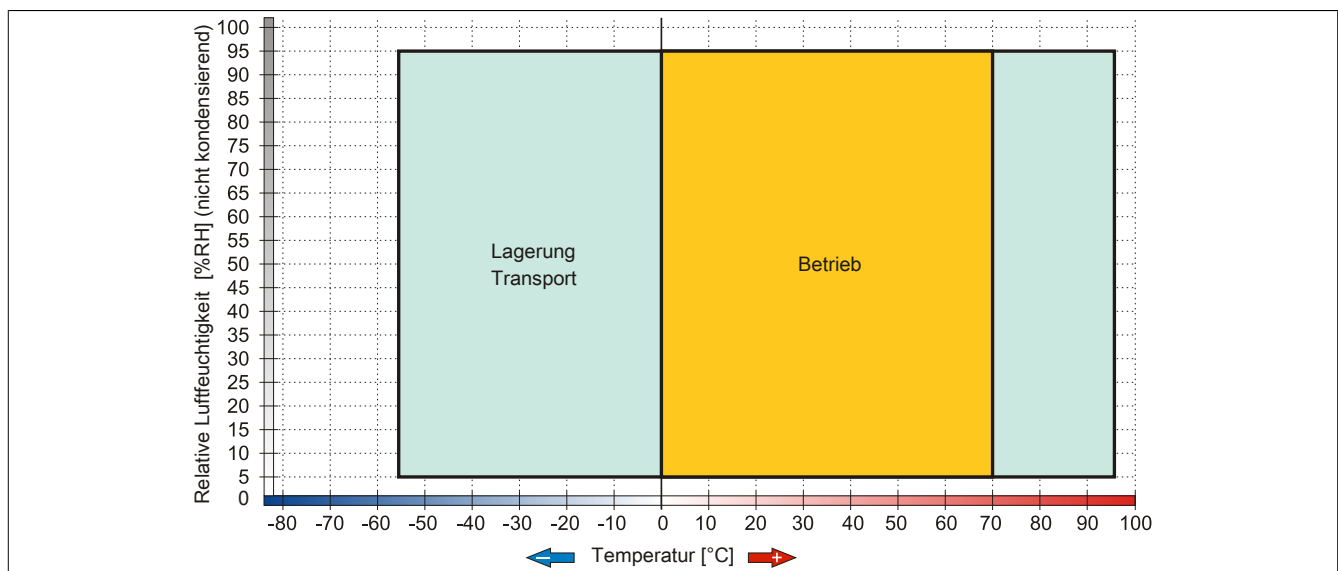


Abbildung 19: 5MMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

3.6.7 5MMSSD.0256-00

3.6.7.1 Allgemeines

Dieses 256 GByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil oder Zubehörteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.

- Ersatzlaufwerk für die SSD Laufwerke 5AC801.SSDI-05 bzw. 5AC901.CSSD-05
- Zubehör für APC510 (optionale SSD für I/O Board)

Information:

Ein Laufwerkseinbau bzw. Laufwerkstausch kann NUR im Werk B&R durchgeführt werden.

3.6.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Laufwerke	
5MMSSD.0256-00	256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Toshiba - SATA	

Tabelle 85: 5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten

3.6.7.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5MMSSD.0256-00
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾
Solid State Drive	
Kapazität	256 GByte
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁵ Bit Lesezugriffen
MTBF	1.500.000 Stunden
S.M.A.R.T. Support	Ja
Schnittstelle	SATA
Wartung	keine
kontinuierliches Lesen	max. 510 MByte/s
kontinuierliches Schreiben	max. 460 MByte/s
IOPS ²⁾	
4k lesen	max. 90.000 (random)
4k schreiben	max. 35.000 (random)
Endurance	
garantierte Datenmenge	
garantiert	148 TBW ³⁾
MLC-Flash	Ja

Tabelle 86: 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

Produktbezeichnung		5MMSSD.0256-00
Kompatibilität		SATA Revision 3.0 compliant ACS-2 SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) Kommando
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb		-30 bis 85°C
Lagerung		-40 bis 95°C
Transport		-40 bis 95°C
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb		8 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung		8 bis 95%, nicht kondensierend
Transport		8 bis 95%, nicht kondensierend
Vibration		
Betrieb		10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung		10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport		10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock		
Betrieb		1500 g, 0,5 ms
Lagerung		1500 g, 0,5 ms
Transport		1500 g, 0,5 ms
Meereshöhe		
Betrieb		-300 bis 12.192 m
Lagerung		-300 bis 12.192 m
Transport		-300 bis 12.192 m
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite		7 mm
Höhe		69 mm
Tiefe		100 mm
Gewicht		78 g
Herstellerinformation		
Hersteller		Toshiba
Herstellerbezeichnung		THNSNJ256WCST

Tabelle 86: 5MMSSD.0256-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) IOPS: Random Read and Write Input/Output Operations per Second
- 3) TBW: Terabyte written

3.6.7.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

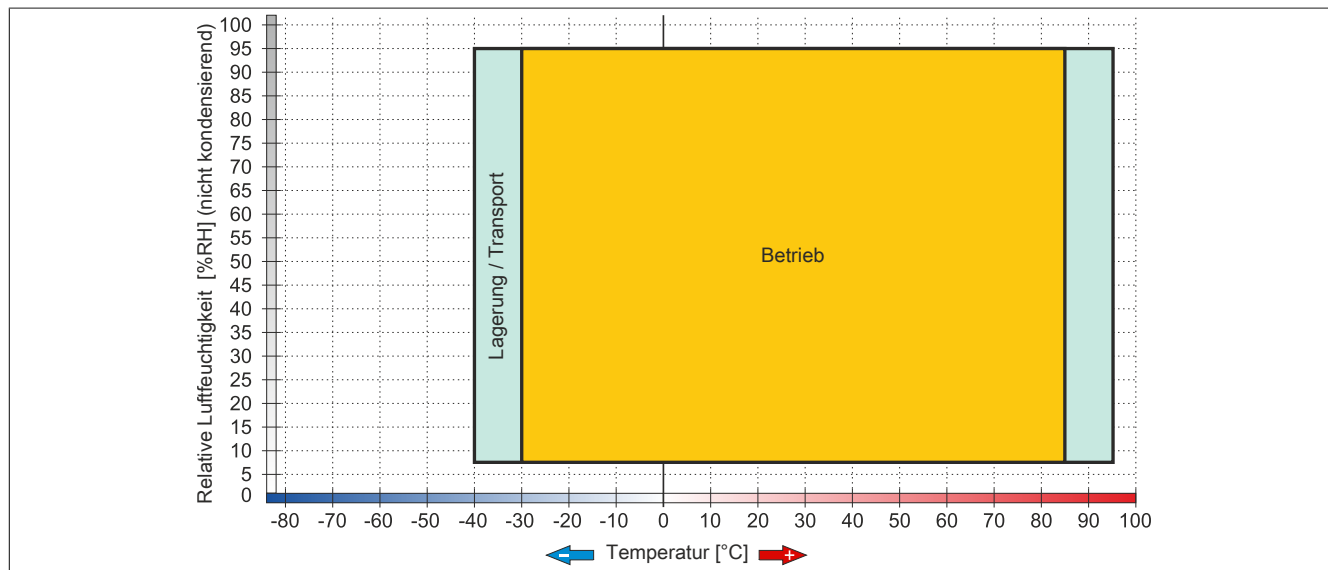


Abbildung 20: 5MMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Die Geräte werden mit den am Gehäuse befindlichen Befestigungslaschen montiert. Die Laschen sind für M5 Schrauben konzipiert.

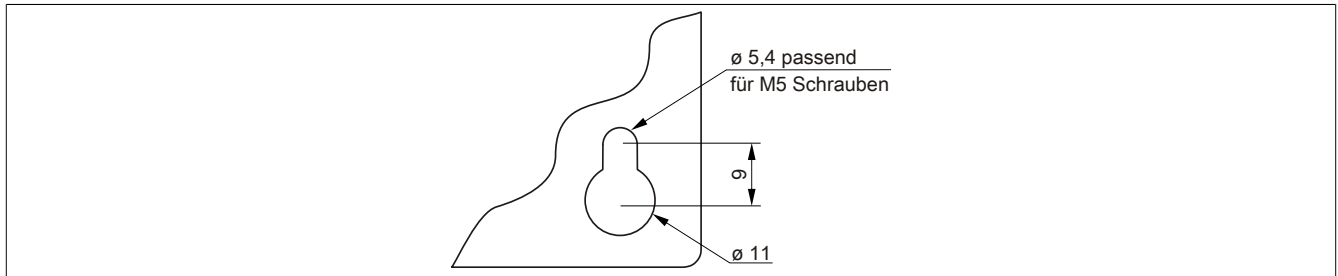


Abbildung 21: Befestigungslasche

Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen im 2 "Technische Daten", Abschnitt "Einzelkomponenten" auf Seite 31 entnommen werden.

1.1 Vorgehensweise

1. Den Schaltschrank mit den benötigten Bohrungen versehen. Die genaue Position für die Befestigungsbohrungen kann aus den Bohrschablonen entnommen werden.
2. Den B&R Industrie PC mit M5 Schrauben am Schaltschrank montieren.

1.2 Wichtige Informationen zur Montage

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Beim Einbau in ein geschlossenes Gehäuse, muss ausreichend Volumen zur Luftumwälzung vorhanden sein.
- Das Gerät muss auf planer Oberfläche montiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Die Lüftungslöcher dürfen nicht verdeckt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass die Wand oder das Schaltschrankblech das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.

1.3 Einbaulagen

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen die spezifizierten Einbaulagen der Automation PC 510 Geräte.

1.3.1 Einbaulage 0°

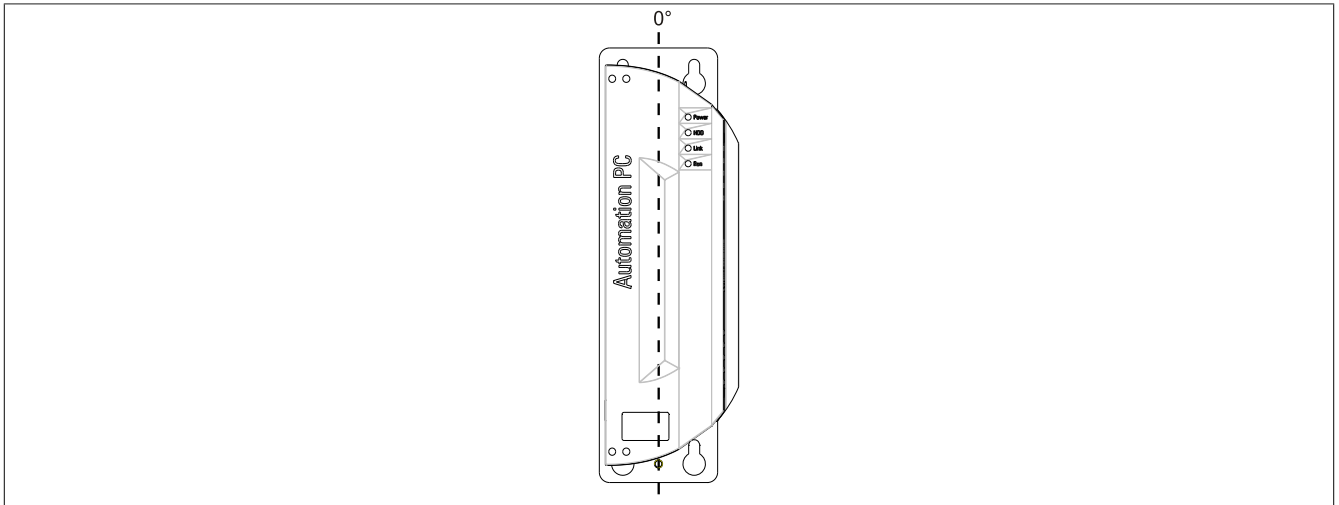


Abbildung 22: Einbaulage 0°

1.3.2 Einbaulage 90°

Die maximale Umgebungstemperaturspezifikation bei einer Einbaulage von 90° (horizontal) muss um **5°C herabgesetzt** werden.

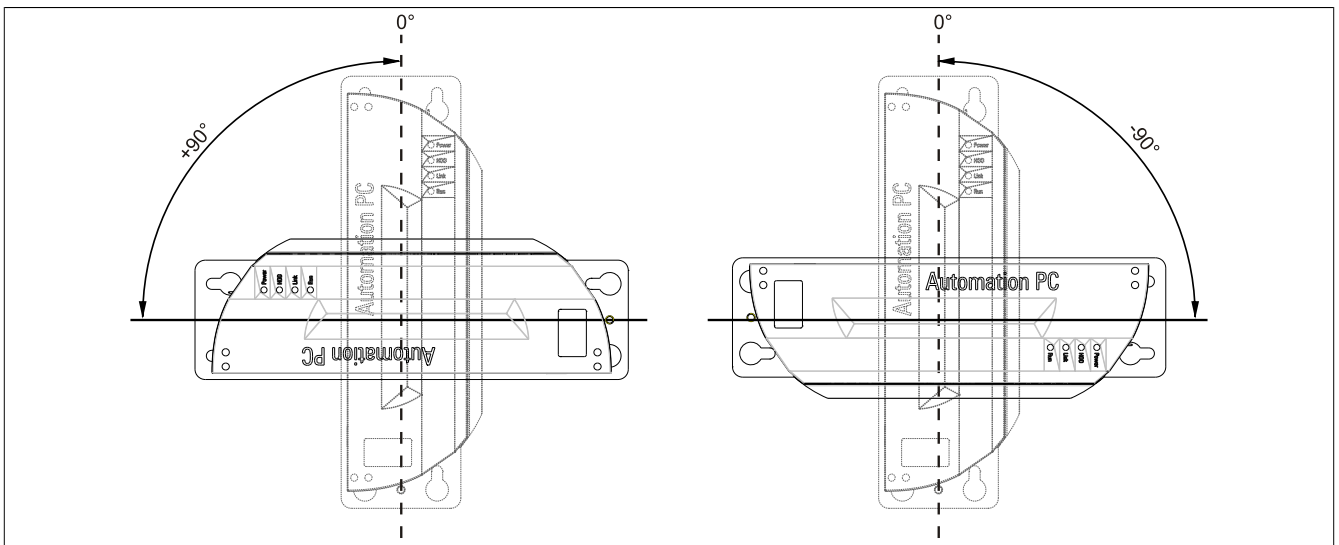


Abbildung 23: Einbaulagen -90° und +90°

1.3.3 Einbaulage 180°

Bei einer Einbaulage von 180° gibt es keine Einschränkungen bezüglich der Umgebungstemperatur.

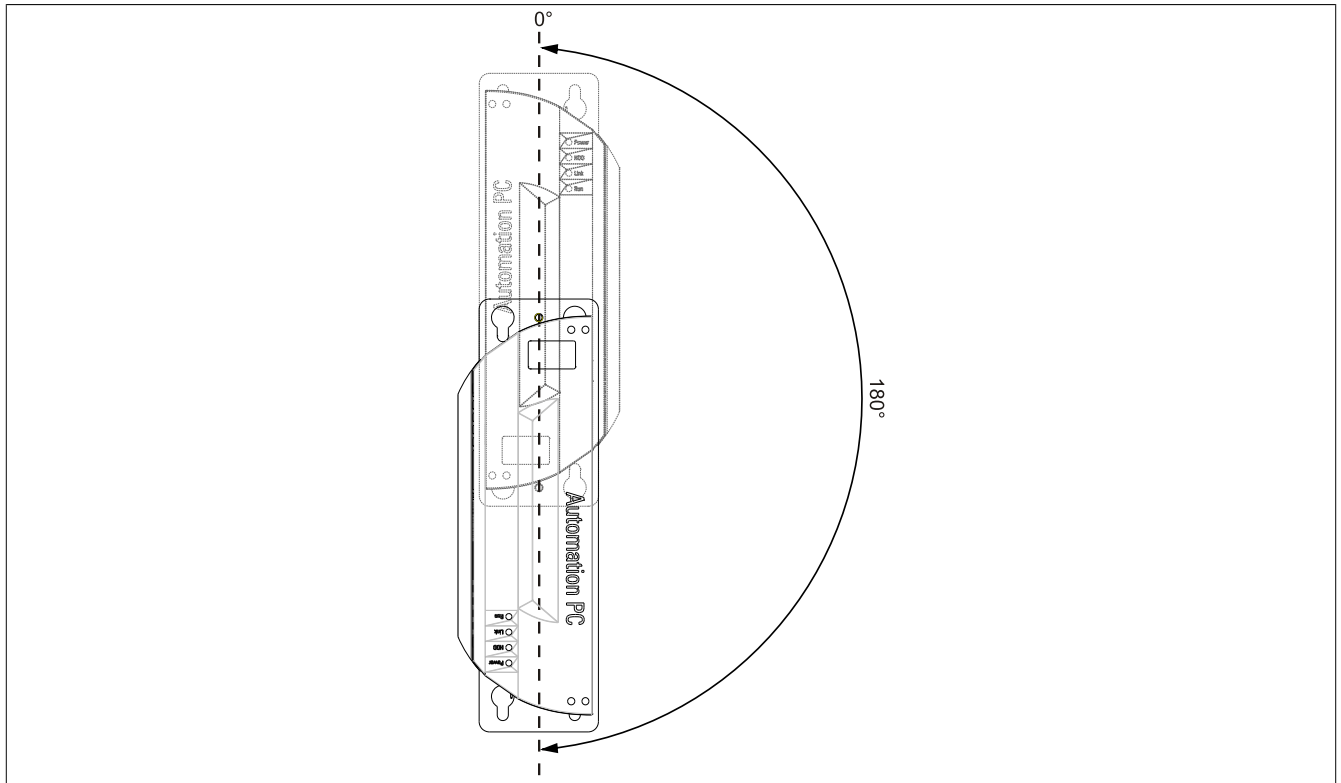


Abbildung 24: Einbaulage 180°

1.4 Luftzirkulationsabstände

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten ist oberhalb, unterhalb, seitlich und rückseitig des Automation PC 510 ein spezifizierter Freiraum vorzusehen. Der minimal spezifizierte Freiraum kann den nachfolgenden Zeichnungen entnommen werden. Dieser ist für sämtliche Automation PC 510 Varianten gültig.

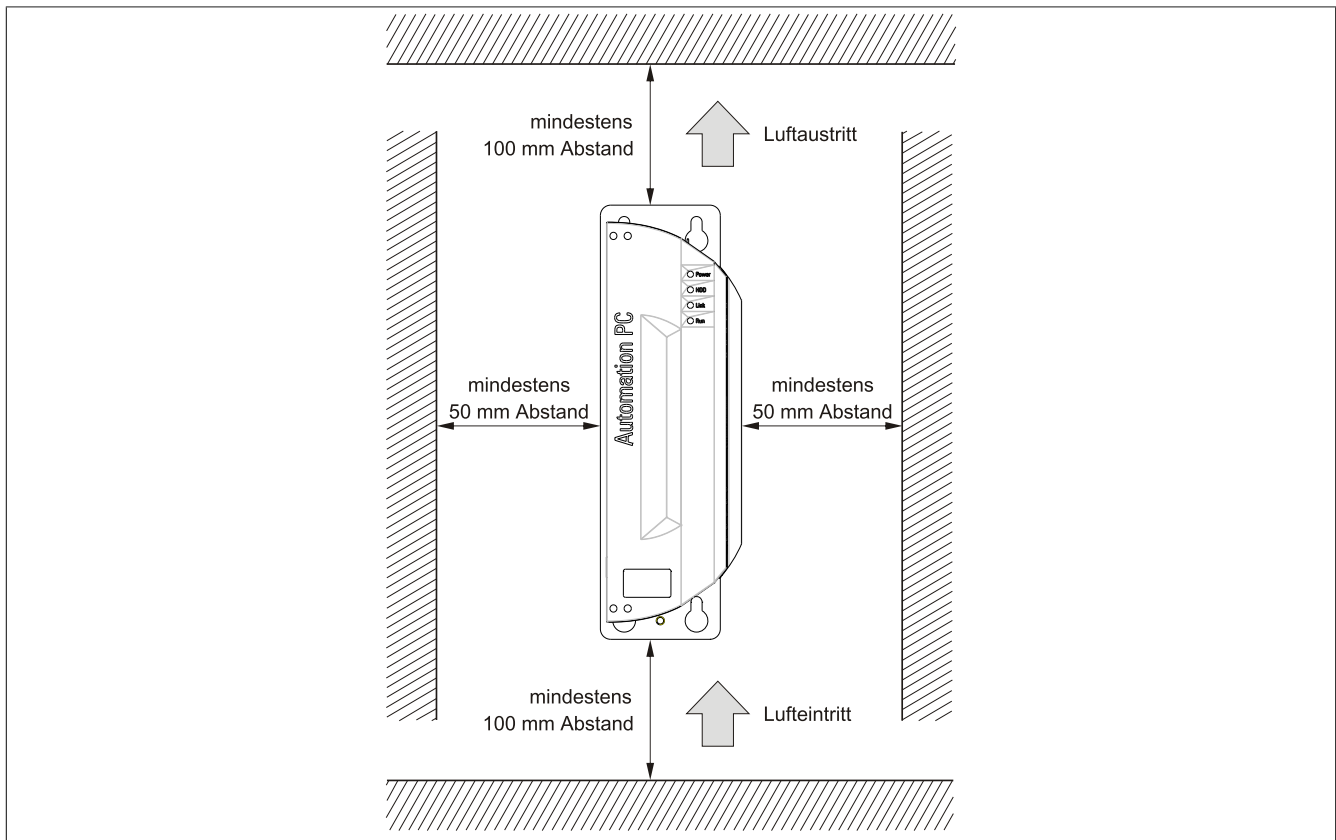


Abbildung 25: Luftzirkulationsabstände

Information:

Die angegebenen Luftzirkulationsabstände gelten für den Worst Case Betrieb bei der maximal spezifizierten Umgebungstemperatur (siehe "Temperaturangaben" im Kapitel "Technische Daten").

Können die angegebenen Luftzirkulationsabstände nicht eingehalten werden, sind die maximal spezifizierten Temperaturen der Temperatursensoren (siehe "Temperatursensorpositionen" im Kapitel "Technische Daten") vom Anwender zu überwachen und bei Überschreiten dieser Werte entsprechende Maßnahmen zu setzen.

2 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.

Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben beträgt 0,5 Nm.

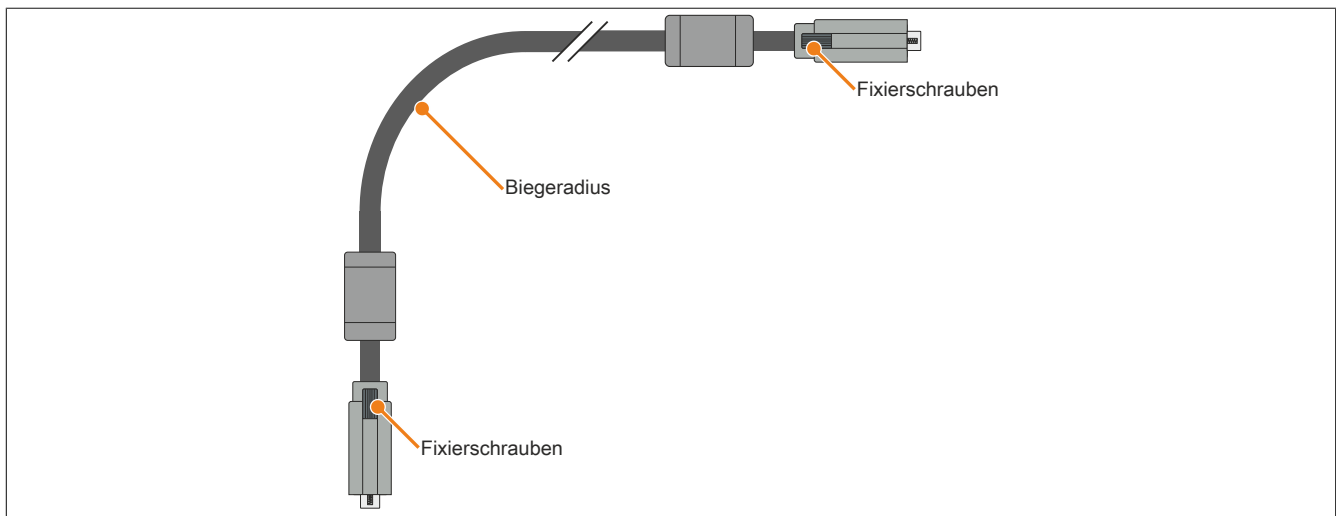


Abbildung 26: Biegeradius Kabelanschluss

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist dem Automation Panel 800 bzw. dem Automation Panel 900 Anwenderhandbuch, welches in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden kann, zu entnehmen.

3 Erdungskonzept

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Die Funktionserde des Gerätes besitzt 2 Anschlüsse:

- Spannungsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhülse an der Feldklemme 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm² pro Anschluss möglich.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.

Die Funktionserde ist am B&R Gerät mit folgendem Symbol gekennzeichnet: 

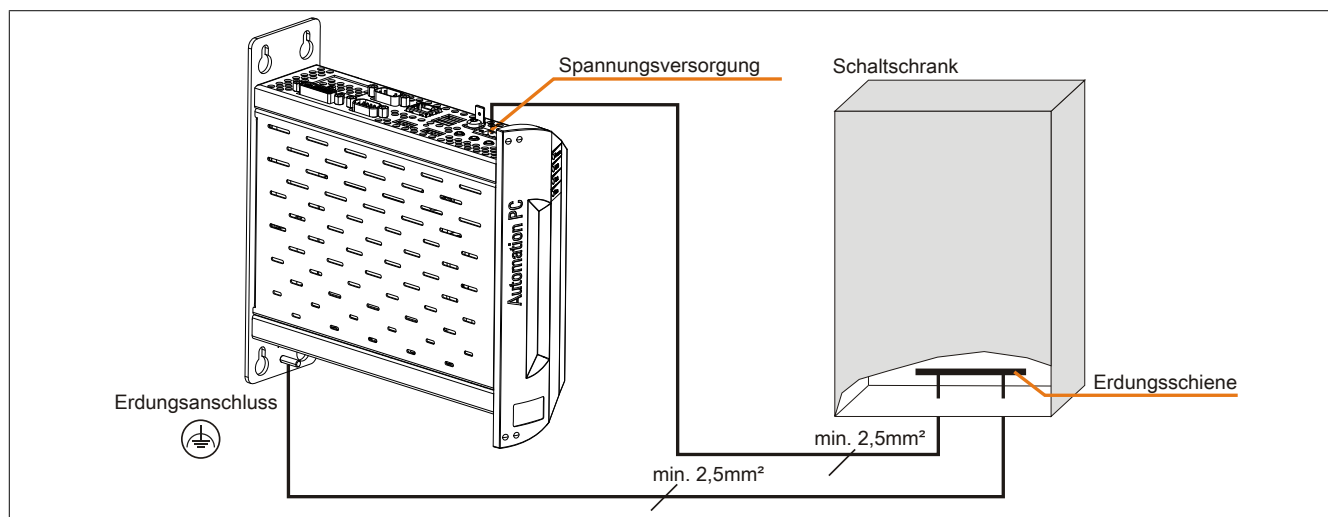


Abbildung 27: Erdungskonzept

4 Allgemeine Anleitung zur Vorgehensweise bei Temperaturtests

Zweck dieser Anleitung ist die allgemeine Vorgehensweise von applikationsspezifischen Temperaturtests mit B&R Industrie PCs oder Power Panels zu erklären. Diese Anleitung stellt jedoch lediglich eine Richtlinie dar.

4.1 Vorgehensweise

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Testbedingungen den Bedingungen im Feldeinsatz entsprechen. Dies bedeutet, dass während den Temperaturtests die Zielapplikation laufen sollte, der PC im später verwendeten Schaltschrankgehäuse montiert sein sollte, etc.

Weiters sollte ein Temperatursensor für das zu testende Gerät montiert werden, um die Umgebungstemperatur laufend zu überwachen. Um korrekte Werte zu erhalten, ist dieser in einem Abstand von ca. 5 bis 10 cm vom B&R Industrie PC, in der Nähe der Luftansaugung (nicht in der Nähe der Abgabeluft), anzubringen.

Jeder B&R Industrie PC oder jedes Power Panel ist mit internen Temperatursensoren ausgestattet. Je nach Gerätefamilie sind diese an verschiedenen Positionen angebracht. Die Anzahl und Temperaturgrenzen sind je nach Gerätefamilie unterschiedlich.

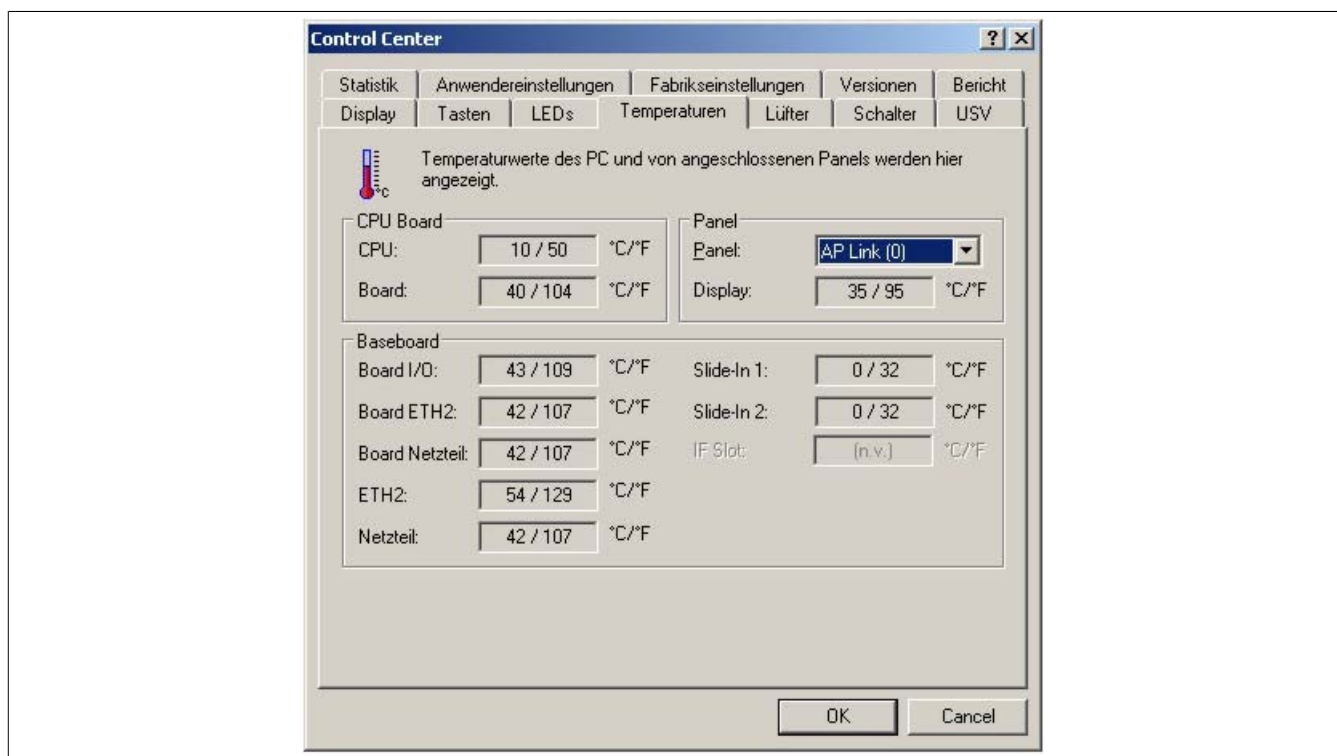
Angaben zur Lage der Temperatursensoren sowie deren maximal spezifizierte Temperaturen sind dem Abschnitt "Temperatursensorpositionen" im 2 "Technische Daten" zu entnehmen.

Zur optimalen Bestimmung und Beurteilung der Temperatursituation wird eine Mindesttestzeit von 8 Stunden empfohlen.

4.2 Auswertung der Temperaturen unter Windows Betriebssystemen

4.2.1 Auswertung mit dem B&R Control Center

Zur Auswertung der Temperaturen kann das B&R Control Center verwendet werden. Die Temperaturen können im Reiter „Temperaturen“ angesehen werden. Das B&R Control Center kann als freier Download von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Das B&R Control Center verwendet das B&R Automation Device Interface (ADI).



Ist eine historische Aufzeichnung der Daten notwendig, so kann eine eigene Applikation erstellt werden.

Information:

Zur Erstellung einer eigenen Applikation sind auf der B&R Homepage (www.br-automation.com) eigene SDK's verfügbar, wie z.B. das ADI .NET SDK.

4.2.2 Auswertung mit dem BurnIn Tool von Passmark

Wird zur Temperatúrauswertung keine eigene Applikation erstellt bzw. verwendet, so empfiehlt B&R die Verwendung des Softwaretools BurnIn Test der Firma Passmark.

Das Softwaretool BurnIn ist in einer Standard und Professional Version erhältlich. Zusätzlich zum Softwarepaket sind auch noch verschiedene Loopback Adapter (Seriell, Parallel, USB, ...) und Test-CDs bzw. DVDs erhältlich. Je nach Ausbaustufe der Software und vorhandenen Loopback Adapter kann eine entsprechend hohe System- und Peripherielast erzeugt werden.

Information:

Loopback Adapter können ebenfalls von der Firma Passmark bezogen werden. Mehr Informationen dazu sind unter www.passmark.com zu finden.

Die nachfolgenden Screenshots beziehen sich auf die Passmark BurnIn Pro Version V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.

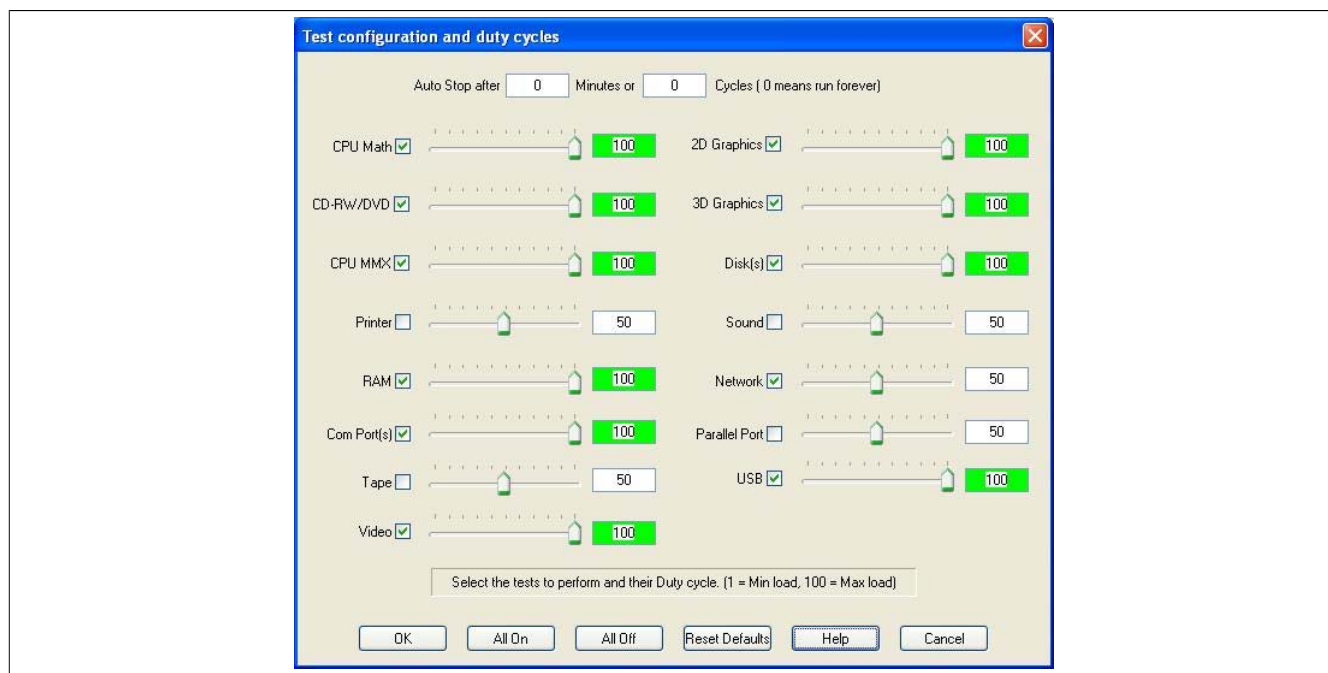
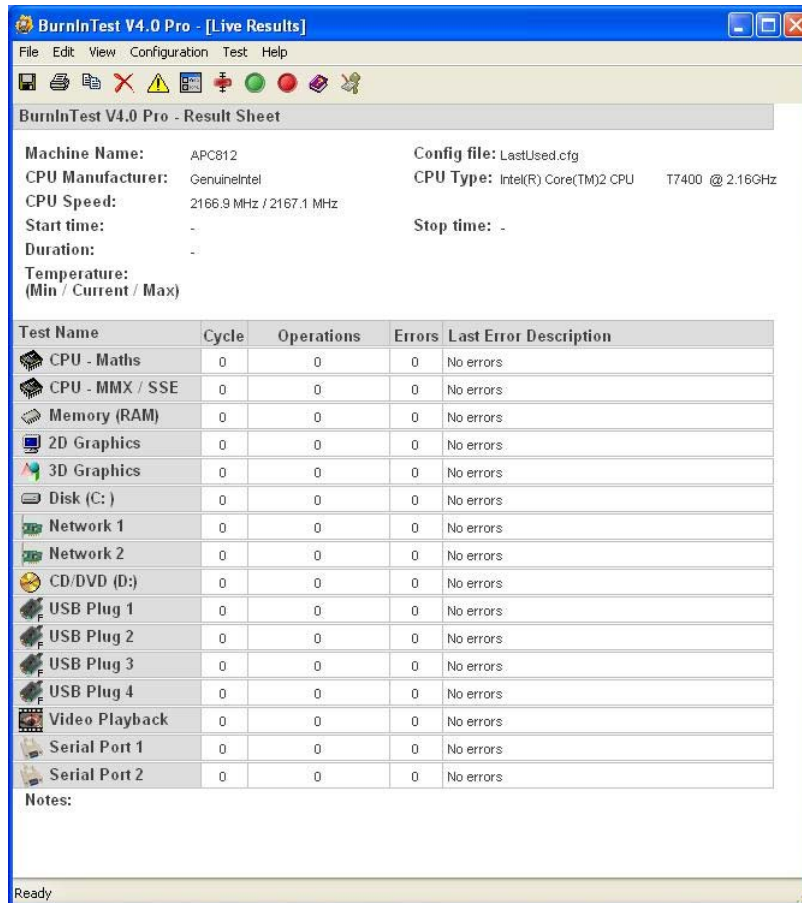


Abbildung 28: Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD



BurnInTest V4.0 Pro - Result Sheet

Machine Name: APC812 Config file: LastUsed.cfg
 CPU Manufacturer: GenuineIntel CPU Type: Intel(R) Core(TM)2 CPU T7400 @ 2.16GHz
 CPU Speed: 2166.9 MHz / 2167.1 MHz
 Start time: - Stop time: -
 Duration: -
 Temperature: (Min / Current / Max)

Test Name	Cycle	Operations	Errors	Last Error Description
CPU - Maths	0	0	0	No errors
CPU - MMX / SSE	0	0	0	No errors
Memory (RAM)	0	0	0	No errors
2D Graphics	0	0	0	No errors
3D Graphics	0	0	0	No errors
Disk (C:)	0	0	0	No errors
Network 1	0	0	0	No errors
Network 2	0	0	0	No errors
CD/DVD (D:)	0	0	0	No errors
USB Plug 1	0	0	0	No errors
USB Plug 2	0	0	0	No errors
USB Plug 3	0	0	0	No errors
USB Plug 4	0	0	0	No errors
Video Playback	0	0	0	No errors
Serial Port 1	0	0	0	No errors
Serial Port 2	0	0	0	No errors

Notes:

Ready

Abbildung 29: Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD

Je nach Verfügbarkeit der Loopback Adapter und DVDs muss eine entsprechende Feineinstellung in den jeweiligen Testproperties vorgenommen werden.

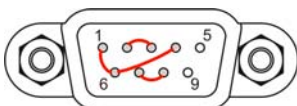
Information:

Stehen keine USB- Loopback Adapter zur Verfügung, so können auch USB Memory Sticks verwendet werden. Die USB Memory Sticks müssen unter Windows als formatiertes Laufwerk zur Verfügung stehen. Der Test USB ist dann abzuwählen und die USB Memory Stick Laufwerke müssen in den Diskproperties als Testdevice konfiguriert werden.



Information:

Serielle Loopback Adapter können relativ einfach selbst erstellt werden. Dazu sind lediglich einige Pins mit Drähten an der seriellen Schnittstelle zu verbinden.



4.3 Auswertung der Temperaturen unter Nicht- Windows Betriebssystemen

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.

Die Implementierungsanleitung beschreibt nur die gerätespezifischen Funktionen und nicht die Hauptfunktion der Beispielprogramme.

Wird der Code aus den Beispielprogrammen übernommen, sind die Hinweise in der Implementierungsanleitung zu den TODO Anweisungen, I/O Zugriffsfunktionen usw. zu beachten!

Information:

Für jeden B&R Industrie PC oder jedes Power Panel können Beispielprogramme und Implementierungsanleitungen von der B&R Homepage (www.br-automation.com) kostenlos heruntergeladen werden.

4.4 Auswertung der Messergebnisse

Der aufgezeichnete maximale Temperaturwert jedes einzelnen Sensors darf die in den Anwenderhandbüchern spezifizierte Temperaturgrenze nicht überschreiten.

Wenn die Temperaturtests nicht in einer geregelten Klimakammer durchgeführt werden können, so können diese z.B. in Büroumgebung durchgeführt werden. Dabei ist allerdings die Erfassung der Umgebungstemperatur notwendig. Auf Grund der im Hause B&R gewonnenen Erfahrung, können bei passiven Systemen (Systeme ohne Lüfter Kit) die gemessenen Temperaturwerte linear zur Umgebungstemperatur hochgerechnet werden. Um auch die Temperaturwerte bei Systemen mit Lüfter Kit hochrechnen zu können, müssen die Lüfter laufen. Weiters ist dabei auf die Drehzahl, usw. zu achten.

Werden die Temperaturtests in einer geregelten Klimakammer mit Lüfter durchgeführt, so werden die zu testenden Geräte durch diesen Lüfter gekühlt und somit auch die Messergebnisse verfälscht. Bei passiven Geräten sind die Messergebnisse somit unbrauchbar. Um jedoch auch Temperaturtests in Klimakammern mit Lüfter durchführen zu können ohne die Messergebnisse zu verfälschen, ist der Lüfter der Klimakammer auszuschalten und eine entsprechend große Vorlaufzeit (mehrere Stunden) einzuhalten.

Beispiel anhand eines APC810 2 Slot

Nachfolgendes Beispiel ist nur unter Einhaltung der Montage- und Einbaulagenvorschriften laut Anwenderhandbuch gültig.

Temperatursensor	Gemessene Temperatur	Hochgerechnete Temperatur	
Umgebungstemperatur	20°C	35°C	45°C
CPU	48°C	63°C	73°C
CPU Board	51°C	66°C	76°C
Board I/O	51°C	66°C	76°C
Board ETH2	52°C	67°C	77°C
Board Netzteil	51°C	66°C	76°C
ETH2	65°C	80°C	90°C
Netzteil	51°C	66°C	76°C

Tabelle 87: Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot

5 Anschlussbeispiele

Die nachfolgenden Beispiele bieten einen Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten, in welcher Art Automation Panel 900 Geräte und/oder Automation Panel 800 Geräte mit dem APC510 verbunden werden können. Es sollen dabei unter anderem folgende Fragen beantwortet werden:

- Wie können Automation Panel 900 Geräte am Monitor / Panel Ausgang des APC510 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Wie können Automation Panel 800 Geräte am Monitor / Panel Ausgang des APC510 angeschlossen werden und worauf ist Acht zu geben?
- Was bedeutet „Display Clone“ Betrieb?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können pro Strang angeschlossen werden?
- Wie viele Automation Panel 900 Geräte können mit einem Automation Panel 800 Gerät pro Strang angeschlossen werden?
- Wie werden die angeschlossenen Geräte intern nummeriert?
- Gibt es Einschränkungen bei der Segmentlänge, wenn ja welche?
- Welche Kabel und Linkbaugruppen werden benötigt?
- Müssen BIOS Einstellungen für eine bestimmte Konfiguration geändert werden?

5.1 Auswahl der Displayeinheiten

Wenn ein Automation Panel 800 und ein Automation Panel 900 an einem Strang angeschlossen werden sollen, müssen die Geräte den gleichen Displaytyp besitzen. In der folgenden Tabelle werden die möglichen AP900 Geräte aufgelistet die mit einem AP800 Gerät an einem Strang angeschlossen werden können.

Automation Panel 800	Automation Panel 900
5AP820.1505-00	5AP920.1505-01 5AP951.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01
5AP880.1505-00	5AP920.1505-01 5AP951.1505-01 5AP980.1505-01 5AP981.1505-01

Tabelle 88: Auswahl der Displayeinheiten

5.2 Ein Automation Panel 900 über DVI onboard

An die integrierte DVI Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 mit max. SXGA Auflösung angeschlossen. Alternativ kann auch ein Office TFT mit DVI Schnittstelle betrieben werden. Touch Screen und USB werden jeweils über eigene Kabel geführt. Sollen USB Geräte am Automation Panel 900 betrieben werden, so kann die Distanz max. 5 Meter betragen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

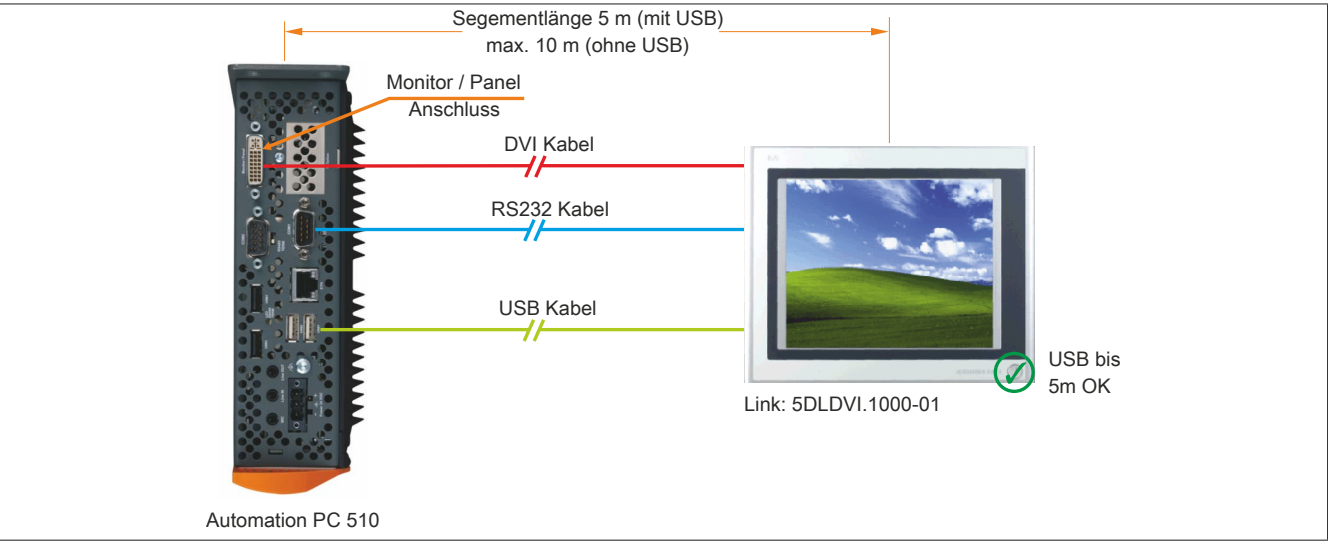


Abbildung 30: Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto)

5.2.1 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DL DVI.1000-01	Automation Panel Link DVI Receiver Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 89: Linkbaugruppen

5.2.2 Kabel

Auswahl jeweils eines Automation Panel 900 Kabels aus den 3 benötigten Typen.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	5 m ±80 mm
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	10 m ±100 mm
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	1,8 m ±50 mm
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	5 m ±80 mm
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	10 m ±100 mm
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	5 m ±50 mm

Tabelle 90: Kabel für DVI Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.2.3 Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

Es können folgende Automation Panel 900 Geräte verwendet werden, wobei in seltenen Fällen eine Einschränkung der Segmentlänge in Abhängigkeit der Auflösung besteht.

Bestellnummer	Diagonale	Auflösung	Touchscreen	Tasten	max. Segmentlänge
5AP920.1043-01	10,4"	VGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1214-01	12,1"	SVGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1505-01	15,0"	XGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1706-01	17,0"	SXGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾
5AP920.1906-01	19,0"	SXGA	✓	-	5 m / 10 m ¹⁾

Tabelle 91: Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen

1) Keine USB Unterstützung am Automation Panel 900 möglich, da USB nur bis 5 m begrenzt einsetzbar ist.

Information:

Bei der Übertragungsart DVI ist kein Auslesen von Statistikwerten bei den Automation Panel 900 Geräten möglich.

5.2.4 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

5.3 Ein Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

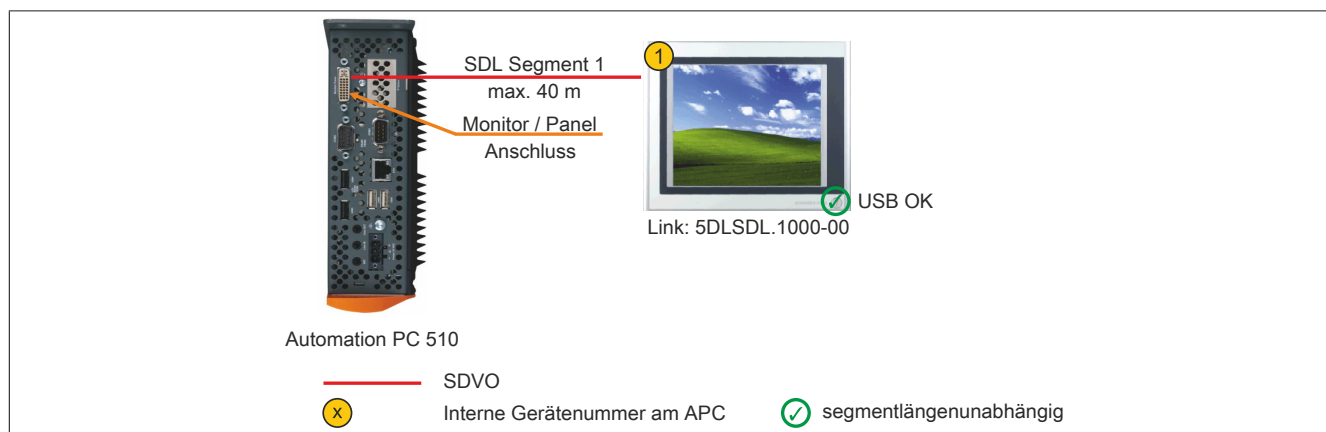


Abbildung 31: Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.3.1 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Ser- vicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 92: Linkbaugruppen

5.3.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 93: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.3.2.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 94: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.3.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices“).

5.4 Ein Automation Panel 800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 800 über SDL Kabel angeschlossen. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Extension Keyboard angeschlossen werden.

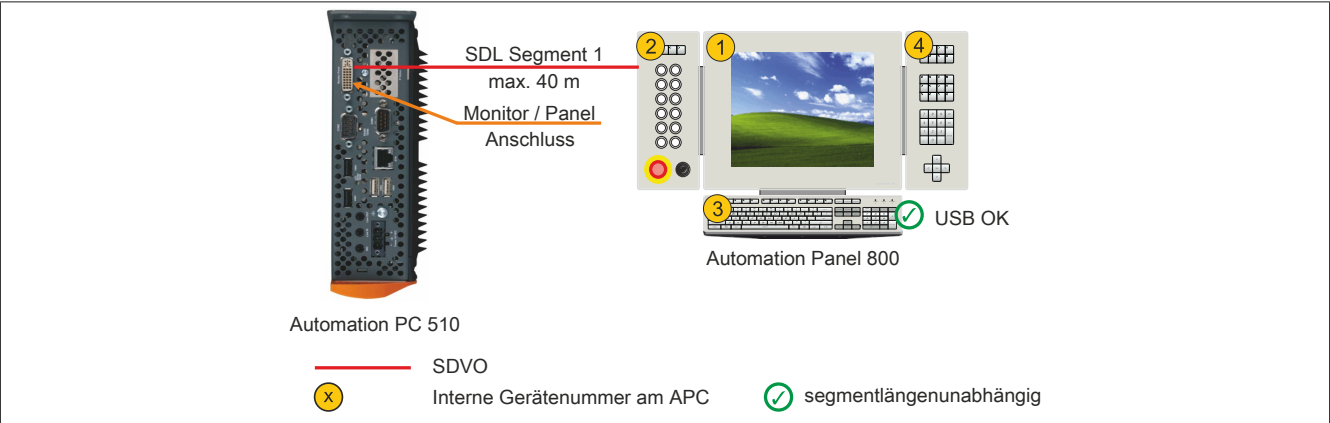


Abbildung 32: Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.4.1 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 800 SDL Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-20	SDL Kabel flex für Automation Panel 800, 25 m.	25 m ±230 mm
5CASDL.0300-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm
5CASDL.0400-30	SDL Kabel flex für Automation Panel 800 mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm

Tabelle 95: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.4.1.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung
	XGA 1024 x 768
1,8	5CASDL.0018-20
5	5CASDL.0050-20
10	5CASDL.0100-20
15	5CASDL.0150-20
20	5CASDL.0200-20
25	5CASDL.0250-20
30	5CASDL.0300-30
40	5CASDL.0400-30

Tabelle 96: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.4.2 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices“).

5.5 Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) sind ein Automation Panel 900 und ein Automation Panel 800 über SDL angeschlossen. Alle zwei Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (Segment 1 + Segment 2) von 30 m an den beiden Displays unterstützt. Ab einer maximalen Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur am ersten Display (front- und rückseitig), bis maximal 40 m, zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) am Automation Panel 900 bzw. am Extension Keyboard angeschlossen werden.

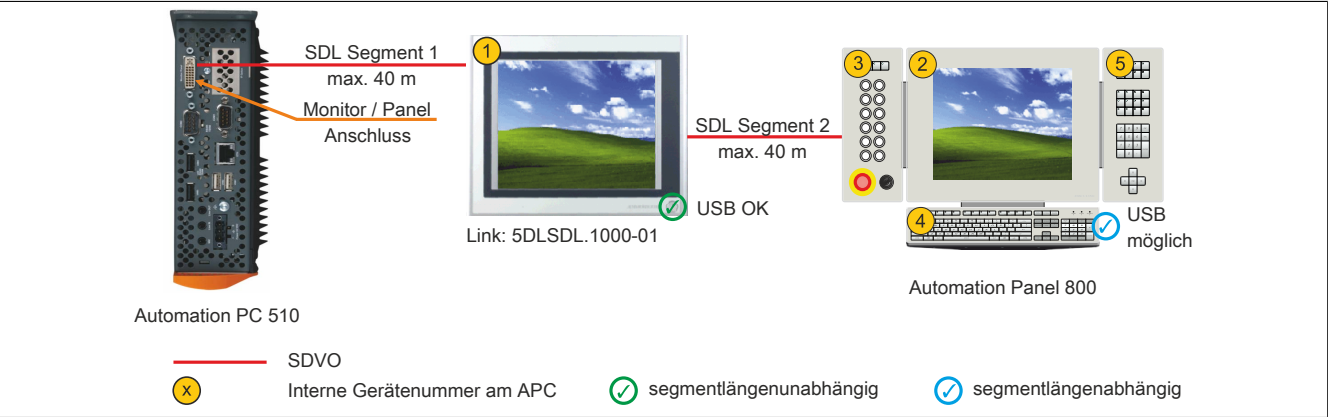


Abbildung 33: Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.5.1 Linkbaugruppe

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 97: Linkbaugruppen

5.5.2 Kabel

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 800 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.5.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.
Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices“).

5.6 Vier Automation Panel 900 über SDL onboard

An die integrierte SDL Schnittstelle (onboard) ist ein Automation Panel 900 über SDL Kabel angeschlossen. An diesem Automation Panel werden bis zu drei weitere Automation Panel des selben Typs über SDL Kabel betrieben. Alle vier Panel zeigen den gleichen Bildinhalt an (Display Clone).

USB wird bis zu einer maximalen Distanz (SDL Segment 1 + SDL Segment 2) von 30 m an den ersten beiden Panel (front- und rückseitig) unterstützt. Ab einer Distanz von 30 m steht USB ausschließlich nur mehr am ersten Panel (front- und rückseitig) zur Verfügung. USB Geräte können nur direkt (ohne Hub) an die Automation Panel angeschlossen werden.

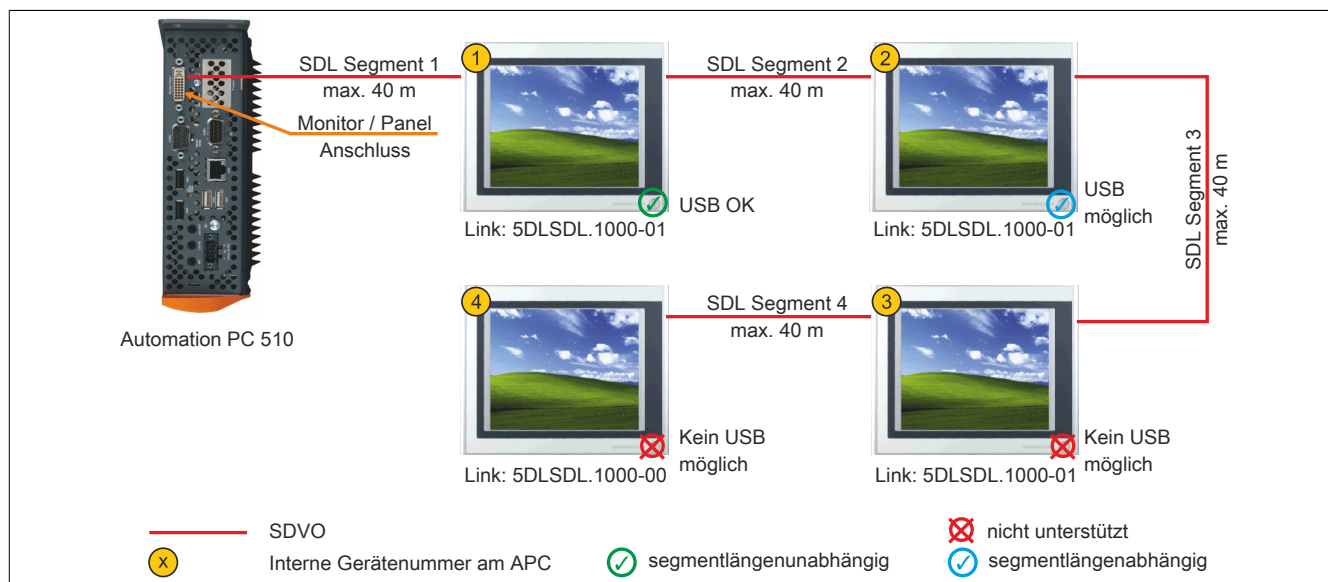


Abbildung 34: Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto)

5.6.1 Linkbaugruppen

Information:

Für jedes verwendete Gerät muss die entsprechende Linkbaugruppe ausgewählt werden!

Bestellnummer	Beschreibung	Anmerkung
5DLSDDL.1000-00	Automation Panel Link SDL Receiver Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900
5DLSDDL.1000-01	Automation Panel Link SDL Transceiver Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).	für Automation Panel 900

Tabelle 98: Linkbaugruppen

5.6.2 Kabel

Auswahl eines Automation Panel 900 Kabels aus der nachfolgenden Tabelle.

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	5 m ±30 mm
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	10 m ±50 mm
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	15 m ±100 mm
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	20 m ±100 mm
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	25 m ±100 mm
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	30 m ±100 mm
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	1,8 m ±20 mm
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	5 m ±45 mm
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	10 m ±90 mm
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	15 m ±135 mm
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	20 m ±180 mm
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	25 m ±225 mm
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	30 m ±270 mm
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	30 m ±280 mm

Tabelle 99: Kabel für SDL Konfigurationen

Bestellnummer	Beschreibung	Länge
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	40 m ±380 mm
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	43 m ±410 mm
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	1,8 m ±30 mm
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	5 m ±50 mm
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	10 m ±100 mm
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	15 m ±100 mm

Tabelle 99: Kabel für SDL Konfigurationen

Information:

Detaillierte technische Daten zu den Kabeln siehe Automation Panel 900 Anwenderhandbuch. Dieses kann in elektronischer Form (pdf) von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

5.6.2.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des SDL Kabels:

SDL Kabel Segmentlänge [m]	Auflösung					
	VGA 640 x 480	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200	FHD 1920 x 1080
1,8	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00	5CASDL.0018-00
	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01	5CASDL.0018-01
	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03	5CASDL.0018-03
5	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00	5CASDL.0050-00
	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0050-01
	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03	5CASDL.0050-03
10	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00	5CASDL.0100-00
	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0100-01
	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03	5CASDL.0100-03
15	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	5CASDL.0150-00	-	-
	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	5CASDL.0150-01	-	-
	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	5CASDL.0150-03	-	5CASDL.0150-03
20	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	5CASDL.0200-00	-	-
	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	5CASDL.0200-03	-	5CASDL.0200-03
25	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	5CASDL.0250-00	-	-	-
	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	5CASDL.0250-03	-	-	-
30	5CASDL.0300-00	5CASDL.0300-00	-	-	-	-
	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-03	5CASDL.0300-13	5CASDL.0300-13	-	5CASDL.0300-13
40	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0400-13	-	5CASDL.0400-13

Tabelle 100: Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung

5.6.3 BIOS Einstellungen

Es müssen für den Betrieb keine speziellen BIOS Einstellungen vorgenommen werden.

Für nähere Informationen siehe Anwenderhandbuch des verwendeten B&R Industrie PCs.

Touch Screen Funktionalität

Für den Betrieb des Touch Screens des angeschlossenen Panels am Monitor / Panel Anschluss, muss die COM C im BIOS aktiviert/Enabled werden (zu finden im BIOS Menü unter „OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices“).

6 Anschluss von USB Peripheriegeräten

Warnung!

An die USB Schnittstellen können USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit am Markt erhältlichen USB Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB Geräte wird die Funktion gewährleistet.

6.1 Lokal am APC510

An die 4 USB Schnittstellen können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können die USB Schnittstellen hierzu jeweils mit 1A belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.



Abbildung 35: Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC510

6.2 Remote am Automation Panel 900 über DVI

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 2.0.

Information:

Am Automation Panel 900 kann kein HUB, sondern es können nur Endgeräte angeschlossen werden.



Abbildung 36: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI

6.3 Remote am Automation Panel 800 / 900 über SDL

An die 2 oder 3 USB Schnittstellen am Automation Panel 900 bzw. USB Anschlüsse bei Automation Panel 800 Geräten können verschiedenste USB Peripheriegeräte angeschlossen werden. Dabei können diese jeweils mit 500 mA belastet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt maximal USB 1.1.

Information:

Am Automation Panel 800/900 kann kein HUB, sondern es können nur Engeräte angeschlossen werden.



Abbildung 37: Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL

7 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Die nachfolgenden Punkte sind bei den APC510 Geräten bekannt:

- Die Grafik Auflösung HD (1366x768) wird vom Intel VBIOS nicht vollständig unterstützt, weshalb es nach dem POST zu Anzeigefehlern kommt. Das Bild flackert und ist um eine Zeile nach unten verschoben. Der BIOS POST sowie das BIOS Setup werden noch korrekt dargestellt. Bei OS Systemen, für die kein Grafiktreiber verfügbar ist (z.B. MS-DOS) oder auch bevor der Grafiktreiber des OS gestartet ist (z.B. Bootlogo des Windows XP), tritt dieser Effekt auf. Bei einem korrekt gebooteten Windows XP bzw. Windows 7 mit installiertem Grafiktreiber, wird die HD Auflösung wieder richtig dargestellt.
- Die Monitor/Panel Schnittstelle unterstützt keine RGB-Signale.

Kapitel 4 • Software

1 BIOS Optionen

Information:

Die nachfolgenden Abbildungen bzw. BIOS Menüpunkte einschließlich Beschreibungen beziehen sich auf die BIOS Version 1.00. Es kann daher vorkommen, dass diese Abbildungen bzw. BIOS Beschreibungen nicht mit der installierten BIOS Version übereinstimmen.

1.1 Allgemeines

BIOS ist die Abkürzung für „Basic Input and Output System“. Es ist die grundlegende standardisierte Verbindung zwischen Anwender und System (Hardware). Bei diesem B&R Industrie PC wird das BIOS von Insyde verwendet.

Das BIOS Setup Utility ermöglicht die Modifizierung grundlegender Einstellungen der Systemkonfiguration. Diese Einstellungen werden im CMOS und im EEPROM (als Backup) gespeichert.

Die CMOS Daten werden durch eine Batterie - sofern vorhanden - gepuffert und bleiben auch im spannungslosen Zustand (keine 24 VDC Versorgung) des B&R Industrie PCs erhalten.

1.2 BIOS Setup und Startvorgang

Sofort nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des B&R Industrie PCs bzw. Drücken des Power Buttons wird das BIOS aktiviert. Es wird überprüft, ob die Setupdaten aus dem EEPROM „OK“ sind. Sind diese „OK“, werden sie in das CMOS übertragen. Sind diese „nicht OK“, werden die CMOS Daten auf Gültigkeit überprüft. Sind die CMOS Daten auch fehlerhaft, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben und man kann mit der Taste <F1> den Bootvorgang problemlos fortsetzen. Damit die Fehlermeldung nicht bei jedem Neustart erscheint, ist mit der Taste <Entf> das BIOS Setup aufzurufen und neu zu speichern.

Das BIOS liest die Systemkonfigurationsinformation, überprüft das System und konfiguriert es durch den Power On Self Test (POST).

Nach Abschluss dieser „Vorbereitungen“ durchsucht das BIOS die im System vorhandenen Datenspeicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, usw.) nach einem Betriebssystem. Das BIOS startet das Betriebssystem und übergibt diesem die Kontrolle über die Systemoperationen.

Um ins BIOS Setup zu gelangen, muss die <F2> Taste nach dem Initialisieren des USB Controllers gedrückt werden, sobald folgende Nachricht am Bildschirm erscheint (während POST): „Press F2 go to Setup Utility“

Information:

Der POST-Screen wird aufgrund von optimierten Bootvorgängen nur für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt. Der Einstieg in das BIOS ist aber trotzdem möglich.

Processor Type : Intel(R) Atom(TM) CPU Z520 @ 1.33GHz

System Memory Speed : 533 MHz

CPUID : 106C2

F2 is pressed. Go to Setup Utility.

Other Device 1 : BR-SSD-C004G-01-0101

Abbildung 38: Bootscreen

1.2.1 BIOS Setup Tasten

Folgende Tasten sind während dem POST aktiviert:

Information:

Die Tastensignale der USB Tastatur werden erst nach dem Initialisieren des USB Controllers angenommen.

Tasten	Funktion
F2	Einstieg in das BIOS Setup Menü.
F12	Aufruf des Bootmenüs. Es werden sämtliche bootfähigen Geräte die mit dem System verbunden sind aufgelistet. Mit Cursor ↑ und Cursor ↓ und durch Bestätigen von <ENTER> wird von diesem Gerät gebootet, mit ESC wird das Bootmenü verlassen. Boot Manager Boot Option Menu BR-SSD-C004G-01-0101 SwissbitunitedCONTRAST ↑ and ↓ to change option, ENTER to select an option, ESC to exit
<Pause>	Mit der <Pause> Taste kann der POST angehalten werden. Nach Drücken jeder anderen beliebigen Taste läuft der POST weiter.

Tabelle 101: Biosrelevante Tasten beim POST

Folgende Tasten können nach dem Einstieg in das BIOS Setup verwendet werden:

Taste	Funktion
F1	Generelle Hilfe.
Cursor ↑	Zum vorigen Objekt.
Cursor ↓	Zum nächsten Objekt.
Cursor ←	Zum vorigen Menü.
Cursor →	Zum nächsten Menü.
F5/F6	BIOS Einstellungen ändern.
Enter	In das ausgewählte Menü wechseln.
F9	CMOS Default Werte für alle BIOS Einstellungen werden geladen und eingestellt.
F10	Speichern und schließen.
Esc	Untermenü verlassen.

Tabelle 102: Biosrelevante Tasten im BIOS Menü

1.3 Main

Unmittelbar nach dem Drücken der Taste <F2> beim Systemstart erscheint das Hauptmenü des BIOS Setups:

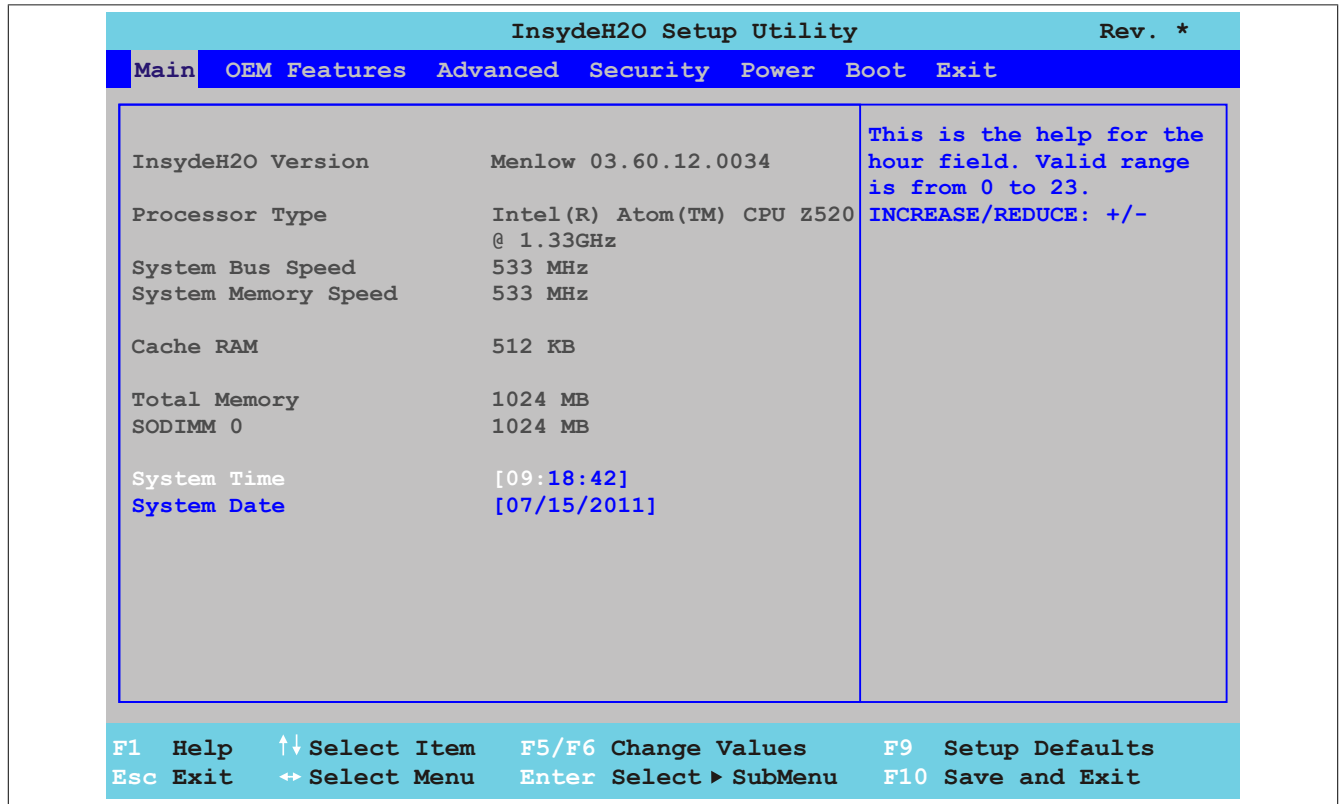


Abbildung 39: US15W Main - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
InsydeH2O Version	Anzeige der InsydeH2O BIOS Version.	keine	-
Processor Type	Anzeige des Prozessortyps.	keine	-
System Bus Speed	Anzeige der System Bus Geschwindigkeit.		
System Memory Speed	Anzeige der Arbeitsspeichergeschwindigkeit.	keine	-
Cache RAM	Anzeige des Cache RAM im System.	keine	-
Total Memory	Anzeige der gesamten Arbeitsspeichergröße.	keine	-
SODIMM 0	Anzeige der Arbeitsspeichergröße im SODIMM 0 Slot.	keine	-
System Time	Ist die aktuell eingestellte Systemzeit. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung der Systemzeit	Individuelle Einstellung der Systemzeit im Format Stunde:Minute:Sekunde (hh:mm:ss).
System Date	Ist das aktuell eingestellte Systemdatum. Wird nach dem Ausschalten des Systems durch eine Batterie (CMOS-Batterie) gepuffert.	Veränderung vom Systemdatum	Individuelle Einstellung des Systemdatums im Format Monat:Tag:Jahr (mm:dd:yyyy).

Tabelle 103: US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten

1.4 OEM Features

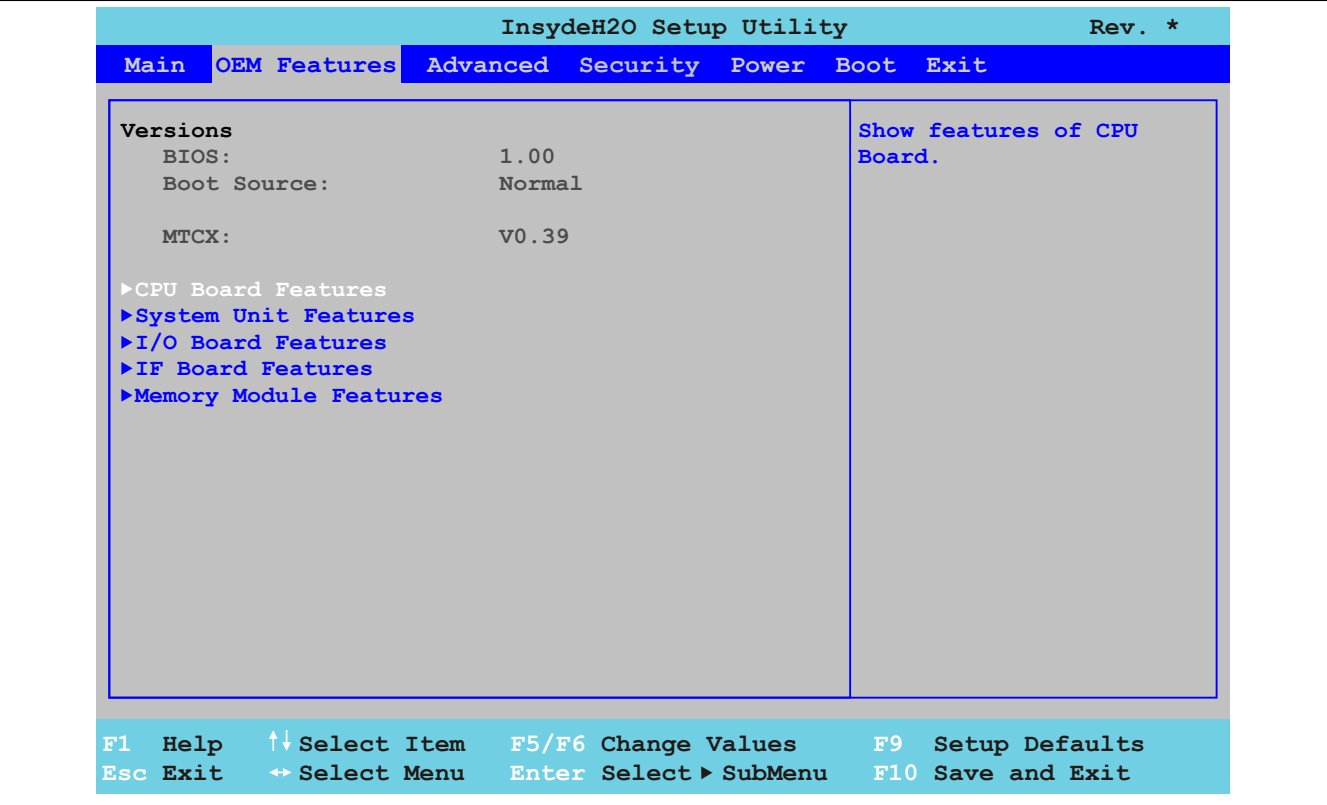


Abbildung 40: US15W OEM Features - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
BIOS	Anzeige der installierten B&R BIOS Version.	keine	-
Boot Source	Anzeige ob von der "normalen" BIOS Version (Normal) oder der Backup BIOS Version (Backup) gebootet wird.		Information: Ist ein BIOS Update fehlgeschlagen, wird automatisch das Backup BIOS geladen. Das BIOS Update kann von hier noch einmal ausgeführt werden.
MTCX	Anzeige der installierten MTCX Version.	keine	
CPU Board Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte des CPU Boards.	Enter	
System Unit Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen und Einstellung gerätespezifischer Werte der Systemeinheit.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "System Unit Features" auf Seite 112
I/O Board Features ¹⁾	Anzeige gerätespezifischer Informationen des I/O Boards.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "I/O Board Features" auf Seite 116
IF Board Features ²⁾	Anzeige gerätespezifischer Informationen des IF Boards.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IF Board Features" auf Seite 121
Memory Module Features	Anzeige gerätespezifischer Informationen des Hauptspeichers.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Memory Module Features" auf Seite 123

Tabelle 104: US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten

- 1) Dieses Submenü wird nur angezeigt wenn ein I/O Board an der Systemeinheit gesteckt ist.
- 2) Dieses Submenü wird nur angezeigt wenn ein Interface Board an der Systemeinheit gesteckt ist.

1.4.1 CPU Board Features

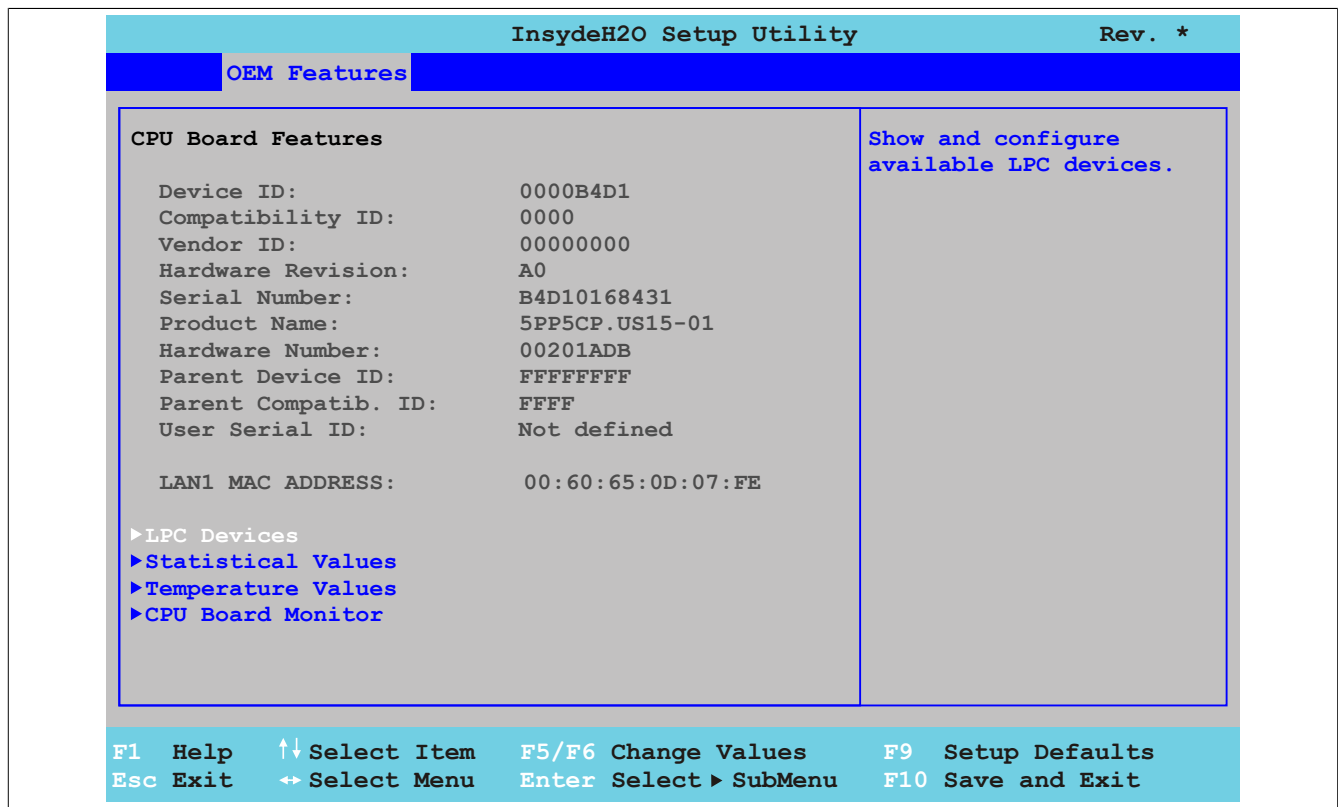


Abbildung 41: US15W OEM Features - CPU Board Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung des CPU Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der CPU Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der CPU Board Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-
LAN1 MAC ADDRESS	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH Schnittstelle.	keine	-
LPC Devices	Konfiguration der LPC Devices.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "LPC Devices" auf Seite 108
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 109
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 110
CPU Board Monitor	Anzeige der aktuellen Spannungen des verwendeten CPU Boards an.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "CPU Board Monitor" auf Seite 111

Tabelle 105: US15W OEM Features - CPU Board Features Einstellmöglichkeiten

1.4.1.1 LPC Devices

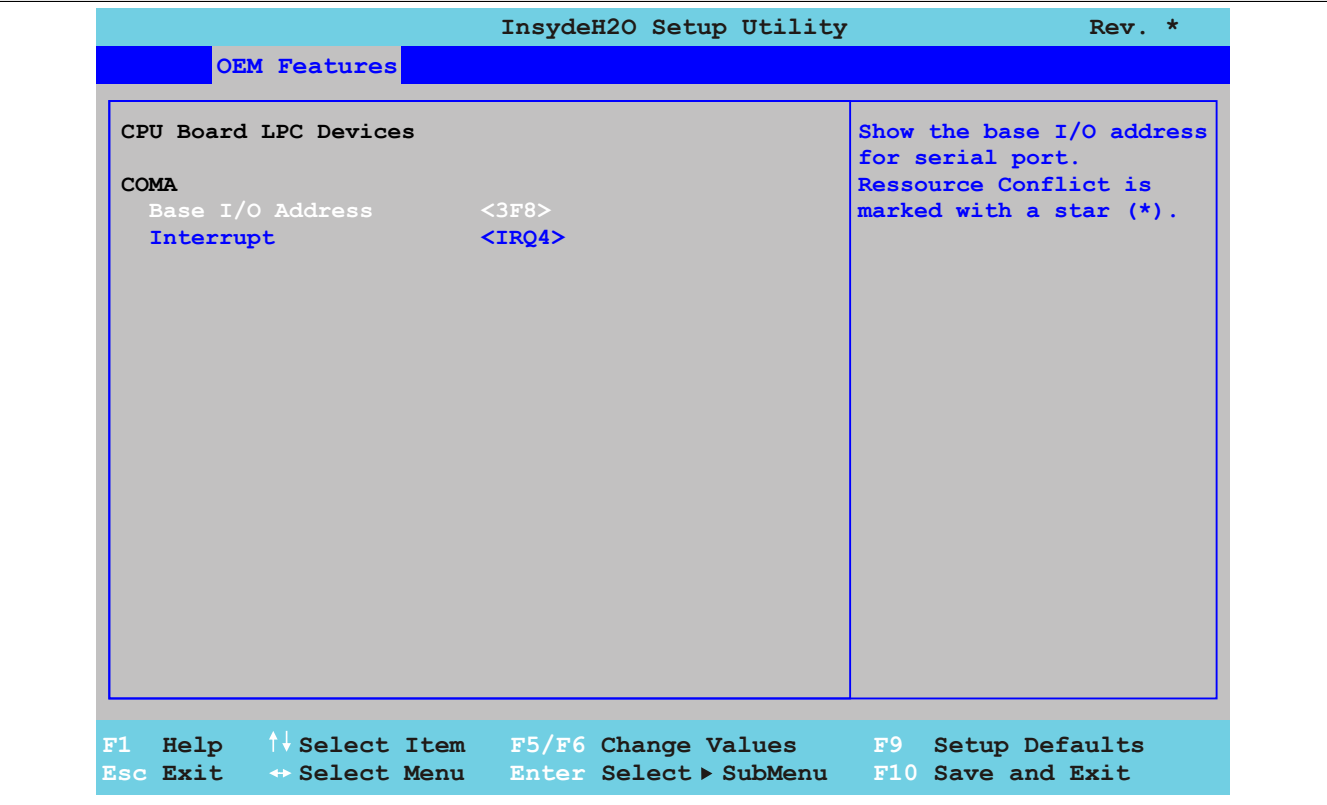


Abbildung 42: US15W OEM Features - CPU Board Features - LPC Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COMA	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM im System.	keine	-
Base I/O Address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	Disabeld, 238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Deaktivierung oder Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.

Tabelle 106: US15W OEM Features - CPU Board Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten

Information:

Bei den Base I/O Adress oder Interrupt Einstellungen kann es zu einem Ressourcenkonflikt kommen, hierbei wird eine Warnung angezeigt. Um die Einstellungen trotzdem zu ändern, muss zuerst die Einstellung bei der verwendeten Base I/O Adress bzw. dem Interrupt geändert werden.

1.4.1.2 Statistical Values

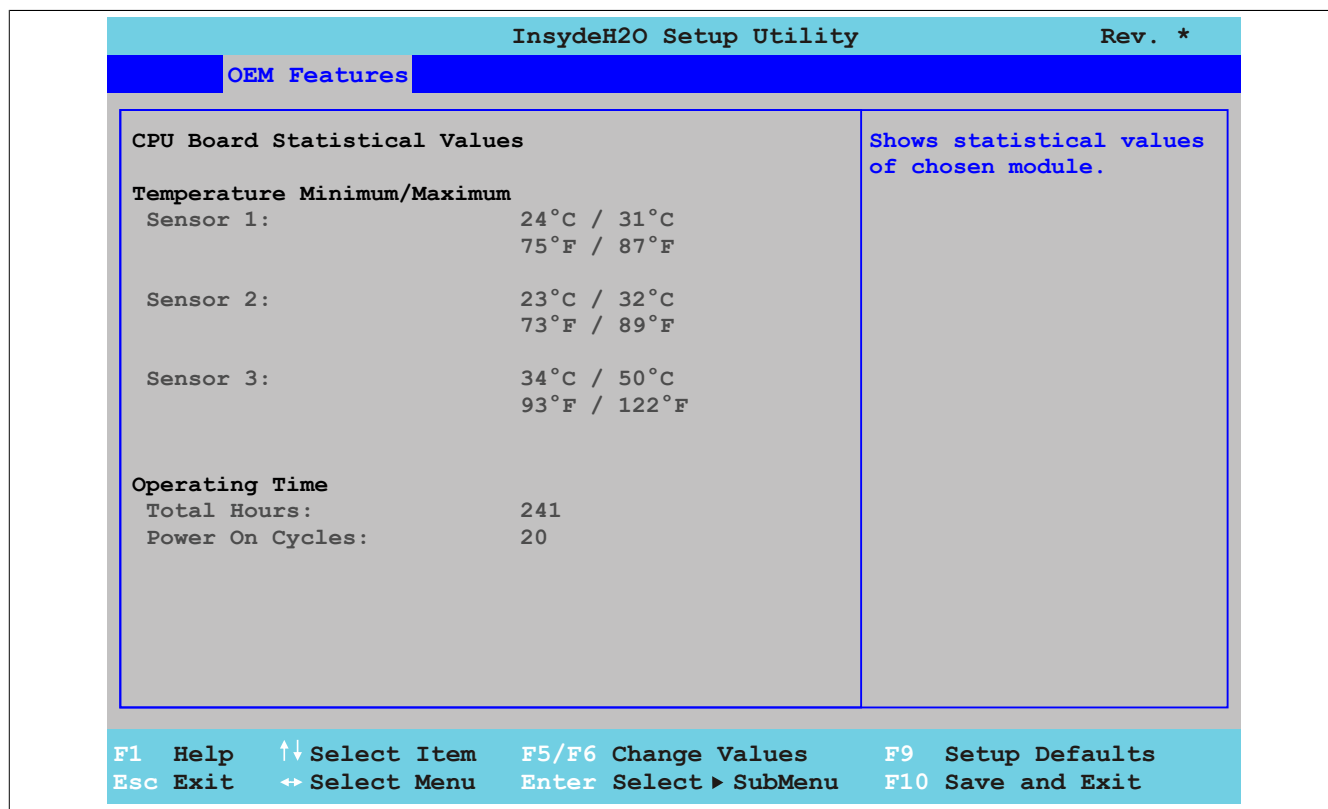


Abbildung 43: US15W OEM Features - CPU Board Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 1 (Schnittstellen) in °C und °F.	keine	-
Sensor 2:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 2 (CPU) in °C und °F.	keine	-
Sensor 3:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 3 (Hauptspeicher) in °C und °F.	keine	-
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 107: US15W OEM Features - CPU Board Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.1.3 Temperature Values

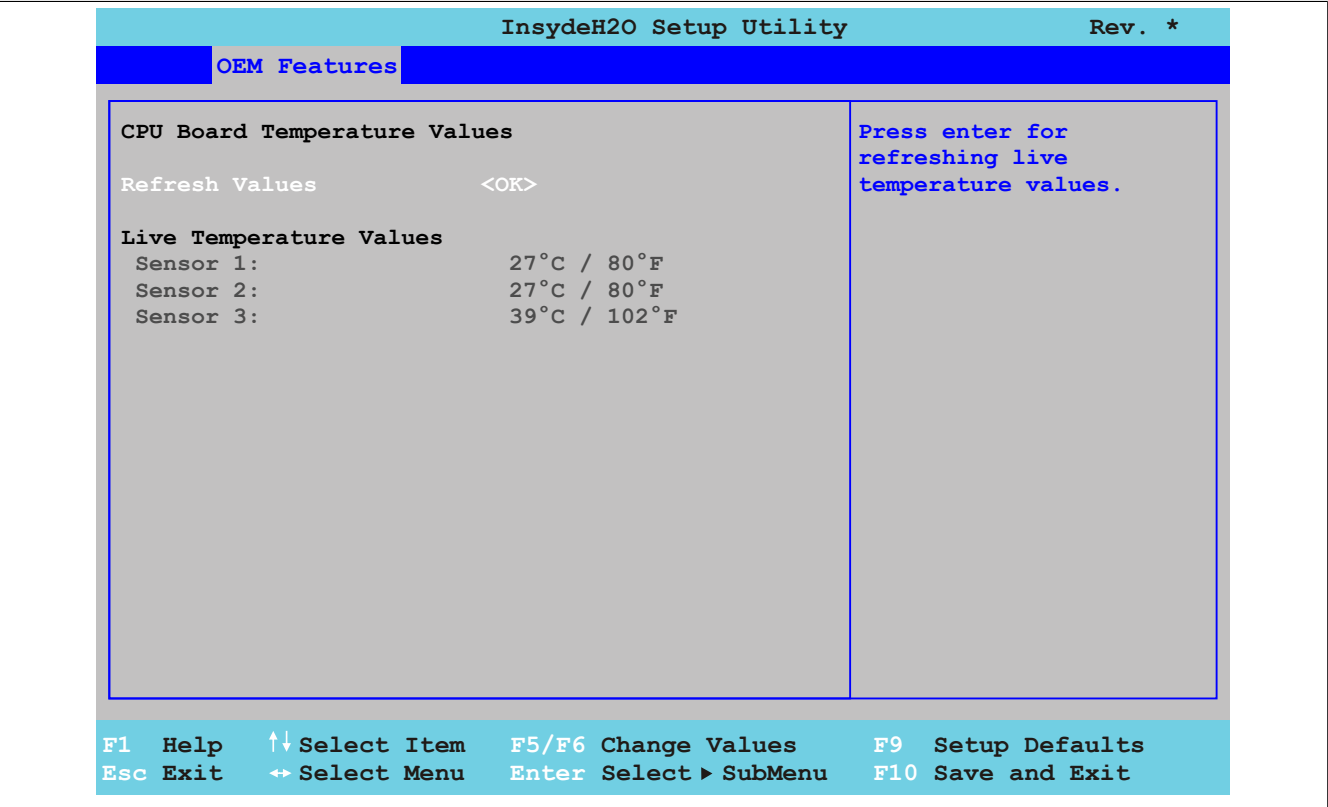


Abbildung 44: US15W OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Values	Option zum Aktualisieren der Temperaturwerte.	OK	Die unten angezeigten Temperaturwerte werden aktualisiert.
Sensor 1:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 (Schnittstellen) in °C und °F.	keine	-
Sensor 2:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 2 (CPU) in °C und °F.	keine	-
Sensor 3:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 3 (Hauptspeicher) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 108: US15W OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten

1.4.1.4 CPU Board Monitor

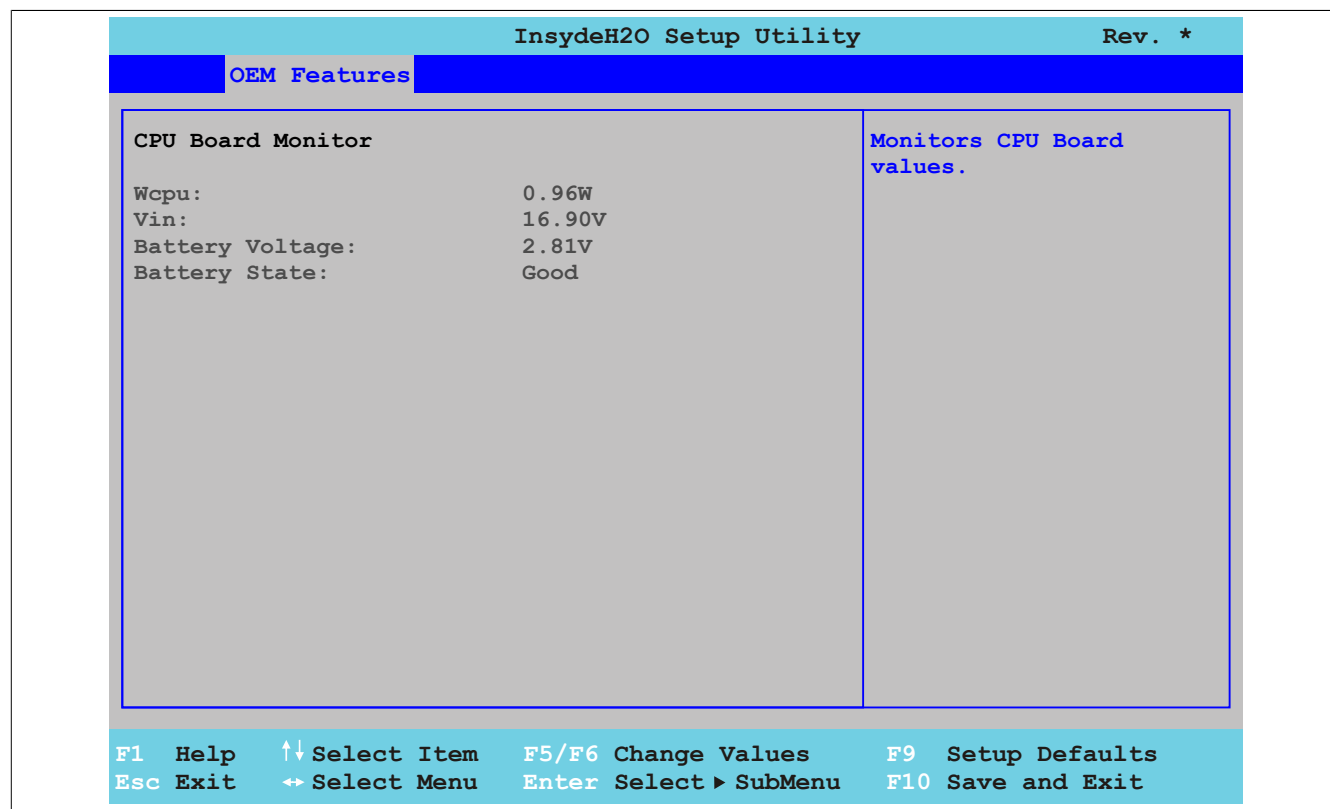


Abbildung 45: US15W OEM Features - CPU Board Features - CPU Board Monitor

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Wcpu:	Anzeige des CPU Leistungsverbrauchs in Watt.	keine	-
Vin:	Anzeige der anliegenden Spannung der Spannungsversorgung in Volt.	keine	-
Battery Voltage:	Anzeige der Batteriespannung in Volt.	keine	-
Battery State:	Anzeige des Batteriestatus.	keine	-

Tabelle 109: US15W OEM Features - CPU Board Features - CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten

1.4.2 System Unit Features

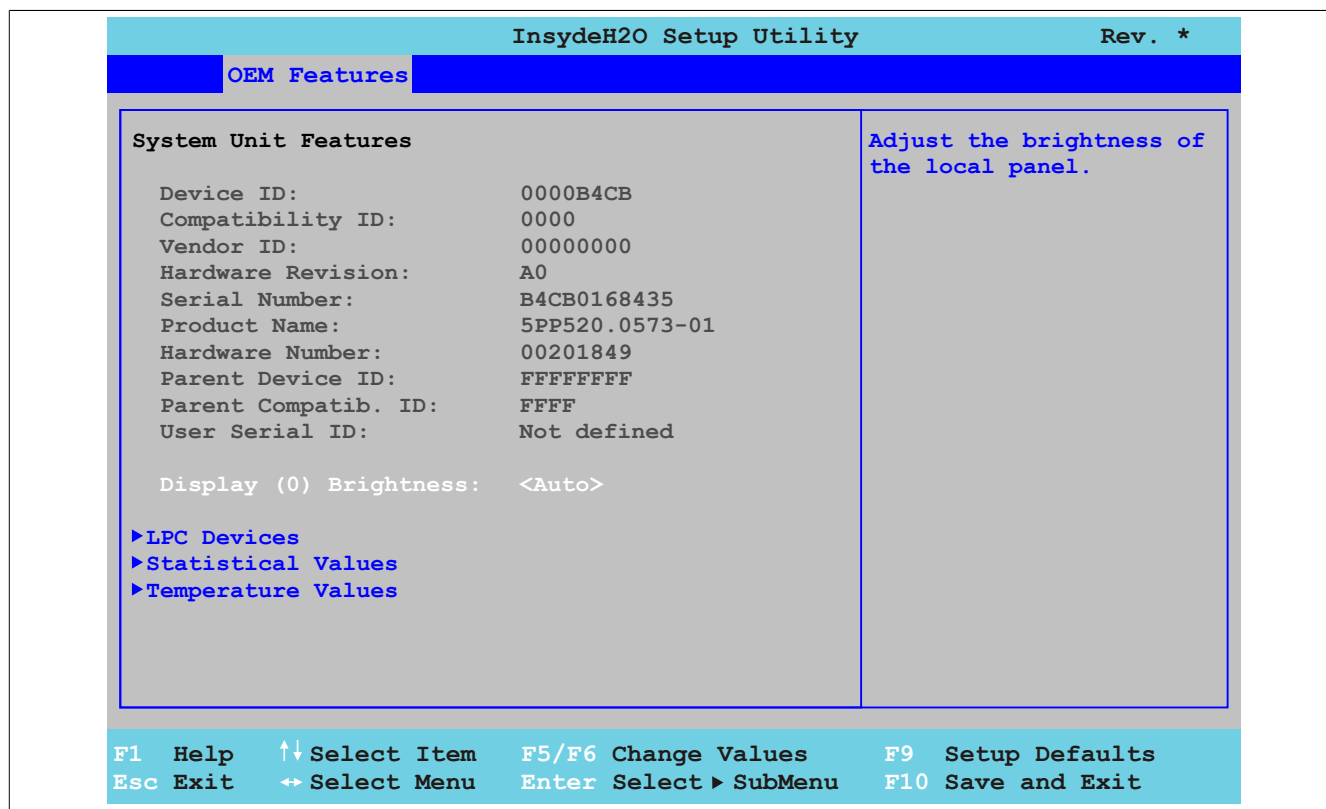


Abbildung 46: US15W OEM Features - System Unit Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Geräteerkennung des Power Panel Gerätes.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Geräteerkennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der Systemeinheit Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der Systemeinheit Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-
Display (0) Brightness ¹⁾	Option zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtungsstärke des Displays.	Auto	Die optimale Helligkeit wird über die Factory Settings automatisch konfiguriert. Dabei wird ein Helligkeitswert zwischen 100% und 0% eingestellt.
		0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Manuelle Einstellung der gewünschten Helligkeit innerhalb der Grenzwerte der Factory Settings.
LPC Devices	Konfiguration der LPC Devices.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "LPC Devices" auf Seite 113
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 114
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 115

Tabelle 110: US15W OEM Features - System Unit Features Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellung ist nur für PP500 Systemeinheiten möglich.

1.4.2.1 LPC Devices

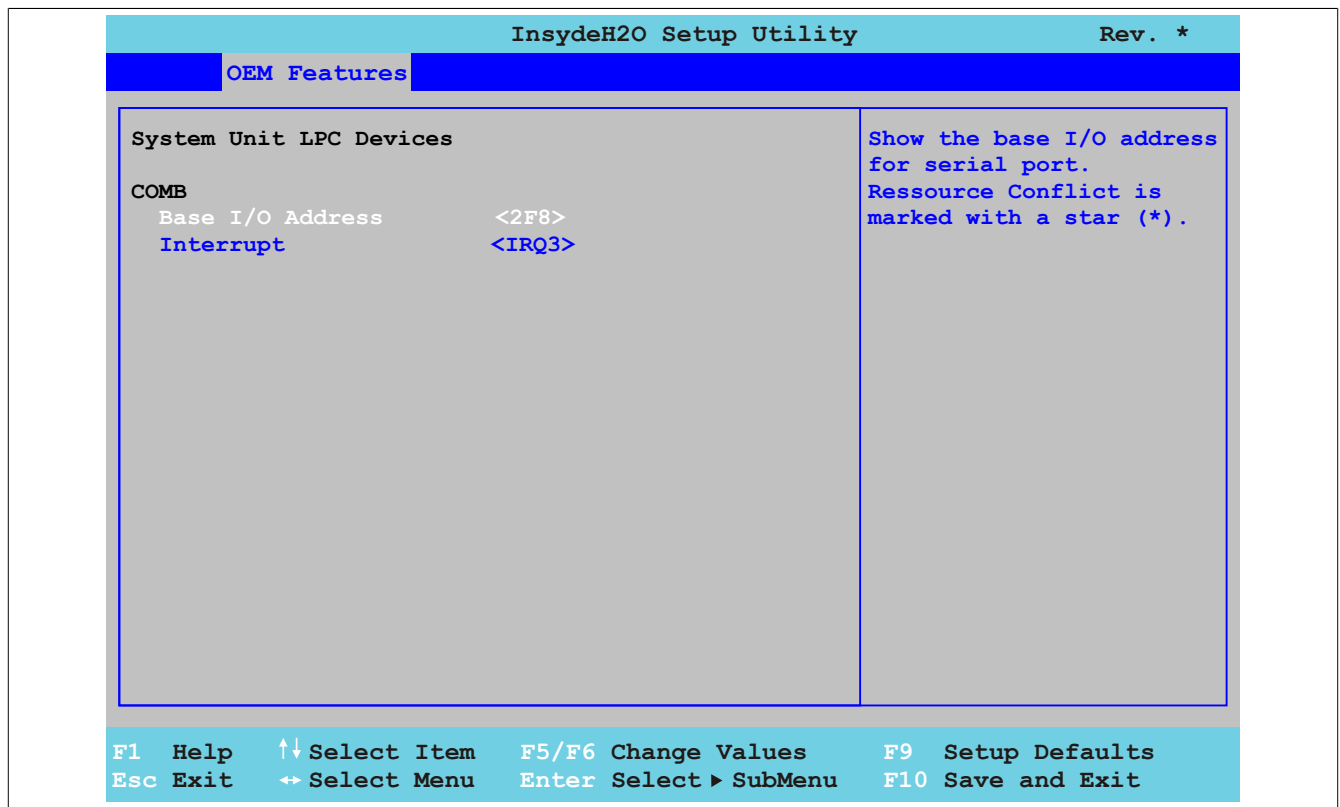


Abbildung 47: US15W OEM Features - System Unit Features - LPC Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COMB	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM im System.	keine	-
Base I/O Address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	Disabeld, 238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Deaktivierung oder Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.

Tabelle 111: US15W OEM Features - System Unit Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten

Information:

Bei den Base I/O Adress oder Interrupt Einstellungen kann es zu einem Ressourcenkonflikt kommen, hierbei wird eine Warnung angezeigt. Um die Einstellungen trotzdem zu ändern, muss zuerst die Einstellung bei der verwendeten Base I/O Adress bzw. dem Interrupt geändert werden.

1.4.2.2 Statistical Values

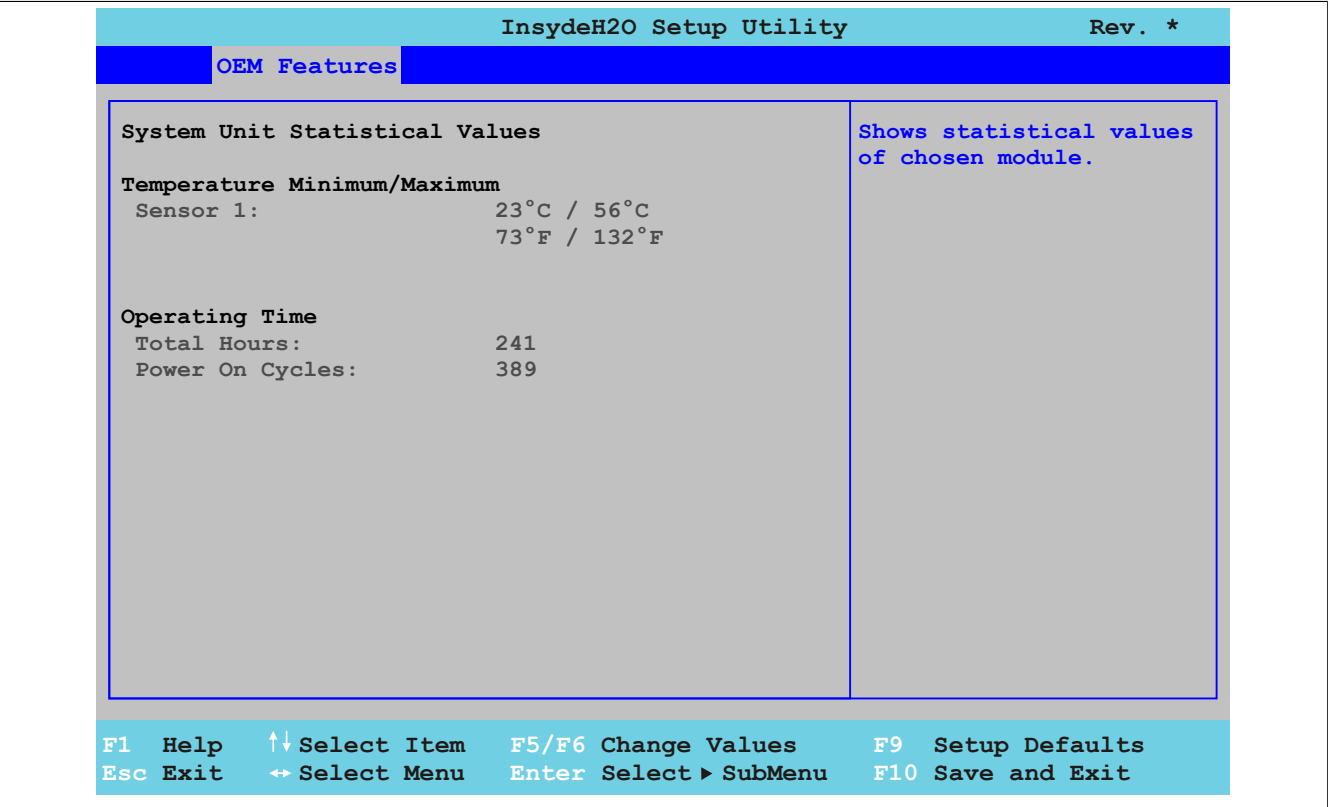


Abbildung 48: US15W OEM Features - System Unit Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 1 in °C und °F.	keine	-
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 112: US15W OEM Features - System Unit Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.2.3 Temperature Values

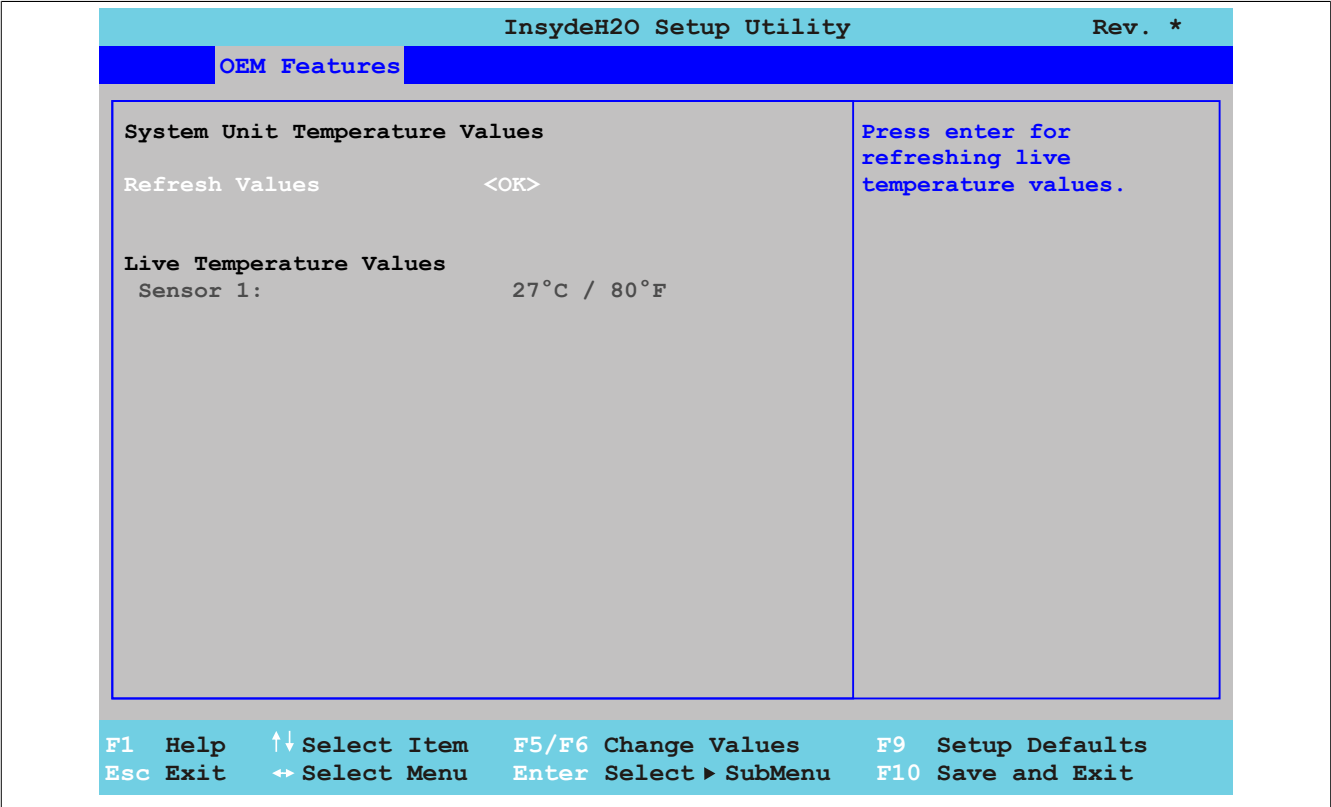


Abbildung 49: US15W OEM Features - System Unit Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Values	Option zum Aktualisieren der Temperaturwerte.	OK	Die unten angezeigten Temperaturwerte werden aktualisiert.
Sensor 1:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 in °C und °F.	keine	-

Tabelle 113: US15W OEM Features - System Unit Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten

1.4.3 I/O Board Features

Information:

Die angezeigten Werte und Einstellungsmenüs können sich je nach gestecktem I/O Board unterscheiden.

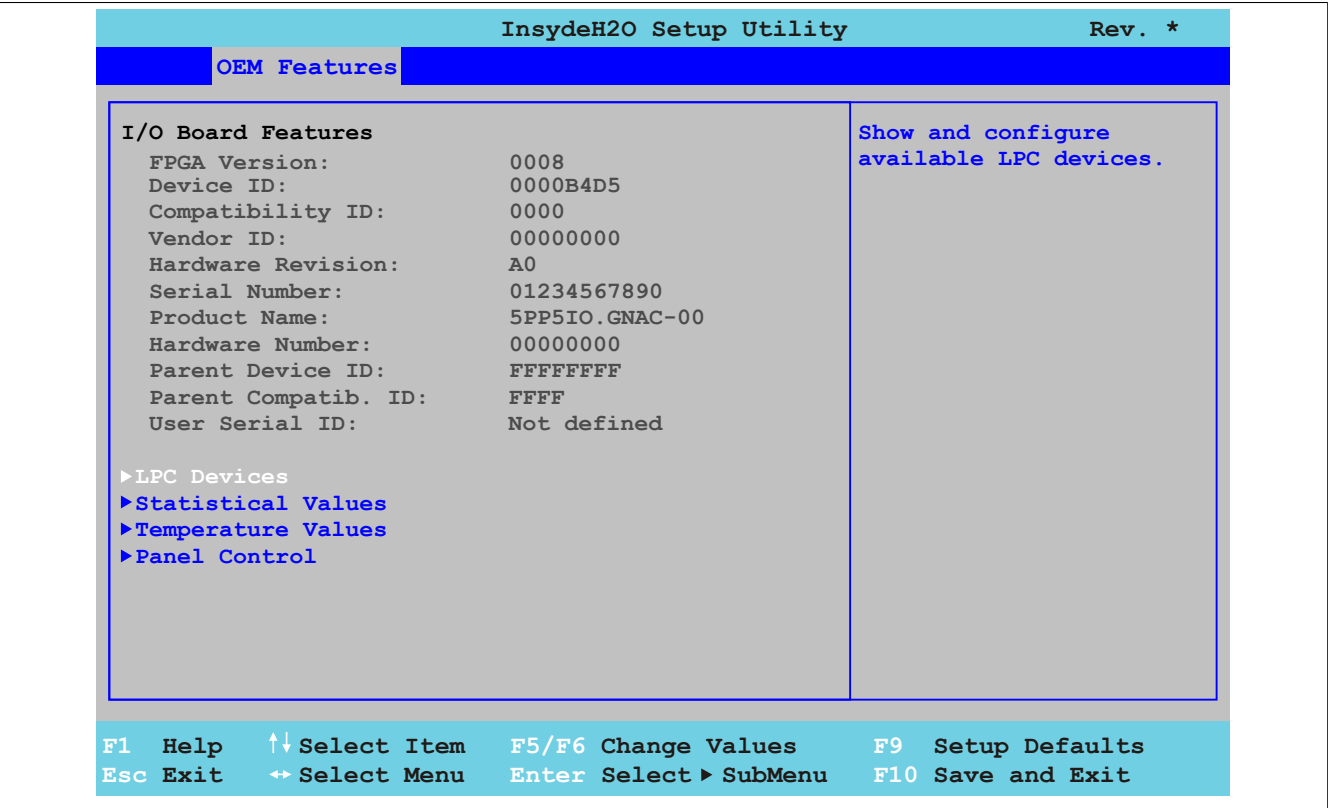


Abbildung 50: US15W OEM Features - I/O Board Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
FPGA Version	Anzeige der FPGA Version des I/O Boards.	keine	-
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des I/O Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der I/O Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der I/O Board Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-
LPC Devices	Konfiguration der LPC Devices.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "LPC Devices" auf Seite 117
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 118
Temperature Values	Anzeige der aktuellen Temperaturwerte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Temperature Values" auf Seite 119
Panel Control	Hier können spezielle Einstellungen für angeschlossene Panel (Displayeinheiten) vorgenommen werden.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Panel Control" auf Seite 120

Tabelle 114: US15W OEM Features - I/O Board Features Einstellmöglichkeiten

1.4.3.1 LPC Devices

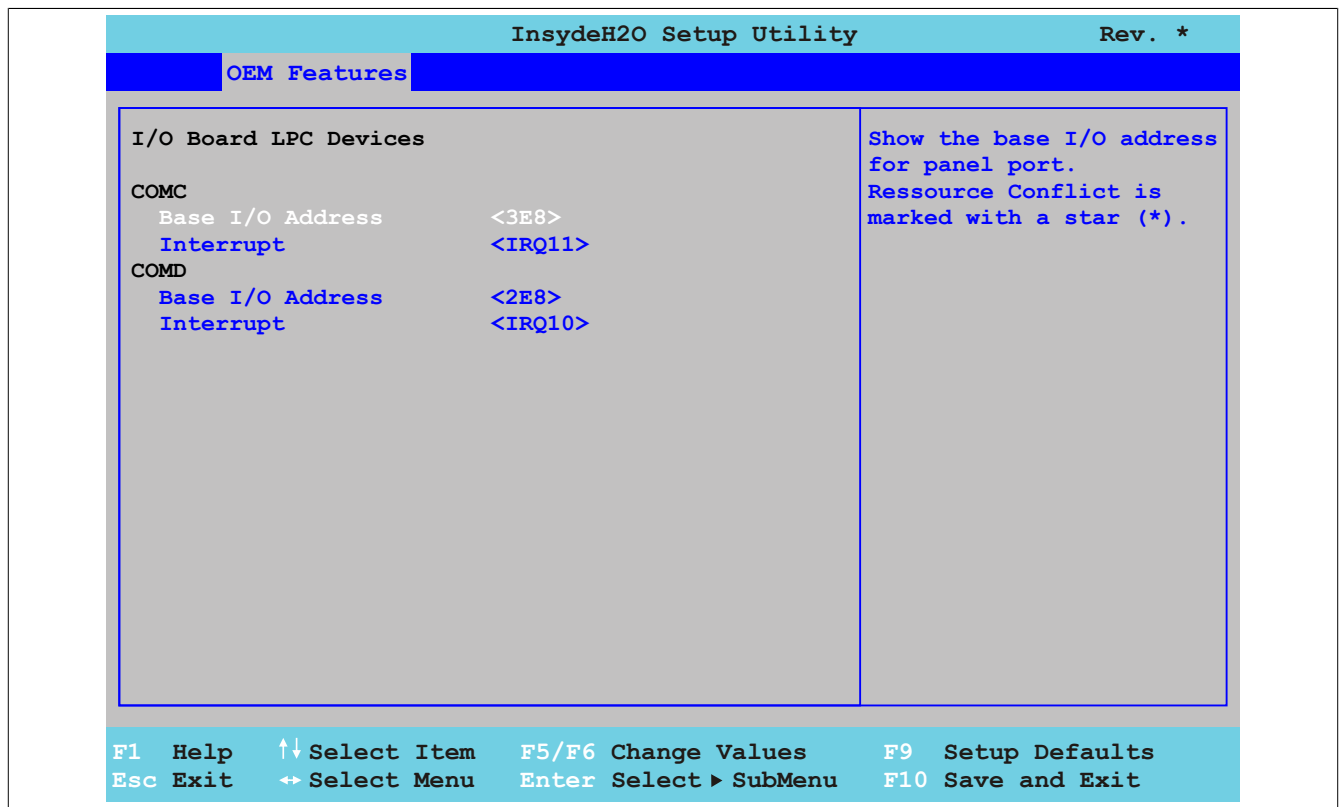


Abbildung 51: US15W OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
COMC	Einstellung für die Panel Schnittstelle am I/O Board.	keine	-
Base I/O Address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	Disabeld, 238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Deaktivierung oder Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.
COMD	Einstellung für die serielle Schnittstelle COM am I/O Board.	keine	-
Base I/O Address	Auswahl der Base I/O Adresse des COM Ports.	Disabeld, 238, 2E8, 2F8, 328, 338, 3E8, 3F8	Deaktivierung oder Zuweisung der ausgewählten Base I/O Adresse.
Interrupt	Auswahl des Interrupts für den COM Port.	IRQ3, IRQ4, IRQ5, IRQ6, IRQ10, IRQ11, IRQ12	Zuweisung des ausgewählten Interrupts.

Tabelle 115: US15W OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten

Information:

Bei den Base I/O Adress oder Interrupt Einstellungen kann es zu einem Ressourcenkonflikt kommen, hierbei wird eine Warnung angezeigt. Um die Einstellungen trotzdem zu ändern, muss zuerst die Einstellung bei der verwendeten Base I/O Adress bzw. dem Interrupt geändert werden.

1.4.3.2 Statistical Values

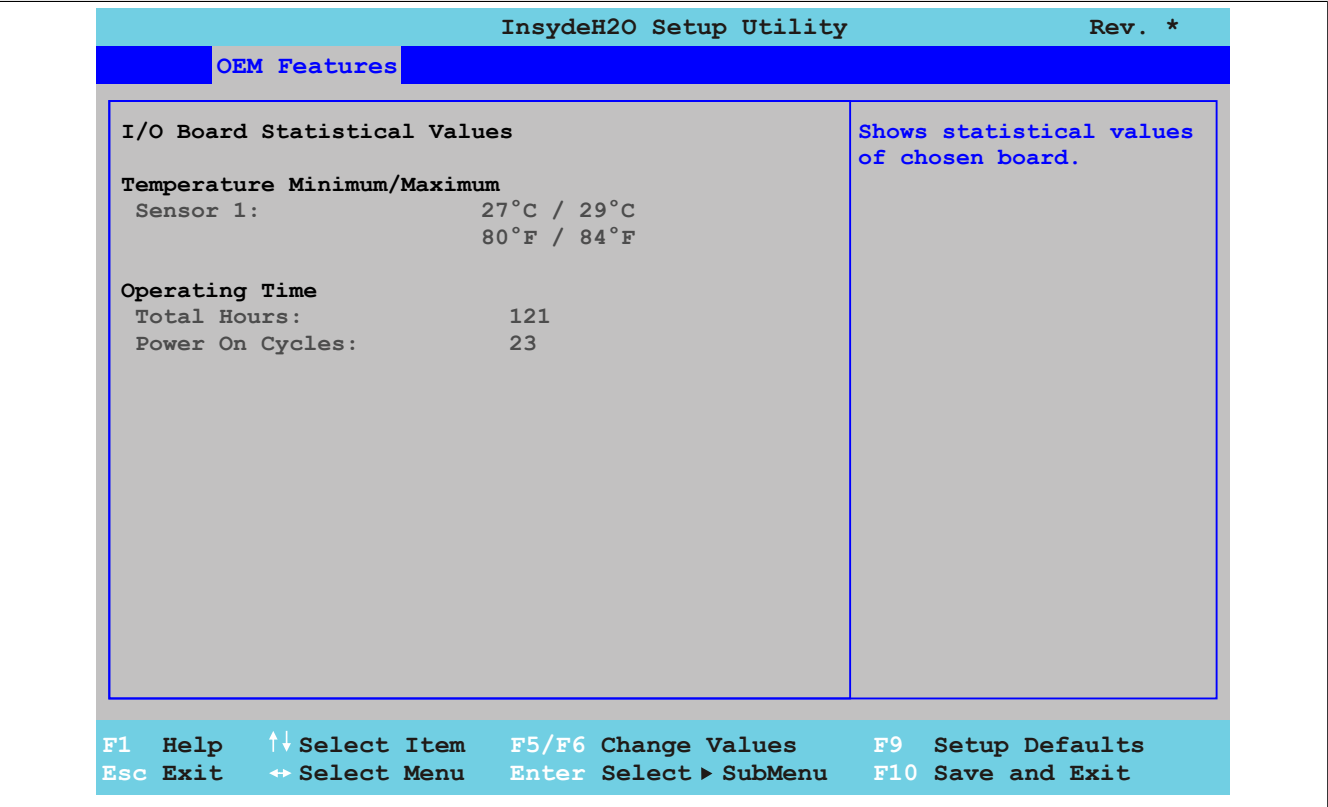


Abbildung 52: US15W OEM Features - I/O Board Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Sensor 1:	Anzeige der minimalen und maximalen Temperatur des Sensors 1 in °C und °F.		
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 116: US15W OEM Features - I/O Board Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.3.3 Temperature Values

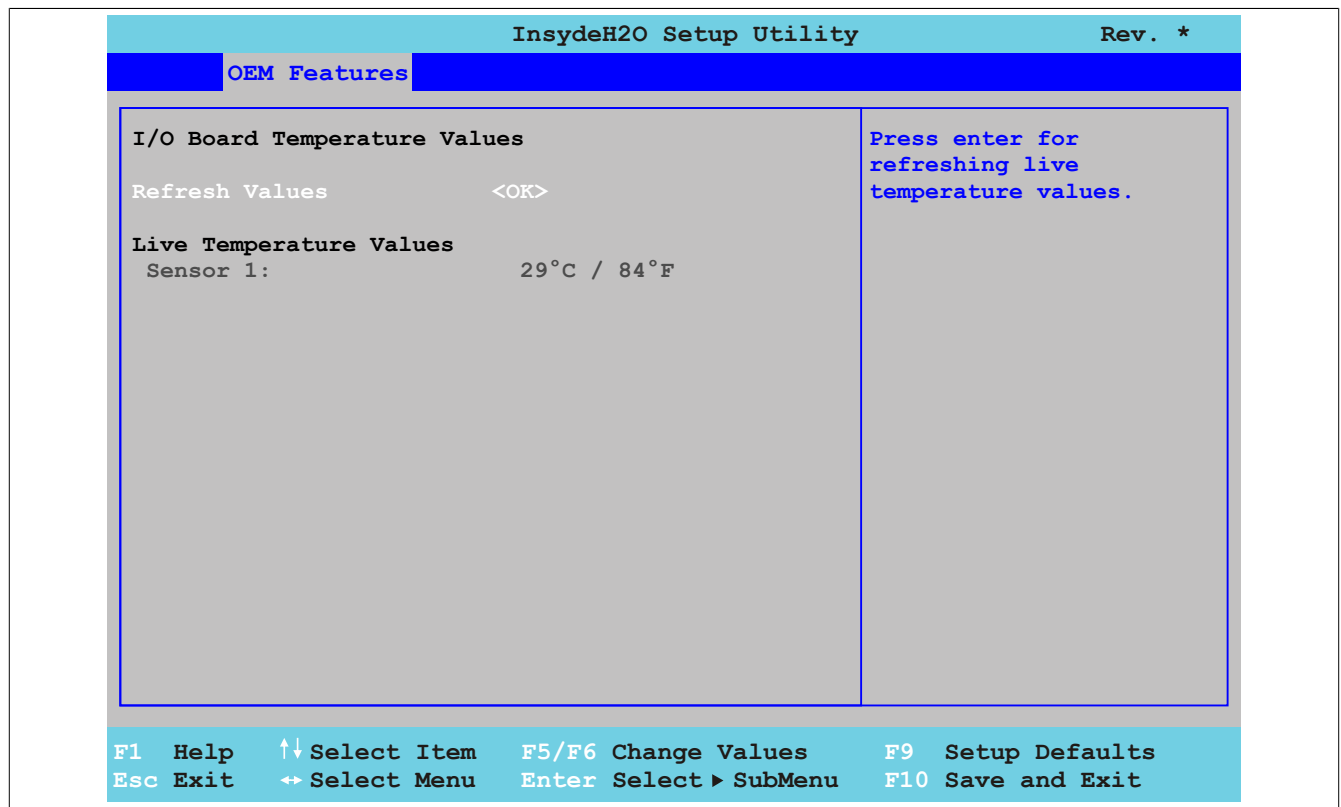


Abbildung 53: US15W OEM Features - I/O Board Features - Temperature Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Values	Option zum Aktualisieren der Temperaturwerte.	OK	Die unten angezeigten Temperaturwerte werden aktualisiert.
Sensor 1:	Anzeige der aktuellen Temperatur des Sensors 1 (Schnittstellen) in °C und °F.	keine	-

Tabelle 117: US15W OEM Features - I/O Board Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten

1.4.3.4 Panel Control

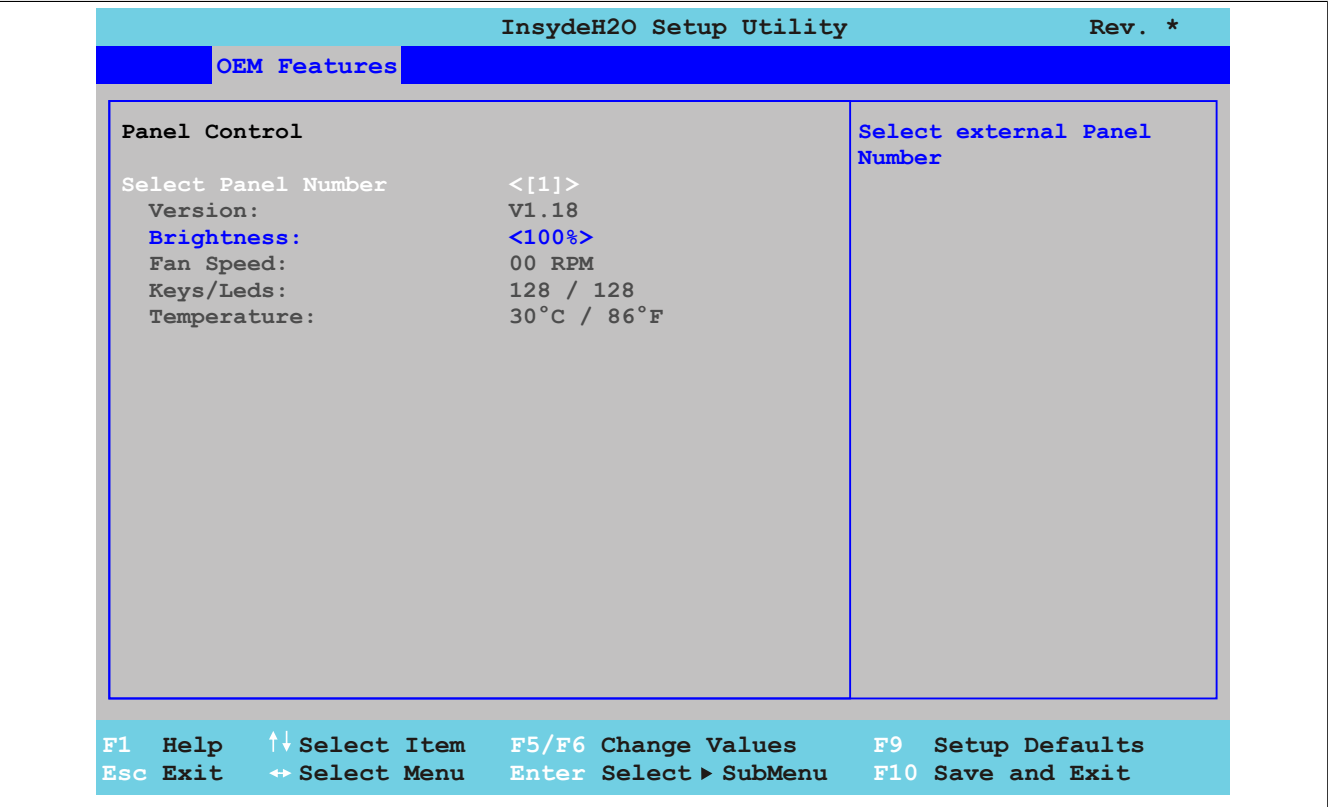


Abbildung 54: US15W OEM Features - I/O Board Features - Panel Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Select Panel Number	Auswahl der Panelnummer, bei dem Werte ausgelesen bzw. geändert werden sollen.	0...15	Panelauswahl 0 ... 15.
Version	Anzeige der Firmwareversion des SDLR Controllers.	keine	-
Brightness	Einstellung der Helligkeit beim ausgewählten Panel.	0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%	Einstellung der Helligkeit in % beim ausgewählten Panel. Wird erst beim Speichern und Neustart des Systems wirksam (z.B. durch Drücken von <F10>).
Fan Speed	Anzeige der Lüfterumdrehungen des ausgewählten Panels.	keine	-
Keys/Leds	Anzeige der vorhandenen Tasten und LEDs des ausgewählten Panels.	keine	-
Temperature	Temperaturanzeige des ausgewählten Panels in °C und °F.	keine	-

Tabelle 118: US15W OEM Features - I/O Board Features - Panel Control Einstellmöglichkeiten

1.4.4 IF Board Features

Information:

Die angezeigten Werte und Einstellungsmenüs können sich je nach gesteckter Interface Karte unterscheiden.

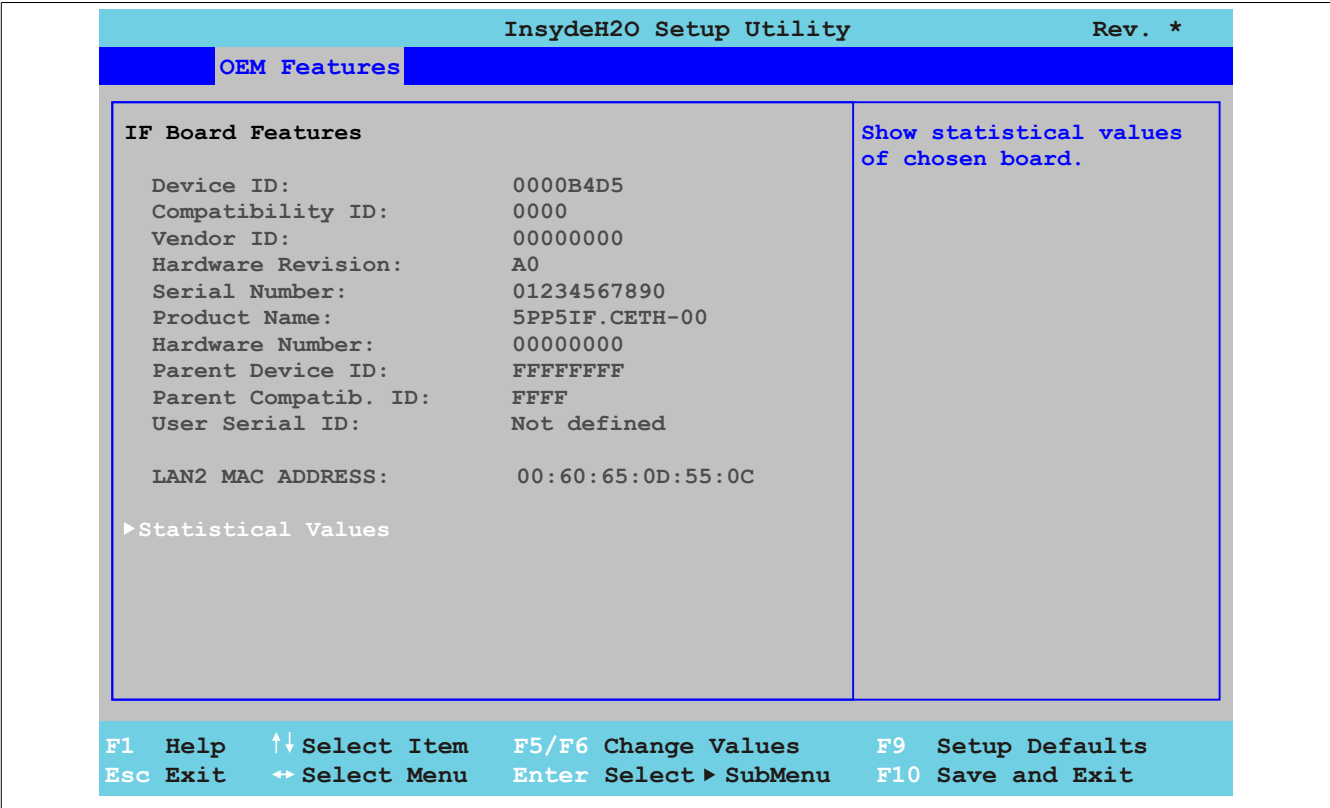


Abbildung 55: US15W OEM Features - IF Board Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des IF Boards.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der IF Board Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der IF Board Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-
LAN2 MAC ADDRESS ¹⁾	Anzeige der vergebenen MAC Adresse der ETH Schnittstelle.	keine	-
Statistical Values	Anzeige der statistischen Werte.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Statistical Values" auf Seite 122

Tabelle 119: US15W OEM Features - IF Board Features Einstellmöglichkeiten

1) Die LAN2 MAC ADDRESS wird nur bei dem Interface Board 5PP5IF.CETH-00 angezeigt.

1.4.4.1 Statistical Values

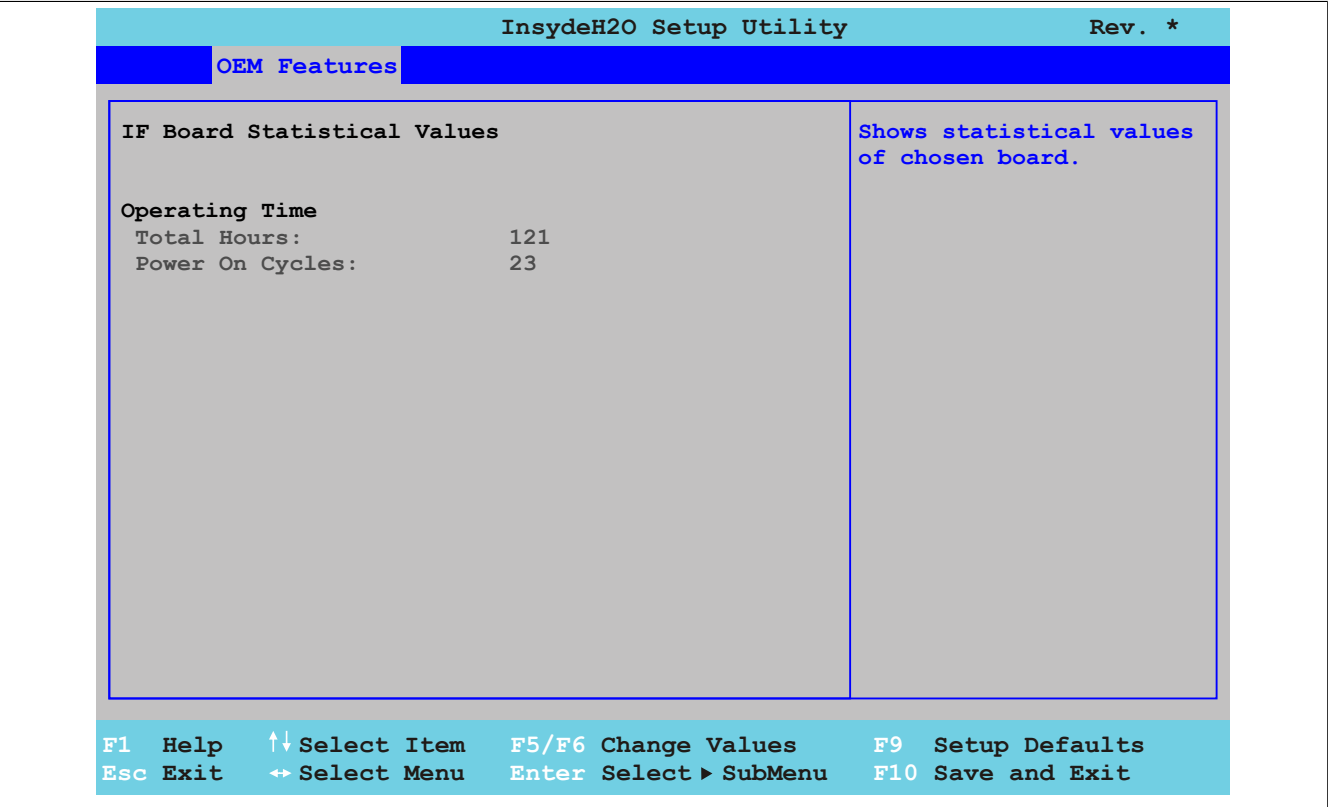


Abbildung 56: US15W OEM Features - IF Board Features - Statistical Values

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Total Hours	Anzeige der Laufzeit in ganzen Stunden.	keine	-
Power On Cycles	Anzeige der Power On Cycles - jeder Neustart erhöht den Zähler um Eins.	keine	-

Tabelle 120: US15W OEM Features - IF Board Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten

1.4.5 Memory Module Features

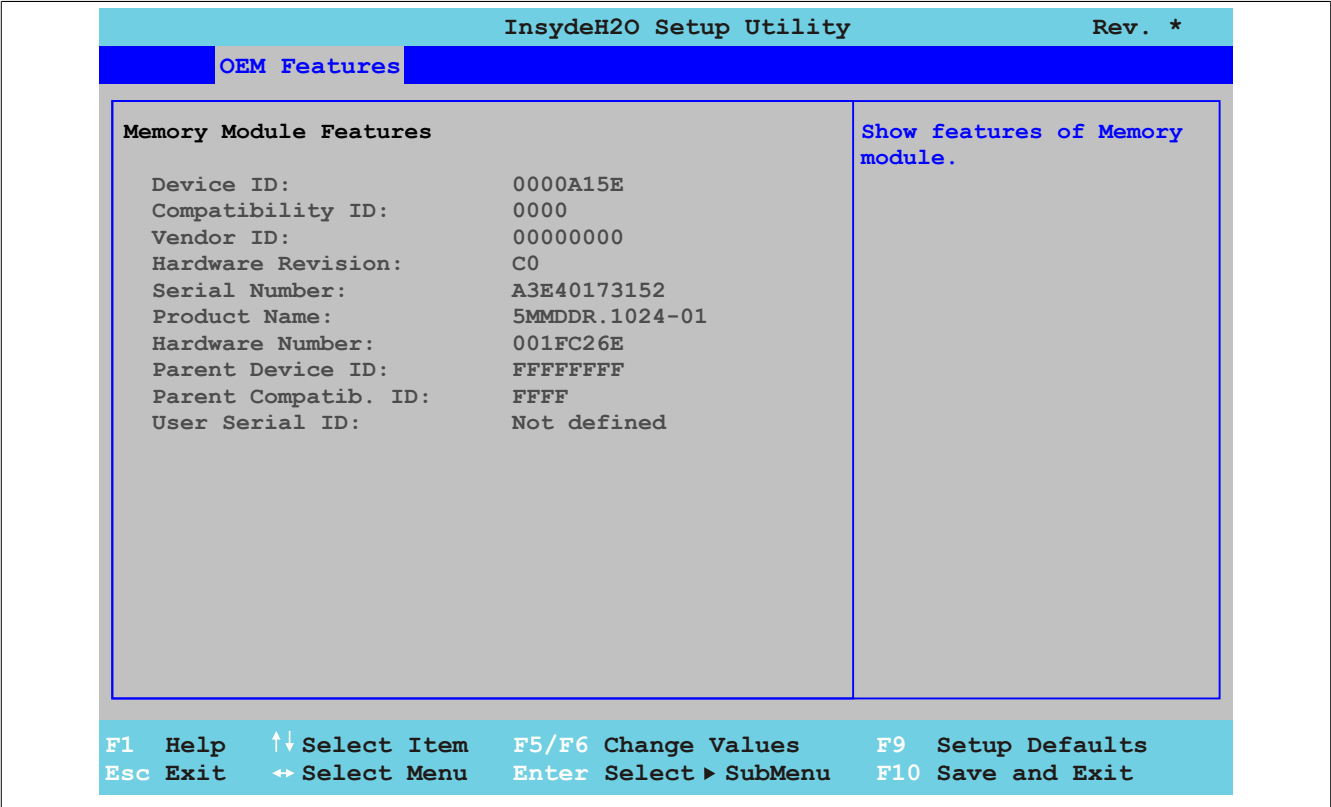


Abbildung 57: US15W OEM Features - Memory Module Features

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Device ID	Anzeige der Gerätekennung des RAM.	keine	-
Compatibility ID	Zeigt die Version des Gerätes innerhalb der gleichen B&R Gerätekennung an. Diese ID wird für das Automation Runtime benötigt.	keine	-
Vendor ID	Anzeige der Hersteller ID.	keine	-
Hardware Revision	Anzeige der Hauptspeicher Hardware Revision.	keine	-
Serial Number	Anzeige der B&R Seriennummer.	keine	-
Product Name	Anzeige der B&R Bestellnummer.	keine	-
Hardware Number	Anzeige der Hauptspeicher Hardwarenummer.	keine	-
Parent Device ID	Anzeige der Herstellernummer.	keine	-
Parent Compatib. ID	Anzeige der Hersteller-ID.	keine	-
User Serial ID	Anzeige der User Serial ID. Dieser 8-stellige Hexwert steht dem Anwender frei zur Verfügung (um z.B. bei dem Gerät eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen) und kann nur mit dem bei B&R erhältlichen „B&R Control Center“ über den ADI Treiber verändert werden.	keine	-

Tabelle 121: US15W OEM Features - Memory Module Features Einstellmöglichkeiten

1.5 Advanced

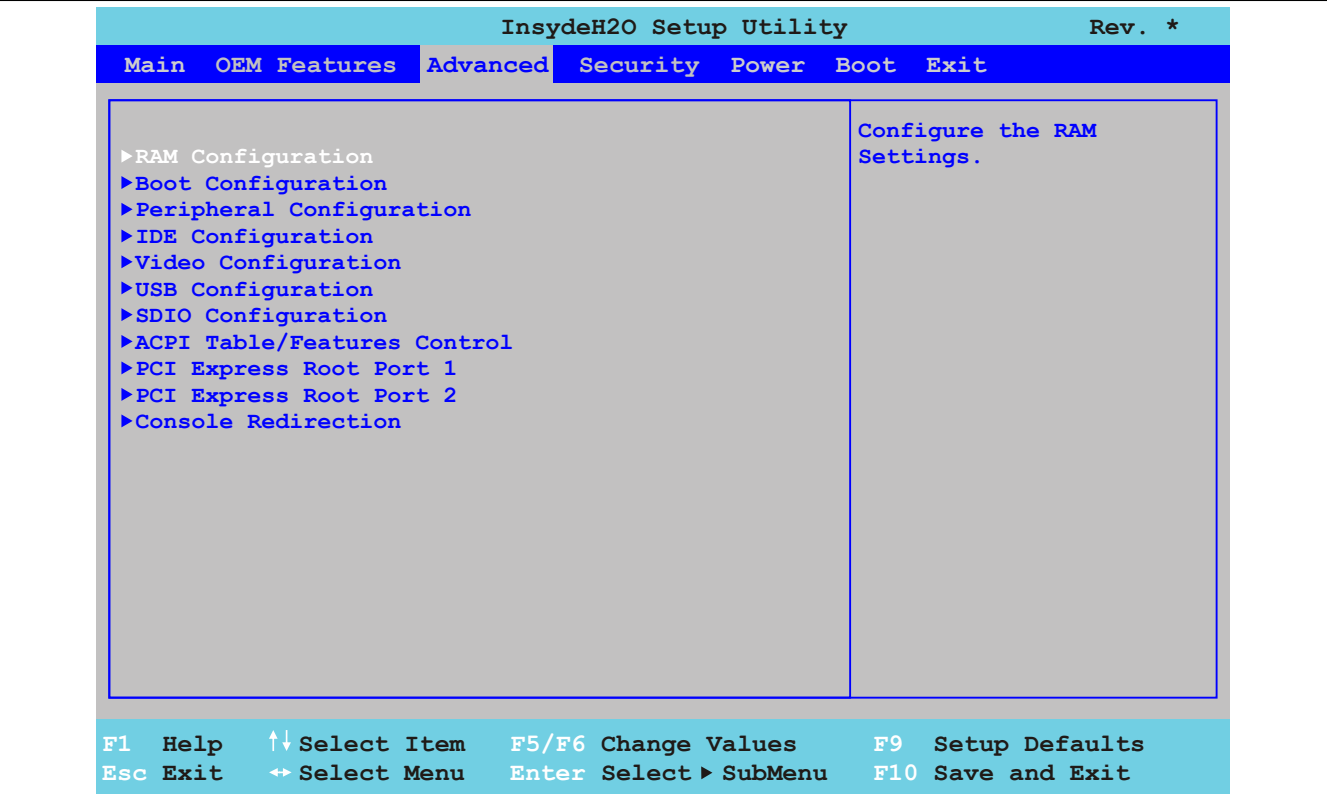


Abbildung 58: US15W Advanced - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
RAM Configuration	Konfiguration der RAM Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "RAM Configuration" auf Seite 125
Boot Configuration	Konfiguration der Boot Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Boot Configuration" auf Seite 126
Peripheral Configuration ¹⁾	Konfiguration der Peripherie Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Peripheral Configuration" auf Seite 127
IDE Configuration	Konfiguration der IDE Funktionen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "IDE Configuration" auf Seite 128
Video Configuration	Konfiguration der Grafikeinstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Video Configuration" auf Seite 131
USB Configuration	Konfiguration der USB Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB Configuration" auf Seite 132
SDIO Configuration ²⁾	Konfiguration der SDIO Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "SDIO Configuration" auf Seite 133
ACPI Table/Features Control Configuration	Konfiguration der ACPI Tabelle/Features.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "ACPI Table/Features Control" auf Seite 134
PCI Express Root Port 1	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 1. Warnung! Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port 1" auf Seite 134

Tabelle 122: US15W Advanced - Menü Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Root Port 2	Konfiguration der PCI Express Einstellungen am Port 2. Warnung! Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "PCI Express Root Port 2" auf Seite 137
Console Redirection ³⁾	Konfiguration der Remote Console.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Console Redirection" auf Seite 139

Tabelle 122: US15W Advanced - Menü Einstellmöglichkeiten

- 1) Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn ein Audio Anschluss vorhanden ist.
 2) SDIO - Secure Digital Input Output
 3) Diese Einstellungen sind nur für Automation PC 511 Systemeinheiten ohne I/O Board sichtbar. Die Mode/Node Schalter müssen auf "00" (default) eingestellt sein.

1.5.1 RAM Configuration

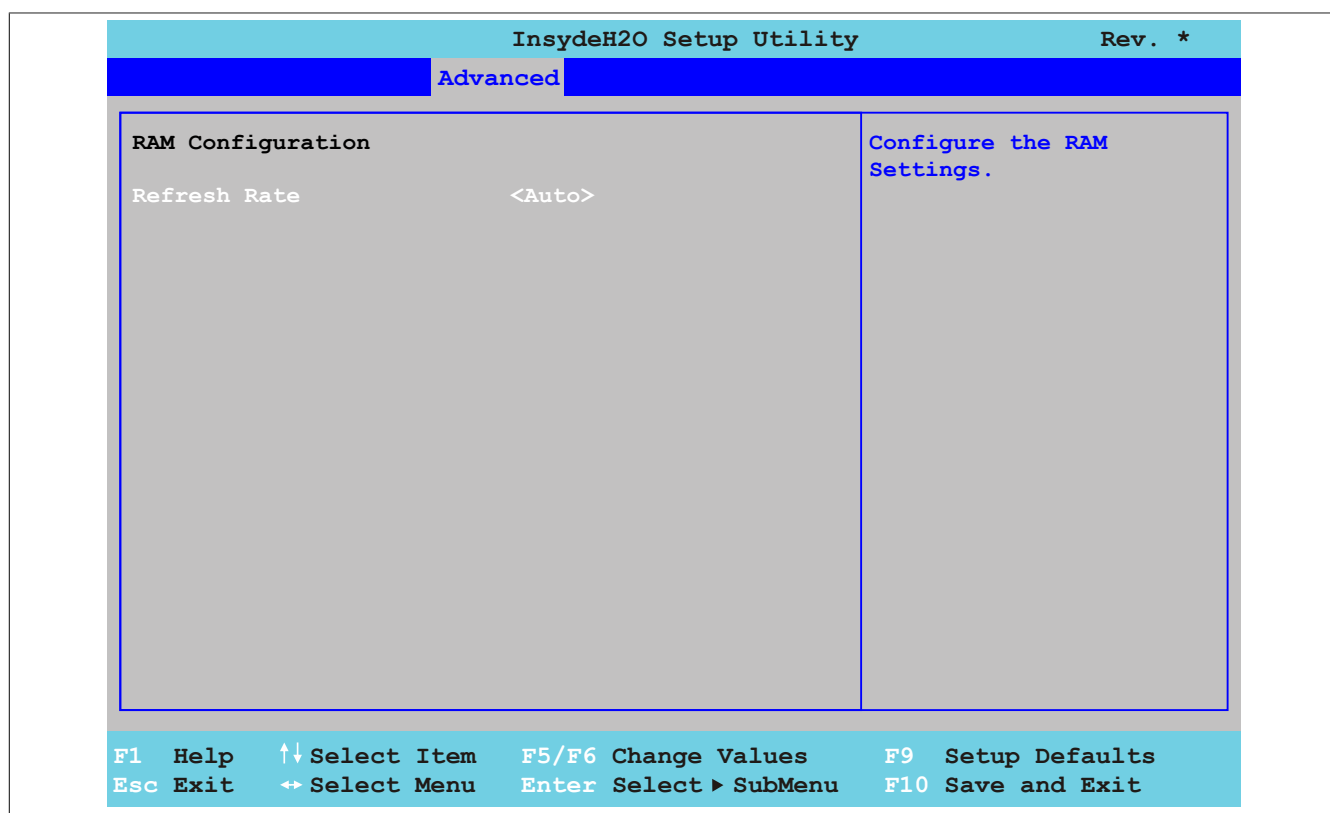


Abbildung 59: US15W Advanced - RAM Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Refresh Rate	Option zum Einstellen der DRAM Refresh Rate.	Auto	DRAM Refresh Rate wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen.
		7,8µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.
		3,9µs	Manuelle Einstellung der DRAM Refresh Rate.

Tabelle 123: US15W Advanced - RAM Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.2 Boot Configuration

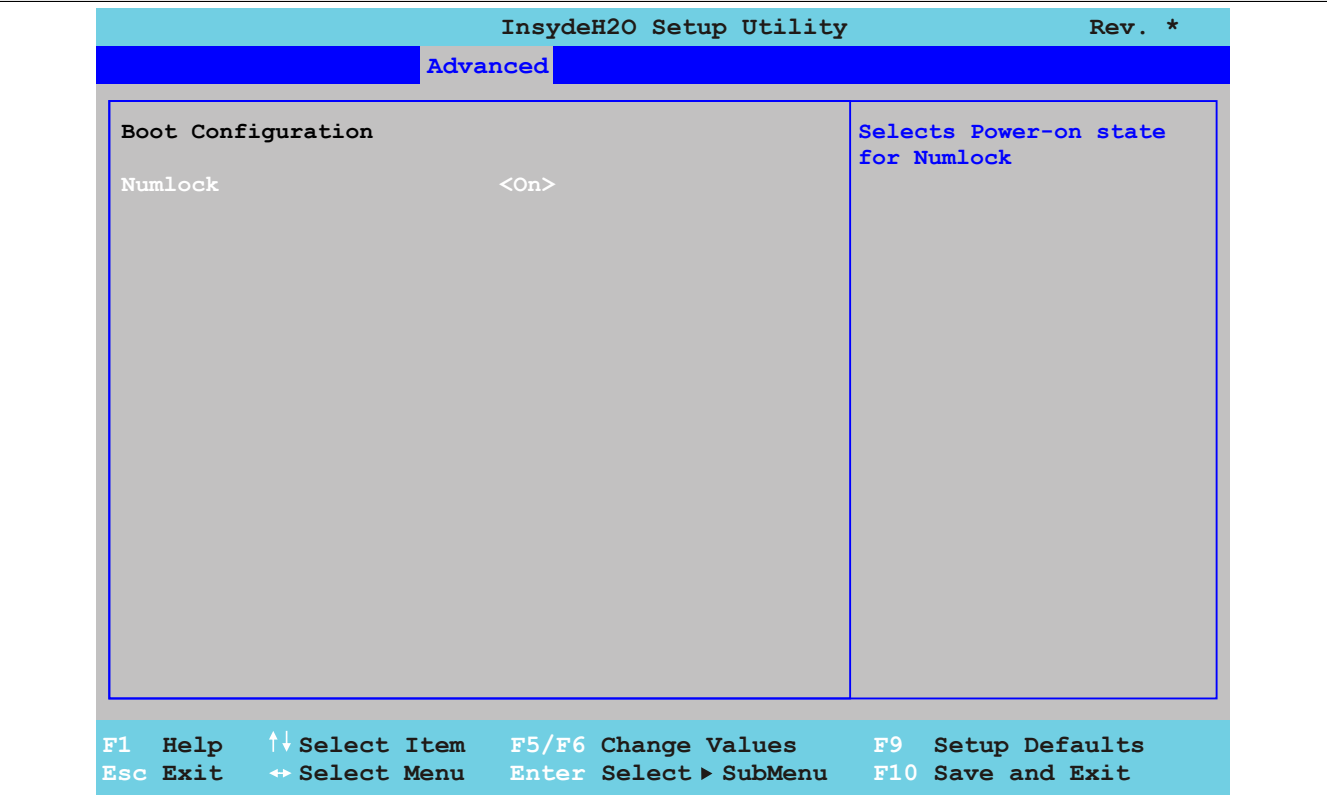


Abbildung 60: US15W Advanced - Boot Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Numlock	Mit diesem Feld kann man den Zustand der Zeh- nertastatur (NumLock) beim Booten des Systems definieren.	On	Numerischer Tastenblock ist aktiviert.
		Off	Vom numerischen Tastenblock sind lediglich die Cursorfunktionen aktiviert.

Tabelle 124: US15W Advanced - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.3 Peripheral Configuration

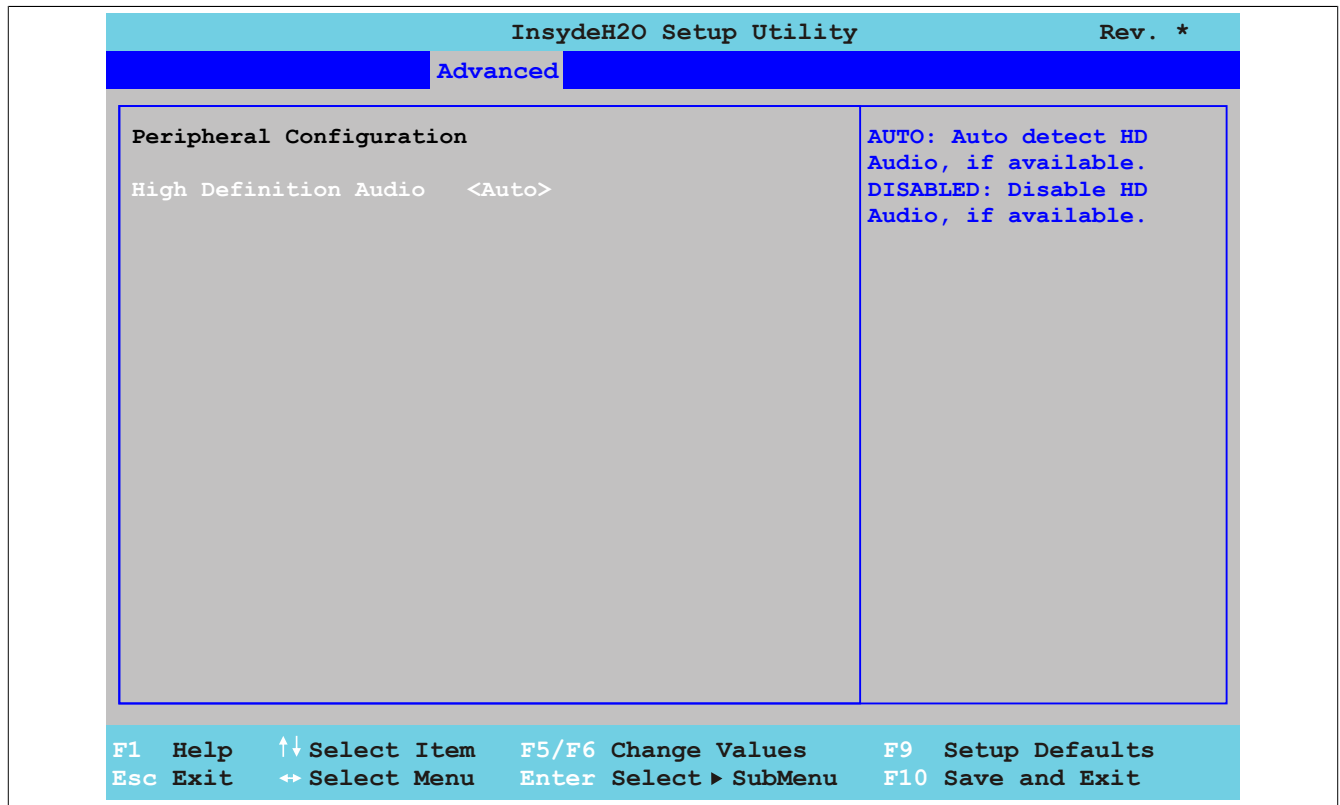


Abbildung 61: US15W Advanced - Peripheral Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
High Definition Audio	Hier kann der Audio Modus Support ein- bzw. ausgeschaltet werden.	Disabled	Deaktivierung des Audio Controllers.
		Auto	Aktivierung des High Definition Audio (HDA) Sound. Der HDA Controller erkennt automatisch installierte Soundgeräte.

Tabelle 125: US15W Advanced - Peripheral Configuration Einstellmöglichkeiten

Information:

Der Menüpunkt "Peripheral Configuration" wird nur angezeigt, wenn ein Audio Anschluss vorhanden ist.

1.5.4 IDE Configuration

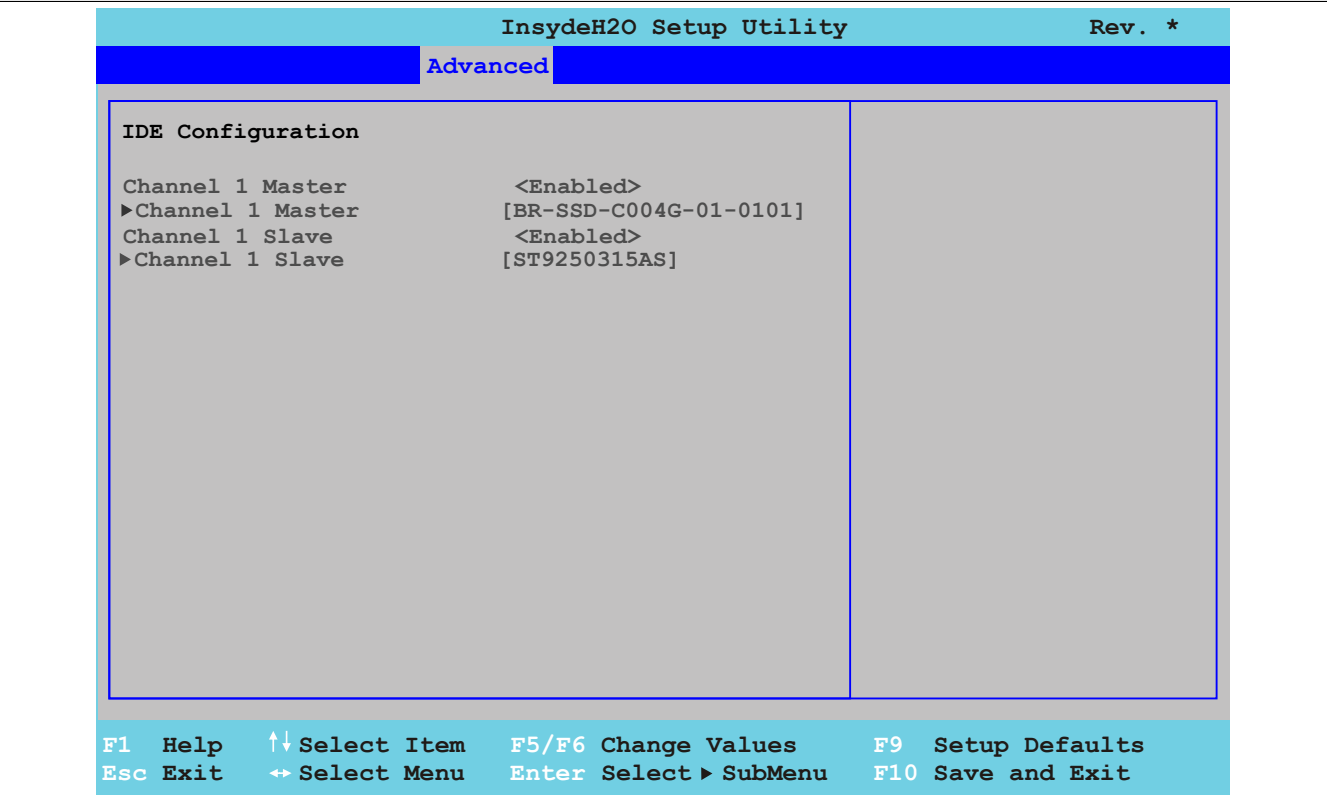


Abbildung 62: US15W Advanced - IDE Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Channel 1 Master	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des vorhandenen Laufwerks, welches am Channel 1 Master angeschlossen ist.	Disabled	Massenspeicher wird deaktiviert
		Enabled	Massenspeicher wird aktiviert
Channel 1 Master	Anzeige des im System vorhandenen Laufwerks, welches am Channel 1 Master angeschlossen ist.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Channel 1 Master" auf Seite 129
Channel 1 Slave	Option zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des vorhandenen Laufwerks, welches am Channel 1 Slave angeschlossen ist.	Disabled	Massenspeicher wird deaktiviert
		Enabled	Massenspeicher wird aktiviert
Channel 1 Slave	Anzeige des im System vorhandenen Laufwerks, welches am Channel 1 Slave angeschlossen ist.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Channel 1 Slave" auf Seite 130

Tabelle 126: US15W Advanced - IDE Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.4.1 Channel 1 Master

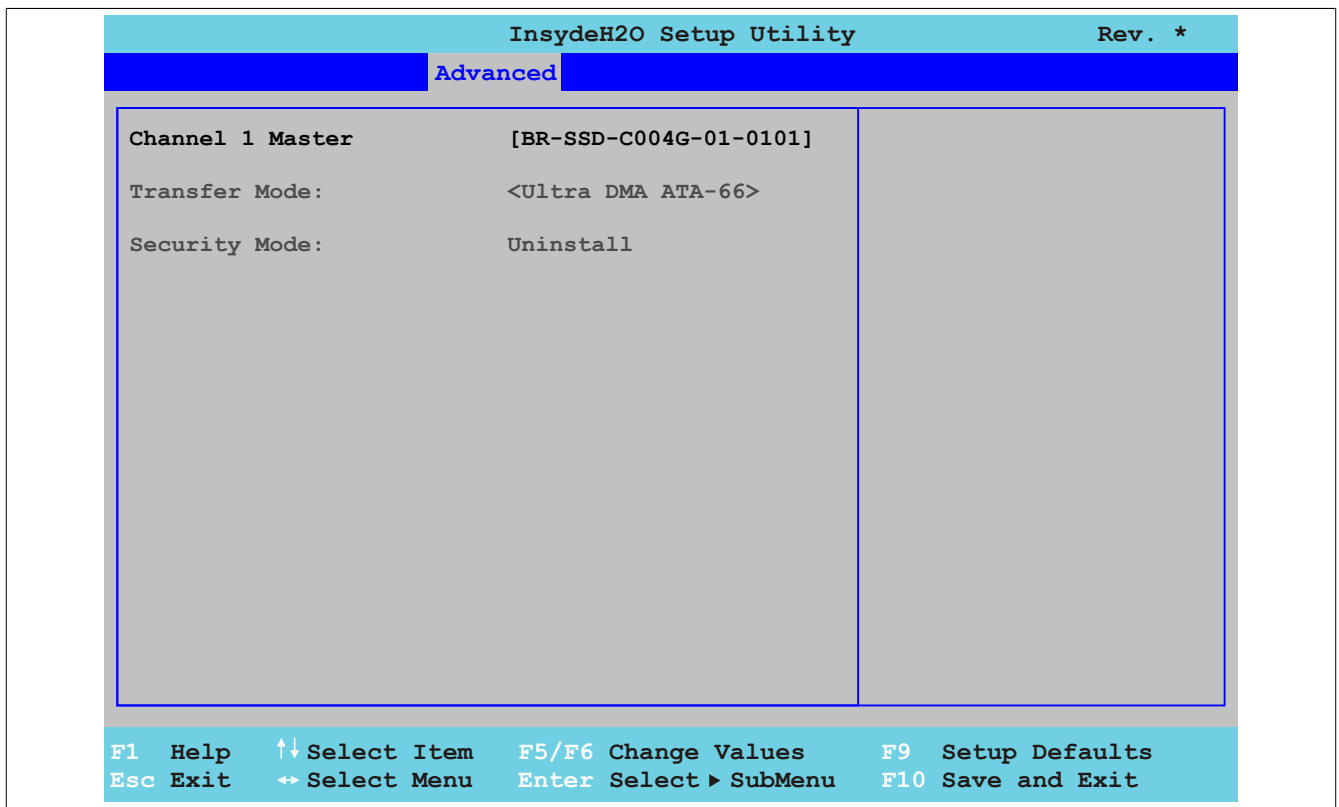


Abbildung 63: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Transfer Mode	Anzeige des Übertragungsstandards des Channel 1 Master Laufwerks zum System Speicher.	keine	-
Security Mode		keine	-

Tabelle 127: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master Einstellmöglichkeiten

1.5.4.2 Channel 1 Slave

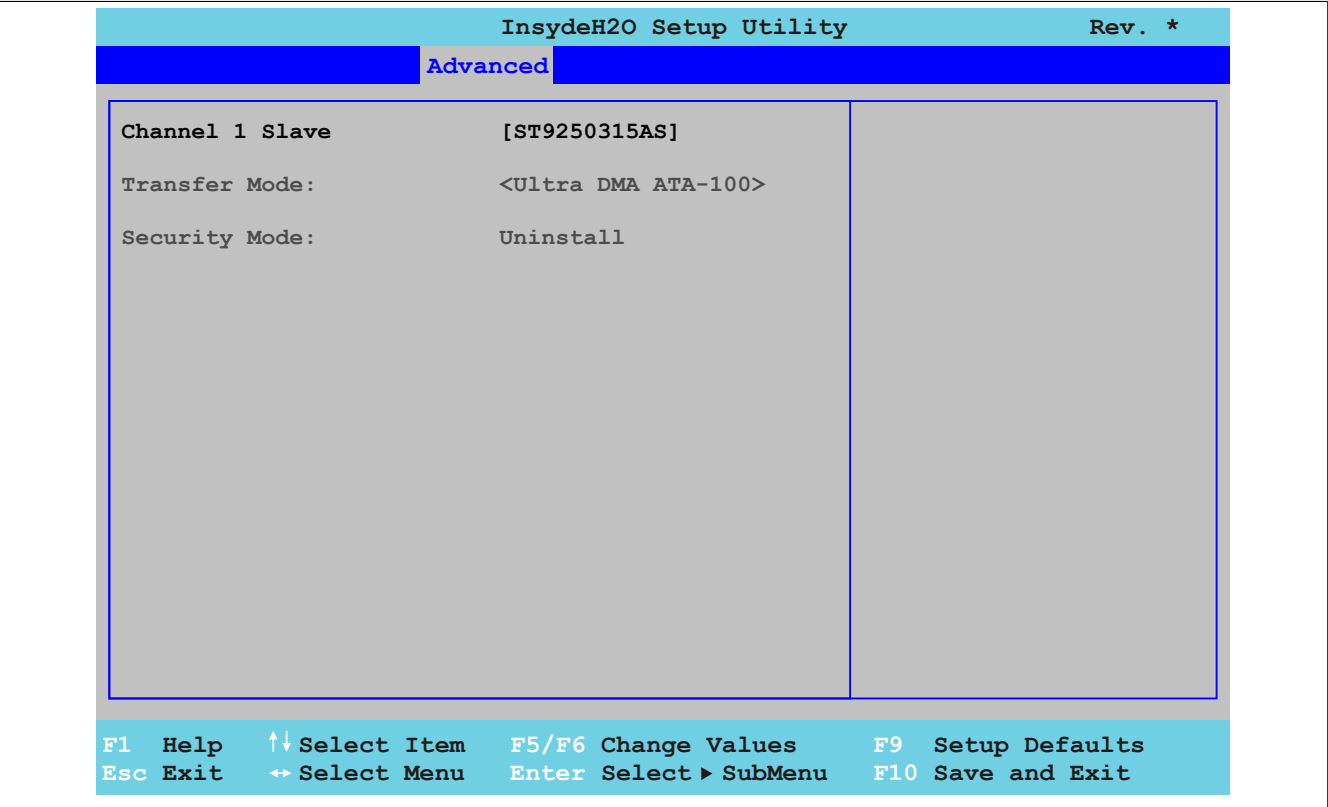


Abbildung 64: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Transfer Mode	Anzeige des Übertragungsstandards des Channel 1 Slave Laufwerks zum System Speicher.	keine	-
Security Mode		keine	-

Tabelle 128: US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave Einstellmöglichkeiten

1.5.5 Video Configuration

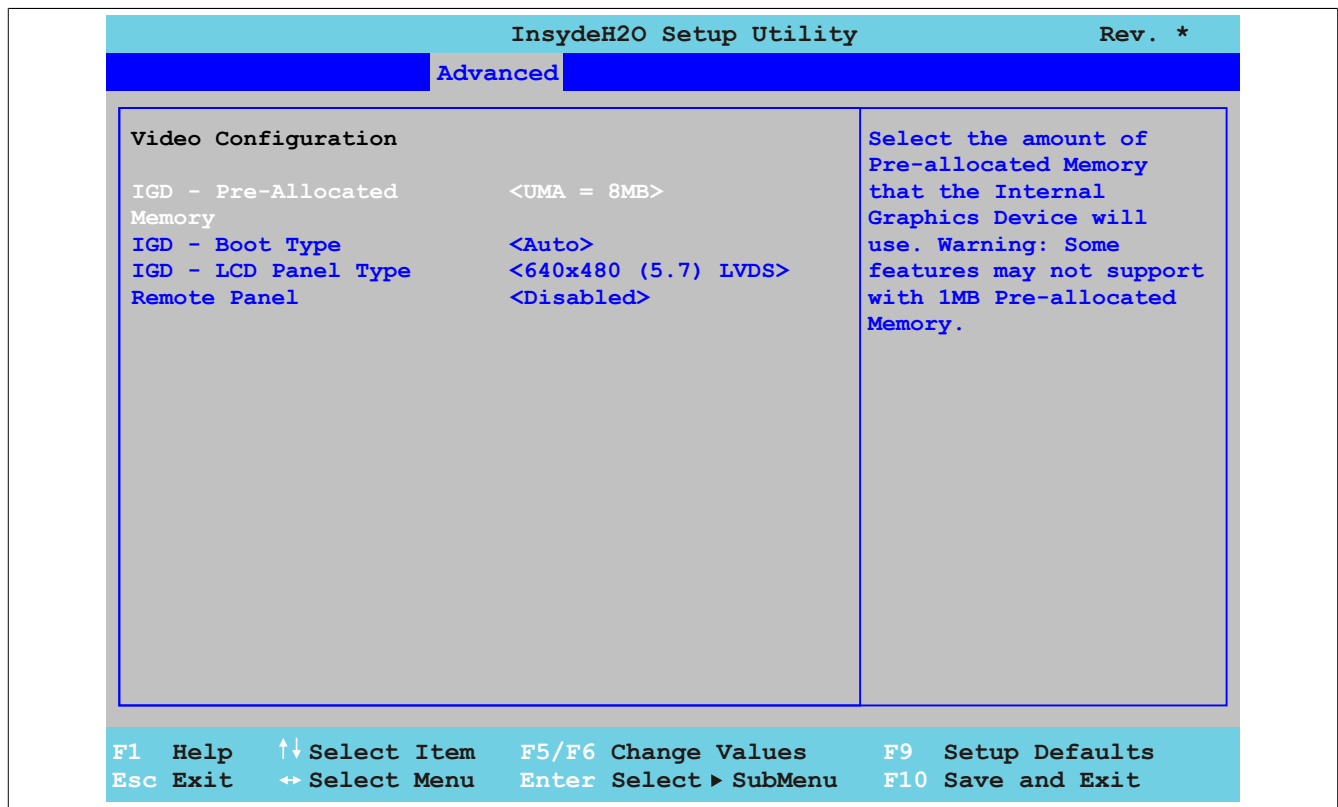


Abbildung 65: US15W Advanced - Video Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
IGD - Pre-Allocated Memory	Option zur Einstellung der Speichergröße, welche für den internen Grafikcontroller verwendet werden kann. Information: Manche Funktionen werden mit der Einstellung "UMA = 1MB" nicht unterstützt.	UMA = 1MB	1 MByte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		UMA = 4MB	4 MByte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
		UMA = 8MB	8 MByte Hauptspeicher wird zur Verfügung gestellt.
IGD - Boot Type	Option zum Festlegen des aktivierten Panels während des POST.	Auto	Es wird automatisch eines der unter "IGD - LCD Panel Type" gelisteten Panels ausgewählt.
		LFP(LVDS)	Das POST wird am Display des Power Panel 500 (LFP = Local Flat Panel) angezeigt.
		EFP(SDL or DVI)	Das POST wird am extern angeschlossenen Panel (EFP = External Flat Panel) angezeigt.
IGD - LCD Panel Type ¹⁾	Option zur Einstellung der Displayauflösung. Information: Ist die Displayeinstellung in den EPROM Daten vorhanden, hat die diese Einstellung keine Auswirkung auf die Displayauflösung da bei jedem Neustart die EPROM Daten neu geladen werden und die BIOS-Einstellung überschrieben wird.	640x480 (5.7) LVDS	Auflösung mit 640 x 480 Pixel (für 5,7" Display)
		800x480 (7.0) LVDS	Auflösung mit 800 x 480 Pixel (für 7" Display)
		800x600 (8.4) LVDS	Auflösung mit 800 x 600 Pixel (für 8,4" Display)
		640x480 (10.4) LVDS	Auflösung mit 640 x 480 Pixel (für 10,4" Display)
		800x600 (12.0) LVDS	Auflösung mit 800 x 600 Pixel (für 12,0" Display)
		1024x768 (15.0) LVDS	Auflösung mit 1024 x 768 Pixel (für 15" Display)
Remote Panel ²⁾	Option zum remotesteuern des Geräts (ohne angeschlossenen Display) mit einem anderen PC über die Ethernet Schnittstelle. Somit können BIOS Einstellungen vorgenommen werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 129: US15W Advanced - Video Configuration Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellung ist nur für PP500 Systemeinheiten möglich.
 2) Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn ein I/O Board verbaut ist. Ist ein Display angeschlossen oder ein Display verbaut, so ist die Option nicht sichtbar. Bei APC511 Systemeinheiten ist sie auch sichtbar, wenn kein I/O Board verbaut ist.

1.5.6 USB Configuration

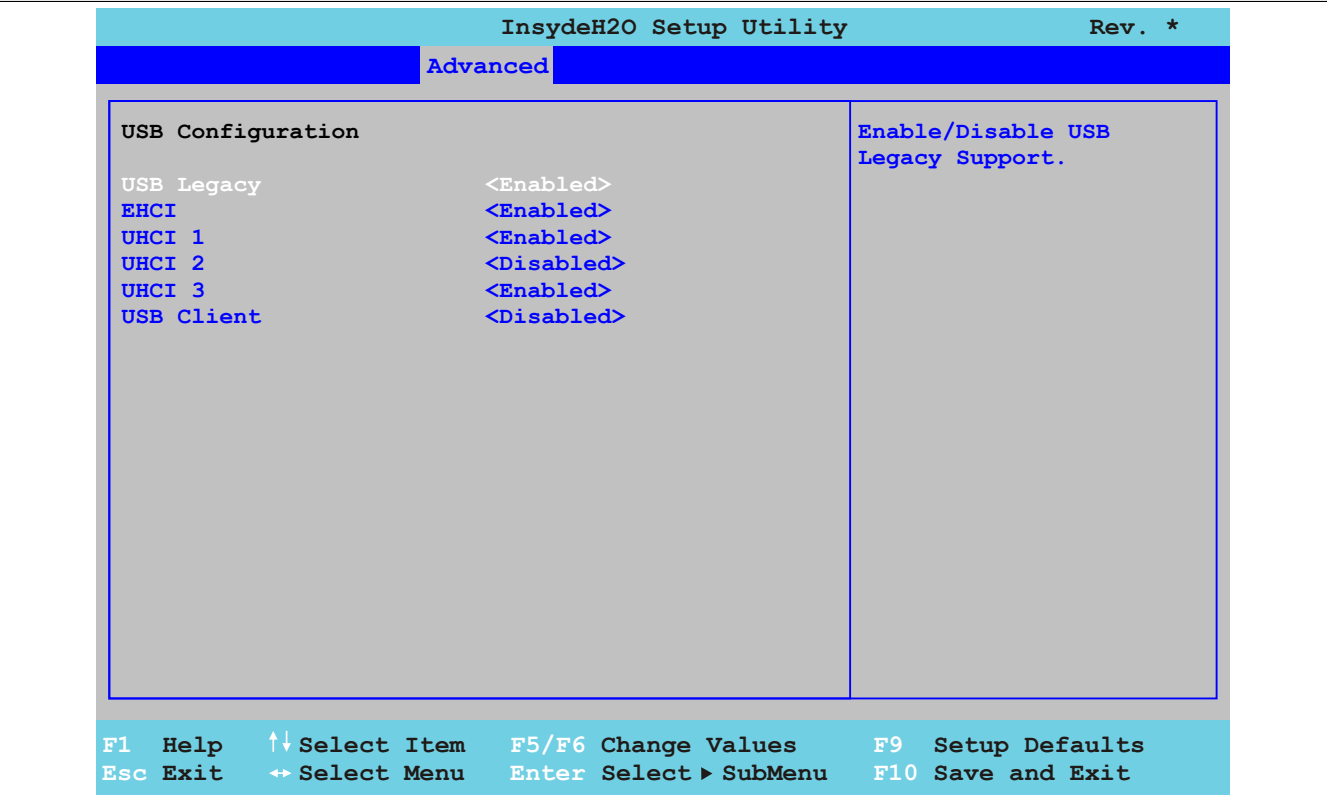


Abbildung 66: US15W Advanced - USB Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
USB Legacy	Hier kann der Legacy USB Support aktiviert/deaktiviert werden. Es funktioniert keine USB Schnittstelle während des Startens. Nach dem Betriebssystemstart steht der USB Support wieder zur Verfügung. Eine USB Tastatur wird während des POST noch erkannt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
EHCI	Hier kann die Unterstützung für Betriebssysteme ohne vollautomatische EHCI Funktion eingerichtet werden.	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung. Die USB 2.0 Unterstützung wird aktiviert, sobald ein USB 2.0 Gerät mit dieser Schnittstelle verbunden ist.
		Disabled	Deaktivierung der USB 2.0 Unterstützung.
UHCI 1	Einstellung des USB UHCI Controllers 1 für USB Port 1, 2 und 3.	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung.
		Disabled	Deaktivierung der USB Unterstützung.
		Warnung! Wird diese Einstellung auf <i>Disabled</i> gestellt, werden auch die Einstellungen <i>UHCI 2</i> und <i>UHCI 3</i> auf <i>Disabled</i> gesetzt und alle USB Ports werden deaktiviert. Ein Wiedereinstieg in das BIOS ist somit nicht mehr möglich. Wurde UHCI 1 dennoch deaktiviert, so kann man mit dem Backup BIOS wieder in das BIOS gelangen. Näheres dazu siehe "OEM Features" auf Seite 106	
UHCI 2 ¹⁾	Einstellung des USB UHCI Controllers 2 für USB Ports am I/O Board.	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung.
		Disabled	Deaktivierung der USB Unterstützung.
UHCI 3 ¹⁾	Einstellung des USB UHCI Controllers 3 für USB Port 3.	Enabled	Aktivierung der USB Unterstützung.
		Disabled	Deaktivierung der USB Unterstützung.
USB Client	Einstellung zur Unterstützung eines USB Clients.	Enabled	Aktivierung der USB Client Unterstützung.
		Disabled	Deaktivierung der USB Client Unterstützung.

Tabelle 130: US15W Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *UHCI 1* auf *Enabled* eingestellt ist.

1.5.7 SDIO Configuration

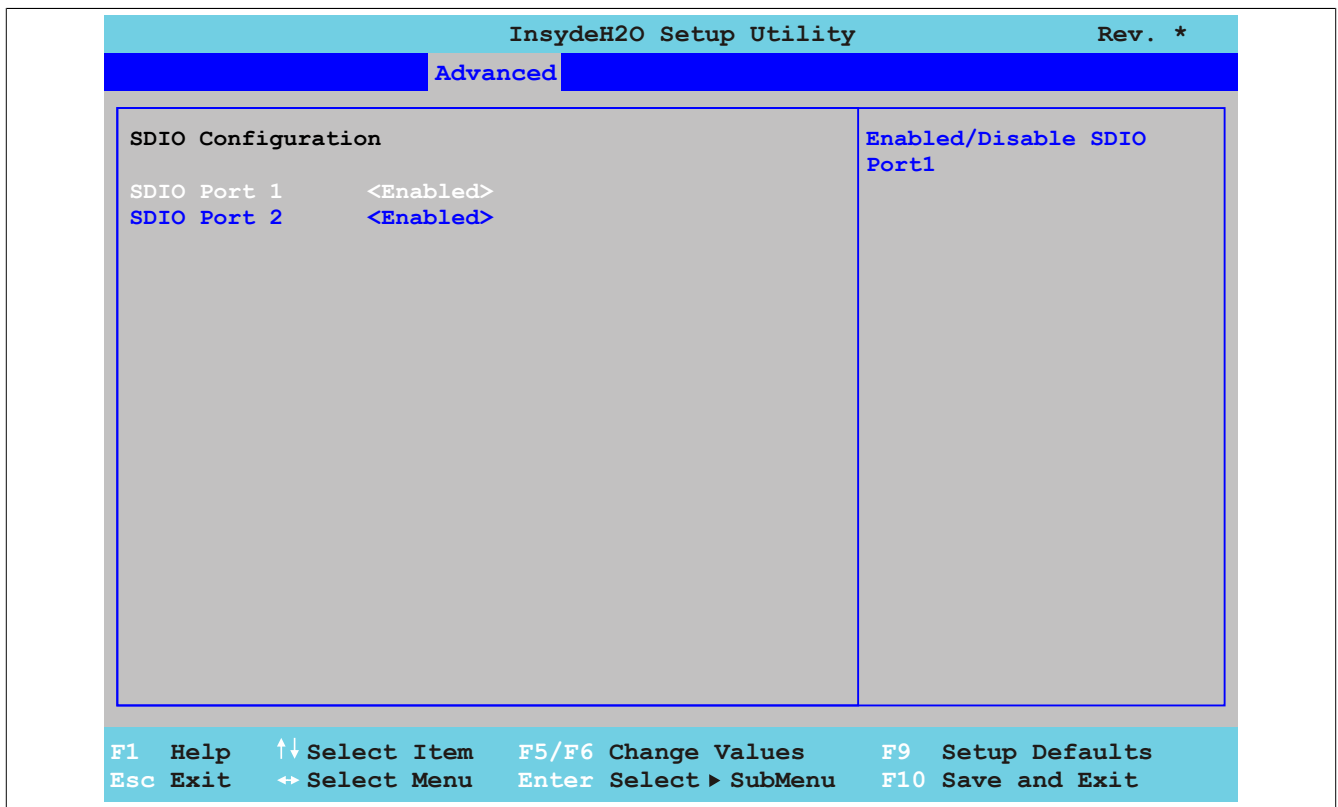


Abbildung 67: US15W Advanced - SDIO Configuration

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SDIO Port 1	Hier kann der SDIO Port 1 (Secure Digital Input Output - SD Memory Card Slot) aktiviert/ deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Diabled	Deaktivierung der Funktion.
SDIO Port 2	Hier kann der SDIO Port 2 (Secure Digital Input Output - SD Memory Card Slot) aktiviert/ deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Diabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 131: US15W Advanced - SDIO Configuration Einstellmöglichkeiten

1.5.8 ACPI Table/Features Control

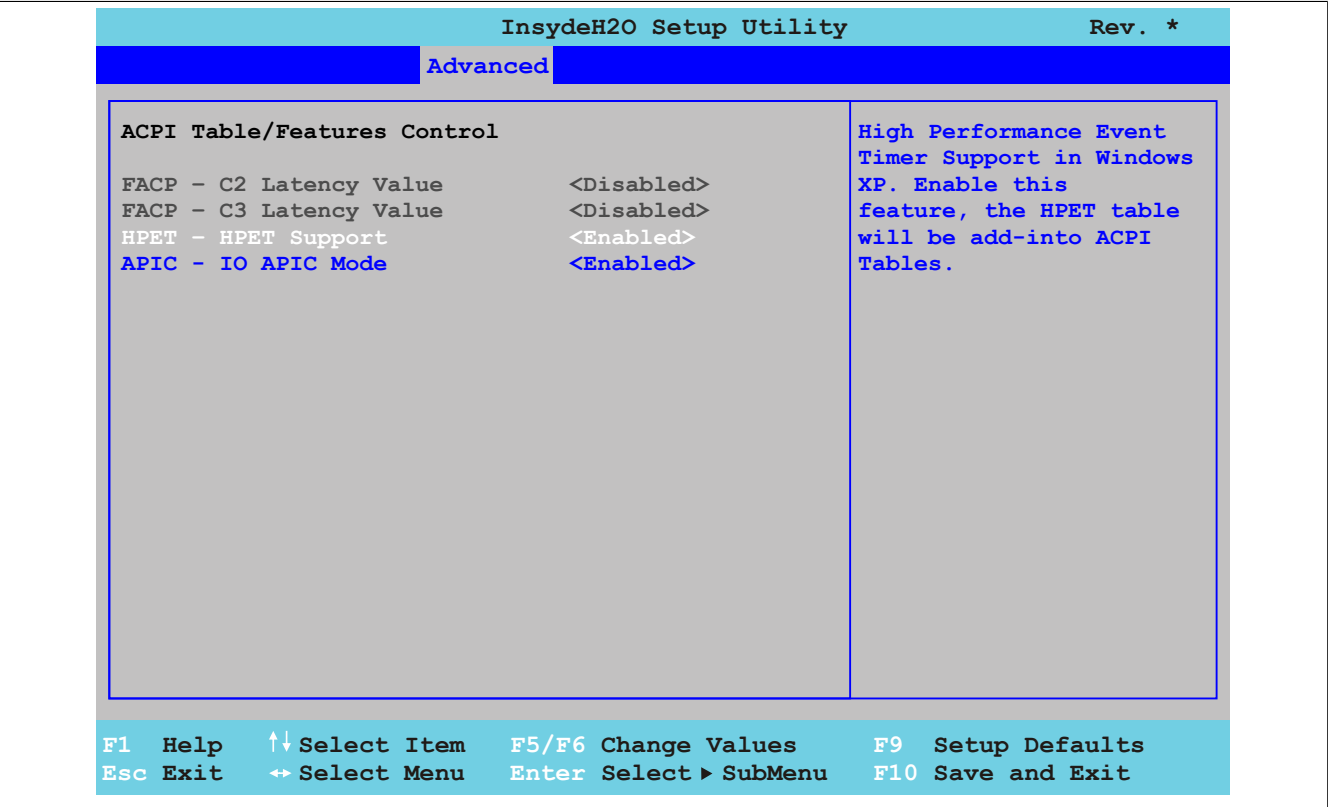


Abbildung 68: US15W Advanced - ACPI Table/Features Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
FACP – C2 Latency Value ¹⁾	Option zum Einstellen einer Latenzzeit im C2-State.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Es wird eine Latenz von 1 µs eingestellt, d.h. innerhalb von 1 µs wird in den C2-State gesprungen und innerhalb von 1 µs wieder heraus.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
FACP – C3 Latency Value ¹⁾	Option zum Einstellen einer Latenzzeit im C3-State.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Es wird eine Latenz von 85 µs eingestellt, d.h. innerhalb von 85 µs wird in den C3-State gesprungen und innerhalb von 85 µs wieder heraus.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
HPET – HPET Support	Der HPET ist ein Zeitgeber im PC. Er ist in der Lage einen Interrupt mit sehr hoher Präzision auszulösen und andere Programme können diverse Anwendungen besser synchronisieren.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Bei Multimedia Anwendungen wird empfohlen, die Funktion auf Enabled zu stellen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
APIC - IO APIC Mode	Über diese Option wird die Unterstützung des Advanced Programmable Interrupt Controllers im Prozessor festgelegt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Warnung!
Wird diese Einstellung auf Disabled gesetzt, so wird Windows XP nicht hochgefahren.

Tabelle 132: US15W Advanced - ACPI Table/Features Control Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn C-States im Menüpunkt *Power - Advanced CPU Control* auf *Enabled* eingestellt ist.

1.5.9 PCI Express Root Port 1

Warnung!

Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.

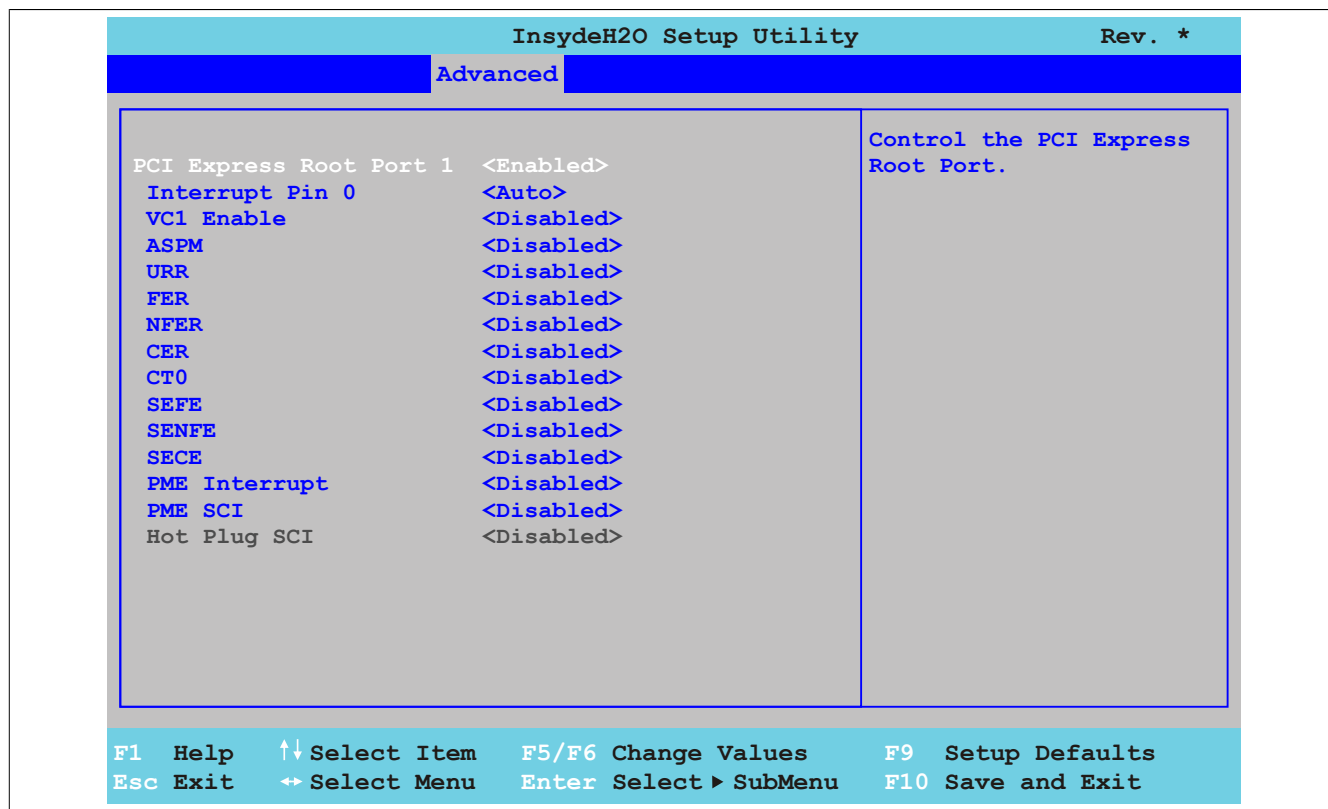


Abbildung 69: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Root Port 1	Mit dieser Option wird der PCI Express Root Port 1 aktiviert / deaktiviert.	Enabled	PCI Express Root Port 1 wird aktiviert.
		Disabled	PCI Express Root Port 1 und 2 wird deaktiviert.
Interrupt Pin 0		Auto	IRQ für Root Port 1 aktiviert.
		Disabled	IRQ für Root Port 1 deaktiviert.
VC1 Enable	Virtual Channel 1	Auto	Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "VC1/TC Mapping".
		Disabled	Deaktivierung der Funktion. Es wird automatisch die TC0 Traffic Klasse verwendet und auf den VC0 Virtual Channel gemapped.
VC1/TC Mapping ¹⁾	Mit dieser Option wird eingestellt, welcher Traffic auf welchen Virtual Channel gemapped wird.	TC0	TBD
		TC1	Die TC1 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC2	Die TC2 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC3	Die TC3 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC4	Die TC4 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC5	Die TC5 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC6	Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
		TC7	Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
ASPM	Active State Power Management Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIe Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Automatic ASPM ²⁾	Option zum Konfigurieren der automatischen oder manuellen Zuordnung des ASPM.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Manual	Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "ASPM L0s" und "ASPM L1".
ASPM L0s ³⁾	Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Root Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert.
		Endpoint Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Endpoint Port aktiviert.
		Root&Endpoint Ports	Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert.
ASPM L1 ³⁾	Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 133: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
URR	<i>Unsupported Request (UR) Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
FER	<i>Fatal Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
NFER	<i>Non-Fatal Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CER	<i>Correctable Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CT0	<i>PCI Express Completion Timer T0</i> Mit dieser Option wird der PCI Express Completion Timer aktiviert / deaktiviert. Information: Wenn das System ein ROB (Processor Reorder Buffer) Timeout entdeckt hat, sollte diese Einstellung auf Enabled gestellt werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SEFE	<i>System Error on Fatal Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SENE	<i>System Error on Non-Fatal Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein nicht-schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SECE	<i>System Error on Correctable Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein korrigierbarer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME Interrupt	<i>Power Management Event Interrupt</i> Option zum Generieren eines PME Interrupts. Ein Interrupt wird beim Empfang einer PME Message von einem PCIe Gerät generiert.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Beim Empfang einer PME Benachrichtigung wird ein PME Interrupt ausgelöst.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Power Management erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Power Management erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Hot Plug SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Hot-Plug erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Hot-Plug erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 133: US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *VC1 Enable* auf *Auto* eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *ASPM* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *Automatic ASPM* auf *Manual* eingestellt ist.

1.5.10 PCI Express Root Port 2

Warnung!

Unbedachte Einstellungen können eine Instabilität oder Geräteprobleme verursachen. Es wird daher ausdrücklich empfohlen, Änderungen der Einstellungen nur von erfahrenen Benutzern vornehmen zu lassen.

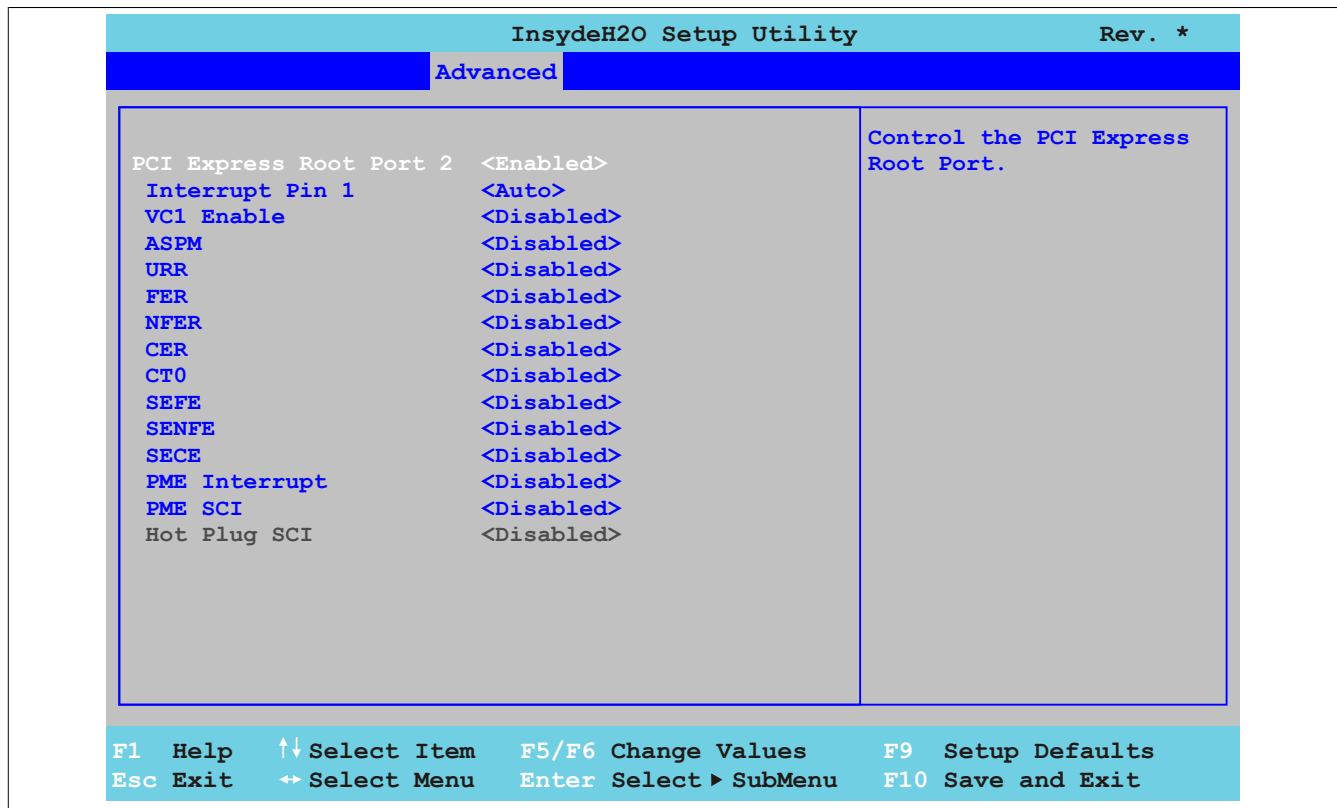


Abbildung 70: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Express Root Port 2	Mit dieser Option wird der PCI Express Root Port 2 aktiviert / deaktiviert.	Enabled Disabled	PCI Express Root Port 2 wird aktiviert. PCI Express Root Port 2 wird deaktiviert.
Interrupt Pin 1	Information: Bei der Verwendung von ARwin und/oder einer Feldbus Karte ist diese Funktion defaultmäßig deaktiviert. Um eine Feldbus Karte verwenden zu können, muss die Funktion unbedingt deaktiviert sein.	Auto Disabled	IRQ für Root Port 2 aktiviert. IRQ für Root Port 2 deaktiviert.
VC1 Enable		Auto Disabled	Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "VC1/TC Mapping". Deaktivierung der Funktion. Es wird automatisch die TC0 Traffic Klasse verwendet und auf den VC0 Virtual Channel gemapped.
VC1/TC Mapping ¹⁾	Mit dieser Option wird eingestellt, welcher Traffic auf welchen Virtual Channel gemapped wird.	TC0 TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7	TBD Die TC1 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC2 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC3 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC4 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC5 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC6 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped. Die TC7 Traffic Klasse wird manuell auf den VC1 Virtual Channel gemapped.
ASPM	Active State Power Management	Enabled	Aktivierung der Funktion.

Tabelle 134: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Option zum Einstellen einer Energiesparfunktion (L0s/L1) für PCIe Links wenn diese nicht sämtliche Leistung benötigen.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Automatic ASPM ²⁾	Option zum Konfigurieren der automatischen oder manuellen Zuordnung des ASPM.	Auto	Automatische Zuordnung durch das BIOS und das Betriebssystem.
		Manual	Einstellen der Zuordnung unter der BIOS Einstellung "ASPM L0s" und "ASPM L1".
ASPM L0s ³⁾	Option zum Einstellen der L0 Energiesparfunktion.	Disabled	Deaktivierung der Funktion.
		Root Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Root Port aktiviert.
		Endpoint Port Only	Die Energiesparfunktion wird für den Endpoint Port aktiviert.
		Root&Endpoint Ports	Die Energiesparfunktion wird für den Root und Endpoint Port aktiviert.
ASPM L1 ³⁾	Option zum Einstellen der L1 Energiesparfunktion. Der Stromverbrauch ist niedriger als bei L0, die Ausstiegslatenz ist jedoch höher.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
URR	<i>Unsupported Request (UR) Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-unterstützten Anfragen. Das Aufzeichnen der Fehlermeldungen, welche vom Root Port empfangen werden, wird exklusiv über das Root Control Register kontrolliert.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
FER	<i>Fatal Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
NFER	<i>Non-Fatal Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CER	<i>Correctable Error Reporting</i> Option zum Benachrichtigen von nicht-schweren Fehlern. Bei einem Multifunktionsgerät werden alle Funktionen innerhalb des Gerätes überwacht. Für den Root Port tritt der Report intern innerhalb des Root Complex auf.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
CT0	<i>PCI Express Completion Timer T0</i> Mit dieser Option wird der PCI Express Completion Timer aktiviert / deaktiviert. Information: Wenn das System ein ROB (Processor Reorder Buffer) Timeout entdeckt hat, sollte diese Einstellung auf Enabled gestellt werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SEFE	<i>System Error on Fatal Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SENF	<i>System Error on Non-Fatal Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein nicht-schwerer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SECE	<i>System Error on Correctable Error</i> Option zum Generieren eines System Errors, wenn ein korrigierbarer Fehler von einem Gerät am Root Port oder dem Root Port selbst gemeldet wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME Interrupt	<i>Power Management Event Interrupt</i> Option zum Generieren eines PME Interrupts. Ein Interrupt wird beim Empfang einer PME Message von einem PCIe Gerät generiert.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Beim Empfang einer PME Benachrichtigung wird ein PME Interrupt ausgelöst.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PME SCI	Option zum Generieren eines SCI wenn ein Power Management erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCI zu generieren wenn ein Power Management erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 134: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Hot Plug SCL	Option zum Generieren eines SCL wenn ein Hot-Plug erkannt wird.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Der Root-Port wird aktiviert um SCL zu generieren wenn ein Hot-Plug erkannt wird.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 134: US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *VC1 Enable* auf *Auto* eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *ASPM* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *Automatic ASPM* auf *Manual* eingestellt ist.

1.5.11 Console Redirection

Information:

Diese Einstellungen sind nur für Automation PC 511 Systemeinheiten ohne I/O Board sichtbar. Die Mode/Node Schalter müssen auf "00" (default) eingestellt sein.

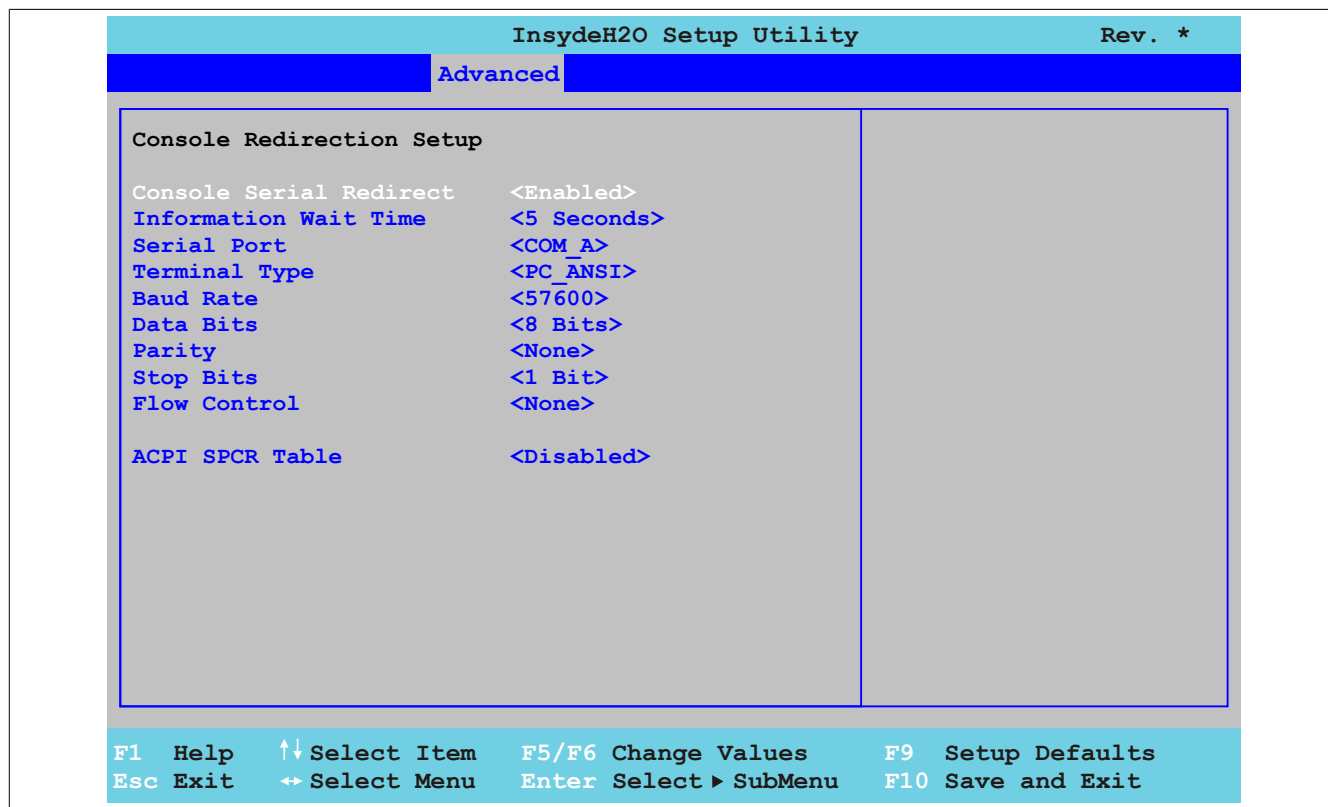


Abbildung 71: US15W Advanced - Console Redirection

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Console Serial Redirect	Option zum Einstellen der Remote Console. Mit der Remote Console kann über die Serielle Schnittstelle mittels Terminal Emulator (PuTTY or HyperTerminal) auf das BIOS Setup zugegriffen werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Information Wait Time	Option zum Einstellen der Zeit, die die Remote Console wartet, bis er das erste Mal auf das BIOS zugreift.	0 Seconds, 2 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds, 30 Seconds	Die Remote Console wartet vor dem ersten BIOS Zugriff x Sekunden.
Serial Port	Option zum Einstellen der Seriellen Schnittstelle.	COM_A	Der Zugriff erfolgt über die Serielle Schnittstelle COMA.
		COM_B	Der Zugriff erfolgt über die Serielle Schnittstelle COMB.
		COM_C	Der Zugriff erfolgt über die Serielle Schnittstelle COMC.
		COM_D	Der Zugriff erfolgt über die Serielle Schnittstelle COMD.

Tabelle 135: US15W Advanced - Console Redirection Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Terminal Type	Option zum Einstellen der Tastatureingabe.	All Ports	TBD
		VT_100	Die VT100 Konvention (ASCII-Zeichensatz) wird aktiviert.
		VT_100+	Die VT100+ Konvention (ASCII-Zeichensatz und Unterstützung von Farbe, Funktionstasten usw.) wird aktiviert.
		VT_UTF8	Die VT-UTF8 Konvention (verwendet UTF8-Kodierung, um Unicode- Zeichen einem oder mehreren Bytes zuzuordnen) wird aktiviert.
		PC_ANSI	Die PC ANSI Konvention (erweiterter ASCII-Zeichensatz) wird aktiviert.
Baud Rate	Option zum Einstellen der Übertragungsrate der Seriellen Schnittstelle (Bit pro Sekunde).	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Es ist die Übertragungsrate von x Bit aktiviert.
Data Bits	Option zum Einstellen der verwendeten Zeichenlänge (Datenbits) bei der seriellen Kommunikation.	7 Bits	Zeichenlänge mit 7 Bit
		8 Bits	Zeichenlänge mit 8 Bit
Parity	Option zum Einstellen der verwendeten Paritätsbits bei der seriellen Kommunikation.	None	Es wird kein Paritätsbit verwendet.
		Even	Es wird eine gerade Anzahl von Paritätsbits verwendet.
		Odd	Es wird eine ungerade Anzahl von Paritätsbits verwendet.
Stop Bits	Option zum Einstellen der verwendeten Stopbits bei der seriellen Kommunikation.	1 Bit	Es wird 1 Bit als Stopbit verwendet.
		2 Bit	Es werden 2 Bit als Stopbits verwendet.
Flow Control	Option zum Einstellen der Datenflusssteuerung.	None	Keine Datenflusssteuerung ist aktiviert.
		RTS/CTS	Hardware Handshake wird aktiviert.
		XON/XOFF	Software Handshake wird aktiviert.
ACPI SPCR Table	Option zum Einstellen der ACPI Serial Port Console Redirection (SPCR).	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 135: US15W Advanced - Console Redirection Einstellmöglichkeiten

1.6 Security

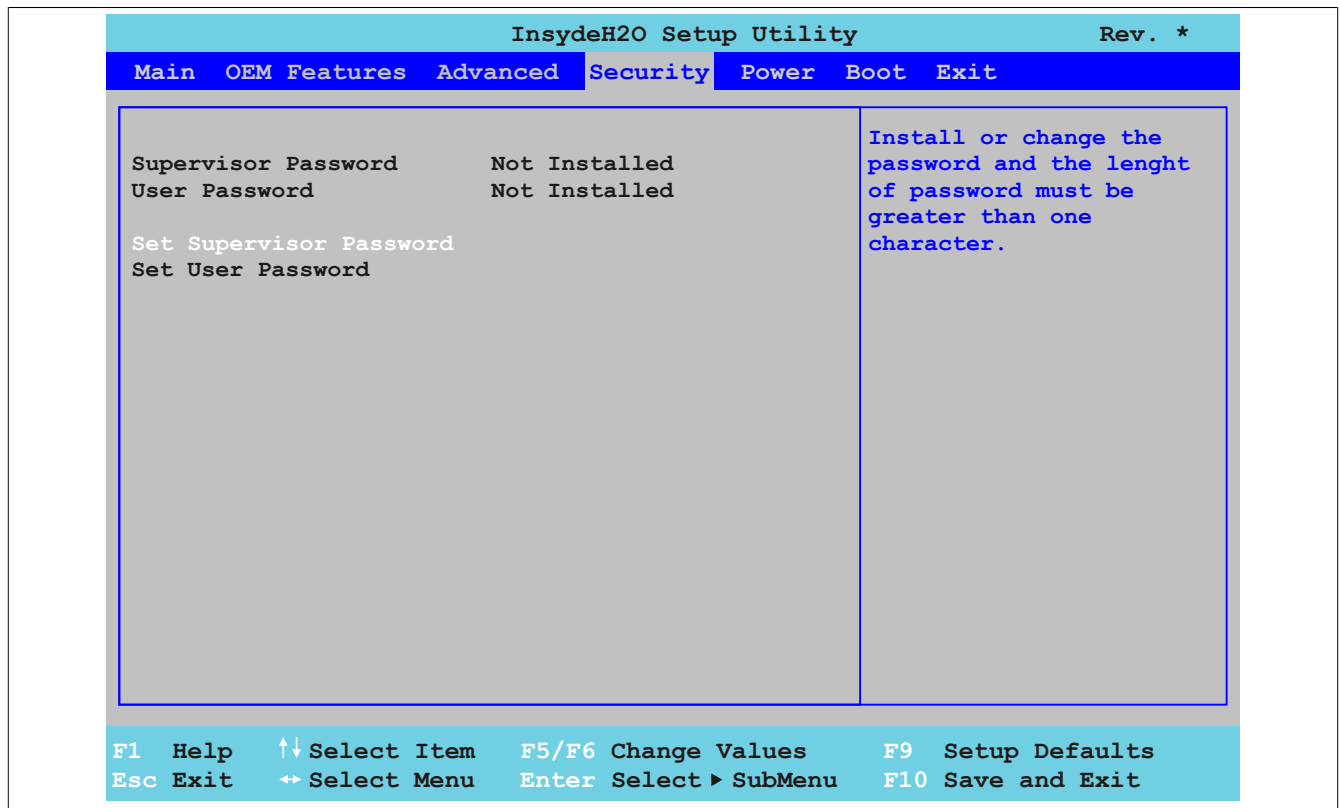


Abbildung 72: US15W Security - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Set Supervisor Password	Option zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passwortes. Nur mit dem Supervisor Passwort können alle BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Set User Password	Option zum Eingeben eines User Passwortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.

Tabelle 136: US15W Security - Menü Einstellmöglichkeiten

1.6.1 Set Supervisor Password

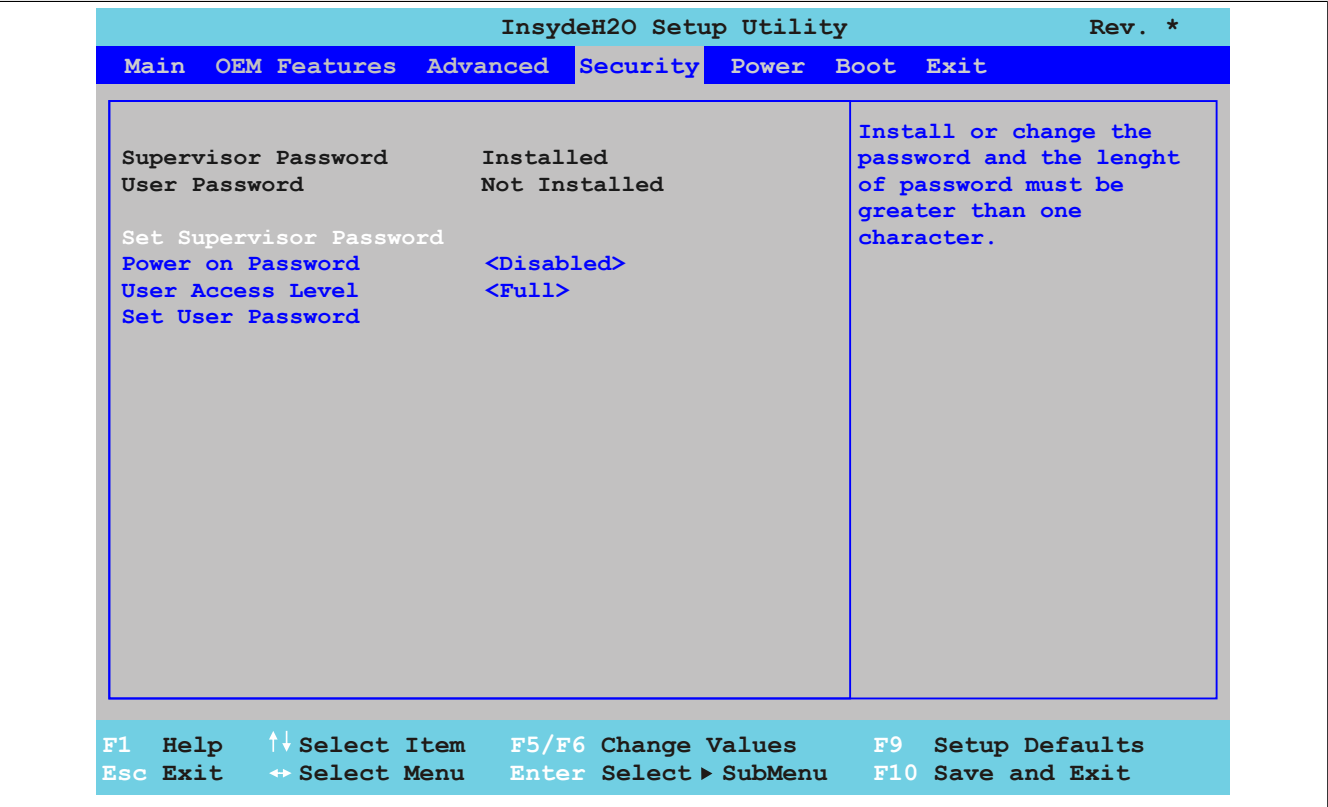


Abbildung 73: US15W Security - Set Supervisor Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Set Supervisor Password	Option zum Eingeben/Ändern eines Supervisor Passworts. Nur mit dem Supervisor Passwort können alle BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Power on Password	Um in das BIOS einzusteigen oder das Betriebssystem zu starten ist die Eingabe des Supervisor Passworts nötig.	Enabled	Beim POST ist die Eingabe des Supervisor Passworts nötig.
		Disabled	Beim Einstieg in das BIOS ist die Eingabe des Supervisor Passworts nötig, das Betriebssystem kann jedoch ohne Passwordeingabe gestartet werden.
User Access Level	Vergabe von Bearbeitungsrechten im BIOS. Diese Einstellungen sind nur wirksam, wenn ein User Passwort angelegt wurde.	View Only	Der User kann nur BIOS Einstellungen sehen, jedoch keine Einstellungen ändern.
		Limited	Der User kann alle BIOS Einstellungen sehen, jedoch nur eingeschränkt Einstellungen ändern. Einstellungen die der User ändern kann: Main - System Time, Main - System Date, Advanced - Boot Configuration - Numlock
		Full	Der User hat vollen Zugriff auf das BIOS und kann alle Einstellungen ändern.

Tabelle 137: US15W Security - Set Supervisor Password Einstellmöglichkeiten

1.6.2 Set User Password

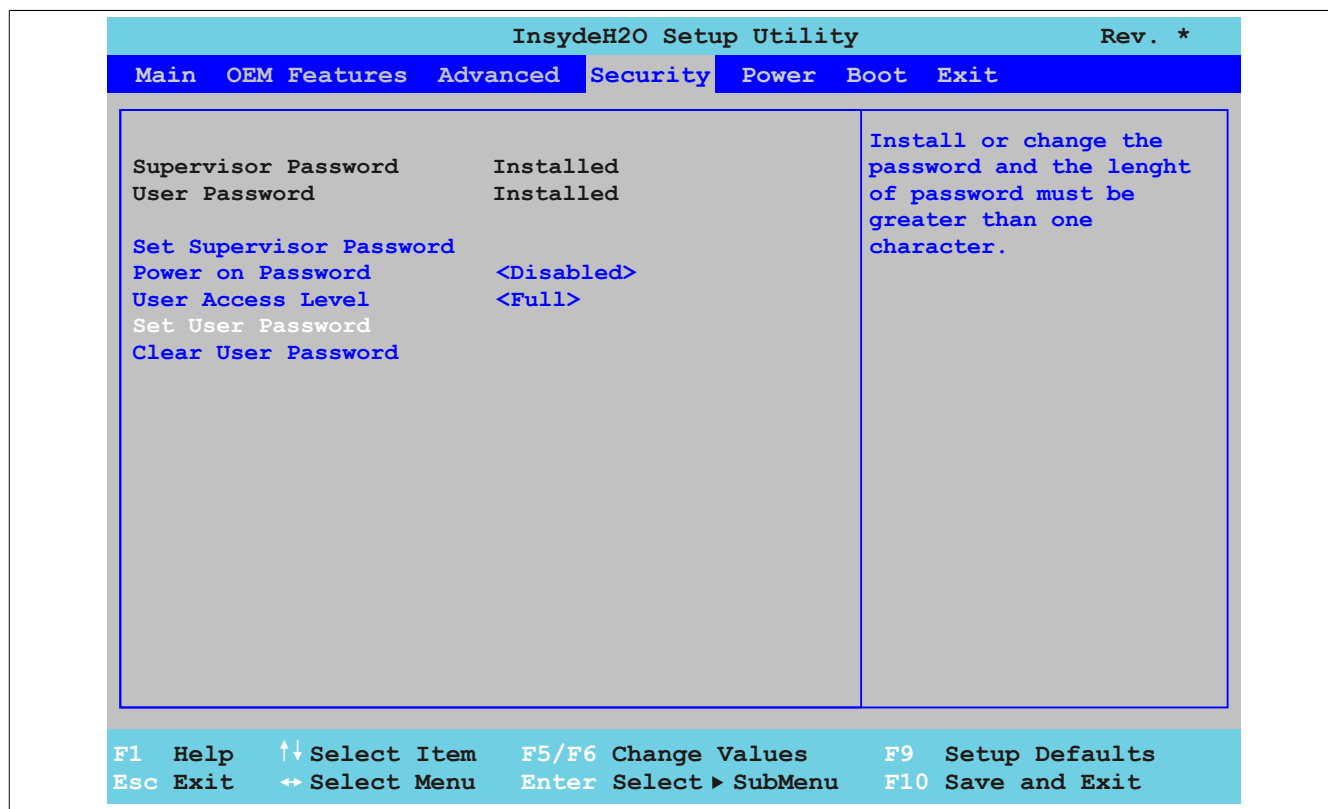


Abbildung 74: US15W Security - Set User Password

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Supervisor Password	Anzeige ob ein Supervisor Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
User Password	Anzeige ob ein User Passwort vorhanden ist oder nicht.	keine	-
Set User Password	Option zum Eingeben/Ändern eines User Passwortes. Mit dem User Passwort können nur bestimmte BIOS Einstellungen editiert werden.	Enter	Passwort eingeben.
Clear User Password ¹⁾	Option zum Löschen des User Passwortes.		Das User Passwort wird gelöscht.

Tabelle 138: US15W Security - Set User Password Einstellmöglichkeiten

1) Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn mit *Set User Password* ein User Passwort angelegt wurde.

1.7 Power

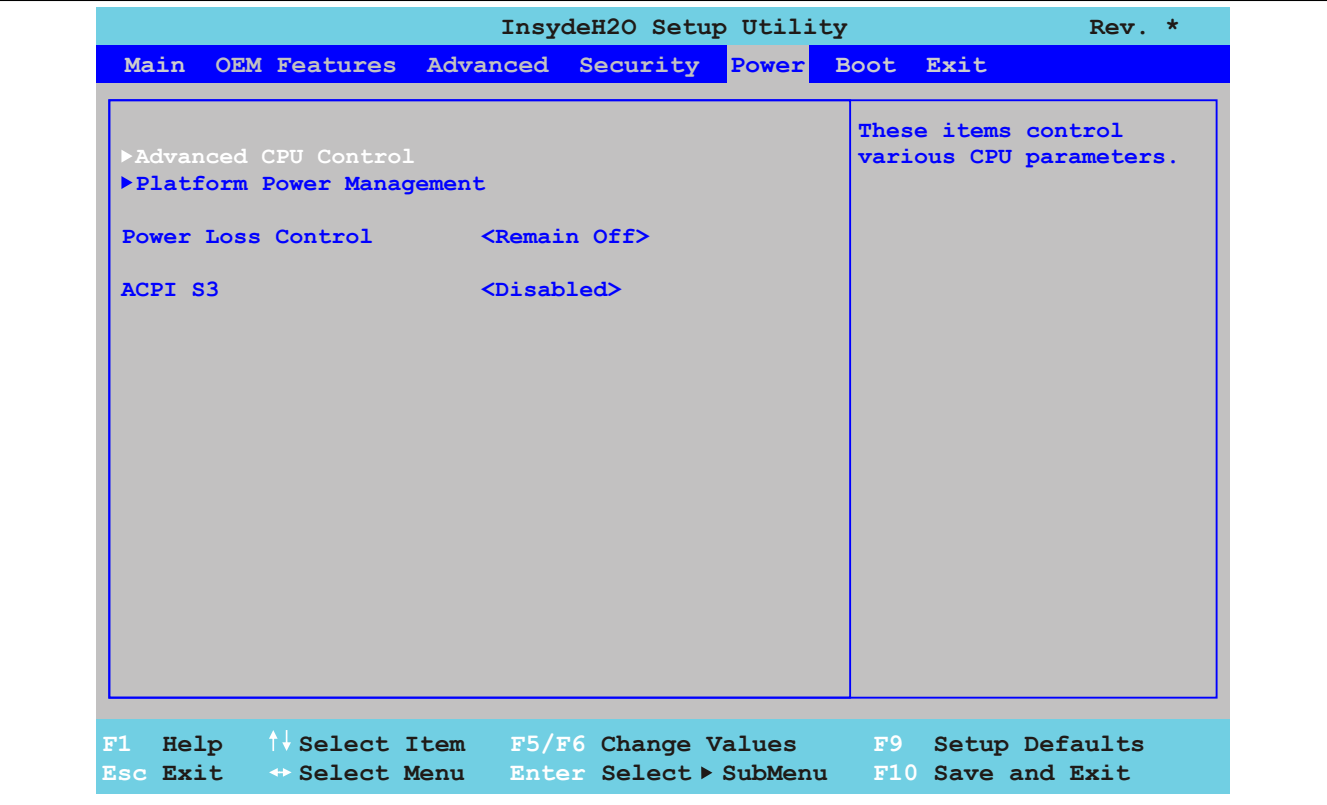


Abbildung 75: US15W Power - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Advanced CPU Control	Konfiguration der Advanced CPU Control Einstellungen.	keine	öffnen des Submenüs siehe "Advanced CPU Control" auf Seite 145
Platform Power Management	Konfiguration der Platform Power Management Einstellungen.	keine	öffnen des Submenüs siehe "Platform Power Management" auf Seite 148
Power Loss Control	Diese Option legt fest was nach einem Stromausfall passieren soll.	Remain Off	Gerät bleibt ausgeschaltet.
		Turn On	Gerät schaltet wieder ein.
ACPI S3	Über diese Option wird festgelegt, ob das Betriebssystem in den RAM geschrieben und nur dieser mit Strom versorgt werden soll.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion

Tabelle 139: US15W Power - Menü Einstellmöglichkeiten

1.7.1 Advanced CPU Control

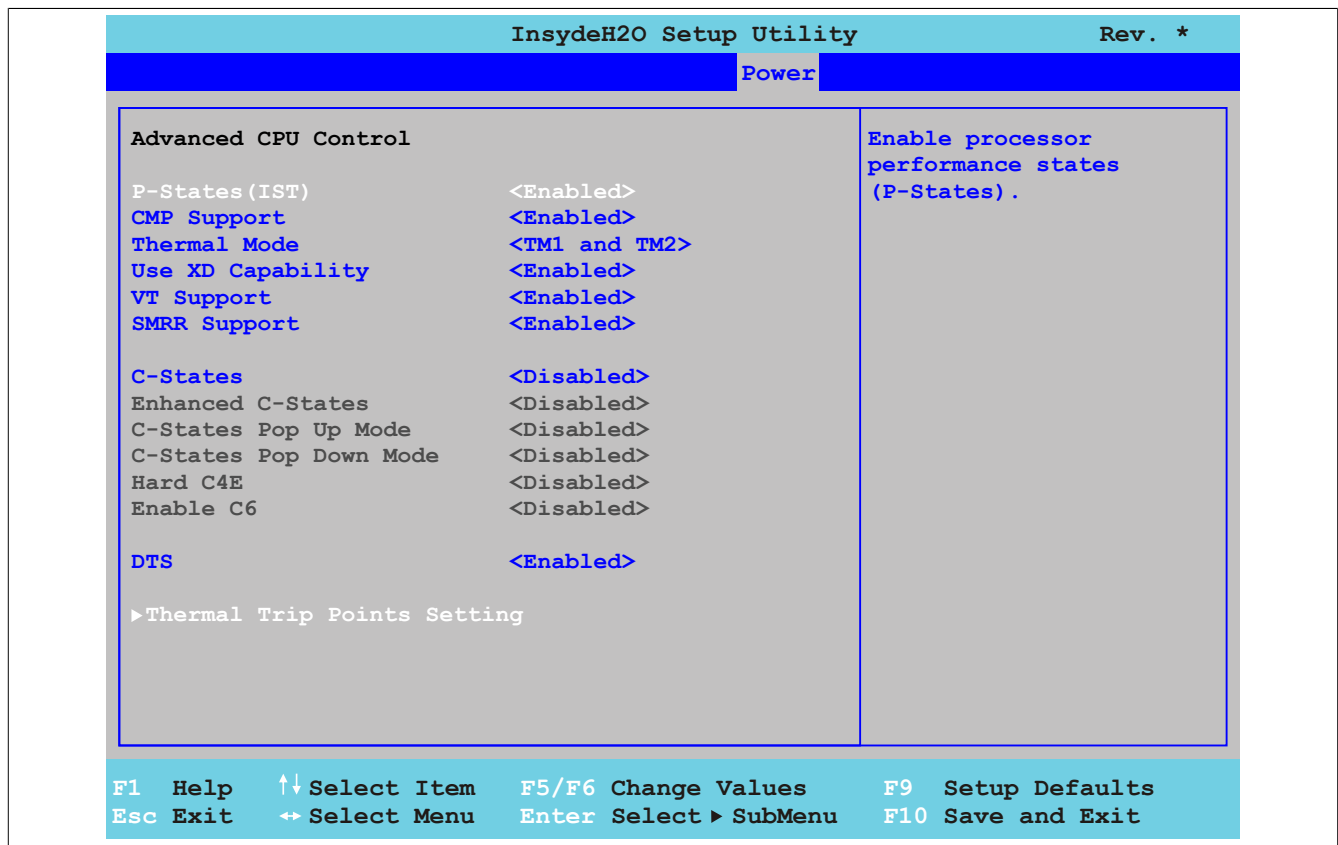


Abbildung 76: US15W Power - Advanced - CPU Control

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
P-States(IST)	Option zum Regeln der Intel(R) SpeedStep(TM) Technologie. Der Prozessor wird entsprechend der Menge von auszuführenden Berechnungen hoch oder heruntergetaktet. Dadurch hängt der Energieverbrauch stark von der Auslastung des Prozessors ab.	Enabled	Die Prozessorgeschwindigkeit wird durch das Betriebssystem geregelt.
		Disabled	Deaktivierung der SpeedStep Technologie.
CMP Support	Diese Option unterstützt den Einsatz von mehreren CPUs (CMP=Core Multiprocessing).	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Für die Verwendung von ARwin ist der CMP Support zwingend auszuschalten, da es ansonsten zu Laufzeitverletzungen kommen kann.		
Thermal Mode ¹⁾	Option zum Einstellen der Temperaturüberwachung.	Disabled	Die Temperaturüberwachung ist deaktiviert.
		TM1	Der Intel Thermal Mode 1 ist aktiviert. Ist eine zu hohe CPU Temperatur erreicht, wird die Prozessorgeschwindigkeit um 50% reduziert.
		TM2	Der Intel Thermal Mode 2 ist aktiviert. Ist eine zu hohe CPU Temperatur erreicht, wird die Intel SpeedStep Technologie aktiviert.
		TM1 and TM2	Der Intel Thermal Mode 1 und 2 ist aktiviert. Ist eine zu hohe CPU Temperatur erreicht, reduziert TM1 die Prozessorgeschwindigkeit um 50% und TM2 aktiviert die Intel SpeedStep Technologie.
Use XD Capability	Diese Option ist ein Sicherheits-Feature, die bestimmte Datenregionen des Systemspeicher vor potentiell schädlichem Code schützt.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
VT Support	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Virtuellen Maschine.	Enabled	Ist die Funktion aktiviert, kann eine Virtuelle Maschine die zusätzlichen Hardwarekapazitäten verwenden.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
	Information: Um eine Änderung der Einstellung wirksam zu machen, ist ein Neustart erforderlich.		

Tabelle 140: US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
SMRR Support	Das SMRR (System Management Range Register) limitiert chachespeicherbare Referenzen von Adressen in SMRAM um den Code im SMM (System Management Mode) laufen zu lassen. Unter Umständen könnte ein Eindringling, welcher als Administrator angemeldet ist, den Intel Prozessor konfigurieren um sich somit Zugang zum SMM zu verschaffen. Die Implementation von SMRR verringert dieses Risiko eines Fremdzugriffes.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
C-States	Diese Einstellung erlaubt dem Betriebssystem die Taktfrequenz der Prozessoren selbst einzuteilen, es kann somit Energie gespart werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Die Prozessoren werden mit unterschiedlicher Frequenz betrieben, es kann somit Energie gespart werden.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion. Beide Prozessoren werden mit der selben Frequenz betrieben.
Enhanced C-States ²⁾	Diese Einstellung erlaubt dem Betriebssystem die Taktfrequenz der Prozessoren selbst einzuteilen, es kann somit Energie gespart werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
C-State Pop Up Mode	Die Einstellung erlaubt es, Bus Master Anfragen zu erkennen und die Taktfrequenz der Prozessoren selbst einzuteilen, es kann somit Energie gespart werden.	Enabled	Wenn der ICH eine Bus Master Anfrage erhält, wird das System von C3/C4 State auf C2 State gesetzt und der Bus Master wird automatisch aktiviert.
		Disabled	Der Bus Master Datenverkehr ist ein Break Event und ICH wird versuchen in den C0 Zustand zurückzukehren.
C-State Pop Down Mode ³⁾	Die Einstellung erlaubt es, Bus Master Anfragen zu erkennen und die Taktfrequenz der Prozessoren selbst einzuteilen, es kann somit Energie gespart werden.	Enabled	Wenn der ICH keine Bus Master Anfrage erhält, wird das System zurück auf C3/C4 State gesetzt.
		Disabled	ICH wird nicht versuchen, automatisch in den C3/C4 State zurückzukehren.
Hard C4E ⁴⁾	Power Management des Intel Atom Prozessors - Enhanced C4 Unterstützung.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Die CPU Spannung wird reduziert und der Memory Cache wird abgeschaltet.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Enable C6	Power Management des Intel Atom Prozessors - C6 Unterstützung.	Enabled	Aktivierung der Funktion. Die interne CPU Spannung wird reduziert, diese kann auch 0 V betragen.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
DTS	Option zum Aktivieren oder Deaktivieren der CPU Digital Thermal Sensor Funktion.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Thermal Trip Points Setting ⁵⁾	Konfiguration der Thermal Trip Points Einstellungen.	Enter	öffnen der Submenüs siehe "Thermal Trip Points Settings" auf Seite 147

Tabelle 140: US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *P-States(IST)* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 2) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *C-States* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 3) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *C-States Pop Up Mode* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 4) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *Enhanced C-States* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 5) Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *DTS* auf *Enabled* eingestellt ist.

1.7.1.1 Thermal Trip Points Settings

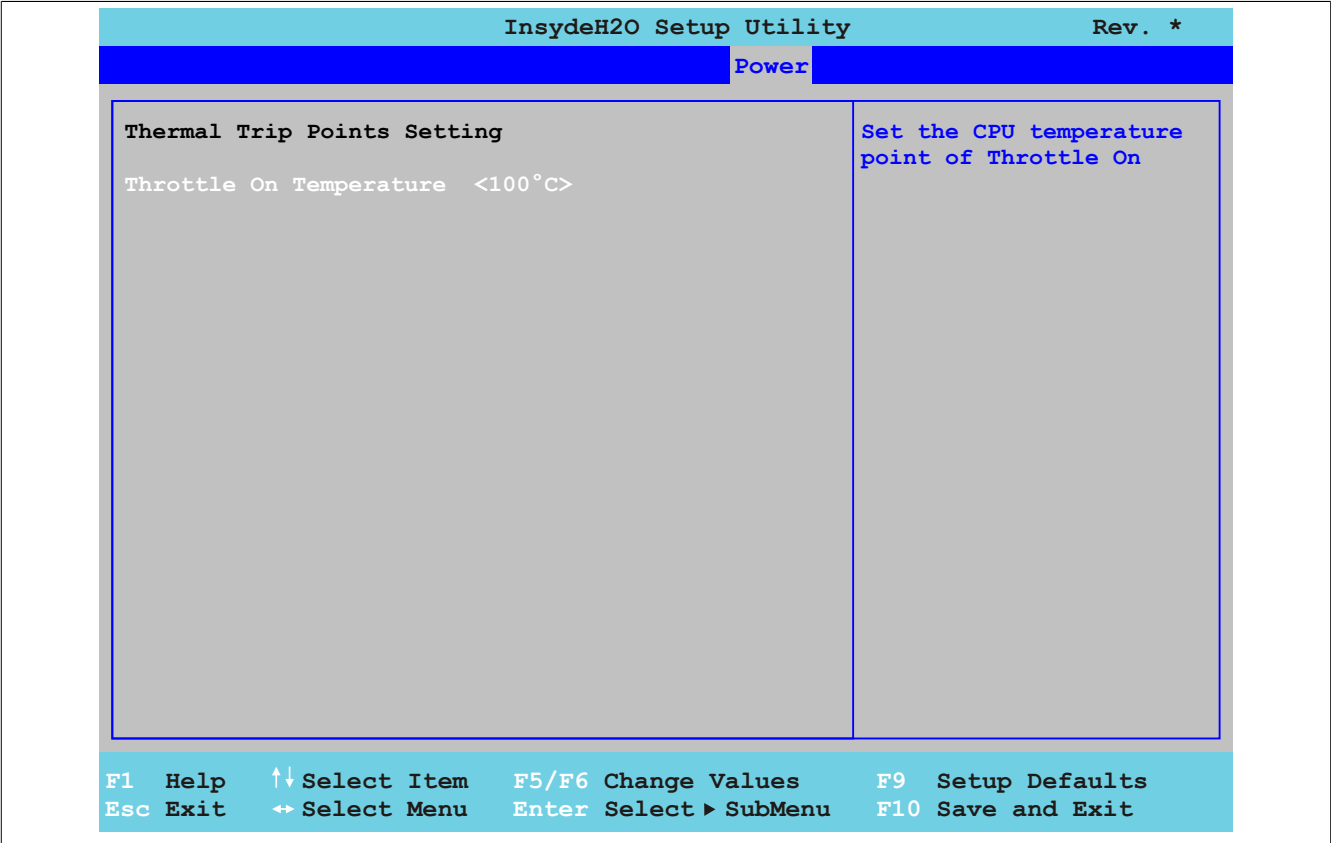


Abbildung 77: US15W Power - Advanced - CPU Control - Thermal Trip Points Settings

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Throttle On Temperature	Über diese Funktion wird eingestellt, bei welcher CPU Temperatur das Betriebssystem das System drosselt.	40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C, 100°C	Temperatureinstellung für den Thermal Trip Point. In 5 Grad Schritten einstellbar.

Tabelle 141: US15W Power - Advanced CPU Control - Thermal Trip Points Settings Einstellmöglichkeiten

Kapitel 4
Software

1.7.2 Platform Power Management

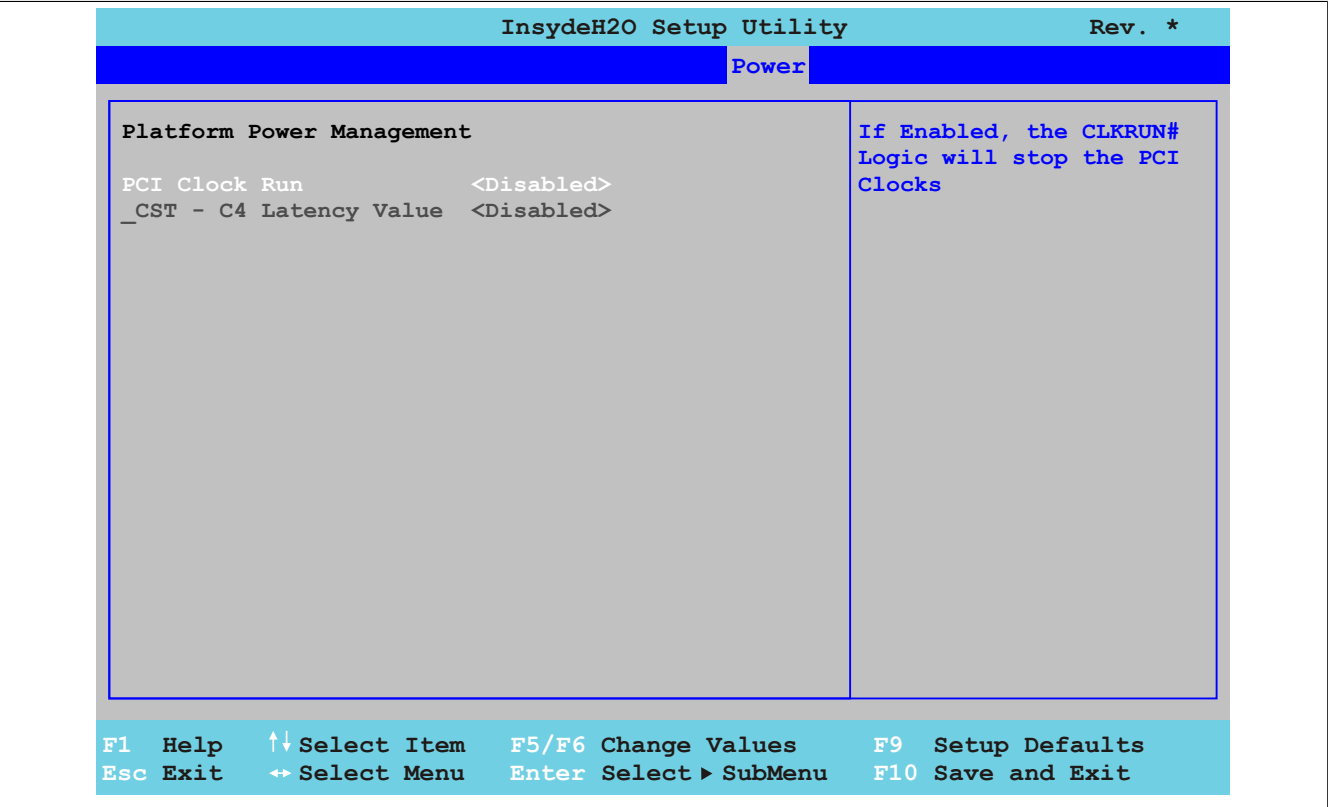


Abbildung 78: US15W Power - Platform Power Management

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
PCI Clock Run	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der PCI Clocks um Energie zu sparen.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Diabled	Deaktivierung der Funktion.
_CST - C4 Latency Value ¹⁾	Option zum Aktivieren / Deaktivieren der Latenzzeit für C4 C-States im ACPI _CST Objekt. Information: Genauere Informationen zu dieser Einstellung sind in der ACPI Sepzifikation zu finden (www.acpi.info).	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
C4 on C3 - Deeper Sleep ²⁾	Verfeinerung der Energiesparfunktion bei einem ACPI Betriebssystem.	Enabled	Prozessor wird in C4 gebracht, wenn das Betriebssystem in einen C3 Zustand initiiert.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.

Tabelle 142: US15W Power - Platform Power Management Einstellmöglichkeiten

- 1)
- Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn C-States im Menüpunkt *Advanced CPU Control* auf *Enabled* eingestellt ist.
- 2)
- Diese Einstellungen sind nur möglich, wenn *_CST - C4 Latency Value* auf *Enabled* eingestellt ist.

1.8 Boot

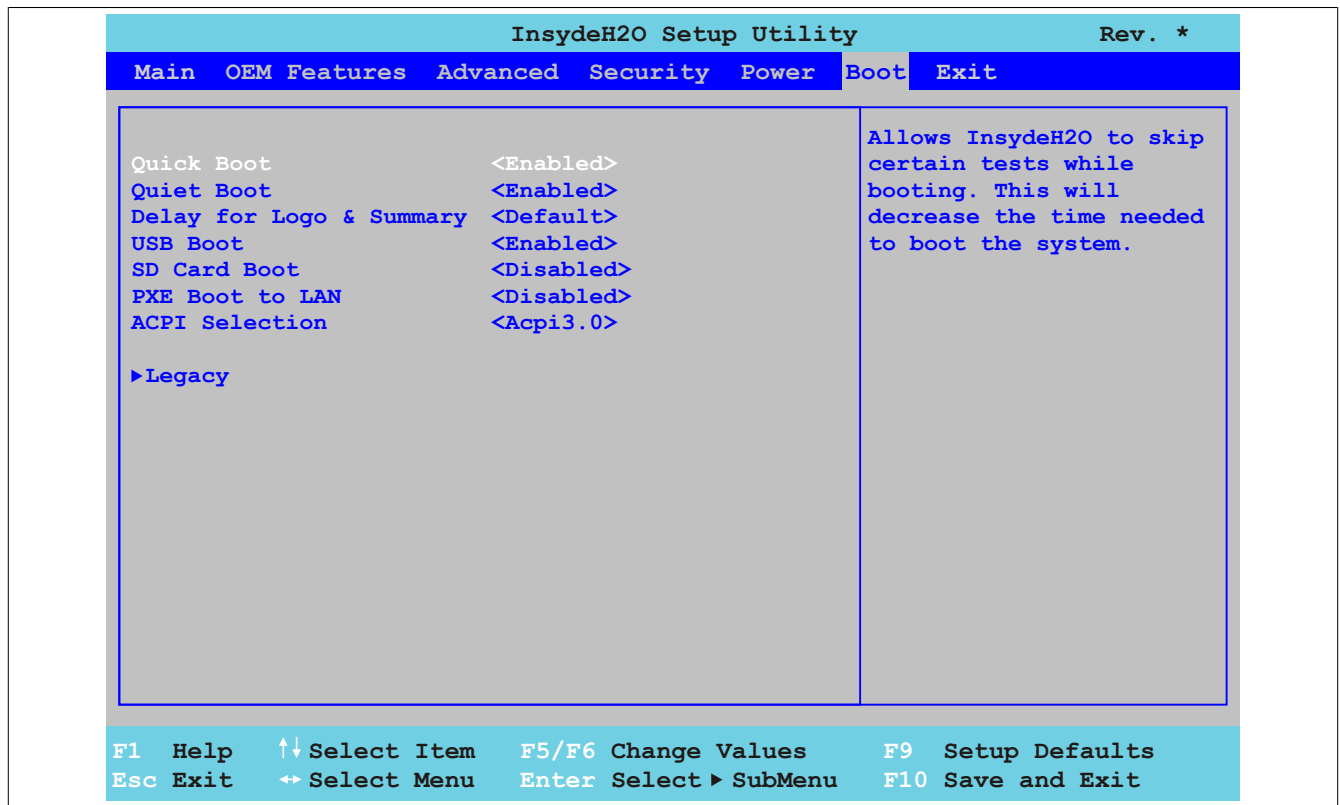


Abbildung 79: US15W Boot - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Quick Boot	Diese Funktion verringert die Zeit zum Booten durch überspringen von einigen POST Tests.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
Quiet Boot	Bestimmt, ob POST Nachricht oder das OEM Logo (Default=schwarzer Hintergrund) angezeigt wird.	Enabled	Anzeige des OEM Logos anstatt der POST Nachricht.
		Disabled	Anzeige der POST Nachricht.
Delay for Logo & Summary	Option zum Einstellen der Anzeigedauer des Logos und des Summary Screens.	Default	Die Anzeigedauer wird für einen schnellen Bootvorgang minimiert.
		1 Sec., 1.5 Sec., 2 Sec., 2.5 Sec., 3 Sec., 4 Sec., 5 Sec., 10 Sec., 20 Sec.	Es kann eine Anzeigedauer von x Sekunden eingestellt werden.
USB Boot	Mit dieser Funktion kann das Booten von USB Geräten aktiviert / deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
SD Card Boot	Mit dieser Funktion kann das Booten von SD Karten aktiviert / deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
PXE Boot to LAN	Mit dieser Funktion kann das Booten von LAN (ETH) aktiviert / deaktiviert werden.	Enabled	Aktivierung der Funktion.
		Disabled	Deaktivierung der Funktion.
ACPI Selection	Option zum Einstellen der zu unterstützenden Energieoptionsspezifikationen. Die Nutzung der ACPI-Funktionen setzt eine entsprechende Unterstützung in den Treibern sowie in den eingesetzten Betriebssystemen voraus.	Acpi 1.0B	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v1.0B
		Acpi 3.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v3.0
		Acpi 4.0	Nutzen der ACPI Funktionen gemäß v4.0
Legacy	Konfiguration und Anzeige der Boot Reihenfolge.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Legacy" auf Seite 150

Tabelle 143: US15W Boot - Menü Einstellmöglichkeiten

1.8.1 Legacy

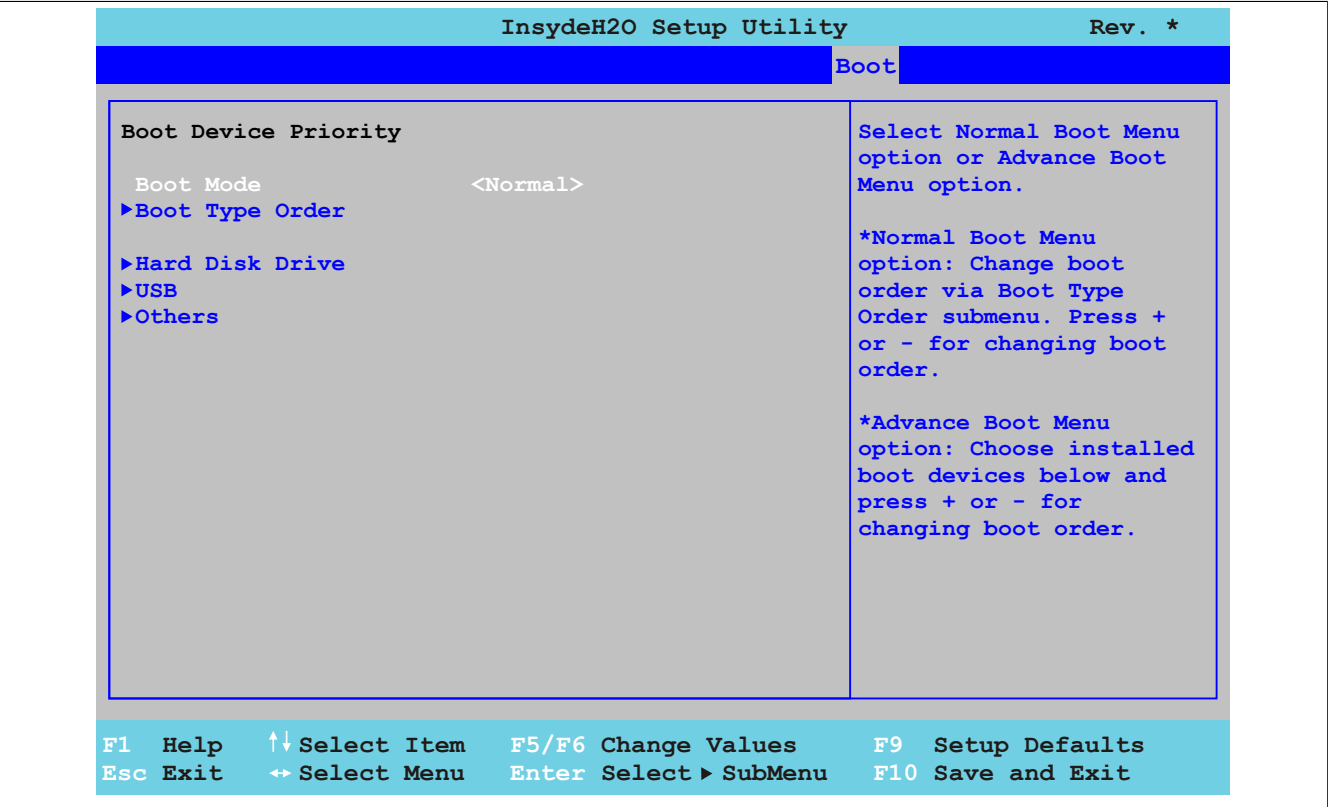


Abbildung 80: US15W Boot - Legacy

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Boot Mode	Konfiguration des Boot Modus.	Normal	Hier werden die Untermenüs angezeigt, in denen die Einstellungen zu Bootreihenfolge vorgenommen werden können.
		Advanced	Hier werden nur die Produktnamen der bootbaren gesteckten Medien angezeigt. Die Bootreihenfolge kann hier direkt vorgenommen werden.
Boot Type Order ¹⁾	Konfiguration der Boot Type Order Einstellungen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Boot Type Order" auf Seite 151
Hard Disk Drive ¹⁾²⁾	Anzeige von gesteckten CompactFlash Karten.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Hard Disk Drive" auf Seite 152
USB ¹⁾³⁾	Anzeige von gesteckten USB Memory Sticks.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "USB" auf Seite 152
Others ¹⁾⁴⁾	Anzeige des CPU Boards / Baseboards für PXE Boot mit den onboard Ethernet Schnittstellen.	Enter	öffnen des Submenüs siehe "Others" auf Seite 153

Tabelle 144: US15W Boot - Legacy Einstellmöglichkeiten

- 1) Diese Submenüs werden nur angezeigt, wenn *Normal Boot Mode* auf *Normal* eingestellt ist.
- 2) Wird nur bei gesteckter CompactFlash Karte angezeigt.
- 3) Wird nur bei gestecktem USB Memory Stick angezeigt.
- 4) Wird nur angezeigt, wenn *PXE Boot to LAN* im Boot Menü auf *Enabled* eingestellt ist.

1.8.1.1 Boot Type Order

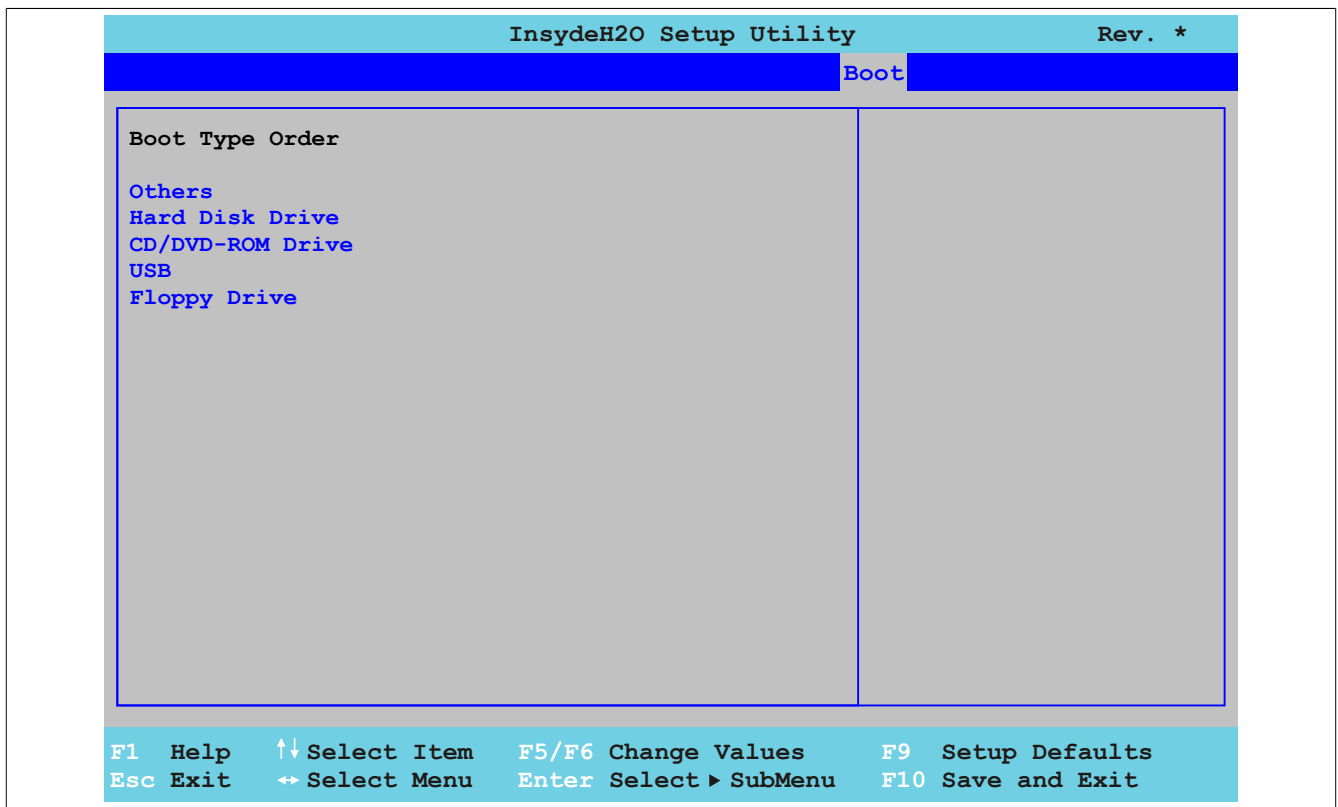


Abbildung 81: US15W Boot - Legacy - Boot Type Order

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Others	Unter dieser Option können die Boot- Laufwerke eingestellt werden.	Others	Auswahl der gewünschten Reihenfolge.
Hard Disk Drive		Hard Disk Drive	
CD/DVD-ROM Drive		CD/DVD-ROM Drive	
USB		USB	
Floppy Drive		Floppy Drive	

Tabelle 145: US15W Boot - Legacy - Boot Type Order Einstellmöglichkeiten

1.8.1.2 Hard Disk Drive

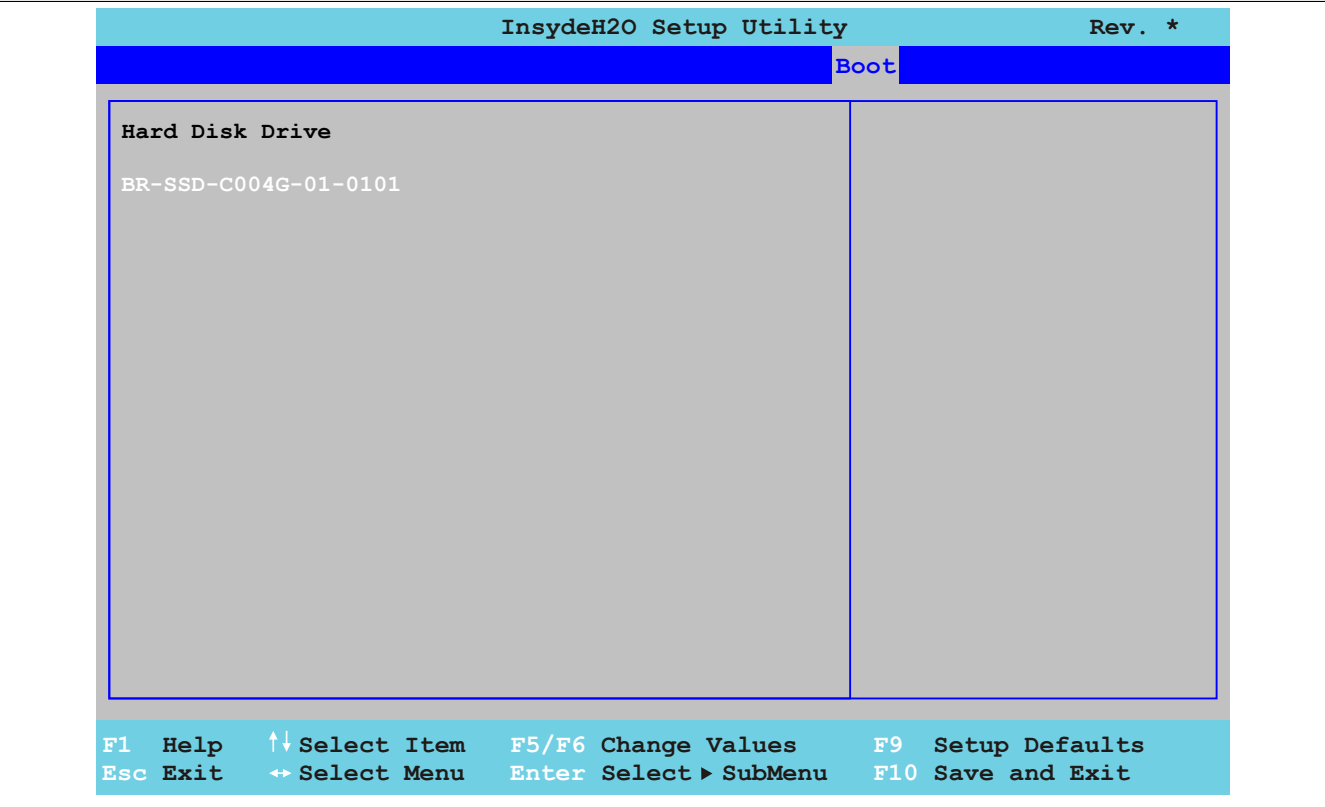


Abbildung 82: US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Anzeige von gesteckten CompactFlash Karten.	keine	-

Tabelle 146: US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive Einstellmöglichkeiten

1.8.1.3 USB

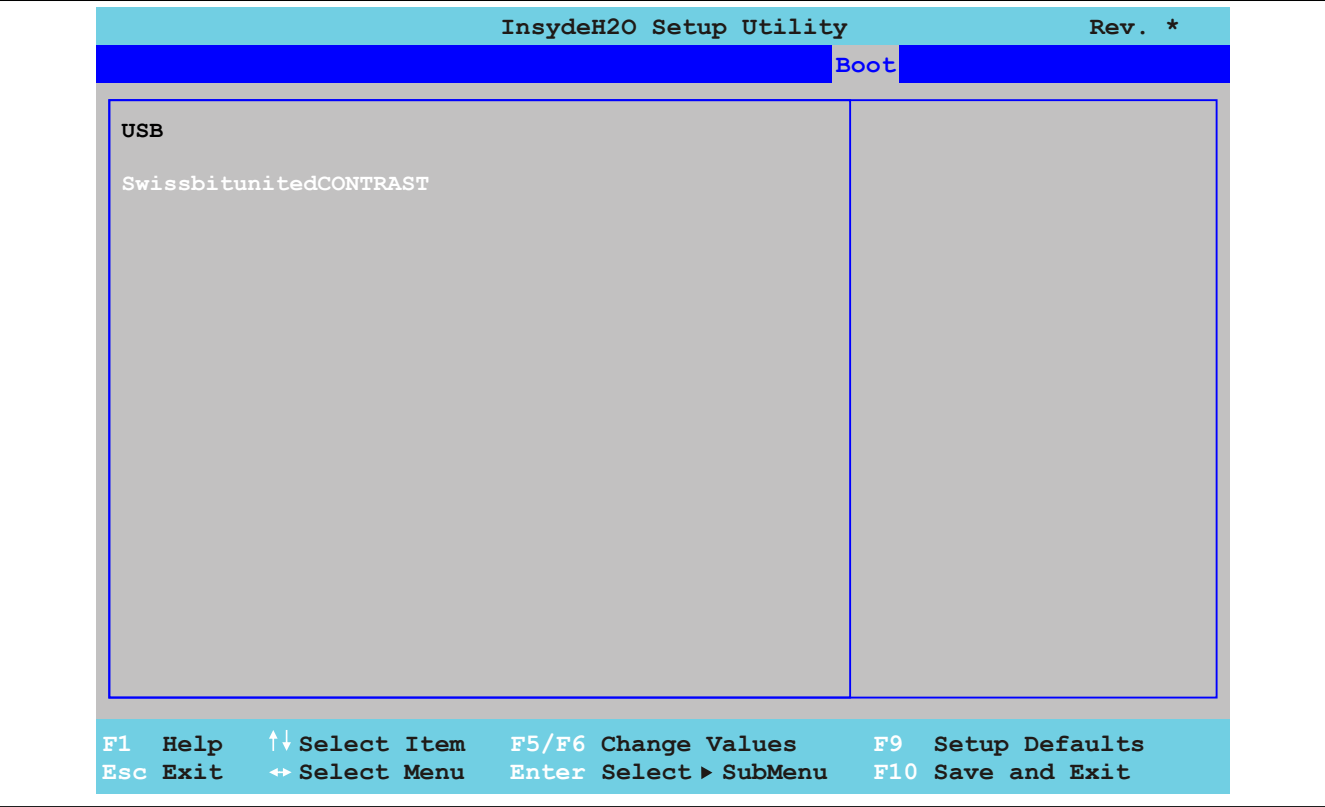


Abbildung 83: US15W Boot - Legacy - USB

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
	Anzeige von gesteckten USB Memory Sticks.	keine	-

Tabelle 147: US15W Boot - Legacy - USB Einstellmöglichkeiten

1.8.1.4 Others

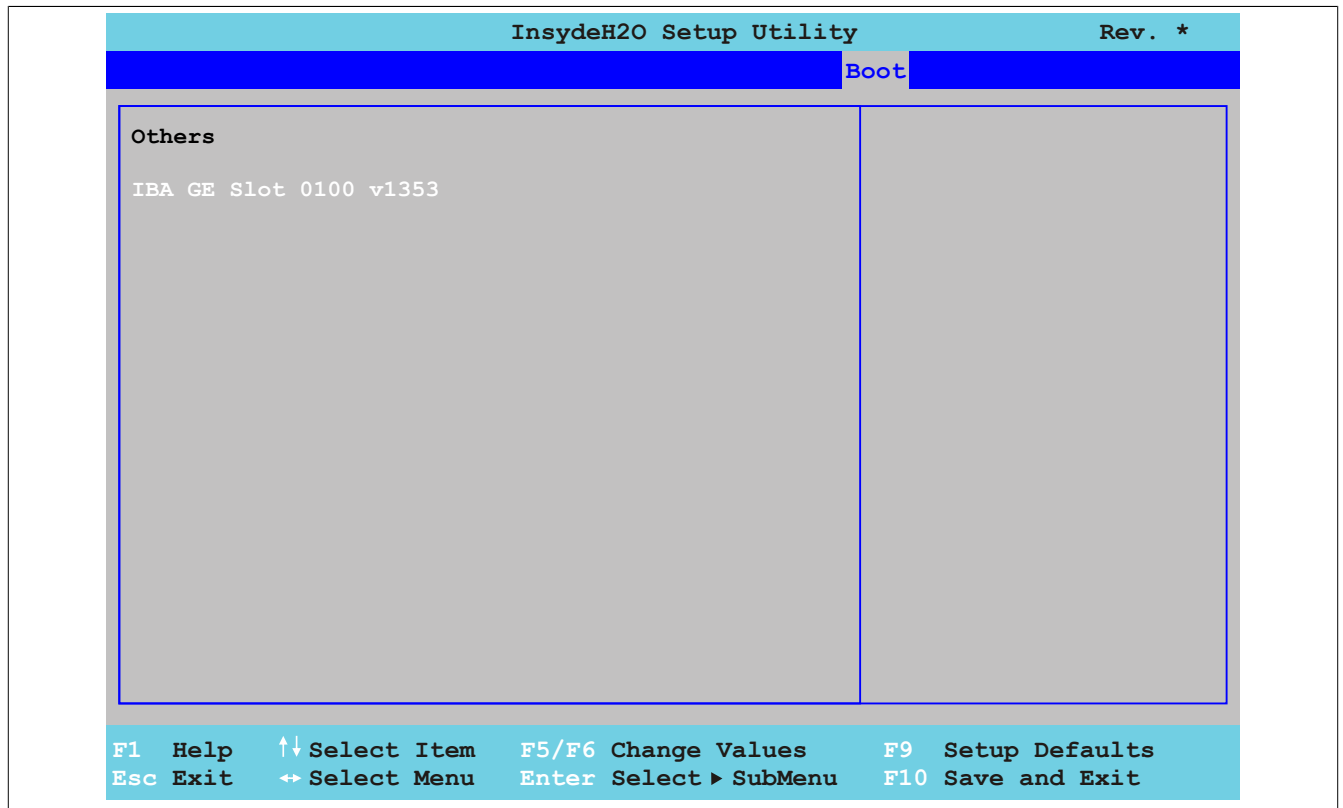


Abbildung 84: US15W Boot - Legacy - Others

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
-	Anzeige des CPU Boards / Baseboards für PXE Boot mit den onboard Ethernet Schnittstellen.	keine	-

Tabelle 148: US15W Boot - Legacy - Others Einstellmöglichkeiten

1.9 Exit

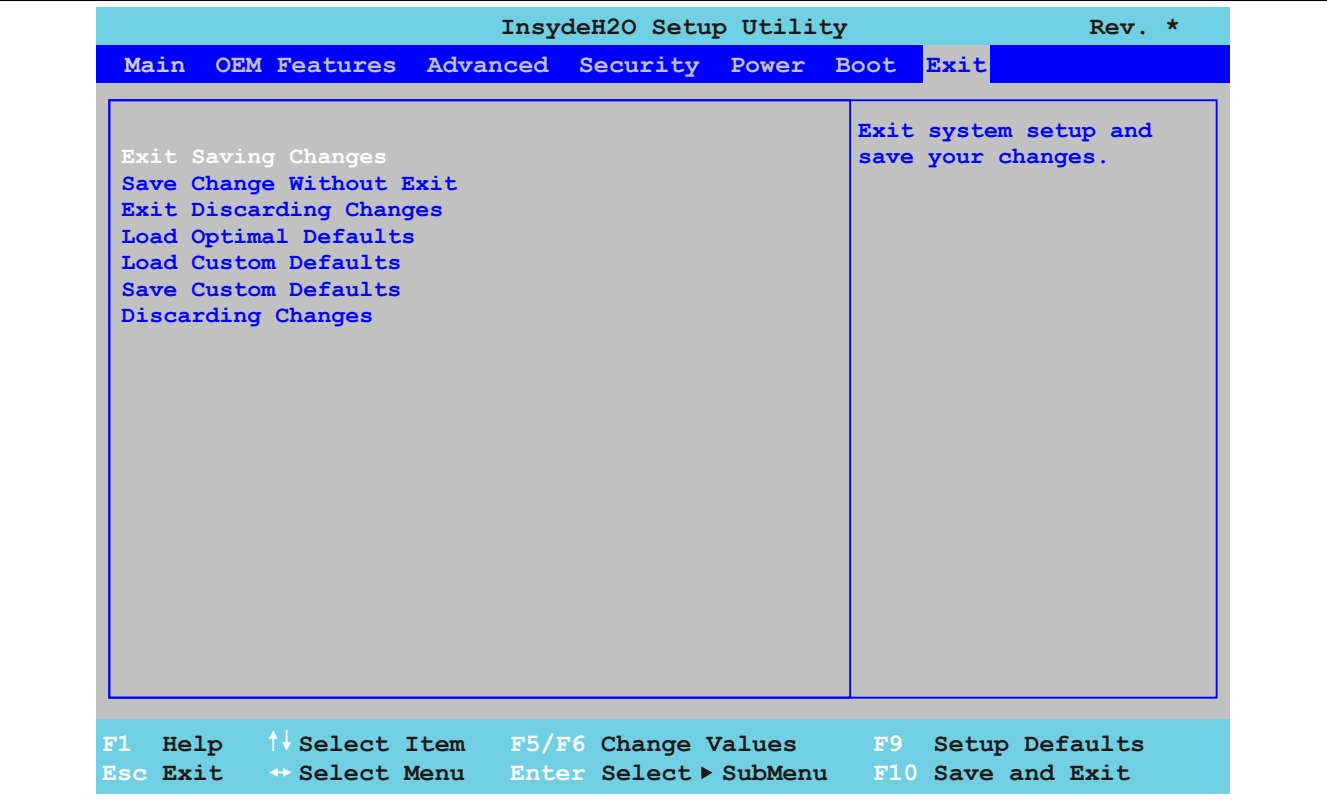


Abbildung 85: US15W Exit - Menü

BIOS Einstellung	Bedeutung	Einstellmöglichkeiten	Wirkung
Exit Saving Changes	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet. Vorgenommene Änderungen werden nach Bestätigung im CMOS gespeichert und das System wird rebootet.	OK / Cancel	
Save Change Without Exit	Bei diesem Punkt werden vorgenommene Änderungen nach Bestätigung im CMOS gespeichert.	OK / Cancel	
Exit Discarding Changes	Bei diesem Punkt wird das BIOS Setup beendet, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Das System wird zusätzlich rebootet.	OK / Cancel	
Load Optimal Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhängigkeit der Mode / Node Schalter definierten CMOS Default Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	
Load Custom Defaults	Bei diesem Punkt werden die in Abhängigkeit der Mode / Node Schalter definierten CMOS Werte geladen. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen geladen und eingestellt.	OK / Cancel	
Save Custom Defaults	Bei diesem Punkt werden definierten CMOS Werte gespeichert. Diese Werte werden für alle BIOS Einstellungen gespeichert.	OK / Cancel	
Discarding Changes	Werden Einstellungen vorgenommen und man weiß nicht mehr welche Einstellungen vorgenommen wurden, können diese wieder zurückgesetzt werden, sofern diese nicht schon gespeichert wurden.	OK / Cancel	

Tabelle 149: US15W Exit - Menü Einstellmöglichkeiten

1.10 BIOS Defaulteinstellungen

Die nachfolgend aufgelisteten BIOS Einstellungen entsprechen jenen Einstellungen, welche nach dem Ausführen der Funktion „Load Optimal Defaults“ im BIOS Setup Hauptmenü „Exit“ oder beim Drücken von <F9> bei den einzelnen BIOS Setup Seiten für diese BIOS Setup Seite optimierten Werte.

1.10.1 Main

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
InsydeH2O Version	-	
Processor Type	-	
System Bus Speed	-	
System Memory Speed	-	
Cache RAM	-	
Total Memory	-	
SODIMM 0	-	
System Time	-	
System Date	-	

Tabelle 150: US15W - Main Profileinstellungsübersicht

1.10.2 OEM Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
BIOS	-	
Boot Source	-	
MTCX	-	

Tabelle 151: US15W - OEM Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.1 CPU Board Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
User Serial ID	-	
LAN1 MAC ADDRESS	-	
LPC Devices		
COMA	-	
Base I/O Address	3F8	
Interrupt	IRQ4	
Statistical Values		
Sensor 1	-	
Sensor 2	-	
Sensor 3	-	
Total Hours	-	
Power On Cycles	-	
Temperature Values		
Refresh Values	-	
Sensor 1	-	
Sensor 2	-	
Sensor 3	-	
Temperature Values		
Wcpu	-	
Vin	-	
Battery Voltage	-	
Battery State	-	

Tabelle 152: US15W - CPU Board Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.2 System Unit Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
User Serial ID	-	
Display (0) Brightness	Auto	
LPC Devices		
COMB	-	
Base I/O Address	2F8	
Interrupt	IRQ3	
Statistical Values		
Sensor 1	-	
Total Hours	-	
Power On Cycles	-	
Temperature Values		
Refresh Values	-	
Sensor 1	-	

Tabelle 153: US15W - System Unit Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.3 I/O Board Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
FPGA Version	-	
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
User Serial ID	-	
I/O Board LPC Devices		
COMC		
Base I/O Address	3E8	
Interrupt	IRQ11	
COMD		
Base I/O Address	2E8	
Interrupt	IRQ10	
Statistical Values		
Sensor 1	-	
Total Hours	-	
Power On Cycles	-	
Refresh Values		
Sensor 1	-	
Panel Control		
Select Panel Number	1	
Version	-	
Brightness	100%	
Fan Speed	-	
Keys/Leds	-	
Temperature	-	

Tabelle 154: US15W - I/O Board Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.4 IF Board Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	

Tabelle 155: US15W - IF Board Features Profileinstellungsübersicht

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
User Serial ID	-	
LAN2 MAC ADDRESS	-	
Statistical Values		
Total Hours	-	
Power On Cycles	-	

Tabelle 155: US15W - IF Board Features Profileinstellungsübersicht

1.10.2.5 Memory Module Features

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Device ID	-	
Compatibility ID	-	
Vendor ID	-	
Hardware Revision	-	
Serial Number	-	
Product Name	-	
Hardware Number	-	
Parent Device ID	-	
Parent Compatib. ID	-	
User Serial ID	-	

Tabelle 156: US15W - Memory Module Features Profileinstellungsübersicht

1.10.3 Advanced

1.10.3.1 RAM Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Refresh Rate	Auto	

Tabelle 157: US15W - RAM Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.2 Boot Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Numlock	On	

Tabelle 158: US15W - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.3 Peripheral Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
High Definition Audio ¹⁾	Auto	

Tabelle 159: US15W - Peripheral Configuration Profileinstellungsübersicht

1) Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn ein Audio Anschluss vorhanden ist.

1.10.3.4 IDE Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Channel 1 Master	Enabled ¹⁾	
Channel 1 Master		
Transfer Mode	-	
Security Mode	-	
Channel 1 Slave	Enabled ¹⁾	
Channel 1 Slave		
Transfer Mode	-	
Security Mode	-	

Tabelle 160: US15W - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht

1) Nur bei eingebautem Laufwerk.

1.10.3.5 Video Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
IGD - Pre-Allocated Memory	UMA = 8MB	
IGD - Boot Type	Auto	
IGD - LCD Panel Type ¹⁾	640x480 (5.7) LVDS	
Reomte Panel	Disabled ²⁾	

Tabelle 161: US15W - Video Configuration Profileinstellungsübersicht

- 1) Diese Einstellung ist nur für PP500 Systemeinheiten möglich.
 2) Bei APC511 Systemeinheiten ohne I/O Board ist diese Option per Default "Enabled".

1.10.3.6 USB Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
USB Legacy	Enabled	
EHCI	Enabled	
UHCI 1	Enabled	
UHCI 2	Ist kein I/O Board gesteckt: Disabled Ist ein I/O Board gesteckt: Enabled	
UHCI 3	Enabled	
USB Client	Disabled	

Tabelle 162: US15W - USB Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.7 SDIO Configuration

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
SDIO Port 1	Enabled	
SDIO Port 2	Enabled	

Tabelle 163: US15W - SDIO Configuration Profileinstellungsübersicht

1.10.3.8 ACPI Table/Features Control

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
FACP - C2 Latency Value	Disabled	
FACP - C3 Latency Value	Disabled	
HPET - HPET Support	Enabled	
APIC - IO APIC Mode	Enabled	

Tabelle 164: US15W - ACPI Table/Features Control Profileinstellungsübersicht

1.10.3.9 PCI Express Root Port 1

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
PCI Express Root Port 1	Enabled	
Interrupt Pin 0	Auto	
VC1 Enable	Disabled	
VC1/TC Mapping	Disabled	
ASPM	Disabled	
Automatic ASPM	Disabled	
ASPM L0s	Disabled	
ASPM L1s	Disabled	
URR	Disabled	
FER	Disabled	
NFER	Disabled	
CER	Disabled	
CT0	Disabled	
SEFE	Disabled	
SENFE	Disabled	
SECE	Disabled	
PME Interrupt	Disabled	
PME SCI	Disabled	
Hot Plug SCI	Disabled	

Tabelle 165: US15W - PCI Express Root Port 1 Profileinstellungsübersicht

1.10.3.10 PCI Express Root Port 2

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
PCI Express Root Port 2	Enabled	
Interrupt Pin 1	Ist keine Feldbus Karte gesteckt: Auto Ist eine Feldbus Karte gesteckt: Disabled	
VC1 Enable	Disabled	
VC1/TC Mapping	Disabled	
ASPM	Disabled	
Automatic ASPM	Disabled	
ASPM L0s	Disabled	
ASPM L1s	Disabled	
URR	Disabled	
FER	Disabled	
NFER	Disabled	
CER	Disabled	
CT0	Disabled	
SEFE	Disabled	
SENE	Disabled	
SECE	Disabled	
PME Interrupt	Disabled	
PME SCI	Disabled	
Hot Plug SCI	Disabled	

Tabelle 166: US15W - PCI Express Root Port 2 Profileinstellungsübersicht

1.10.3.11 Console Redirection

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Console Serial Redirect	Enabled	
Information Wait Time	5 Seconds	
Serial Port	COM_A	
Terminal Type	PC_ANSI	
Baud Rate	57600	
Data Bits	8 Bits	
Parity	None	
Stop Bits	1 Bit	
Flow Control	None	
ACPI SPCR Table	Disabled	

Tabelle 167: US15W - Console Redirection Profileinstellungsübersicht

1.10.4 Power

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Power Loss Control	wird von den EEPROM Daten ausgelesen	
ACPI S3	Disabled	

Tabelle 168: US15W - Power Profileinstellungsübersicht

1.10.4.1 Advanced CPU Control

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
P-States(IST)	Enabled	
CMP Support	Enabled	
Thermal Mode	TM1 and TM2	
Use XD Capability	Enabled	
VT Support	Enabled	
SMRR Support	Enabled	
C-States	Disabled	
Enhanced C-States	Disabled	
C-States Pop Up Mode	Disabled	
C-States Pop Down Mode	Disabled	
Hard C4E	Disabled	
Enable C6	Disabled	
DTS	Enabled	
Thermal Trip Point Settings		
Throttle On Temperature	100°C	

Tabelle 169: US15W - Advanced CPU Control Profileinstellungsübersicht

1.10.4.2 Platform Power Management

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
PCI Clock Run	Disabled	
_CST - C4 Latency Value	Disabled	
C4 on C3 - Deeper Sleep	Disabled	

Tabelle 170: US15W - Platform Power Management Profileinstellungsübersicht

1.10.5 Boot

Einstellung / Anzeige	Profil 0	Meine Einstellung
Quick Boot	Enabled	
Quiet Boot	Enabled	
Delay for Logo & Summary	Default	
USB Boot	Enabled	
SD Card Boot	Disabled	
PXE Boot to LAN	Disabled	
ACPI Selection	Acpi3.0	

Tabelle 171: US15W - Boot Profileinstellungsübersicht

1.11 Ressourcenaufteilung

1.11.1 RAM-Adressbelegung

RAM Adresse	Adresse in Hex	Ressource
(TOM - FB ¹⁾) – TOM ²⁾	N.A.	ACPI reclaim, MPS und NVS area ³⁾
(TOM - FB - TSEG ⁴⁾) – (TOM - FB)	N.A.	VGA frame buffer ⁵⁾
1024 kB – (TOM - 8 MB - 192 kB)	100000h - N.A.	Extended memory
896 kB – 1024 kB	0E0000h - 0FFFFFFh	Runtime BIOS
832 kB – 896 kB	0D0000h - 0DFFFFh	Upper memory
640 kB – 832 kB	0A0000h - 0CFFFFh	Video memory and BIOS
639 kB – 640 kB	09FC00h - 09FFFFh	Extended BIOS data
0 – 639 kB	000000h - 09FC00h	Conventional memory

Tabelle 172: RAM-Adressbelegung

- 1) FB - VGA frame buffer
- 2) TOM - Top of memory: max. installierter DRAM
- 3) Nur wenn ACPI Aware OS im Setup auf „YES“ eingestellt ist.
- 4) TSEG - Intern vorgesehen beim System BIOS für SMI Handling.
- 5) Der VGA Grafikspeicher kann im Setup auf 1 MB reduziert werden.

1.11.2 I/O-Adressbelegung

I/O Adresse	Ressource
0000h - 00FFh	Motherboard Ressourcen
01F0h - 01F7h	Primary IDE Kanal
03B0h - 03DFh	Video System
03F6h - 03F6h	Primary IDE Kanal Kommando Port
03F7h - 03F7h	Primary IDE Kanal Status Port
03F8h - 03FFh	COM1
0480h - 04BFh	Motherboard Ressourcen
04D0h - 04D1h	Motherboard Ressourcen
0800h - 087Fh	Motherboard Ressourcen
0CF8h - 0CFBh	PCI Config Address Register
0CFCh - 0CFFh	PCI Config Data Register
0D00h - FFFFh	PCI / PCI Express Bus ¹⁾
4100h - 417Fh	MTCX
FF00h - FF07h	IDE Bus Master Register

Tabelle 173: I/O-Adressbelegung

- 1) Das BIOS weist dem PCI und PCI Express Bus I/O Ressourcen von FFF0h abwärts zu. Nicht PnP/PCI/PCI Express fähige Geräte dürfen die I/O Ressourcen in diesem Bereich nicht verwenden.

1.11.3 Interrupt- Zuweisungen in PIC Mode

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	NMI	NONE
Systemtimer	•																	
Tastatur		•																
IRQ Kaskade			•															
COM1 (Serial port A)				○	•	○	○				○	○	○					
COM2 (Serial port B)				•	○	○	○				○	○	○					
ACPI ¹⁾										•								
Echtzeituhr									•									
Coprozessor (FPU)														•				
Primär IDE Kanal															•			
Secondary IDE Kanal																•		

Tabelle 174: IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode

- 1) Advanced Configuration and Power Interface.

- ... Standardeinstellung
- ... mögliche Einstellung

1.11.4 Interrupt- Zuweisungen in APIC Mode

Im APIC (**A**dvanced **P**rogrammable Interrupt **C**ontroller) Mode stehen insgesamt 23 IRQs zur Verfügung. Die Aktivierung der Option wird nur dann wirksam, wenn diese vor der Installation des Betriebssystems aktiviert wird.

IRQ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	NMI	NO-NE
Systemtimer	•																									
Tastatur		•																								
IRQ Kaskade			•																							
COM1 (Serial port A)				○	•	○	○				○	○	○													
COM2 (Serial port B)				•	○	○	○				○	○	○													
ACPI ¹⁾									•																	
Echtzeituhr									•																	
Coprozessor (FPU)														•												
Primary IDE Kanal															•											
Secondary IDE Kanal																•										
PIRQ A ²⁾																	•									
PIRQ B ³⁾																		•								
PIRQ C ⁴⁾																			•							
PIRQ D ⁵⁾																				•						
PIRQ E ⁶⁾																					•					
PIRQ F ⁷⁾																						•				
PIRQ G ⁸⁾																							•			
PIRQ H ⁹⁾																								•		

Tabelle 175: IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode

- 1) **A**dvanced **C**onfiguration and **P**ower **I**nterface.
- 2) PIRQ A: für IF Board; GMA500 Grafikcontroller, LPC, Root Port 1, Ethernet Controller, USB Client
- 3) PIRQ B: für IF Board; Root Port 2
- 4) PIRQ C: für IF Board
- 5) PIRQ D: für IF Board; HDA Audio
- 6) PIRQ E: UHCI Host Controller 0, SDIO 0 Controller
- 7) PIRQ F: UHCI Host Controller 1, SDIO 1 Controller
- 8) PIRQ G: UHCI Host Controller 2, SDIO 2 Controller
- 9) PIRQ H: EHCI Host Controller

- ... Standardeinstellung
- ... mögliche Einstellung

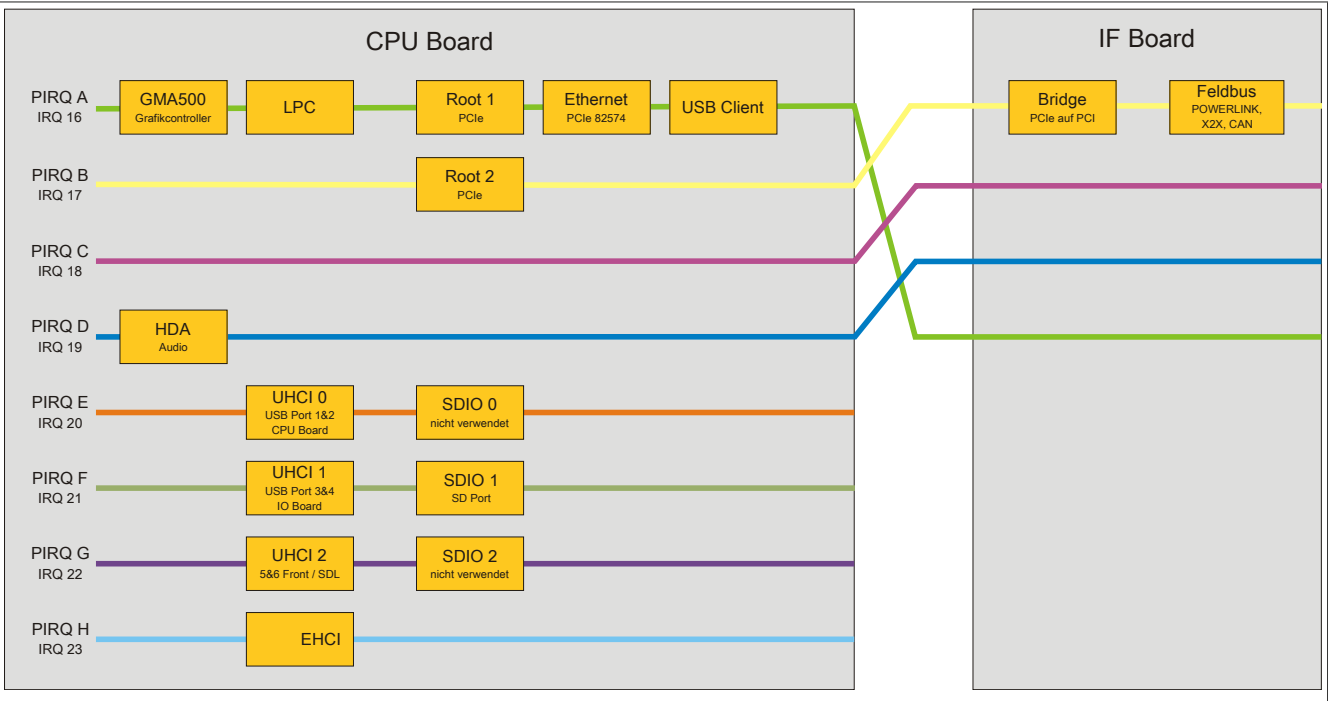


Abbildung 86: Interrupt Routing mit aktiviertem APIC - ab BIOS Version N0.15

2 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.1 BIOS Upgrade

Ein Upgrade kann z.B. aus folgendem Grund notwendig sein:

- Um die im BIOS Setup implementierten Funktionen zu aktualisieren bzw. neu realisierte Funktionen oder Komponenten hinzuzufügen (Informationen über Änderungen können der Liesmich bzw. der Readme Datei des BIOS Upgrades entnommen werden).

2.1.1 Was muss ich wissen?

Information:

Bei einem BIOS Upgrade werden individuell gespeicherte BIOS Einstellungen gelöscht.

Bevor man mit dem Upgrade beginnt, ist es sinnvoll die verschiedenen Softwareversionen festzustellen.

2.1.1.1 Welche BIOS Version und Firmware ist bereits am Gerät installiert?

Diese Informationen sind auf folgender BIOS Setupseite zu finden:

- Nach dem Einschalten des Gerätes gelangt man mit „F2“ ins BIOS Setup.
- Unter dem BIOS Hauptmenü „OEM Features“ kann die aktuelle BIOS und MTCX Version ermittelt werden.

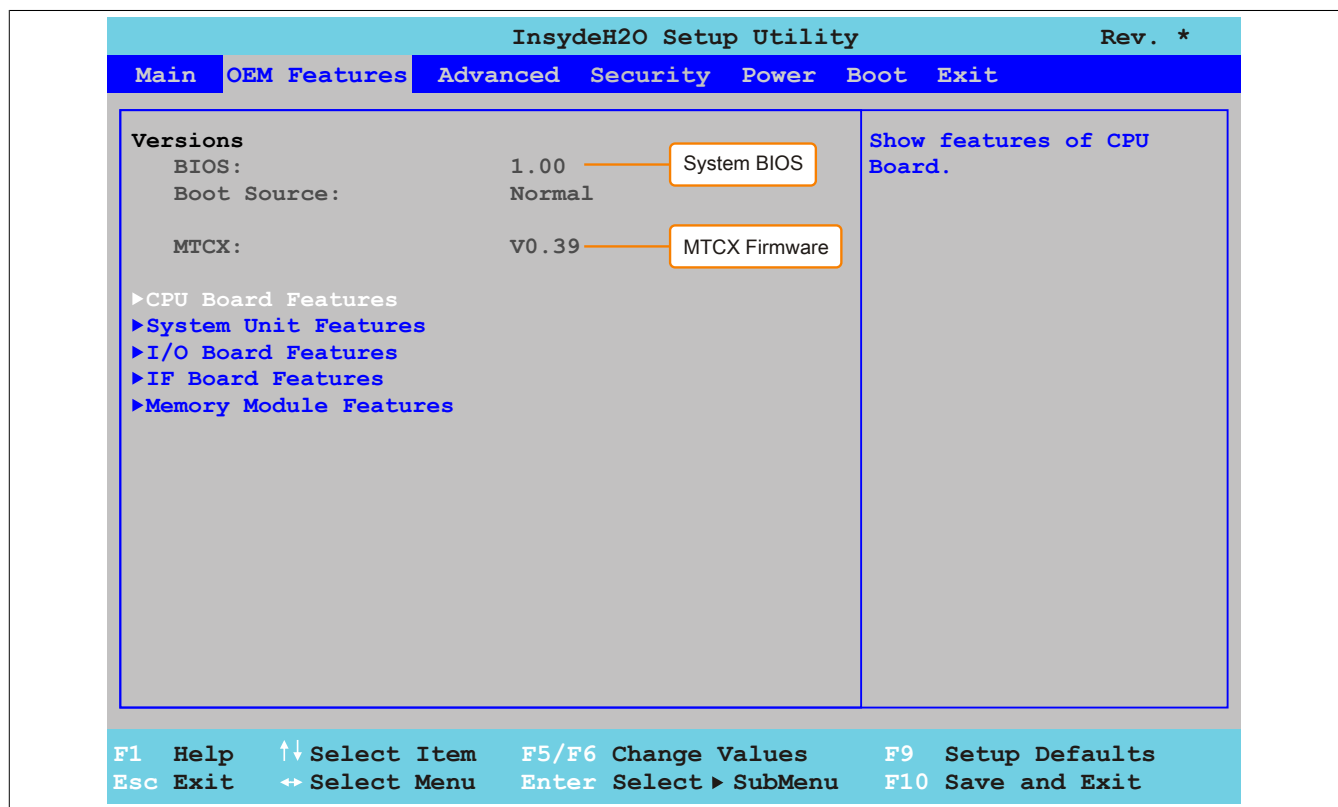


Abbildung 87: BIOS und MTCX Softwareversionen

Die Informationen über die BIOS und Firmware Version können auch dem Control Center (Start->Systemsteuerung->Control Center->Versionen) entnommen werden.

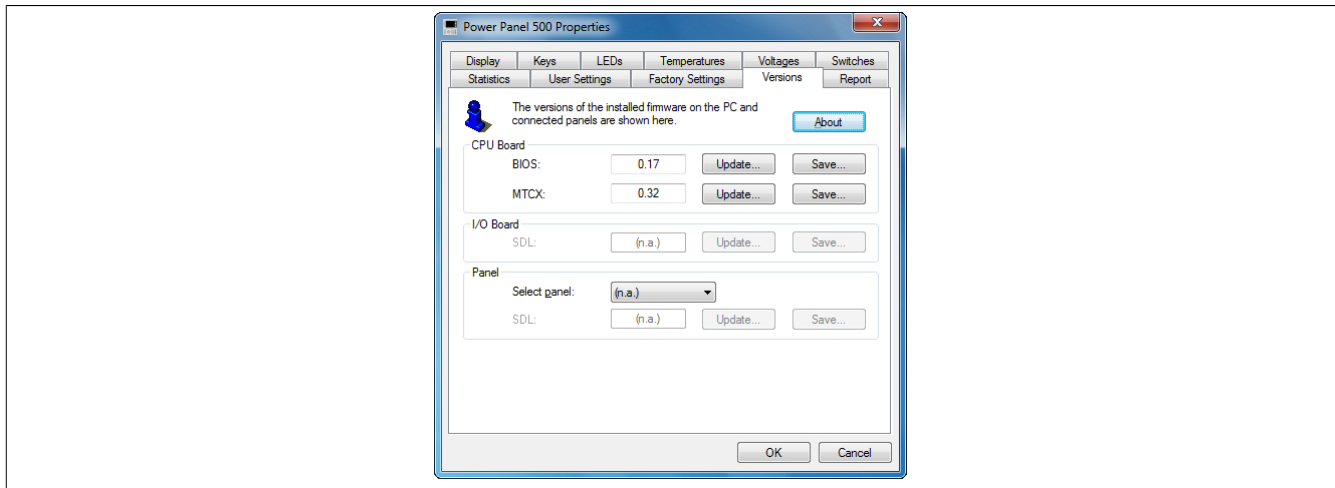


Abbildung 88: BIOS und MTCX Softwareversionen - Control Center

2.1.2 Vorgangsweise mit dem Control Center

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. In der Systemsteuerung das **Control Center** öffnen
3. Die Registerkarte **Versionen** öffnen
4. Unter **CPU Board** bei **BIOS** auf **Update** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.
5. Unter **Dateiname** den Namen der BIOS Datei eingeben oder eine Datei auswählen.
6. Auf **Öffnen** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. Abbrechen ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann abhängig vom verwendeten Speicherbaustein mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Das System muss neu gestartet werden, damit das neue BIOS wirksam wird und die aktualisierte Version angezeigt wird. Beim Beenden des Control Centers, wird eine Aufforderung zum Systemneustart angezeigt.

Information:

Genauere Informationen zum Sichern und Updaten des BIOS ist der Control Center Hilfe zu entnehmen.

2.2 Firmwareupgrade

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt über den Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2.2.1 Vorgangsweise

1. ZIP Datei von der B&R Homepage (www.br-automation.com) downloaden.
2. In der Systemsteuerung das **Control Center** öffnen.
3. Die Registerkarte **Versionen** öffnen.
4. Unter **CPU Board** bei **MTCX** bzw. **MTCX FPGA** auf **Update** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.
5. Unter **Dateiname** den Namen der Firmwaredatei eingeben oder eine Datei auswählen.
6. Auf **Öffnen** klicken. Der Dialog "Öffnen" wird geöffnet.

Die Übertragung kann durch Klicken auf **Abbrechen** im Download Dialog abgebrochen werden. **Abbrechen** ist während des Schreibens auf den Flashspeicher deaktiviert.

Warnung!

Während der Übertragung der Firmware dürfen keine Paneltasten gedrückt werden! Dies kann den Vorgang stören.

Das Löschen der Daten im Flashspeicher kann abhängig vom verwendeten Speicherbaustein mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wird die Fortschrittsanzeige nicht aktualisiert.

Information:

Die Stromversorgung des PC muss aus- und wieder einschaltet werden, damit die neue Firmware wirksam und die aktualisierte Version angezeigt wird. Beim Beenden des Control Centers wird eine Aufforderung dazu angezeigt.

Information:

Genauere Informationen zum Sichern und Updaten der Firmware ist der Control Center Hilfe zu entnehmen.

2.3 Upgradeprobleme

Mögliche Upgradeprobleme können in den Liesmich.txt bzw. Readme.txt Dateien der Upgrade Disks nachgelesen werden.

3 Windows 7

3.1 Allgemeines

Windows® 7 bietet eine Vielzahl innovativer Features und Leistungsverbesserungen. Schnelleres Versetzen in den Energiesparmodus, schnelleres Wiederherstellen, geringere Speichernutzung und schnelleres Erkennen von USB-Geräten sind nur einige der Vorteile, die Windows® 7 bietet. In der Professional Ausführung steht Windows® 7 in den Sprachvarianten Deutsch und Englisch zur Verfügung, während Windows® 7 Ultimate bis zu 35 Sprachen (ab Service Pack 1 bis zu 36 Sprachen) unterstützt. Eine Produktaktivierung ist beim Einsatz auf B&R PCs nicht erforderlich, ein großer Vorteil für einfache logistische Abläufe im Zuge der Maschinenautomatisierung.

Alle von B&R angebotenen Windows® Betriebssysteme stammen von der Microsoft Embedded Division. Dies bedeutet eine gegenüber dem Consumermarkt erheblich längere Verfügbarkeit.

3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows 7 Professional/Ultimate	
5SWWI7.0100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1100-ENG	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1100-GER	Microsoft OEM Windows 7 Professional 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.0300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWI7.1300-MUL	Microsoft OEM Windows 7 Ultimate 32-Bit, Service Pack 1, DVD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 176: 5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL - Bestelldaten

3.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1100-ENG	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.1100-GER	Professional	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Deutsch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 US15W		32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.1300-MUL	Ultimate	APC510 APC511 APC810 APC910 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP1	32-Bit	Multilingual	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

3.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows 7 Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

3.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

3.6 Eigenheiten, Einschränkungen

- In Windows 7 ist kein Beep.sys mehr enthalten, somit ist auch z.B. bei einem Tastendruck kein akustisches Signal mehr hörbar.
- Die Ermittlung der Windows 7 Systembewertung (Systemklassifikation) wird aktuell nicht unterstützt (dies gilt nicht für PP500, APC510, APC511, APC910 und PPC800 mit NM10 Chipsatz).

4 Windows Embedded Standard 7

4.1 Allgemeines

Das Pendant zu Windows® XP Embedded heißt in der neuen Variante Windows® Embedded Standard 7. Wie bei den Vorgängerversionen bietet das embedded Betriebssystem die volle Systemunterstützung von B&R Industrie PCs. Windows® Embedded Standard 7 beinhaltet neben neuen Features, die auch in Windows® 7 Professional enthalten sind, die bewährten embedded Komponenten wie Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter und USB Boot. Windows® Embedded Standard 7 wird in zwei Versionen geliefert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Möglichkeit der mehrsprachigen Ausführung. Die Basisvariante Windows® Embedded Standard 7 wird in einer Sprachversion geliefert, während Windows® Embedded Standard 7 Premium mehrere gleichzeitig installierte Sprachen unterstützt.

Bei Windows® Embedded Standard 7 hat Microsoft beim Thema Sicherheit nochmals nachgelegt. Der AppLocker der Premium Variante kann die Ausführung von unbekannten und möglicherweise unerwünschten Applikationen verhindern, die zum Beispiel über Netzwerk oder direkt angeschlossene Laufwerke installiert werden sollen. Dabei kann abgestuft zwischen Skripten (.ps1, .bat, .cmd, .vbs, and .js), Installer Files (.msi, .msp) und Libraries (.dll, .ocx) unterschieden werden. Der AppLocker kann so konfiguriert werden, dass er verbotene Aktivitäten aufzeichnet und im EventViewer darstellt. Windows® Embedded Standard 7 wird sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit Version angeboten.⁴⁾ Damit werden auch anspruchsvolle Applikationen unterstützt, die auf 64-Bit Basis laufen.

4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0537-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	
5SWWI7.1537-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
5SWWI7.0737-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Multilanguage; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 8 GByte).	
5SWWI7.1737-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 Premium 32-Bit, Service Pack 1, Multilanguage; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 16 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
	Optionales Zubehör	
	Windows Embedded Standard 7	
5SWWI7.0900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Language Pack DVD	
5SWWI7.1900-MUL	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 7 32-Bit, Service Pack 1, Language Pack DVD	

Tabelle 177: 5SWWI7.0537-ENG, 5SWWI7.1537-ENG, 5SWWI7.0737-MUL, 5SWWI7.1737-MUL - Bestelldaten

4.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWI7.0537-ENG	Embedded	APC510	US15W		32-Bit	Englisch	auf Wunsch	8 GByte	1 GByte
5SWWI7.1537-ENG	Embedded	APC510	US15W	SP1	32-Bit	Englisch	auf Wunsch	16 GByte	1 GByte
5SWWI7.0737-MUL	Premium	APC510	US15W		32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	8 GByte ¹⁾	1 GByte
5SWWI7.1737-MUL	Premium	APC510	US15W	SP1	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	16 GByte ¹⁾	1 GByte

1) Bei der Mindestgröße des Datenträgers wird der Speicherbedarf der zusätzlichen Sprachpakete nicht berücksichtigt.

⁴⁾ 64-Bit Versionen werden nicht von allen Systemen unterstützt

4.4 Features mit WES7 (Windows Embedded Standard 7)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen und Unterschiede von Windows Embedded Standard 7 und Windows Embedded Standard 7 Premium.

Funktion	Windows Embedded Standard 7	Windows Embedded Standard 7 Premium
Enhanced Write Filter (EWF)	✓	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓	✓
Administrator Account	✓	✓
User Account	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows Explorer Shell	✓	✓
Registry Filter	✓	✓
Internet Explorer 8.0	✓	✓
Internet Information Service (IIS) 7.0	✓	✓
AntiMalware (Windows Defender)	-	✓
Add-ons (Snipping tool, Sticky Notes)	-	✓
Windows Firewall	✓	✓
.NET Framework 3.5	✓	✓
Remote Desktop Protocol 7.0	✓	✓
File Compression Utility	✓	✓
Windows Installer Service	✓	✓
Windows XP Mode	-	-
Media Player 12	✓	✓
DirectX	✓	✓
Multilingual User Interface Packs im selben Image	-	✓
International Components and Language Services	✓	✓
Language Pack Setup	✓	✓
Windows Update	konfigurierbar	konfigurierbar
Windows PowerShell 2.0	✓	✓
BitLocker	-	✓
AppLocker	-	✓
Tablet PC Support	-	✓
Windows Touch	-	✓
Boot from USB Stick	✓	✓
Accessories	✓	✓
Pagefile	konfigurierbar	konfigurierbar
Anzahl der Fonts	134	134

Tabelle 178: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7

4.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 7 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 8 GByte bzw. 16 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 30 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

Information:

Wenn der EWF verwendet werden soll, sind während des Setup oder SYSPREP alle Massenspeicher (außer dem Bootlaufwerk) aus dem System zu entfernen. Alternativ können die zusätzlichen Massenspeicher auch im BIOS deaktiviert werden.

4.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversionen installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

4.6.1 Touch Screen Treiber

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein B&R Automation Panel nachträglich angeschlossen, muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert oder in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Der Treiber kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein „Enhanced Write Filter (EWF)“ oder „File Based Write Filter (FBWF)“ aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

5 Windows XP Professional

5.1 Allgemeines

Information:

Abkündigung des Supportes für Windows XP durch Microsoft:

Ab dem 08. April 2014 werden für Windows XP keine Sicherheitsupdates, Hotfixes, kostenloser oder bezahlter Support sowie technische Ressourcen mehr angeboten.

5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows XP Professional	
5SWWWXP.0600-ENG	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Englisch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWWXP.0600-GER	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Deutsch. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	
5SWWWXP.0600-MUL	Microsoft OEM Windows XP Professional Service Pack 3, CD, Multilanguage. Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät.	

Tabelle 179: 5SWWWXP.0600-ENG, 5SWWWXP.0600-GER, 5SWWWXP.0600-MUL - Bestelldaten

5.3 Übersicht

Bestellnummer	Edition	Zielsystem	Chipsatz	Service Pack	Sprache	Vorinstalliert	Benötigter Speicherplatz auf Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWWXP.0600-ENG	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Englisch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWWXP.0600-GER	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Deutsch	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte
5SWWWXP.0600-MUL	Professional	APC510 APC511 APC620 APC810 APC820 APC910 PPC700 PPC725 PPC800 PPC900 PP500	945GME GM45 QM77/HM76 NM10 US15W	SP3	Multilanguage	auf Wunsch	≤ 2,1 GByte	128 MByte

5.4 Installation

Auf Wunsch wird die benötigte Windows XP Professional Version schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

5.5 Treiber

Aktuelle Treiber für alle freigegebenen Betriebssysteme stehen im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

6 Windows Embedded Standard 2009

6.1 Allgemeines

Windows® Embedded Standard 2009 ist die modulare Variante von Windows® XP Professional. Es kommt zum Einsatz wenn XP Applikationen bei minimierter Betriebssystemgröße ablaufen sollen. In Kombination mit CompactFlash Speichern ermöglicht Windows® Embedded Standard 2009 den Einsatz des Microsoft Desktop Betriebssystems bei rauen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich zu bekannten Features von Windows® XP Professional ist Windows® Embedded Standard 2009 durch einen Write Filter für einzelne Speicherpartitionen in Bezug auf die Zuverlässigkeit verbessert worden. Durch den Schutz einzelner Partitionen, wie der Bootpartition kann das PC System auch nach einem Stromausfall wieder problemlos gestartet werden. Um den Einstieg bei Windows® Embedded Standard 2009 so einfach wie möglich zu gestalten bietet B&R komplette Images für Industrie PCs, Power Panel und Mobile Panel an. Neben Windows® Embedded Standard 2009 steht auch das Standard Betriebssystem Windows® XP Professional in den Varianten deutsch, englisch und multilanguage zur Verfügung.

Windows® Embedded Standard 2009 basiert auf den gleichen Binaries wie Windows® XP Professional mit Service Pack 3 und ist für die verwendete Hardware optimal zugeschnitten, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Aufbauend auf der bewährten Codebasis von Windows® XP Professional mit SP3 liefert Windows® Embedded Standard 2009 in der Industrie führende Zuverlässigkeit, Sicherheitsverbesserungen und Performance zusammen mit den neuesten Möglichkeiten des Webbrowsing und umfangreiche Geräteunterstützung.

6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Windows Embedded Standard 2009	
5SWWXP.0737-ENG	Microsoft OEM Windows Embedded Standard 2009, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 1 GByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 180: 5SWWXP.0737-ENG - Bestelldaten

6.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWXP.0737-ENG	APC510	US15W	Englisch	Ja	1 GByte	256 MByte

6.4 Features mit WES2009 (Windows Embedded Standard 2009)

Die Feature Liste zeigt die wesentlichen Gerätefunktionen von Windows Embedded Standard 2009.

Funktion	vorhanden
Enhanced Write Filter (EWF)	✓
File Based Write Filter (FBWF)	✓
Pagefile	konfigurierbar
Administrator Account	✓
User Account	konfigurierbar
Explorer Shell	✓
Registry Filter	✓
Internet Explorer 8.0	✓
Internet Information Service (IIS)	-
Terminal Service	✓
Windows Firewall	✓
MSN-Explorer	-
Outlook Express	-
Administrative Tools	✓
Remote Desktop	✓
Remote Assistance	-
.NET Framework	-
ASP.NET	-
OpenGL Support	✓
Local Network Bridge	✓

Tabelle 181: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

Funktion	vorhanden
Codepages/User Locale/Keyboard	✓
Disk Management Service	✓
Windows Installer Service	✓
Class Installer	✓
CoDevice Installer	✓
Media Player 6.4	✓
DirectX 9.0c	✓
Accessories	✓
Anzahl der Fonts	89

Tabelle 181: Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009

6.5 Installation

Auf Wunsch wird Windows Embedded Standard 2009 schon im Hause B&R auf einer geeigneten CompactFlash Karte (mind. 1 GByte) vorinstalliert. Nach dem ersten Einschalten wird das System automatisch konfiguriert. Dieser Vorgang nimmt ca. 10 Minuten in Anspruch und das Gerät wird dabei außerdem einige Male automatisch rebootet.

6.6 Treiber

Das Betriebssystem enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber. Sollte eine ältere Treiberversion installiert sein, kann die aktuellste Version über die B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen und installiert werden. Dabei ist nur auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

6.6.1 Touch Screen Treiber

Beim Windows Embedded Standard 2009 Setup wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert. Wurde ein Automation Panel 800/900 nachträglich angeschlossen, muss in den Touch Screen Einstellungen in der Windows Systemsteuerung die zusätzliche Touch Screen Schnittstelle ausgewählt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass kein „Enhanced Write Filter (EWF)“ oder „File Based Write Filter (FBWF)“ aktiviert ist.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

7 Windows CE

7.1 Allgemeines

B&R Windows CE ist ein Betriebssystem, das für das von B&R angebotene Gerät optimal zugeschnitten ist, d.h. es sind nur die Funktionen und Module enthalten, die für das jeweilige Gerät benötigt werden. Dadurch ist dieses Betriebssystem äußerst robust und stabil. Ein weiterer Vorteil den B&R Windows CE gegenüber anderen Betriebssystemen mit sich bringt sind die geringen Lizenzkosten.

7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5SWWCE.0837-ENG	Windows CE 6.0 Microsoft OEM Windows CE 6.0 Professional, Englisch; für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 128 MByte).	
	Erforderliches Zubehör	
	CompactFlash	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 182: 5SWWCE.0837-ENG - Bestelldaten

7.3 Übersicht

Bestellnummer	Zielsystem	Chipsatz	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWWCE.0837-ENG	APC510	US15W	Englisch	Ja	128 MByte	128 MByte

7.4 Features Windows CE 6.0

Eine ausführliche Anleitung zu Windows CE für B&R Geräte kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

Ausstattung	Windows CE 6.0
Unterstützte Bildschirmauflösung	WVGA (TFT), VGA (TFT), SVGA (TFT), XGA (TFT)
Chipset	Intel US15W
Farbtiefe	16 Bit bzw. 65.536 Farben ¹⁾
Grafikkartentreiber	Intel(R) Embedded Graphics Driver
Hauptspeicher	Automatische Erkennung und Verwendung von bis zu 512 MByte RAM
Bootzeit / Hochlaufzeit	ca. 25 Sekunden
Screenrotation	wird nicht unterstützt
Webbrowser	Internet Explorer
.Net	Compact Framework
Imagegröße	ca. 40 MByte ²⁾ , nicht komprimiert
Kundenspezifische Tasten	werden unterstützt
PVI	wird unterstützt
Automation Device Interface	wird unterstützt
Remote Desktop Protokoll für Thin Client	wird unterstützt
B&R VNC Viewer	wird unterstützt
B&R Task Manager	wird unterstützt
B&R Picture Viewer	wird unterstützt
Kompatibel mit zenOn	Ja
Kompatibel mit Wonderware	Nein
Serielle Schnittstellen zur freien Verwendung	2
DirectX	Nein
Audio Schnittstellen	"Line OUT" und "MIC" werden unterstützt. "Line IN" wird nicht unterstützt

Tabelle 183: Eigenschaften Windows CE 6.0

- 1) Die Farbtiefe hängt auch vom verwendeten Display ab.
- 2) Verwenden Sie die Funktion „Windows CE Image komprimieren“ des B&R Embedded OS Installers um die Imagegröße zu reduzieren.

7.5 Was wird benötigt

Das Gerät muss folgende Kriterien erfüllen um das Betriebssystem Windows CE zu betreiben.

- Mindestens 128 MByte Hauptspeicher
- Mindestens eine 128 MByte CompactFlash Karte (Größe ist bei der Bestellung mitanzugeben)

7.6 Installation

Generell wird Windows CE schon im Hause B&R vorinstalliert.

7.7 B&R Embedded OS Installer

Mit dem B&R Embedded OS Installer ist es möglich bestehende B&R Windows CE Images zu installieren. Es müssen dazu die 4 Dateien NK.BIN, BLDR, LOGOXRES.BMP und LOGOQVGA. BMP von einer bereits funktionierenden B&R Windows CE Installation vorliegen.

Der B&R Embedded OS Installer kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Weitere Informationen sind der Online Hilfe des B&R Embedded OS Installers zu entnehmen.

8 Automation Runtime

8.1 Allgemeines

Integraler Bestandteil des Automation Studio ist das Echtzeit Betriebssystem. Dieses Echtzeit Betriebssystem bildet den Softwarekern um Anwendungen auf einem Zielsystem laufen zu lassen.

- Garantiert höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware
- Läuft auf allen B&R Zielsystemen
- Macht die Anwendung hardwareunabhängig
- Anwendungen können einfach zwischen B&R Zielsystemen portiert werden
- Garantierter Determinismus durch zyklisches Laufzeitsystem
- Multitasking nach dem deterministischen Verfahren der Laufzeitgarantie
- Konfiguration der Prioritäten, Zeitklassen und Jitter-Toleranz
- Bis zu 8 verschiedene Zeitklassen mit beliebigen Unterprogrammen
- Garantierte Reaktion auf Zeitverletzungen und Jitter-Überschreitung
- Ausnahmebehandlung
- Jitter-Toleranz in allen Task-Klassen konfigurierbar
- Unterstützung aller relevanten Programmiersprachen wie IEC 61131-3 und ANSI-C
- Umfangreiche Funktionsbibliothek nach IEC 61131-3 und zusätzlich die erweiterte Automation Bibliothek
- Zugriff auf alle Netzwerke und Bussysteme durch die Konfiguration in Automation Studio oder über Funktionsaufrufe

Das B&R Automation Runtime ist voll im entsprechenden Zielsystem (Hardware, auf der das Automation Runtime installiert wird) eingebettet. Es ermöglicht damit den Zugriff der Anwenderprogramme auf I/O Systeme (auch via Feldbus) und andere Geräte wie Schnittstellen und Netzwerke.

8.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Automation Runtime	
1A4600.10-5	B&R Automation Runtime ARwin, inkl. Lizenzaufkleber	
1A4601.06-5	B&R Automation Runtime AREmb, inkl. Lizenzaufkleber	
1A4601.06-T	B&R Automation Runtime AREmb Terminal, inkl. Lizenzaufkleber	

Tabelle 184: 1A4600.10-5, 1A4601.06-5, 1A4601.06-T - Bestelldaten

8.3 Automation Runtime Windows (ARwin)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das ARwin auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.

Information:

Die Audio Ausgabe unter ARwin wird ab AR 4.01 unterstützt.

8.4 Automation Runtime Embedded (AREmb)

Eine Unterstützung des Systems erfolgt durch das AREmb auf Basis eines AS 3.0.90 / AR 4.00 Upgrades.

Information:

Die Audio Ausgabe unter AREmb wird ab AR 4.01 unterstützt.

9 Debian (GNU/Linux)

9.1 Allgemeines

Als Linux oder GNU/Linux werden in der Regel freie, unix-ähnliche Mehrbenutzer-Betriebssysteme bezeichnet, die auf dem Linux-Kernel und wesentlich auf GNU-Software basieren. Die weite, auch kommerzielle Verbreitung wurde ab 1992 durch die Lizenzierung des Linux-Kernels unter der GPL ermöglicht.

Das von B&R erstellte Debian 6.0 beinhaltet bereits alle für das jeweilige Gerät notwendigen Treiber und kann dadurch ohne weiteren Aufwand sofort eingesetzt werden.

Vorteile von Debian:

- Hohe Stabilität.
- Große Paketauswahl.
- Für Debian stehen bereits passende Pakete mit Realtime Kernel zur Verfügung.

Mehr Informationen zu Debian siehe <http://www.debian.org>.

9.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5SWLIN.0137-MUL	Debian 6.0 32-Bit, Multilanguage, für APC510; CompactFlash separat bestellen (mind. 4 GByte).	

Tabelle 185: 5SWLIN.0137-MUL - Bestelldaten

9.3 Übersicht

Materialnummer	Zielsystem	Chipsatz	Architektur	Sprache	Vorinstalliert	Mindestgröße Datenträger	Mindestgröße Arbeitsspeicher
5SWLIN.0137-MUL	APC510	US15W	32-Bit	Multilanguage	auf Wunsch	4 GByte	512 MByte

9.4 Features

- Gnome Desktop
- Touch Treiber (für Power Panel 500 und Automation Panel mit resistivem Touch Screen)
- MTCX Treiber
- ADI Library
- HMI Diagnose Tool
- Tool für Rechtsklick Support über Touch
- Tool für Einstellung der Displayhelligkeit
- Virtuelle Tastatur
- Support folgender Auflösungen:

Displaydiagonale	Displayauflösung
5,7"	VGA, 640x480
7"	WVGA, 800x480
10,4"	VGA, 640x480
12,1"	SVGA, 800x600
15"	XGA, 1024x768

Tabelle 186: Auflösungen Debian

Eine ausführliche Anleitung zu Debian 6.0 für B&R Geräte kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

9.5 Installation / Treiber

Auf Wunsch wird Debian 6.0 schon im Hause B&R auf dem gewünschten Massenspeicher (z.B. CompactFlash Karte, etc.) vorinstalliert. Dabei werden auch alle notwendigen Treiber (Grafik, Netzwerk, usw.) für den Betrieb mitinstalliert.

Debian 6.0 kann auch von der Debian Homepage (<http://www.debian.org>) heruntergeladen und selbst installiert werden. Entsprechende Anleitungen sind ebenfalls auf der Debian Homepage zu finden.

Hinweise zu den Besonderheiten bei der Installation auf B&R Geräten sind in einem eigenen Dokument beschrieben, das auf der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden kann.

Für die notwendigen B&R Anpassungen stehen Installationspakete zur Verfügung, die ebenfalls von der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden können.

B&R Debian 6.0 enthält alle für den Betrieb notwendigen Treiber.

10 B&R Automation Device Interface (ADI) - Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können mit dem B&R Control Center Applet in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.

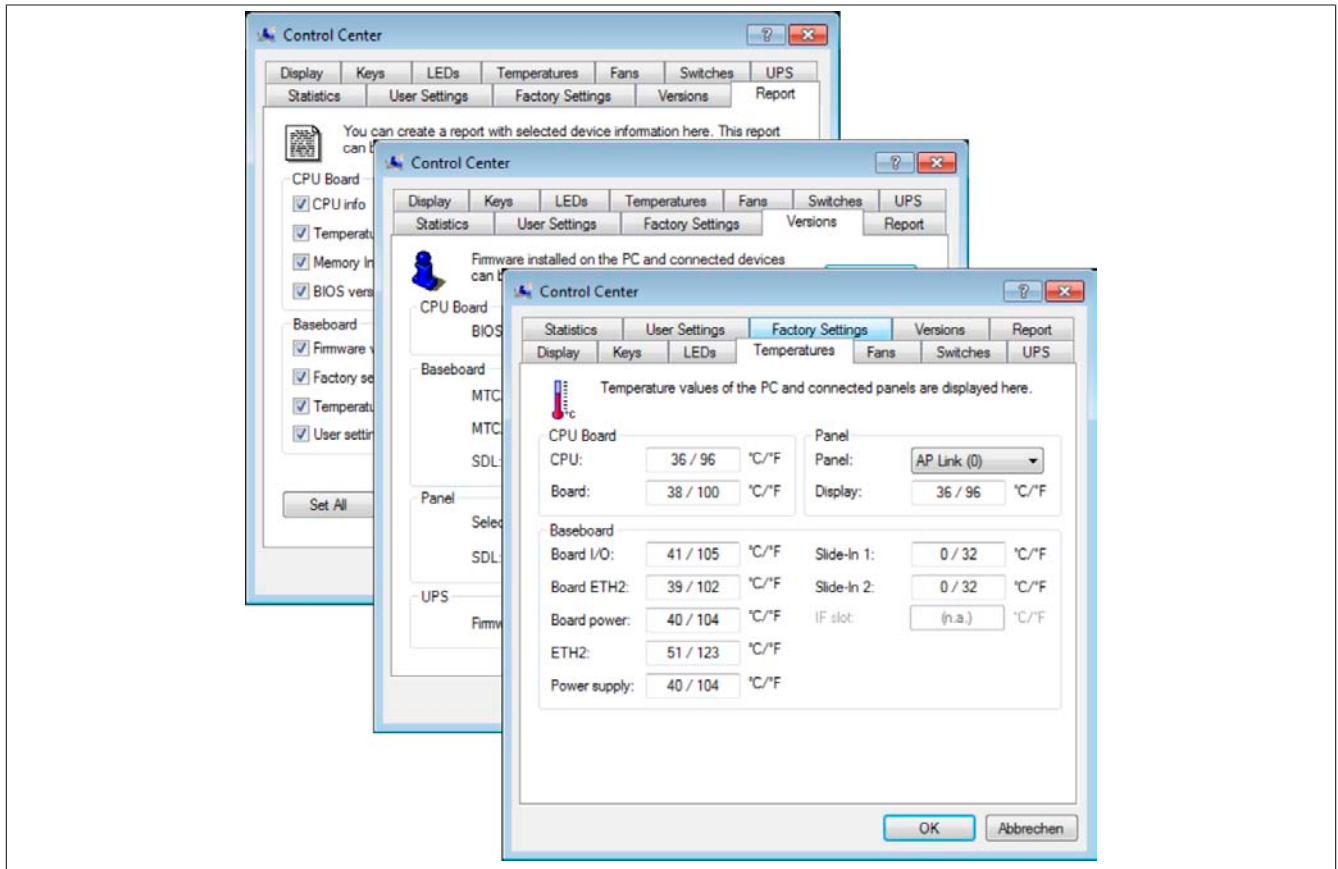


Abbildung 89: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) auf der entsprechenden ADI Seite stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarmer bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfalle.

10.1 Funktionen

Information:

Die vom Automation Device Interface (ADI) - Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)
- Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung

- Ändern der User Serial ID

Unterstützt werden folgende Systeme:

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- angeschlossene Automation Panel 800
- angeschlossene Automation Panel 900

10.2 Installation

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist der integrierten Online Hilfe zu entnehmen. Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch Control Center) kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

1. Herunterladen und entpacken des ZIP Archives
2. Schließen aller Anwendungen
3. Starten der Setup.exe Datei (z.B. durch Doppelklick im Explorer)

Information:

In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten „Enhanced Write Filter (EWF)“ zu achten.

11 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit folgenden Entwicklungsumgebungen erstellt wurden:

- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer)

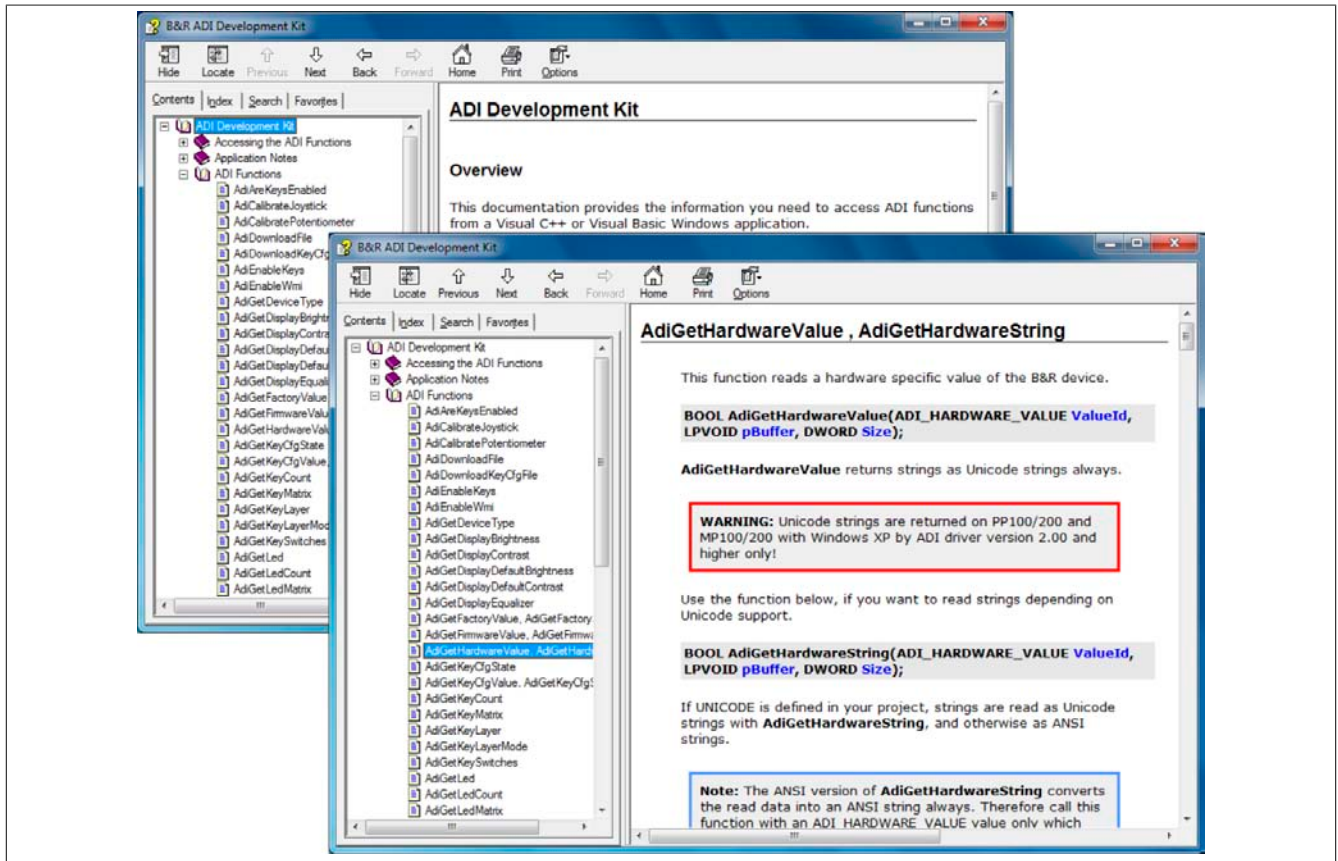


Abbildung 90: ADI Development Kit Screenshots (Version 3.60)

Features:

- Ein Microsoft Visual Basic Modul mit Deklarationen der ADI Funktionen
- Header Dateien und Import Libraries für Microsoft Visual C++
- Hilfedateien für Visual Basic und Visual C++
- Beispielprojekte für Visual Basic und Visual C++
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 3.60):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400

- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

12 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio 2005 (oder neuer) erstellt wurden.

Unterstützte Programmiersprachen:

- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#

Systemvoraussetzungen:

- Entwicklungssystem: PC mit Windows XP/7 mit
 - Microsoft Visual Studio 2005 oder neuer
 - Microsoft .NET Framework 2.0 und / oder Microsoft .NET Compact Framework 2.0 oder neuer

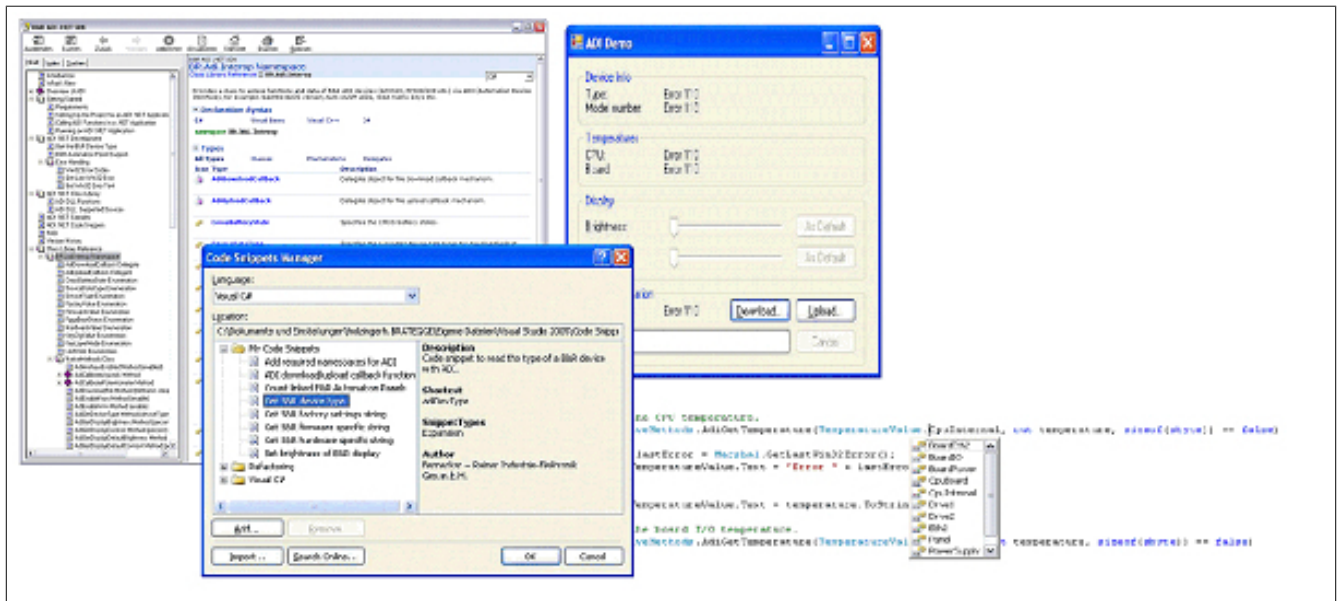


Abbildung 91: ADI .NET SDK Screenshots (Version 2.00)

Features (ab Version 2.00):

- ADI .NET Class Library.
- Hilfedateien im HTML Help 1.0 Format (.chm Datei) und MS Help 2.0 Format (.HxS Datei). (Hilfe ist in Englisch)
- Beispielprojekte und Code Snippets für Visual Basic, Visual C++, Visual C#.
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).

Unterstützt werden folgende Systeme (ab Version 2.00):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50

- Mobile Panel 100/200

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

13 B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Displayeinheiten ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich.

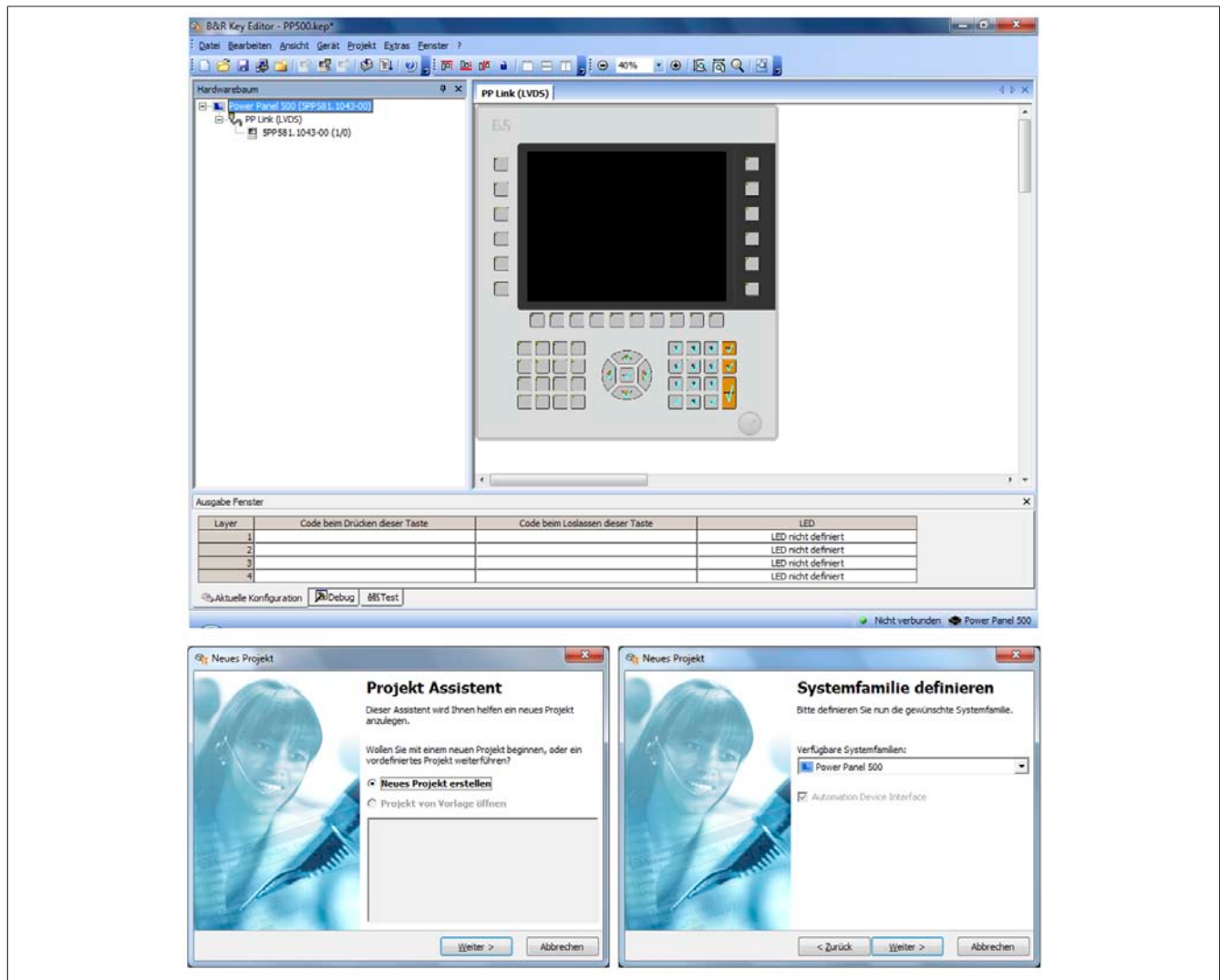


Abbildung 92: B&R Key Editor Screenshots Version 3.40 (Symbolfoto)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LEDs Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel 900 Geräte bei Automation PCs und Panel PCs.

Unterstützt werden folgende Systeme (Version 3.40):

- Automation PC 510
- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation PC 910
- Automation Panel 800
- Automation Panel 830

- Automation Panel 900
- Automation Panel 9x3
- IPC2000, IPC2001, IPC2002
- IPC5000, IPC5600
- IPC5000C, IPC5600C
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Panel PC 300
- Panel PC 700
- Panel PC 800
- Panel PC 900
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden. Der B&R Key Editor kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden. Weiters ist dieser auf der B&R HMI Treiber- und Utilities- DVD (Best. Nr. 5SWH-MI.0000-00) zu finden.

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklärungen

1.1 CE- Kennzeichnung



Alle für die gültigen Richtlinien harmonisierten EN-Normen werden für B&R Produkte erfüllt.

1.2 EMV-Richtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereich
EN 61000-6-4:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrundnorm Störaussendung für Industriebereich

1.3 Niederspannungsrichtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 60204-1:2006 + A1:2009	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn **ALLE** darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entsprechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche **KEINE** entsprechende Zulassung besitzt, so enthält auch das Gesamtgerät **KEINE** Zulassung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:

2.1 UL Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equipment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL508 - 17th Edition
Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 142-M1987

2.2 GOST-R



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle zertifiziert und dürfen in die Russische Föderation eingeführt werden.

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Ersatz CMOS Batterien

1.1 0AC201.91 / 4A0006.00-000

1.1.1 Allgemeines

Die Lithiumbatterie wird zur Pufferung der BIOS CMOS Daten und der Echtzeituhr (RTC) benötigt.

Die Batterie stellt ein Verschleißteil dar und muss bei nicht ausreichender Batteriekapazität, Status „Bad“, ausgetauscht werden.

1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Batterien	
0AC201.91	Lithium Batterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle Hereby we declare that the Lithium cells contained in this shipment qualify as „partly regulated“. Handle with care. If the package is damaged, inspect cells, repack intact cells and protect cells against short circuits. For emergency information, call RENATA SA at + 41 61 319 28 27	
4A0006.00-000	Lithium Batterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle	

Tabelle 187: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten

1.1.3 Technische Daten

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Allgemeines		
Lagerzeit	max. 3 Jahre bei 30°C	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
cULus	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Kapazität	950 mAh	

Tabelle 188: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

Produktbezeichnung	0AC201.91	4A0006.00-000
Selbstentladung	<1% pro Jahr (bei 23°C)	
Spannungsbereich	3V	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur	-20 bis 60°C	
Lagerung		
Luftfeuchtigkeit	0 bis 95%	
Betrieb		
Lagerung		
Transport		

Tabelle 188: 0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm ² , Vibrationsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 189: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörtell alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	0TB103.9		0TB103.91
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
cULus HazLoc Class 1 Division 2	Ja ¹⁾		
GL	Ja ¹⁾		
Feldklemme			
Anmerkung	Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL		
Anzahl der Pole	3 (female)		
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme ³⁾	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)		
Kontaktabstand	5,08 mm		
Anschlussquerschnitt			
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14		AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen		0,20 bis 1,50 mm²	
eindrähtig		0,20 bis 2,50 mm²	
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²		0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse		0,20 bis 1,50 mm²	
Anzugsmoment	0,4 Nm	-	
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	300 V		
Nennstrom ²⁾	10 A / Kontakt		
Durchgangswiderstand	≤5 mΩ		

Tabelle 190: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
 2) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!
 3) Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.

3 Interface Board Stecker

3.1 0TB1208.3100

3.1.1 Allgemeines

Die zweireihige 8-polige Feldklemme TB1208 wird zum Anschluss an verschiedene Power Panel 500 Interface Boards verwendet.

3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB1208.3100	Steckverbinder, 8-polig Federzugklemme, 1 mm ² , Vibrationschutz durch Schraubflansch.	

Tabelle 191: 0TB1208.3100 - Bestelldaten

3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	0TB1208.3100
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GL	Ja
Feldklemme	
Anmerkung	Nennaten nach UL
Anzahl der Pole	8 (female)
Art der Klemmung	Zugfeder-Anschluss
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Kontaktabstand	3,5 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 28 bis 18
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,13 bis 0,34 mm ²
eindrätig	0,20 bis 1 mm ²
feindrätig	0,20 bis 1 mm ²
mit Aderendhülse	0,13 bis 0,34 mm ²
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	300 V
Nennstrom ¹⁾	10 A / Kontakt

Tabelle 192: 0TB1208.3100 - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzwerte der I/O Module sind zu berücksichtigen!

4 CompactFlash Karten

4.1 Allgemeines

CompactFlash Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt- (Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CompactFlash Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

4.2 Grundlagen

CompactFlash Karten, welche für den Einsatz in der Industrieautomation geeignet sind, müssen eine besonders hohe Zuverlässigkeit haben. Um diese erreichen zu können sind folgende Punkte sehr wichtig:

- Verwendete Flashtechnologie
- Effizienter Algorithmus zur Maximierung der Lebenszeit
- Gute Mechanismen zur Erkennung und Behebung von Fehlern des Flash Speichers

4.2.1 Flashtechnologie

Aktuell sind CompactFlash Karten mit MLC (Multi Level Cell) und SLC (Single Level Cell) Flashbausteinen erhältlich.

SLC Flashes haben eine um Faktor 10 höhere garantierte Lebenszeit als MLC Flashes, wodurch für den industriellen Einsatz nur CompactFlash Karten mit SLC Flashbausteinen zum Einsatz kommen.

4.2.2 Wear Leveling

Unter Wear Leveling versteht man einen Algorithmus, welcher zur Maximierung der Lebenszeit einer CompactFlash eingesetzt werden kann. Zwischen folgenden Algorithmen wird unterschieden:

- Kein Wear Leveling
- Dynamic Wear Leveling
- Static Wear Leveling

Der grundlegende Gedanke von Wear Leveling ist, dass Daten über einen breiten Bereich an Blöcken bzw. Zellen auf dem Datenträger verteilt werden, damit nicht immer die gleichen Bereiche gelöscht und neu programmiert werden müssen.

4.2.2.1 Kein Wear Leveling

Erste CompactFlash Karten hatten keinen Algorithmus implementiert welcher zur Maximierung der Lebenszeit beitrug. Die Lebenszeit der CompactFlash war hier einzig und allein durch die garantierte Lebenszeit der Flashblöcke definiert.

4.2.2.2 Dynamic Wear Leveling

Dynamisches Wear Leveling bietet die Möglichkeit beim Schreiben auf ein File, noch nicht benutzte Flashblöcke für die Verteilung zu verwenden.

Wenn der Datenträger schon zu 80% mit Files voll ist, können nur 20% für das Wear Leveling verwendet werden. Die Lebensdauer der CompactFlash hängt hier also ursächlich von nicht benutzten Flashblöcken ab.

4.2.2.3 Static Wear Leveling

Statisches Wear Leveling überwacht zusätzlich, welche Daten nur selten verändert werden. Diese werden dann vom Controller von Zeit zu Zeit in Blöcke verschoben, welche schon häufig programmiert wurden um eine weitere Abnutzung der Zellen zu vermeiden.

4.2.3 Fehlerkorrektur ECC

Bei Inaktivität oder Betrieb einer bestimmten Zelle können Bitfehler entstehen. Durch ein per Hard- oder Software implementiertes Error Correction Coding (ECC) lassen sich viele derartige Fehler erkennen und korrigieren.

4.2.4 S.M.A.R.T. -Support

Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (kurz S.M.A.R.T., System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) ist ein Industriestandard für Massenspeicher der eingeführt wurde, um wichtige Parameter zu überwachen und drohende Ausfälle frühzeitig zu erkennen. Durch die Überwachung und Speicherung von kritischen Leistungs- und Kalibrierdaten wird versucht, die Wahrscheinlichkeit von Fehlerzuständen vorherzusagen.

4.2.5 Maximale Zuverlässigkeit

CompactFlash Karten welche von B&R eingesetzt werden, erzielen durch Verwendung von SLC Flashes in Verbindung mit statischem Wear Leveling gemeinsam mit einem performanten ECC Algorithmus einen Maximalwert an Zuverlässigkeit.

4.3 5CFCRD.xxxx-06

4.3.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von B&R CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 203

Information:

Die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-06 werden auf B&R Geräten unter WinCE ab der Version ≥ 6.0 unterstützt.

4.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0512-06	CompactFlash 512 MByte B&R (SLC)	
5CFCRD.1024-06	CompactFlash 1 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.2048-06	CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.4096-06	CompactFlash 4 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.8192-06	CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.016G-06	CompactFlash 16 GByte B&R (SLC)	
5CFCRD.032G-06	CompactFlash 32 GByte B&R (SLC)	

Tabelle 193: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten

4.3.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es darüber hinaus zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, wird die Verwendung einer USV empfohlen.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehöerteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06
Allgemeines							
Kapazität	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre						
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10^{14} Bit Lesezugriffen						
Lifetime Monitoring	Ja						
MTBF	> 3.000.000 Stunden (bei 25°C)						
Wartung	keine						
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-6, Multiword DMA Mode 0-4, Ultra DMA Mode 0-4						

Tabelle 194: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06
kontinuierliches Lesen							
typisch	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	33 MByte/s	36 MByte/s	36 MByte/s
maximal	35 MByte/s	35 MByte/s	35 MByte/s	34 MByte/s	34 MByte/s	37 MByte/s	37 MByte/s
kontinuierliches Schreiben							
typisch	15 MByte/s	15 MByte/s	15 MByte/s	14 MByte/s	14 MByte/s	28 MByte/s	28 MByte/s
maximal	18 MByte/s	18 MByte/s	18 MByte/s	17 MByte/s	17 MByte/s	30 MByte/s	30 MByte/s
Zertifizierungen							
CE				Ja			
cULus				Ja			
cULus HazLoc Class 1 Division 2	-	-	-	-	-	Ja ¹⁾	-
ATEX Zone 22	-	-	-	-	-	Ja ¹⁾	-
GOST-R				Ja			
GL				Ja ¹⁾			
Endurance							
garantierte Datenmenge							
garantiert ²⁾	50 TByte	100 TByte	200 TByte	400 TByte	800 TByte	1600 TByte	3200 TByte
ergibt bei 5 Jahren ²⁾	27,40 GByte/Tag	54,79 GByte/Tag	109,59 GByte/Tag	219,18 GByte/Tag	438,36 GByte/Tag	876,72 GByte/Tag	1753,44 GByte/Tag
Lösch- / Schreibzyklen							
garantiert	100.000						
SLC-Flash				Ja			
Wear Leveling				statisch			
Error Correction Coding (ECC)				Ja			
S.M.A.R.T. Support				Ja			
Unterstützung							
Hardware	PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820						
Betriebssysteme							
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows XP Professional	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows XP Embedded				Ja			
Windows Embedded Standard 2009	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Windows CE 6.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³⁾	Ja ³⁾
Windows CE 5.0				Nein			
Software							
PVI Transfer Tool	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V2.06.00.3011)	≥ V3.6.8.40 (Teil von PVI Develop- ment Setup ≥ V3.0.0.3020)	≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Deve- lopment Setup ≥ V3.0.2.3014)
B&R Embedded OS Installer	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.10	≥ V3.20	≥ V3.21
Umgebungsbedingungen							
Temperatur							
Betrieb	0 bis 70°C						
Lagerung	-65 bis 150°C						
Transport	-65 bis 150°C						
Luftfeuchtigkeit							
Betrieb	max. 85% bei 85°C						
Lagerung	max. 85% bei 85°C						
Transport	max. 85% bei 85°C						
Vibration							
Betrieb	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Lagerung	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Transport	20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6)						
Schock							
Betrieb	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Lagerung	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Transport	1,5 kg peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27)						
Meereshöhe							
Betrieb	max. 4.572 m						

Tabelle 194: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0512-06	5CFCRD. 1024-06	5CFCRD. 2048-06	5CFCRD. 4096-06	5CFCRD. 8192-06	5CFCRD. 016G-06	5CFCRD. 032G-06
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen							
Breite	42,8 ±0,10 mm						
Länge	36,4 ±0,15 mm						
Höhe	3,3 ±0,10 mm						
Gewicht	10 g						

Tabelle 194: 5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 2) Endurance bei B&R CFs (Bei linear geschriebener Blockgröße mit ≥ 128 kB)
- 3) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

4.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

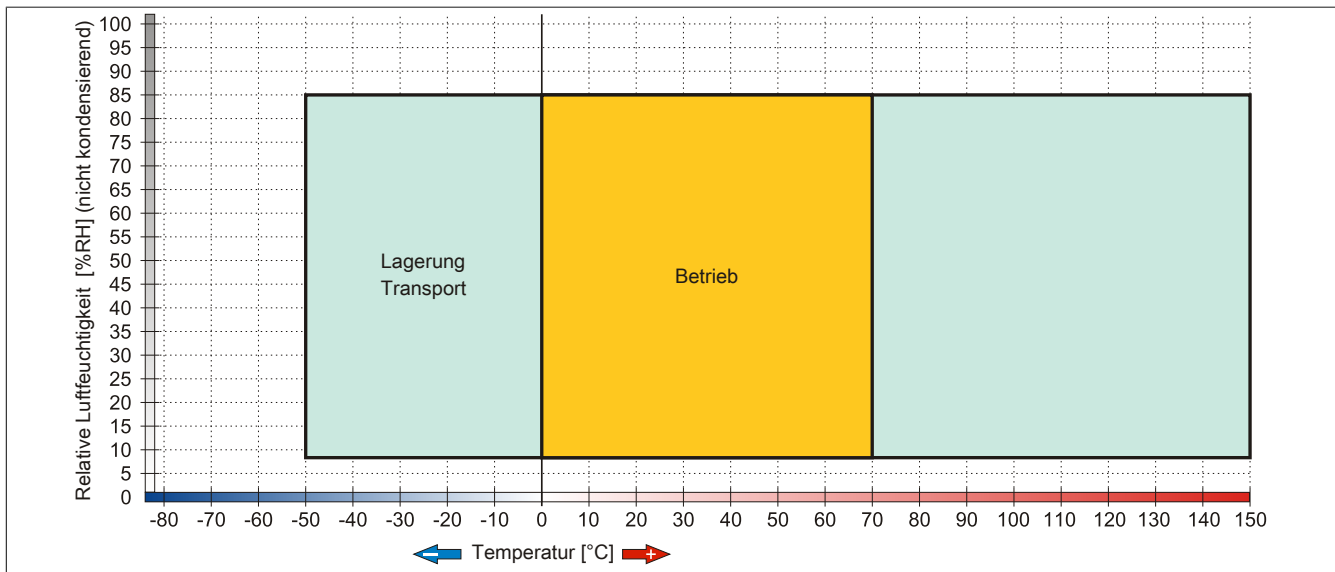


Abbildung 93: 5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

4.3.5 Abmessungen

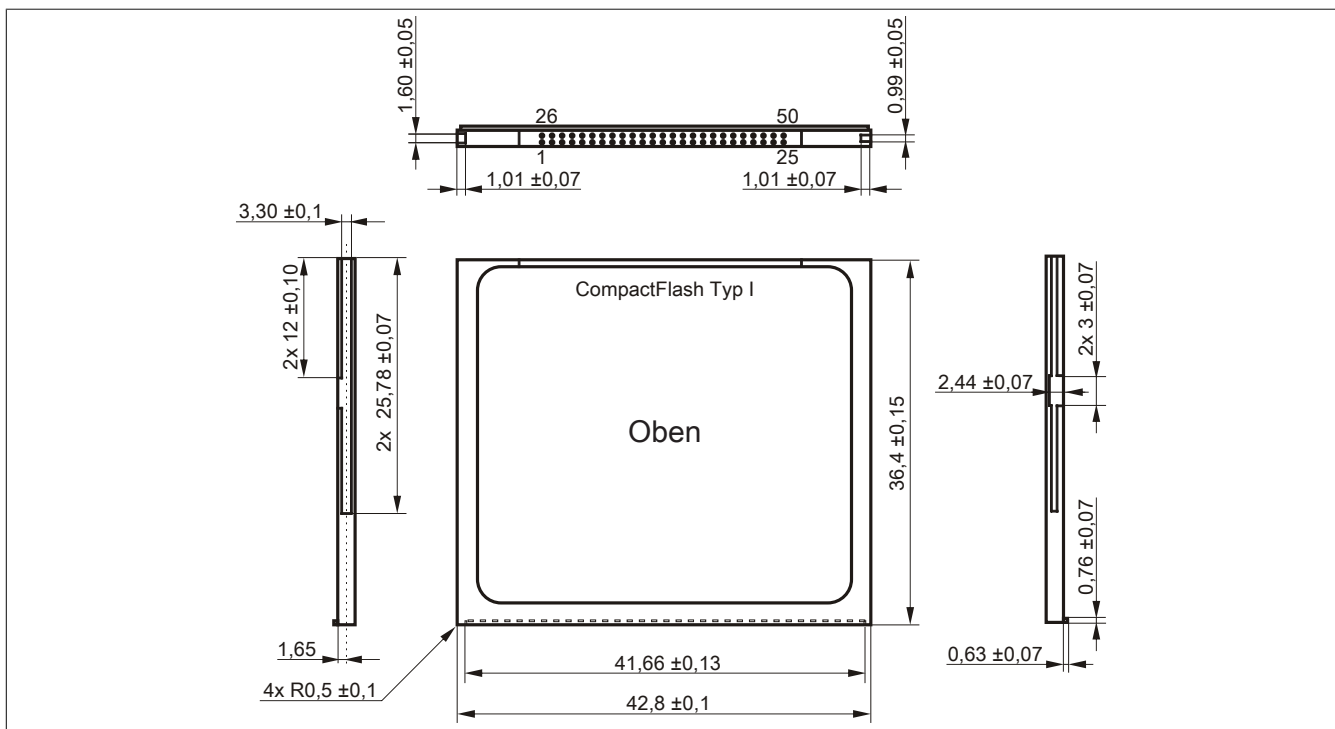


Abbildung 94: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

4.3.6 Benchmark

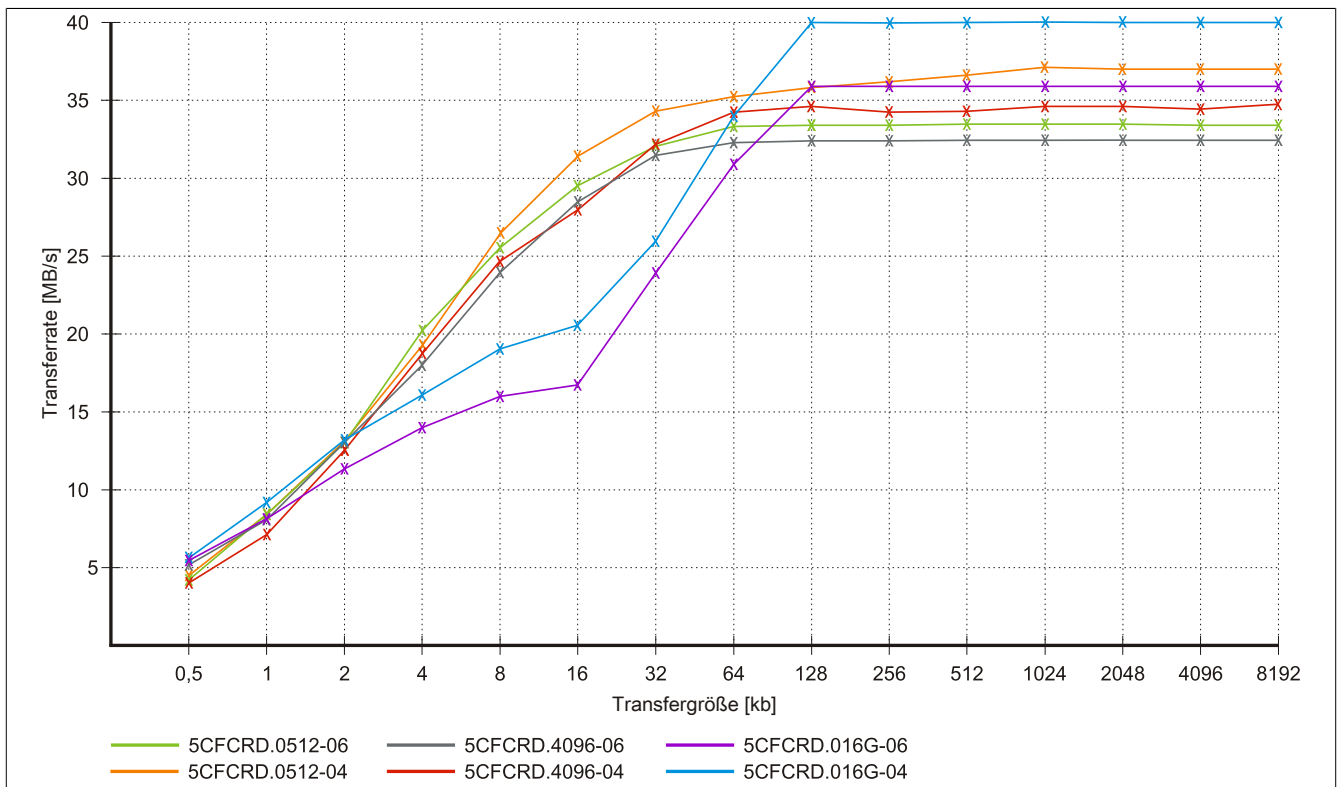


Abbildung 95: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

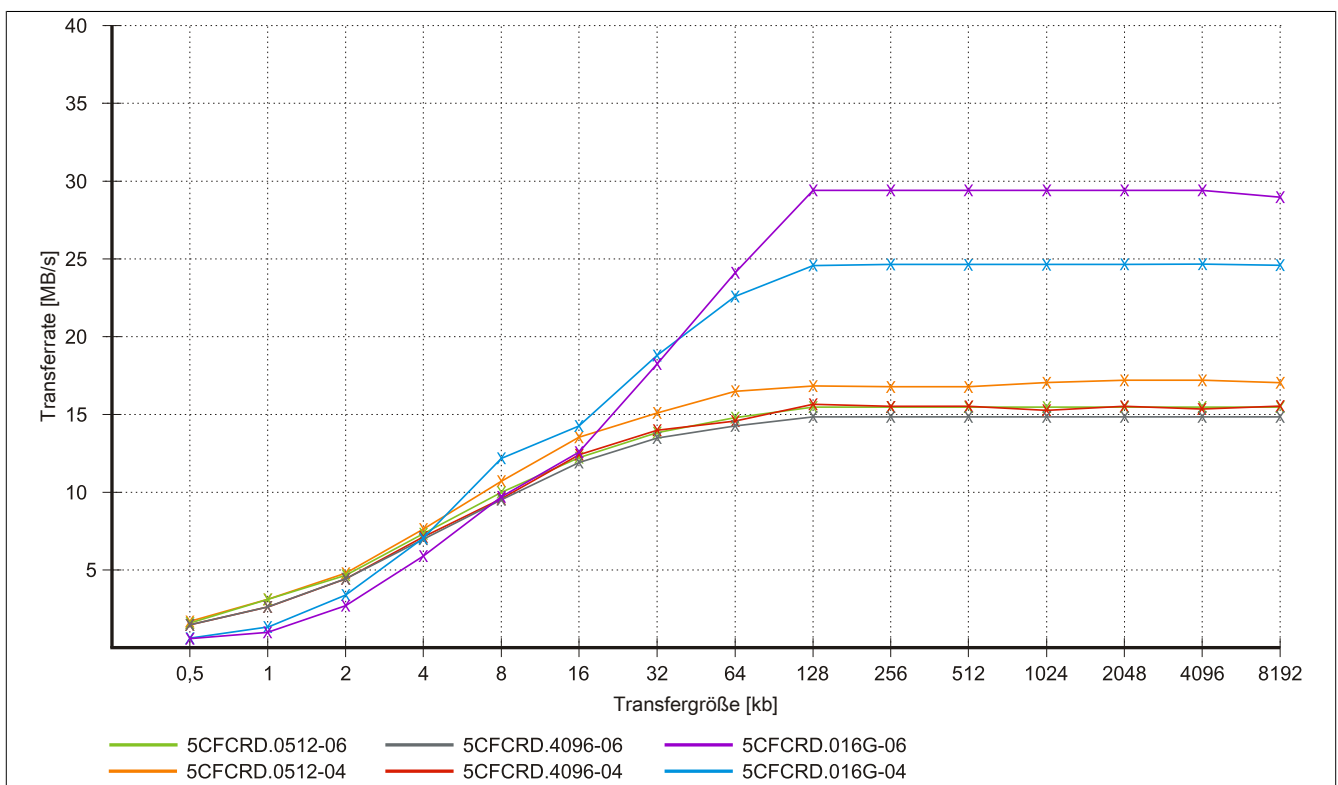


Abbildung 96: ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06

4.4 5CFCRD.xxxx-03

4.4.1 Allgemeines

Information:

Der gleichzeitige Betrieb von Western Digital CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx- 03 und CompactFlash Karten anderer Hersteller in einem System ist nicht erlaubt. Aufgrund von Technologieunterschieden (ältere, neuere Technologien) kann es beim Systemstart zu Problemen kommen, was auf die unterschiedlichen Hochlaufzeiten zurückzuführen ist.

siehe "Bekannte Probleme / Eigenheiten" auf Seite 203

Information:

Auf Windows CE 5.0 Geräten werden die CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 bis zu 1GB unterstützt.

Information:

Bei den CompactFlash Karten 5CFCRD.xxxx-03 hat sich lediglich der Aufkleber und die Beschreibung geändert. Die technischen Daten sind unverändert.

4.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CompactFlash	
5CFCRD.0064-03	CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0128-03	CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0256-03	CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.0512-03	CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.1024-03	CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.2048-03	CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.4096-03	CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC)	
5CFCRD.8192-03	CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC)	

Tabelle 195: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten

4.4.3 Technische Daten

Vorsicht!

Ein plötzlicher Spannungsausfall kann zum Datenverlust führen! In sehr seltenen Fällen kann es zu einer Beschädigung des Massenspeichers kommen!

Um einem Datenverlust bzw. einer Beschädigung vorbeugend entgegen zu wirken, empfiehlt B&R die Verwendung einer USV.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	5CFCRD. 0064-03	5CFCRD. 0128-03	5CFCRD. 0256-03	5CFCRD. 0512-03	5CFCRD. 1024-03	5CFCRD. 2048-03	5CFCRD. 4096-03	5CFCRD. 8192-03
Allgemeines								
Kapazität	64 MByte	128 MByte	256 MByte	512 MByte	1 GByte	2 GByte	4 GByte	8 GByte
Datenerhaltung	10 Jahre							
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen							
Lifetime Monitoring	Ja							
MTBF	> 4.000.000 Stunden (bei 25°C)							
Wartung	keine							
unterstützte Betriebsmodi	PIO Mode 0-4, Multiword DMA Mode 0-2							
kontinuierliches Lesen typisch	8 MByte/s							
kontinuierliches Schreiben typisch	6 MByte/s							
Zertifizierungen CE cULus GOST-R GL	Ja ¹⁾	Ja ¹⁾	Ja	Ja ¹⁾	Ja ¹⁾	Ja ¹⁾	Ja ¹⁾	Ja ¹⁾
Endurance								
Lösch- / Schreibzyklen typisch	> 2.000.000							
SLC-Flash	Ja							
Wear Leveling	statisch							
Error Correction Coding (ECC)	Ja							
S.M.A.R.T. Support	Nein							
Unterstützung								
Hardware	MP100/200, PP100/200, PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, Provit 2000, Provit 5000, APC620, APC680, APC810, APC820							
Betriebssysteme Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows Embedded Standard 7 32-Bit Windows Embedded Standard 7 64-Bit Windows XP Professional Windows XP Embedded Windows Embedded Standard 2009 Windows CE 6.0 Windows CE 5.0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ²⁾
	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Software PVI Transfer Tool B&R Embedded OS Installer	≥ V2.57 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.5.3.3005) ≥ V2.21							
Umgebungsbedingungen								
Temperatur Betrieb Lagerung Transport	0 bis 70°C -50 bis 100°C -50 bis 100°C							
Luftfeuchtigkeit Betrieb Lagerung Transport	8 bis 95%, nicht kondensierend 8 bis 95%, nicht kondensierend 8 bis 95%, nicht kondensierend							
Vibration Betrieb Lagerung Transport	max. 16,3 g (159 m/s² 0-peak) max. 30 g (294 m/s² 0-peak) max. 30 g (294 m/s² 0-peak)							
Schock Betrieb Lagerung Transport	max. 1000 g (9810 m/s² 0-peak) max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak) max. 3000 g (29430 m/s² 0-peak)							
Meereshöhe Betrieb	max. 24.383 m							
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen Breite Länge Höhe	42,8 ±0,10 mm 36,4 ±0,15 mm 3,3 ±0,10 mm							
Gewicht	11,4 g							

Tabelle 196: 5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
2) Wird vom B&R Embedded OS Installer nicht unterstützt.

4.4.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

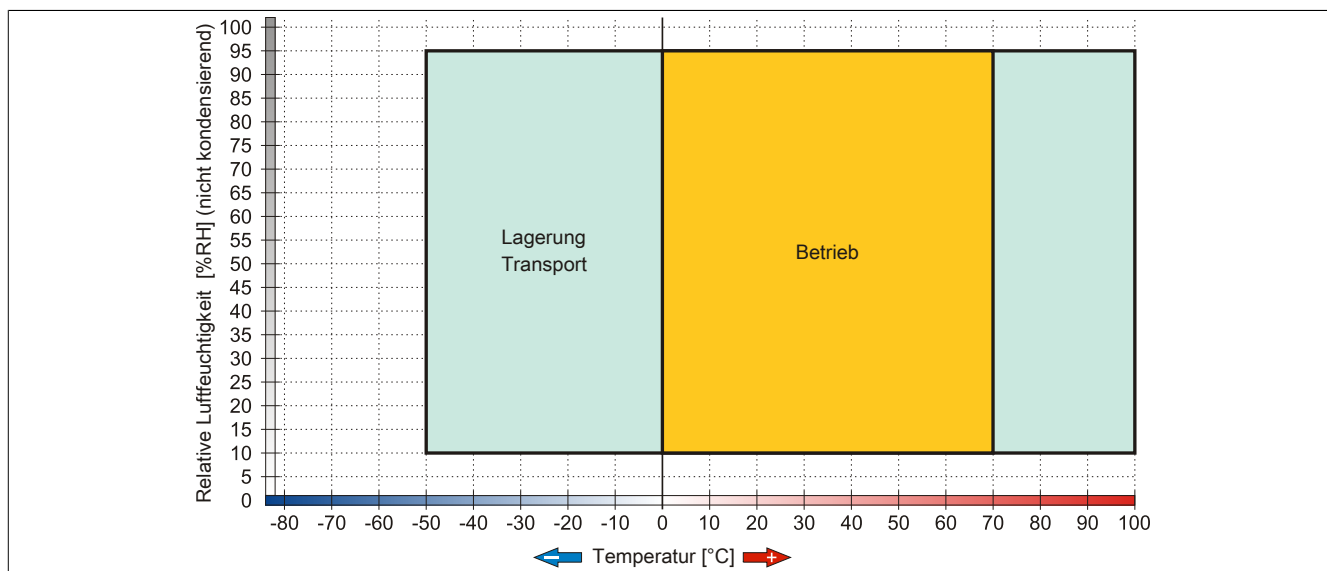


Abbildung 97: 5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten

4.4.5 Abmessungen

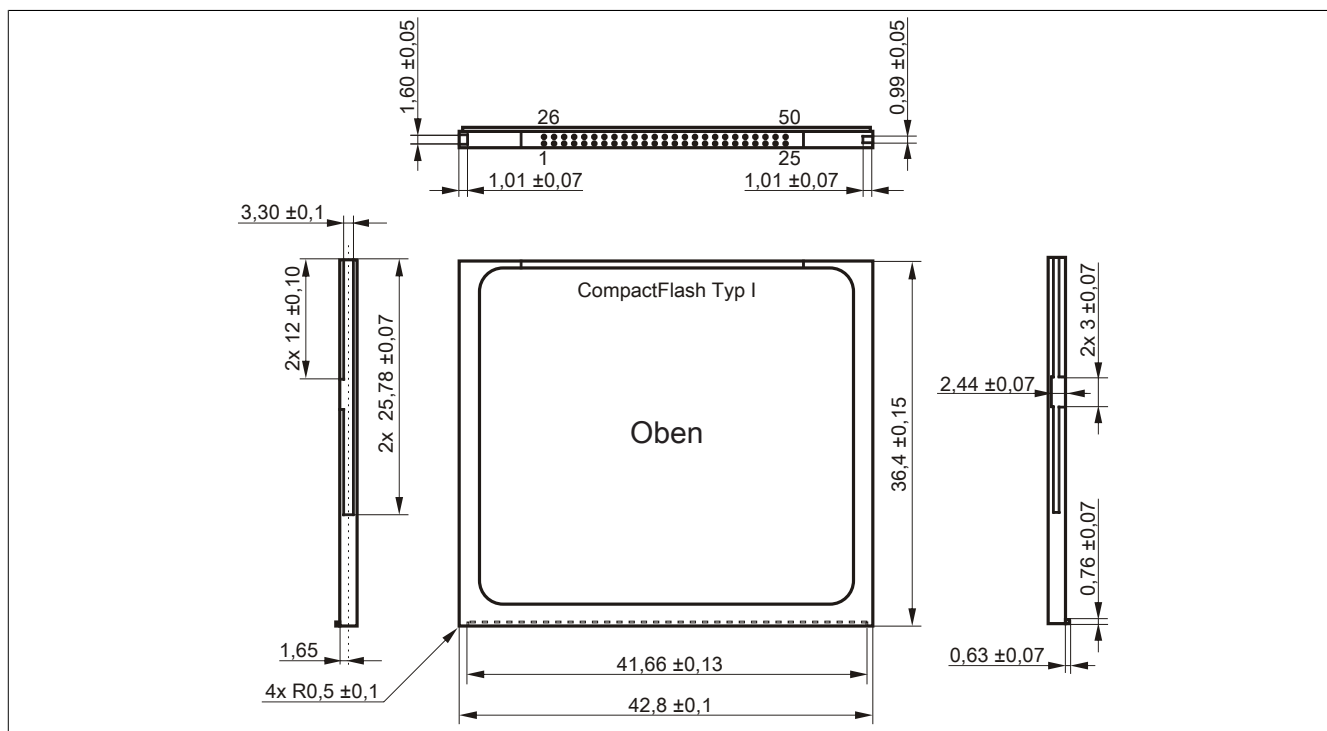


Abbildung 98: Abmessungen CompactFlash Karte Typ I

4.5 Bekannte Probleme / Eigenheiten

Der nachfolgende Punkt ist bei Geräten mit zwei CompactFlash Slots bekannt:

- Der Betrieb von zwei CompactFlash Karten unterschiedlicher Type kann in Automation PCs und Panel PCs zu Problemen führen. Es kann vorkommen, dass beim Systemstart eine der beiden Karten nicht erkannt wird. Der Grund hierfür liegt in dem unterschiedlich schnellen Hochlaufverhalten. Die CompactFlash Karten älterer Technologie benötigen beim Systemstart erheblich mehr Zeit als CompactFlash Karten mit neuerer Technologie. Dieses Verhalten liegt im Grenzbereich des hierfür während des Hochlaufs zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Da die Hochlaufzeit bei den CompactFlash Karten durch die Streuung der verwendeten Bauteile schwankt kann es daher zu dem beschriebenen Problem kommen. Je nach verwendeten CompactFlash Karten kann der Fehler nie, selten oder immer auftreten.

5 USB Media Drive

5.1 5MD900.USB2-02

5.1.1 Allgemeines

Das USB Media Drive besitzt ein DVD-R/RW DVD+R/RW- Laufwerk, einen CompactFlash Slot sowie einen rück- und frontseitigen USB Anschluss. Es wird an den USB Anschluss des B&R Industrie PCs angeschlossen.

- Betrieb als Tisch- bzw. Einbaugerät (Hutschienenwinkel)
- Integriertes DVD-R/RW DVD+R/RW Laufwerk
- Integrierter CompactFlash Slot IDE/ATAPI (Hot Plug fähig)
- Integrierter USB 2.0 Anschluss
- Versorgung, +24 VDC rückseitig
- USB 2.0 Anschluss rückseitig
- optionale Frontklappe

5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MD900.USB2-02	USB 2.0 Laufwerkskombination, bestehend aus DVD-R/RW DVD+R/RW, CompactFlash Slot (Typ II), USB Anschluss (Typ A frontseitig, Typ B rückseitig); 24 VDC, (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)	
	Erforderliches Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB103.9	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Schraubklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
0TB103.91	Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female, Federzugklemme 3,31 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch	
	Sonstiges	
5SWUTI.0000-00	OEM Nero CD-RW Software, nur in Verbindung mit einem CD-RW Laufwerk erhältlich.	
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 197: 5MD900.USB2-02 - Bestelldaten

5.1.3 Schnittstellen

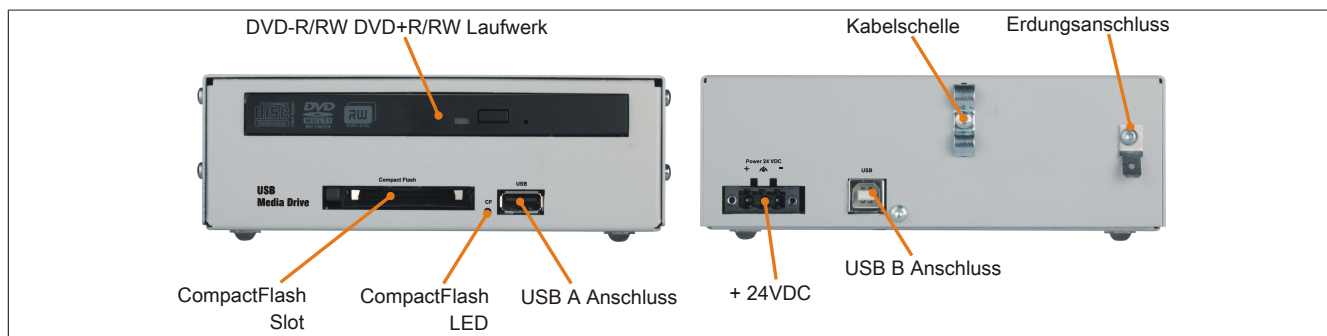


Abbildung 99: 5MD900.USB2-02 - Schnittstellen

5.1.4 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Allgemeines	
max. Kabellänge	5 m (ohne Hub)
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja

Tabelle 198: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Schnittstellen	
CompactFlash Slot 1	
Typ	Typ I
Anschluss	IDE/ATAPI
Activity LED	signalisiert einen Lese- bzw. Schreibzugriff auf einer gesteckten CompactFlash Karte
USB	
Typ	USB 2.0
Ausführung	Typ A frontseitig Typ B rückseitig
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	max. 500 mA
CD / DVD Laufwerk	
Datenpufferkapazität	2 MByte
Datentransferrate	max. 33,3 MByte/s
Drehzahl	max. 5090 rpm $\pm 1\%$
Geräuschpegel	ca. 45 dBA in 50 cm Entfernung (voller Lesezugriff)
Kompatible Formate	CD-DA, CD-ROM Mode 1/ Mode 2 CD-ROM XA Mode 2 (Form 1, Form 2) Photo CD (single/multi-session), Enhanced CD, CD-Text DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video DVD-RAM (4,7 GB, 2,6 GB) DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Laserklasse	Class 1 Laser
Lebensdauer	60.000 POH (Power On Hours)
Schnittstelle	IDE (ATAPI)
Hochlaufzeit	
CD	max. 14 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
DVD	max. 15 Sekunden (von 0 rpm auf Lesezugriff)
Zugriffszeit	
CD	typ. 140 ms (24x)
DVD	typ. 150 ms (8x)
Lesbare Medien	
CD	CD/CD-ROM (12 cm, 8 cm), CD-R, CD-RW
DVD	DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R (Double Layer), DVD+RW
Beschreibbare Medien	
CD	CD-R, CD-RW
DVD	DVD-R/RW, DVD-RAM (4,7 GB), DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer)
Lesegeschwindigkeit	
CD	24x
DVD	8x
Schreibgeschwindigkeit	
CD-R	10 bis 24x
CD-RW	10 bis 24x
DVD+R	3,3 bis 8x
DVD+R (Double Layer)	2,4 bis 4x
DVD+RW	3,3 bis 8x
DVD-R	2 bis 6x
DVD-R (Double Layer)	2 bis 4x
DVD-RAM	3 bis 5x
DVD-RW	2 bis 6x
Schreibmethoden	
CD	Disc at once, Session at once, Packet write, Track at once
DVD	Disc at once, Incremental, Over write, Sequential
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC $\pm 25\%$
Einsatzbedingungen	
Schutzart nach EN 60529	IP65 frontseitig (nur mit optionaler Frontklappe), IP20 rückseitig
Umgebungsbedingungen	
Temperatur ¹⁾	
Betrieb	5 bis 45°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 80%
Lagerung	5 bis 90%
Transport	5 bis 95%
Vibration	
Betrieb	5 bis 500 Hz: 0,3 g (2,9 m/s ² 0-peak)
Lagerung	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak)
Transport	10 bis 100 Hz: 2 g (19,6 m/s ² 0-peak)
Schock	
Betrieb	5 g, 11 ms
Lagerung	60 g, 11 ms
Transport	60 g, 11 ms

Tabelle 198: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MD900.USB2-02
Meereshöhe Betrieb	max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	156 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	ca. 1100 g (ohne Frontklappe)

Tabelle 198: 5MD900.USB2-02 - Technische Daten

- 1) Die Temperaturangaben entsprechen einer Angabe bei 500 Metern. Herabsenkung (Derating) der max. Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter ü. NN.

5.1.5 Abmessungen

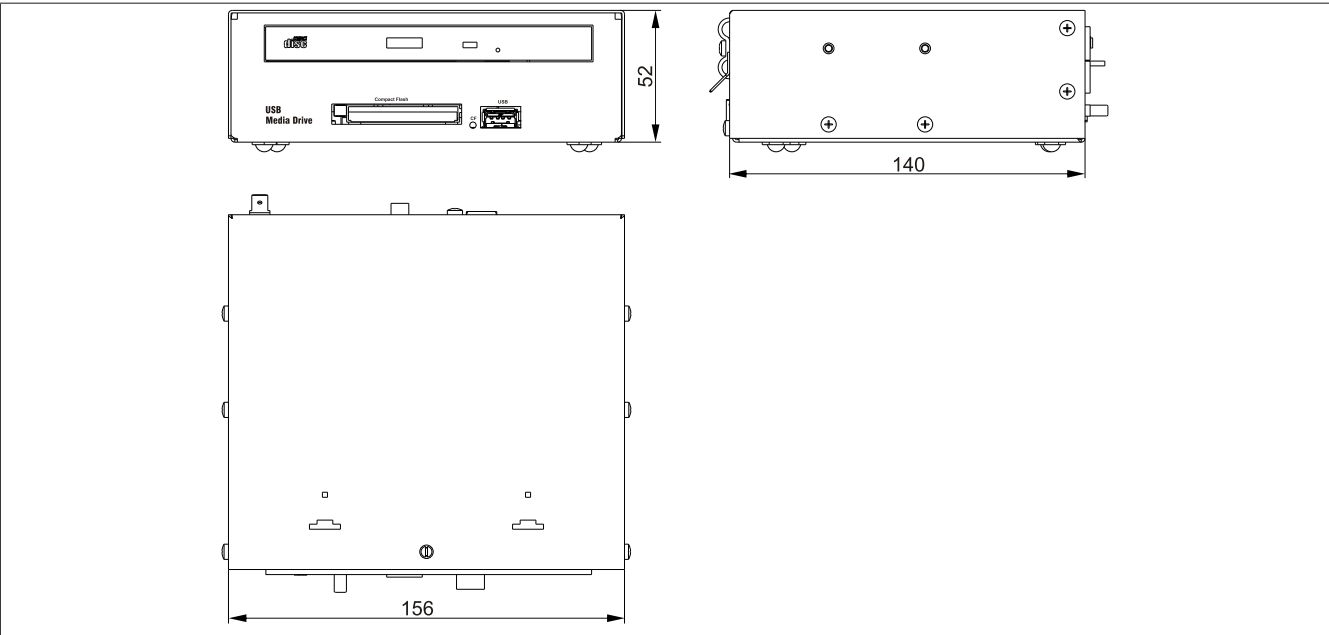


Abbildung 100: 5MD900.USB2-02 - Abmessungen

5.1.6 Abmessungen mit Frontklappe

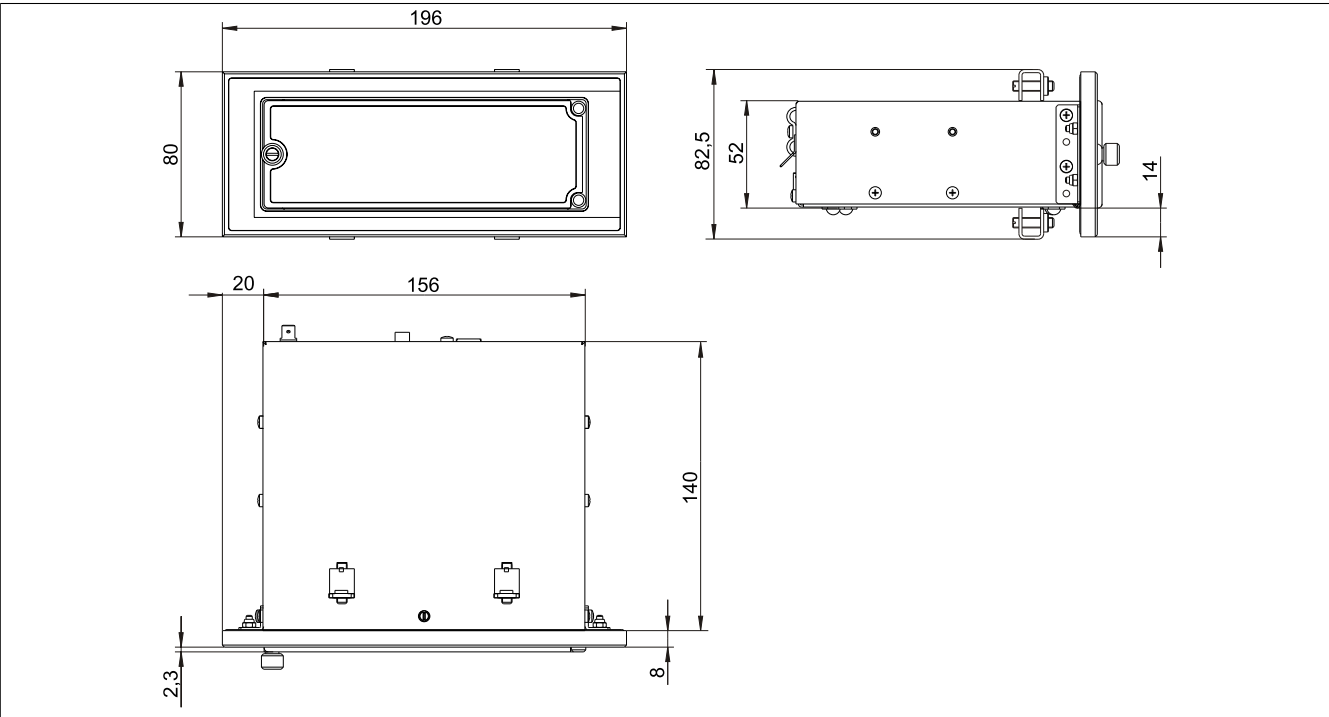


Abbildung 101: Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe

5.1.7 Einbau in Wanddurchbrüche

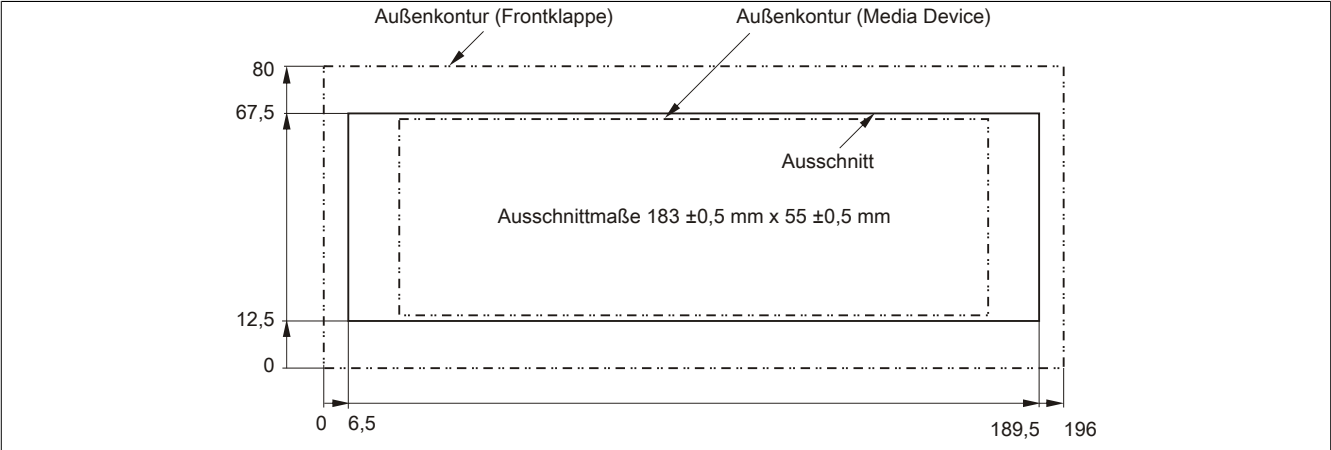


Abbildung 102: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

5.1.8 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	USB Media Drive Gesamtgerät
2	Hutschienenwinkel

Tabelle 199: 5MD900.USB2-02 - Lieferumfang

5.1.9 Montage

Das USB Media Drive Laufwerk ist sowohl für den Tischbetrieb (aufgeklebte Gummifüße) als auch für den Betrieb als Einbaugerät (2 Hutschienenwinkel werden beige packt) geeignet.

5.1.9.1 Einbaulagen

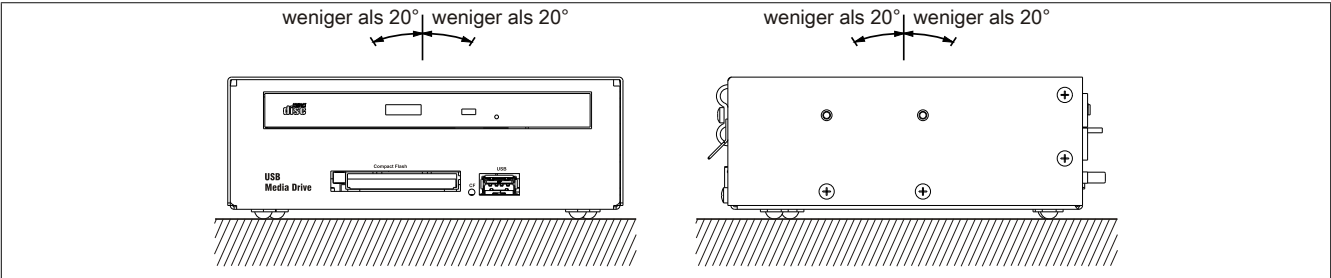


Abbildung 103: 5MD900.USB2-02 - Einbaulage

5.2 5A5003.03

5.2.1 Allgemeines

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 bzw. 5MD900.USB2-02) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

5.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5A5003.03	Frontklappe, für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02 und USB 2.0 Laufwerkskombination 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 und 5MD900.USB2-02.	

Tabelle 200: 5A5003.03 - Bestelldaten

5.2.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5A5003.03
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
cULus	Ja
GOST-R	Ja
Mechanische Eigenschaften	
Front	
Dekorfolie	
Farbe heller Hintergrund	ähnlich Pantone 427CV
Abmessungen	
Breite	196 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	8 mm

Tabelle 201: 5A5003.03 - Technische Daten

5.2.4 Abmessungen

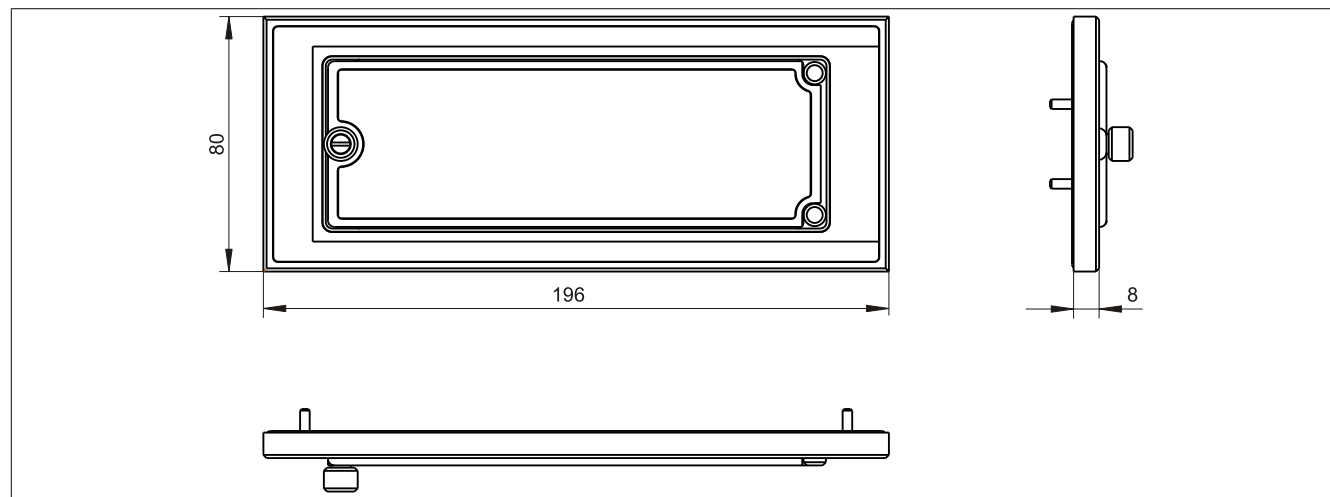


Abbildung 104: 5A5003.03 - Abmessungen

5.2.5 Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Frontklappe 5A5003.03 für das USB Media Drive
4	M3 Sicherungsmutter
4	Haube Halteklammer

Tabelle 202: 5A5003.03 - Lieferumfang

5.2.6 Montage

Die Frontklappe wird mittels den 2 Hutschienenwinkel (beigepackt beim USB Media Drive) und den 4 M3 Sicherungsmuttern befestigt. Mit den 4 beiliegenden Halteklammern kann das Gesamtgerät (USB Media Drive + Frontklappe) z.B. in einer Schaltschranktür montiert werden.

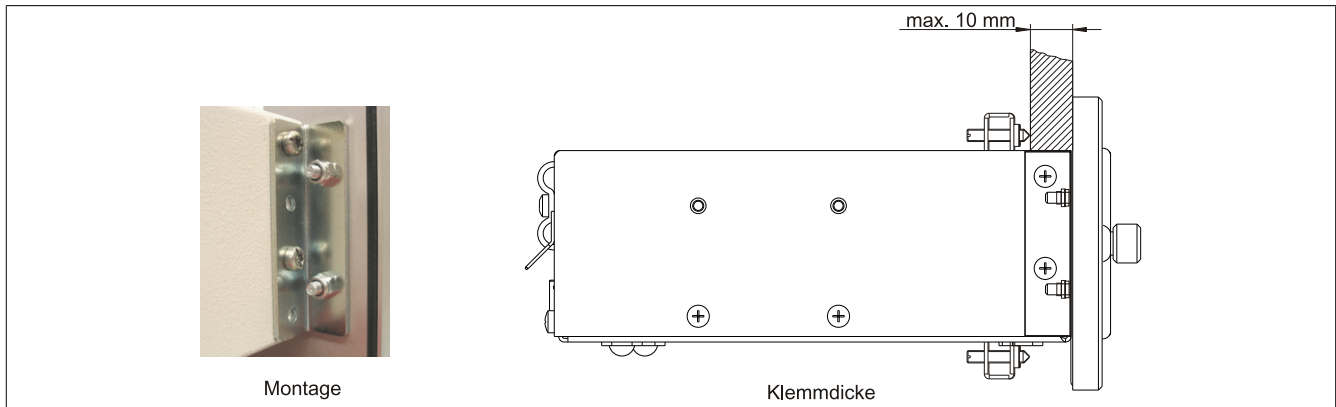


Abbildung 105: Frontklappenmontage und Klemmdicke

5.2.6.1 Einbau in Wanddurchbrüche

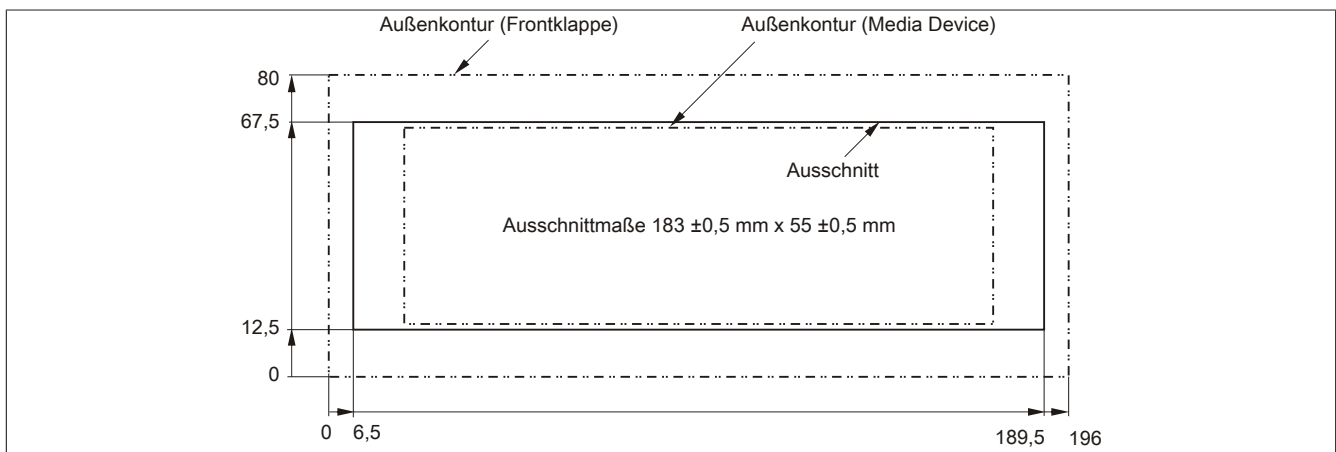


Abbildung 106: Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe

6 USB Memory Sticks

6.1 5MMUSB.xxxx-01

6.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Controller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein „fdisk / mbr“ auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick, 2048 MByte, B&R	
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick, 4096 MByte, B&R	

Tabelle 203: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten

6.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Allgemeines		
Kapazität	2 GByte	4 GByte
Datenerhaltung	> 10 Jahre	
LEDs	1 LED (grün) ¹⁾	
MTBF	> 3.000.000 Stunden	
Typ	USB 1.1, USB 2.0	
Wartung	keine	
Formatierung ab Werk	FAT16	FAT32
Zertifizierungen		
CE	Ja	
GOST-R	Ja	
Schnittstellen		
USB		
Typ	USB 1.1, USB 2.0	
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle	
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	
sequentielles Lesen	Full Speed max. 1 MByte/s, High Speed max. 32 MByte/s	
sequentielles Schreiben	Full Speed max. 0,9 MByte/s, High Speed max. 23 MByte/s	
Unterstützung		
Betriebssysteme		
Windows 7	Ja	
Windows XP Professional	Ja	
Windows XP Embedded	Ja	
Windows ME	Ja	
Windows 2000	Ja	
Windows CE 5.0	Ja	
Windows CE 4.2	Ja	
Elektrische Eigenschaften		
Stromaufnahme	max. 500 uA Schlafmodus, max. 120 mA Lesen/Schreiben	

Tabelle 204: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-50 bis 100°C	
Transport	-50 bis 100°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	85%, nicht kondensierend	
Lagerung	85%, nicht kondensierend	
Transport	85%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Schock		
Betrieb	max. 1500 g (peak)	
Lagerung	max. 1500 g (peak)	
Transport	max. 1500 g (peak)	
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3048 m	
Lagerung	max. 12192 m	
Transport	max. 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	17,97 mm	
Länge	67,85 mm	
Höhe	8,35 mm	

Tabelle 204: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

6.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm

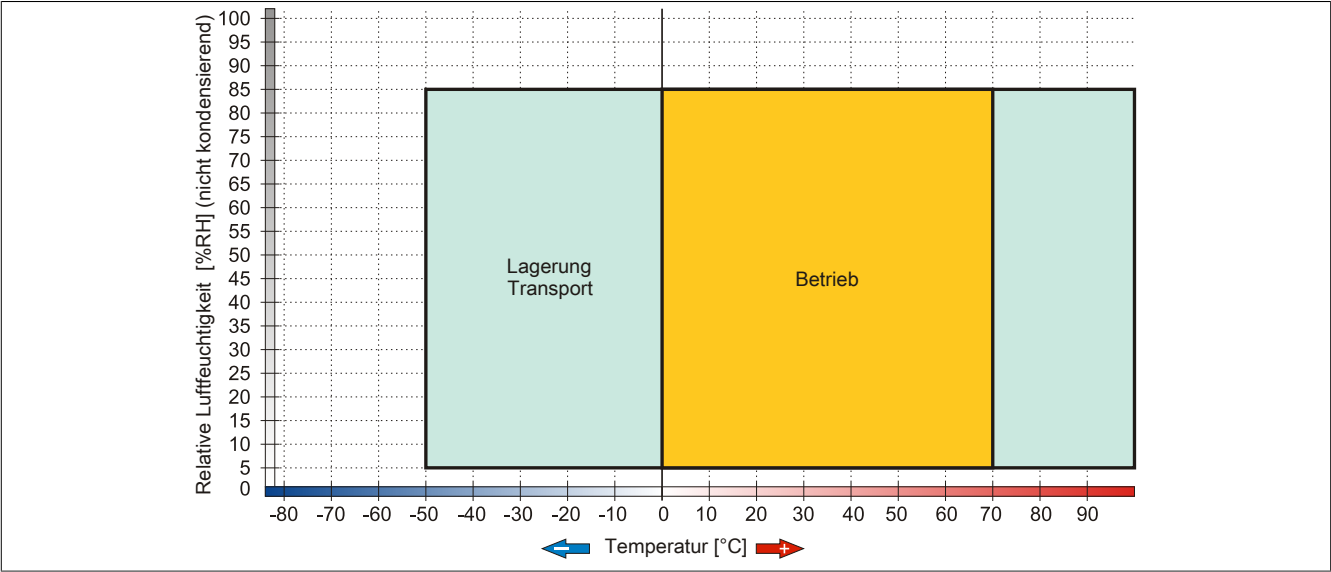


Abbildung 107: 5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

7 Kabel

7.1 DVI Kabel

7.1.1 5CADVI.0xxx-00

7.1.1.1 Allgemeines

Die DVI Kabel 5CADVI.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

7.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	DVI Kabel	
5CADVI.0018-00	DVI-D Kabel, 1,8 m.	
5CADVI.0050-00	DVI-D Kabel, 5 m.	
5CADVI.0100-00	DVI-D Kabel, 10 m.	

Tabelle 205: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten

7.1.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CADVI.0018-00	5CADVI.0050-00	5CADVI.0100-00
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
cULus	Ja		
GOST-R	Ja		
GL	Ja ¹⁾		
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 28		
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt		
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 86%		
Außenmantel			
Material	PVC		
Farbe	beige		
Bedruckung	AWM STYLE 20276 80°C 30V VW1 DVI DIGITAL SINGLE LINK DER AN		
Steckverbindung			
Typ	2x DVI-D (18+1), male		
Steckzyklen	100		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Elektrische Eigenschaften			
Leiterwiderstand	max. 237 Ω/km		
Isolationswiderstand	min. 100 MΩ/km		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser	max. 8,5 mm		
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)		
Gewicht	ca. 260 g	ca. 460 g	ca. 790 g

Tabelle 206: 5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

7.1.1.4 Biegeradiusspezifikation

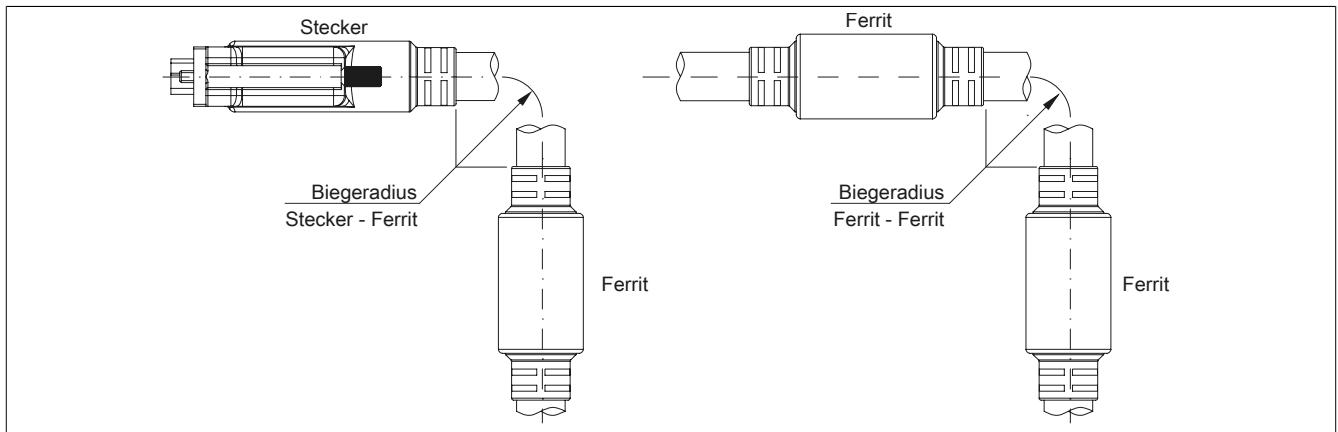


Abbildung 108: Biegeradiusspezifikation

7.1.1.5 Abmessungen

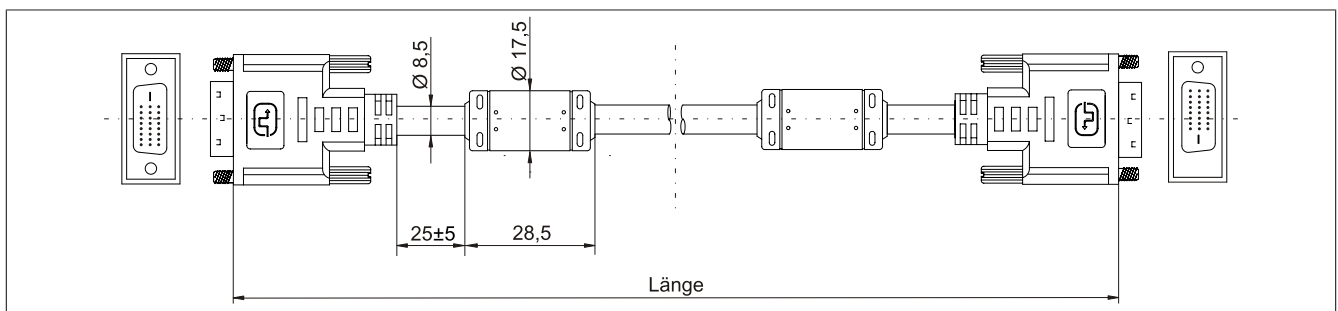


Abbildung 109: 5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen

7.1.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

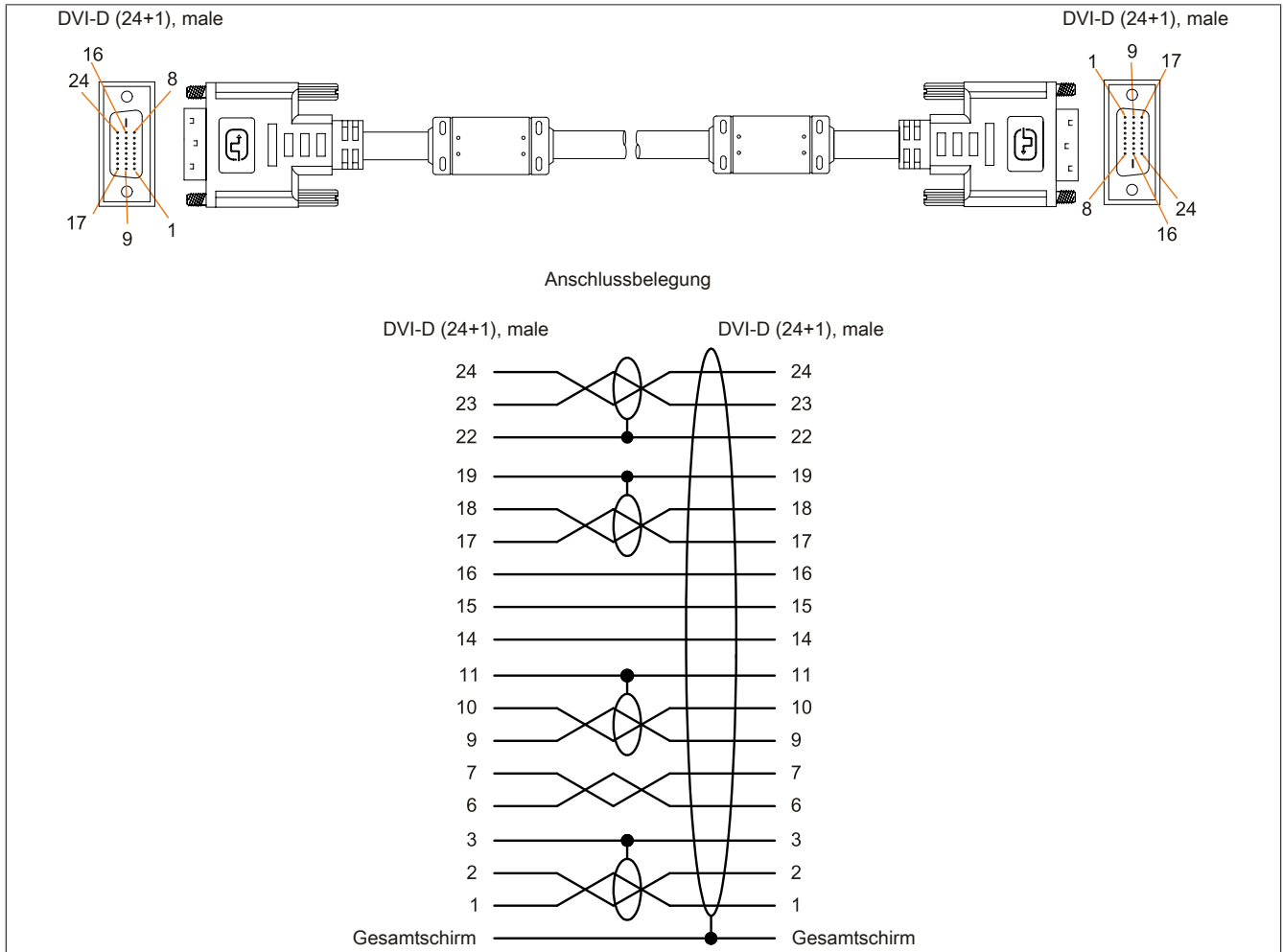


Abbildung 110: 5CADVI.0xxx-00 - Belegung

7.2 SDL Kabel

7.2.1 5CASDL.0xxx-00

7.2.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel 5CASDL.0xxx-00 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert. Für eine flexible Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) ist der Einsatz der SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 erforderlich.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

7.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel, 1,8 m.	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel, 5 m.	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel, 10 m.	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel, 15 m.	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel, 20 m.	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel, 25 m.	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel, 30 m.	

Tabelle 207: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

7.2.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-00	5CASDL. 0050-00	5CASDL. 0100-00	5CASDL. 0150-00	5CASDL. 0200-00	5CASDL. 0250-00	5CASDL. 0300-00
Allgemeines							
Zertifizierungen	Ja Ja Ja Ja ¹⁾						
CE							
cULus							
GOST-R							
GL							
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24				
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85%						
Außenmantel	PVC schwarz E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK						
Material							
Farbe							
Bedruckung							
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	100						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm						
Elektrische Eigenschaften							
Leiterwiderstand	- ≤ 93 Ω/km -						
AWG 24							
AWG 28							
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen	1,8 m ±30 mm 5 m ±30 mm 10 m ±50 mm 15 m ±100 mm 20 m ±100 mm 25 m ±100 mm 30 m ±100 mm typ. 8,6 ±0,2 mm max. 9 mm typ. 11 ±0,2 mm max. 11,5 mm						
Länge							
Durchmesser							
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)						
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)						
Gewicht	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 g	ca. 2880 g	ca. 4800 g	ca. 5520 g

Tabelle 208: 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

7.2.1.4 Biegeradiusspezifikation

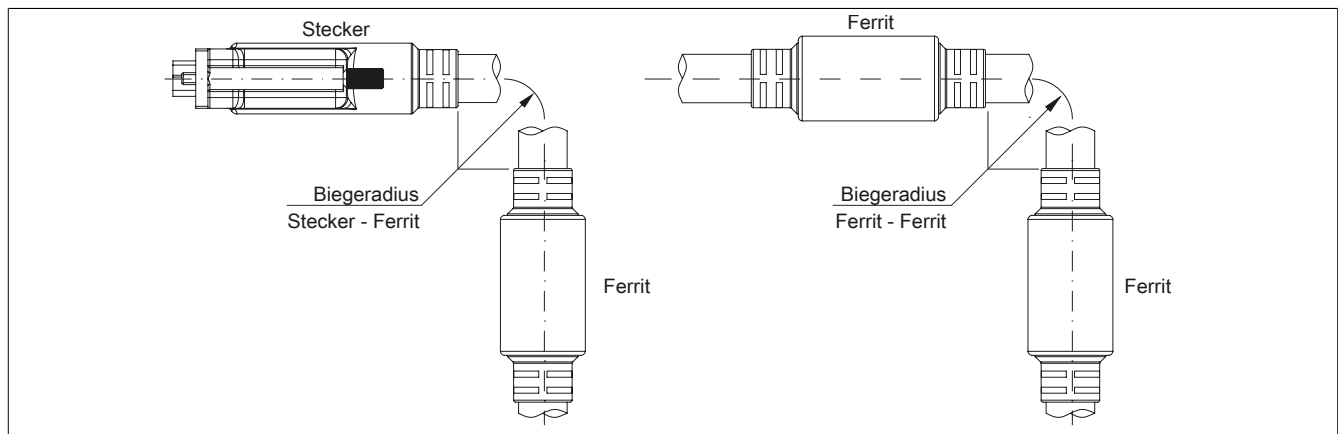


Abbildung 111: Biegeradiusspezifikation

7.2.1.5 Abmessungen

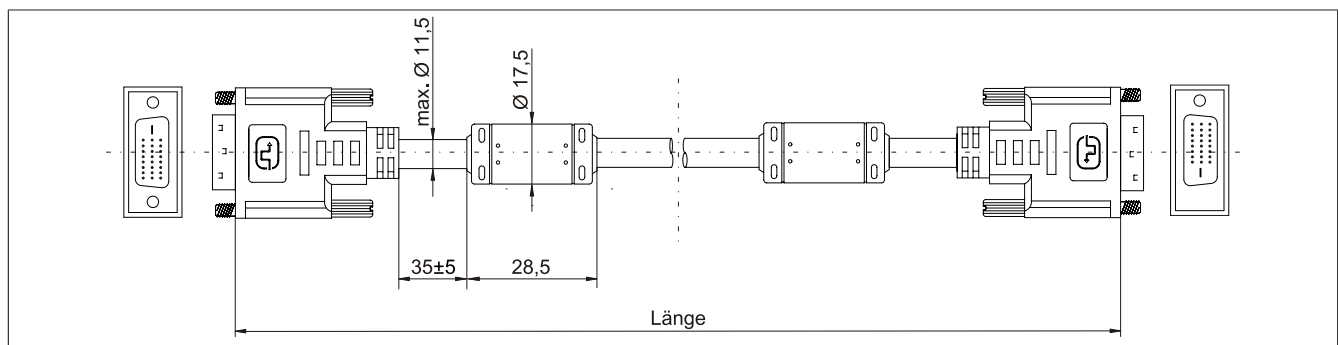


Abbildung 112: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

7.2.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

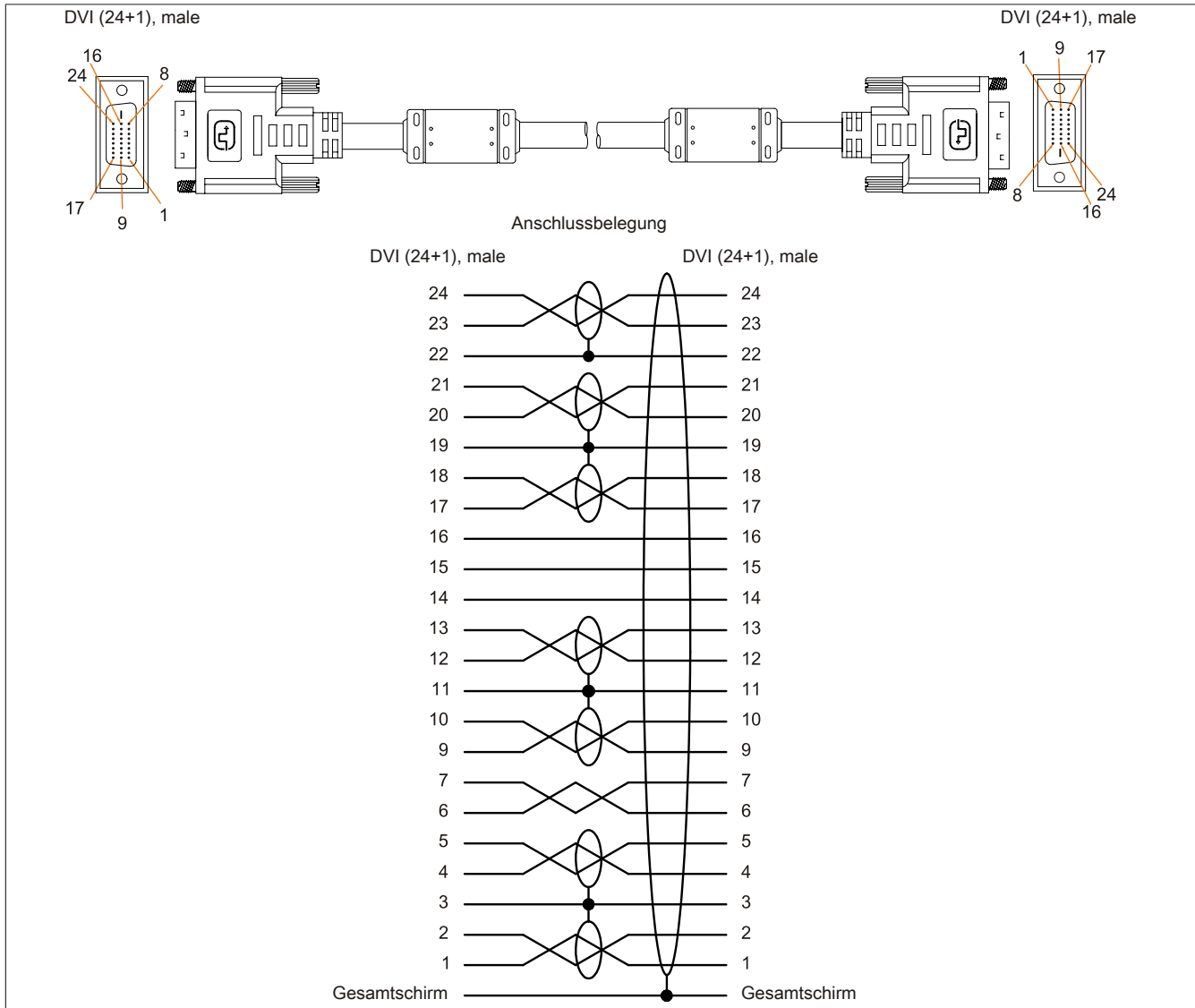


Abbildung 113: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

7.3 SDL Kabel mit 45° Stecker

7.3.1 5CASDL.0xxx-01

7.3.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel mit 45° Stecker 5CASDL.0xxx-01 sind für den Anwendungsfall einer starren Verlegung konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

7.3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel 45° Anschluss	
5CASDL.0018-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 1,8 m.	
5CASDL.0050-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 5 m.	
5CASDL.0100-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 10 m.	
5CASDL.0150-01	SDL Kabel; 45° Anschluss, 15 m.	

Tabelle 209: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten

7.3.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0018-01	5CASDL.0050-01	5CASDL.0100-01	5CASDL.0150-01
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	Ja			
cULus	Ja			
GOST-R	Ja			
GL	Ja ¹⁾			
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt	AWG 28		AWG 24	
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt			
Gesamtschirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85%			
Außenmantel				
Material	PVC			
Farbe	schwarz			
Steckverbindung				
Typ	2x DVI-D (24+1), male			
Steckzyklen	100			
Kontakte	vergoldet			
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung			
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm			
Elektrische Eigenschaften				
Leiterwiderstand				
AWG 24	-		≤ 93 Ω/km	
AWG 28	≤ 237 Ω/km		-	
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km			
Mechanische Eigenschaften				
Abmessungen				
Länge	1,8 m ±30 mm	5 m ±50 mm	10 m ±100 mm	15 m ±100 mm
Durchmesser	max. 9 mm		max. 11,5 mm	
Biegeradius				
feste Verlegung	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)			
Beweglichkeit	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen / Minute)			
Gewicht	ca. 300 g	ca. 590 g	ca. 2800 g	ca. 2860 g

Tabelle 210: 5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

7.3.1.4 Biegeradiusspezifikation

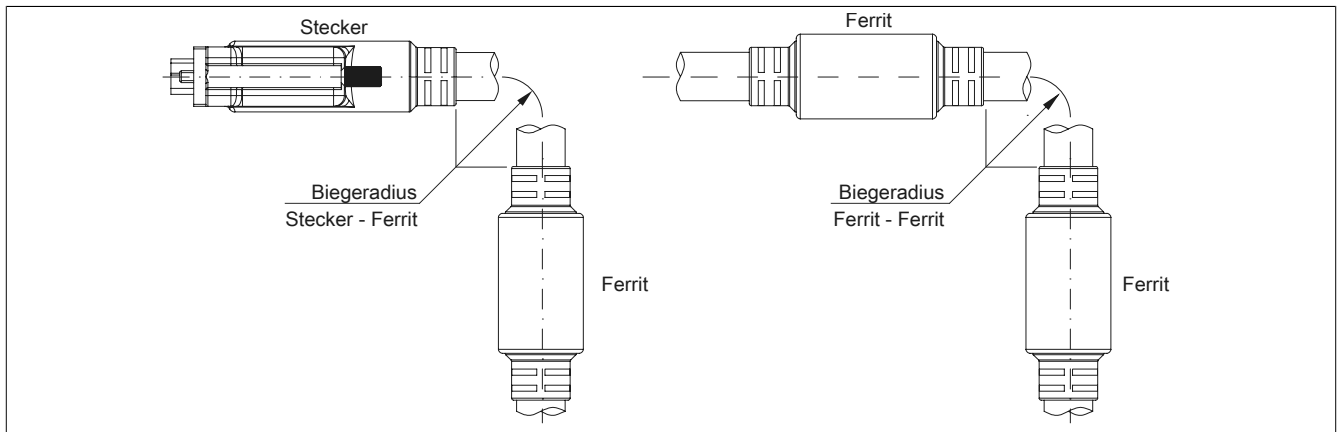


Abbildung 114: Biegeradiusspezifikation

7.3.1.5 Abmessungen

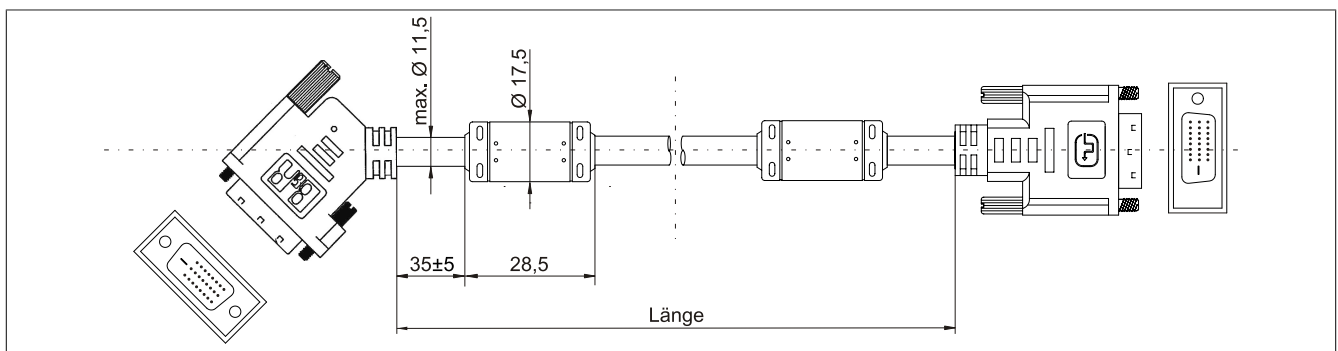


Abbildung 115: 5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen

7.3.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

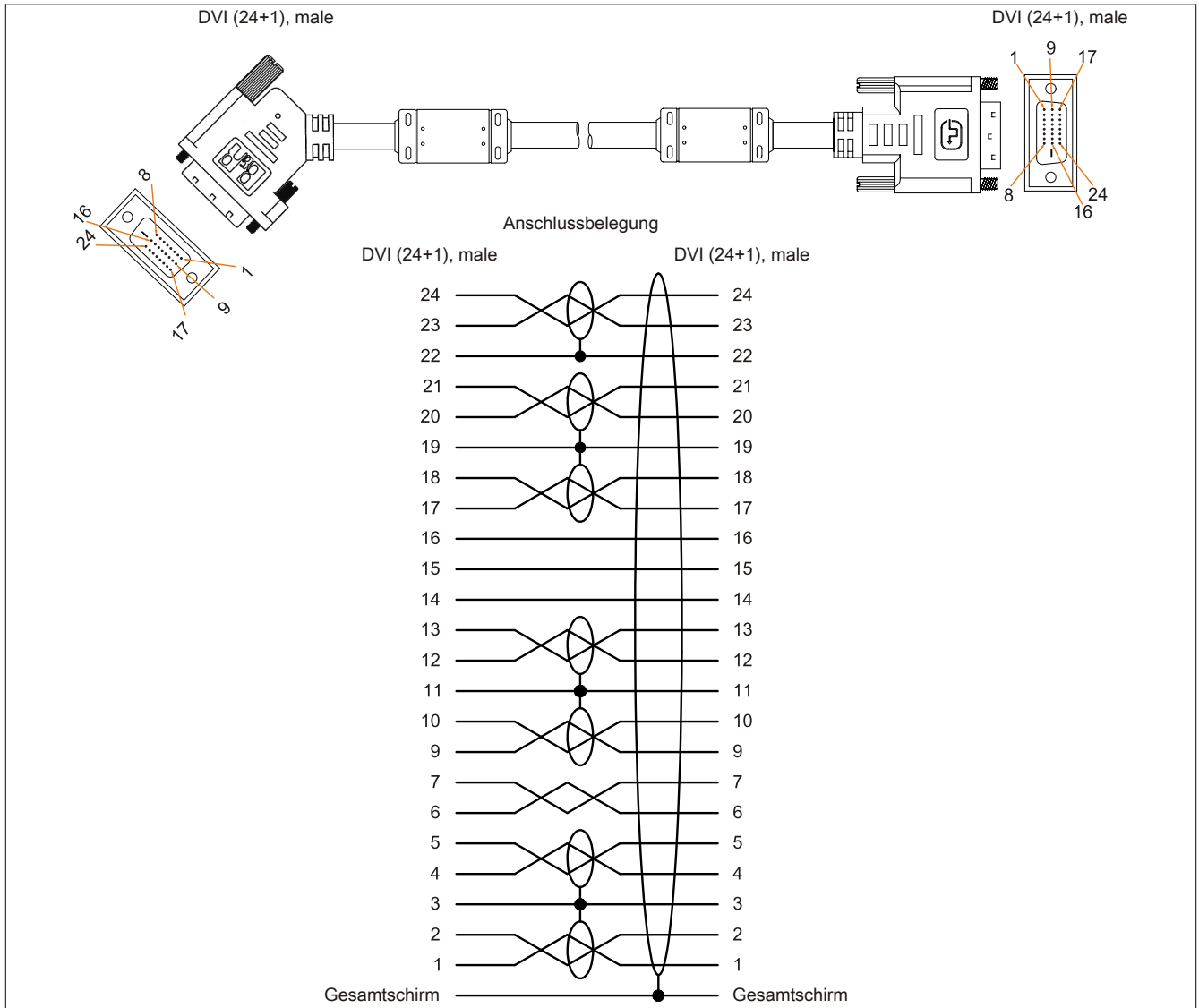


Abbildung 116: 5CASDL.0xxx-01 - Belegung

7.4 SDL Kabel flex

7.4.1 5CASDL.0xxx-03

7.4.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

7.4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0018-03	SDL Kabel flex, 1,8 m.	
5CASDL.0050-03	SDL Kabel flex, 5 m.	
5CASDL.0100-03	SDL Kabel flex, 10 m.	
5CASDL.0150-03	SDL Kabel flex, 15 m.	
5CASDL.0200-03	SDL Kabel flex, 20 m.	
5CASDL.0250-03	SDL Kabel flex, 25 m.	
5CASDL.0300-03	SDL Kabel flex, 30 m.	

Tabelle 211: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten

7.4.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Allgemeines							
Zertifizierungen	Ja Ja Ja Ja ¹⁾						
CE							
cULus							
GOST-R							
GL							
Kabelaufbau							
Drahtquerschnitt	AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)						
Eigenschaften	halogen- und silikonfrei						
Schirm	Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt						
Gesamtschirmung	alukaschierte Folie + verzinntes Kupfergeflecht						
Außenmantel	Spezial-TMPU - seidenmatt schwarz (B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E 63216						
Material							
Farbe							
Bedruckung							
Steckverbindung							
Typ	2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen	min. 200						
Kontakte	vergoldet						
mechanischer Schutz	Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung						
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm						
Elektrische Eigenschaften							
Betriebsspannung	≤ 30 V						
Prüfspannung	1 kV 0,5 kV						
Ader/Ader							
Ader/Schirm							
Wellenwiderstand	100 ±10 Ω						
Leiterwiderstand	≤ 95 Ω/km ≤ 145 Ω/km						
AWG 24							
AWG 26							
Isulationswiderstand	> 200 MΩ/km						
Einsatzbedingungen							
Approbation	UL AWM 20236 80°C 30V						
Flammwidrigkeit	gemäß UL758 (cable vertical flame test)						
Öl- und Hydrolysebeständigkeit	gemäß VDE 0282-10						

Tabelle 212: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL. 0018-03	5CASDL. 0050-03	5CASDL. 0100-03	5CASDL. 0150-03	5CASDL. 0200-03	5CASDL. 0250-03	5CASDL. 0300-03
Umgebungsbedingungen							
Temperatur	-20 bis 80°C						
Lagerung							
feste Verlegung							
flexible Verlegung	-5 bis 60°C						
Mechanische Eigenschaften							
Abmessungen	1,8 m ±20 mm 5 m ±45 mm 10 m ±90 mm 15 m ±135 mm 20 m ±180 mm 25 m ±225 mm 30 m ±270 mm max. 12 mm						
Länge							
Durchmesser							
Biegeradius	≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit) ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit) ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)						
feste Verlegung							
flexible Verlegung							
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)						
Schleppkettendaten	300.000 4800 Zyklen/Stunde 180 mm; 15x Kabeldurchmesser 460 mm						
Biegewechsel							
Geschwindigkeit							
Biegeradius							
Hub							
Gewicht	ca. 460 g	ca. 1020 g	ca. 1940 g	ca. 2840 g	ca. 3740 g	ca. 4560 g	ca. 5590 g
Zugbelastbarkeit	≤ 50 N ≤ 400 N						
in Betrieb							
bei Verlegung							

Tabelle 212: 5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

7.4.1.4 Biegeradiusspezifikation

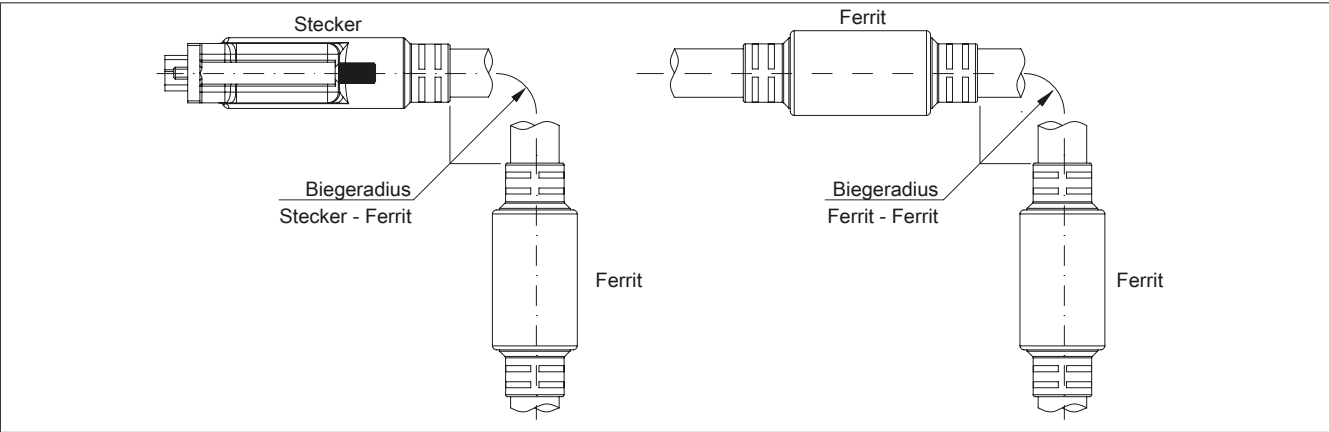


Abbildung 117: Biegeradiusspezifikation

7.4.1.5 Abmessungen

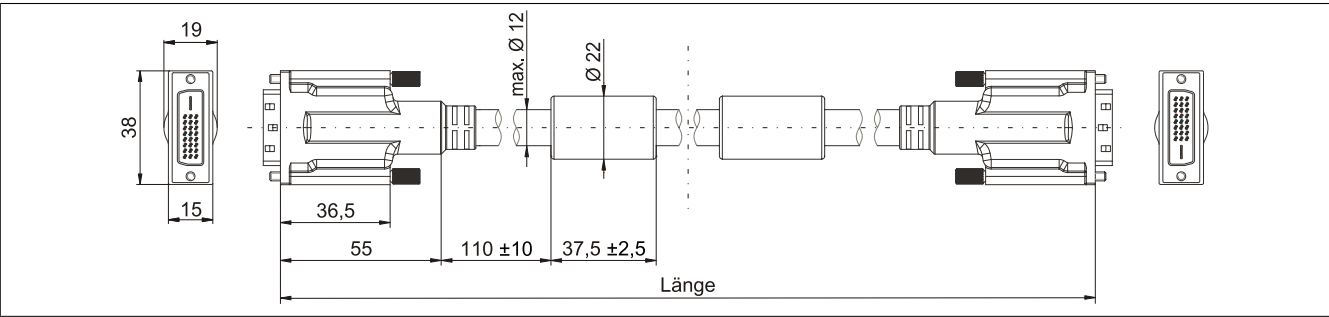


Abbildung 118: 5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen

7.4.1.6 Aufbau

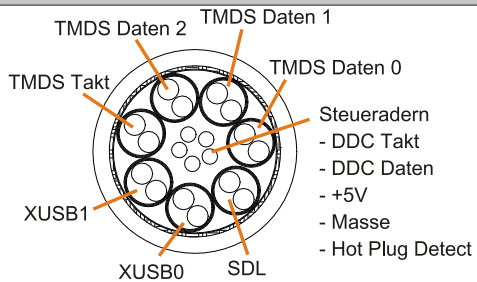
Element	Belegung	Querschnitt	
DVI	TMDS Daten 0	26 AWG	
	TMDS Daten 1	26 AWG	
	TMDS Daten 2	26 AWG	
	TMDS Takt	26 AWG	
USB	XUSB0	26 AWG	Steueradern - DDC Takt - DDC Daten - +5V - Masse - Hot Plug Detect
	XUSB1	26 AWG	
Daten	SDL	26 AWG	
Steueradern	DDC Takt	24 AWG	
	DDC Daten	24 AWG	
	+5 V	24 AWG	
	Masse	24 AWG	
	Hot Plug Detect	24 AWG	

Tabelle 213: Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03

7.4.1.7 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

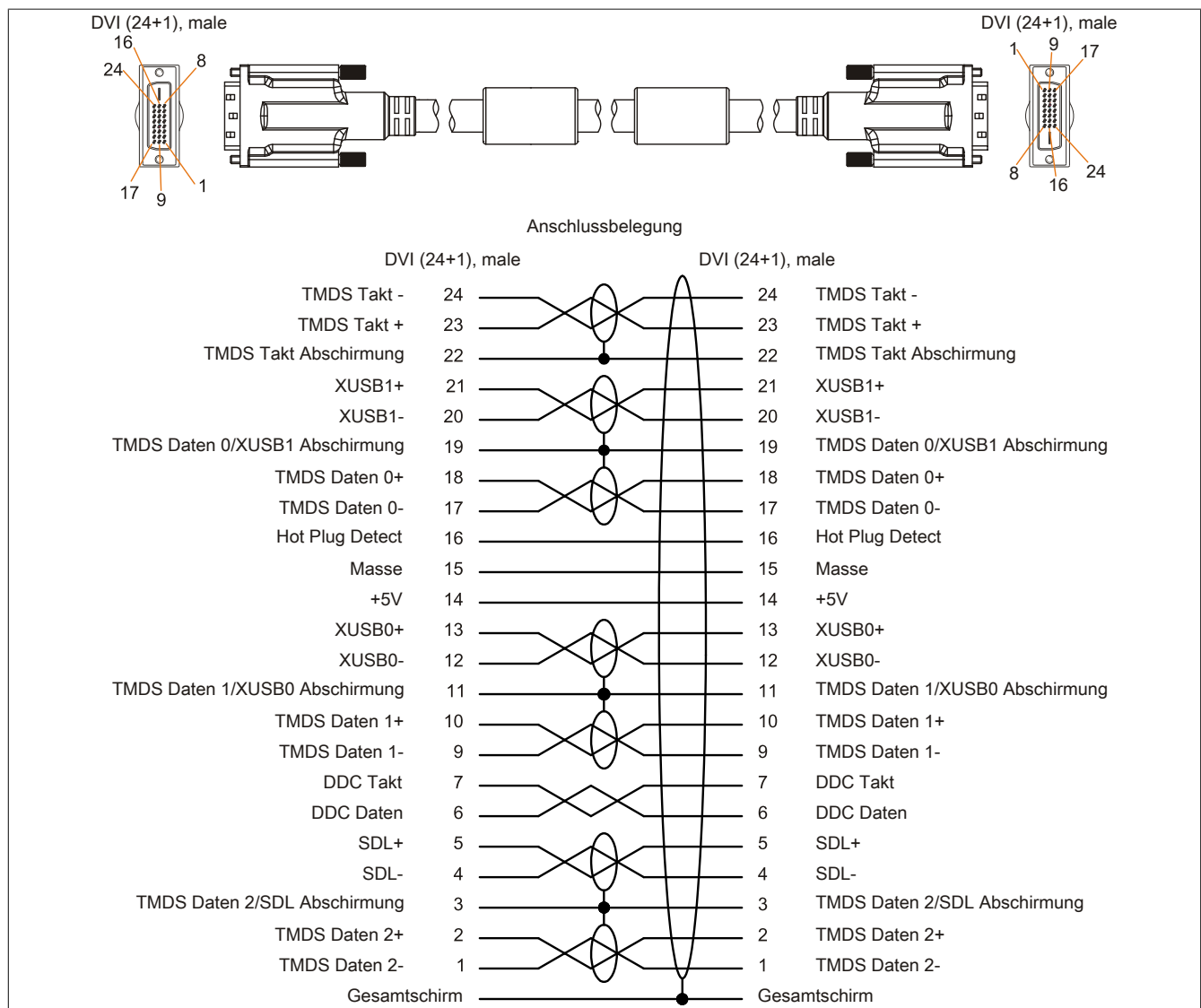


Abbildung 119: 5CASDL.0xxx-03 - Belegung

7.5 SDL Kabel flex mit Extender

7.5.1 5CASDL.0xx0-13

7.5.1.1 Allgemeines

Die SDL Kabel flex mit Extender 5CASDL.0xx0-13 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

7.5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL Kabel flex	
5CASDL.0300-13	SDL Kabel flex mit Extender, 30 m.	
5CASDL.0400-13	SDL Kabel flex mit Extender, 40 m.	
5CASDL.0430-13	SDL Kabel flex mit Extender, 43 m.	

Tabelle 214: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten

7.5.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung		5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE			Ja	
cULus			Ja	
GOST-R			Ja	
GL			Ja ¹⁾	
Kabelaufbau				
Drahtquerschnitt			AWG 24 (Steueradern) AWG 26 (DVI, USB, Daten)	
Eigenschaften			halogen- und silikonfrei	
Schirm			Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt	
Gesamtschirmung			alukaschierte Folie + verzinntes Kupfergeflecht	
Außenmantel				
Material			Spezial-TMPU - seidenmatt	
Farbe			schwarz	
Bedruckung			(B&R) SDL Cable (UL) AWM 20236 80°C 30V E63216	
Steckverbindung				
Typ			2x DVI-D (24+1), male	
Steckzyklen			min. 200	
Kontakte			vergoldet	
mechanischer Schutz			Metallhaube mit vercrimpter Zugentlastung	
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben			max. 0,5 Nm	
Elektrische Eigenschaften				
Betriebsspannung			≤ 30 V	
Prüfspannung				
Ader/Ader			1 kV	
Ader/Schirm			0,5 kV	
Wellenwiderstand			100 ±10 Ω	
Leiterwiderstand				
AWG 24			≤ 95 Ω/km	
AWG 26			≤ 145 Ω/km	
Isolationswiderstand			> 200 MΩ/km	
Einsatzbedingungen				
Approbation			UL AWM 20236 80°C 30V	
Flammwidrigkeit			gemäß UL758 (cable vertical flame test)	
Öl- und Hydrolysebeständigkeit			gemäß VDE 0282-10	
Umgebungsbedingungen				
Temperatur				
Lagerung			-20 bis 60°C	
feste Verlegung			-20 bis 60°C	
flexible Verlegung			-5 bis 60°C	

Tabelle 215: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

Produktbezeichnung	5CASDL.0300-13	5CASDL.0400-13	5CASDL.0430-13
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	30 m ±280 mm	40 m ±380 mm	43 m ±410 mm
Durchmesser		max. 12 mm	
Extender Box			
Breite		35 mm	
Länge		125 mm	
Höhe		18,5 mm	
Biegeradius			
feste Verlegung	≥ 6x Kabeldurchmesser (von Stecker - Ferrit)		
	≥ 10x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)		
flexible Verlegung	≥ 15x Kabeldurchmesser (von Ferrit - Ferrit)		
Beweglichkeit	flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 300000 Zyklen bei 15x Kabeldurchmesser, 4800 Zyklen / Stunde)		
Schleppkettendaten			
Biegewechsel	300.000		
Geschwindigkeit	4800 Zyklen/Stunde		
Biegeradius	180 mm; 15x Kabeldurchmesser		
Hub	460 mm		
Gewicht	ca. 5430 g	ca. 7200 g	ca. 7790 g
Zugbelastbarkeit			
in Betrieb	≤ 50 N		
bei Verlegung	≤ 400 N		

Tabelle 215: 5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

7.5.1.4 Biegeradiusspezifikation

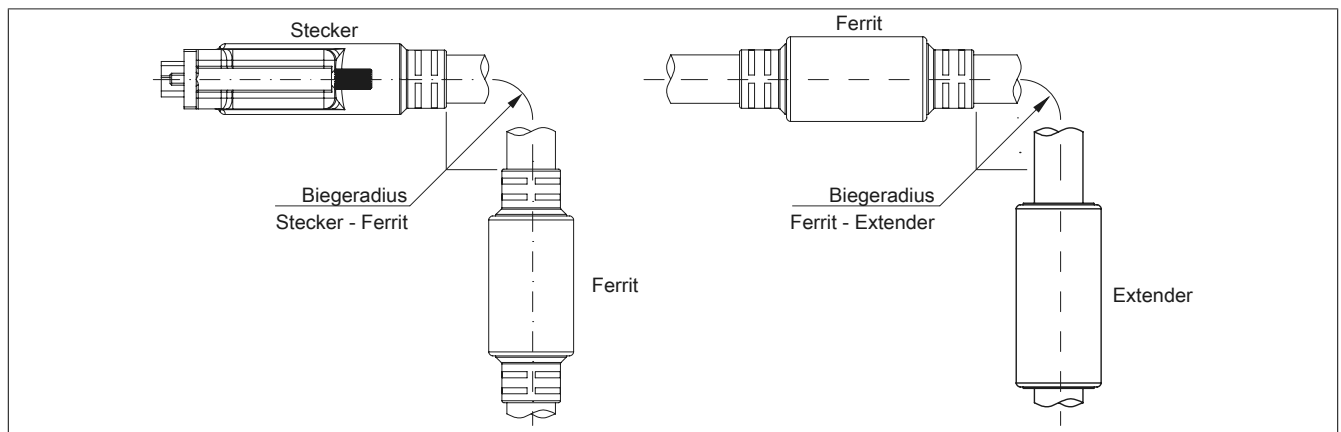


Abbildung 120: Biegeradiusspezifikation mit Extender

7.5.1.5 Abmessungen

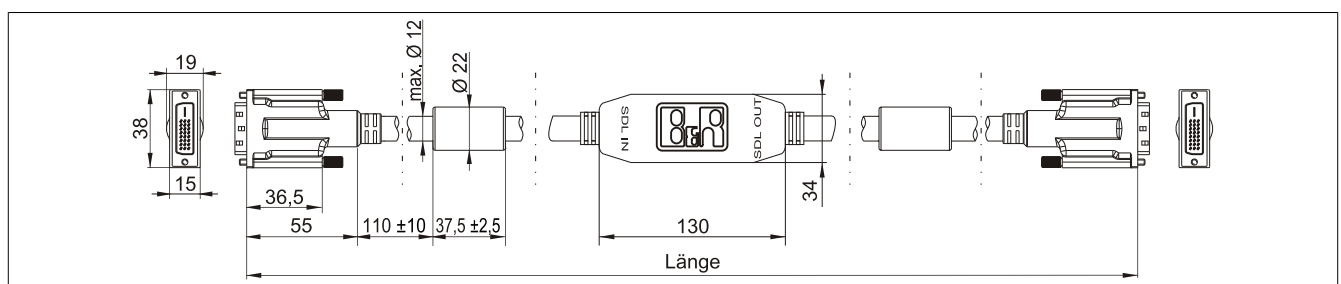


Abbildung 121: 5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen

7.5.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

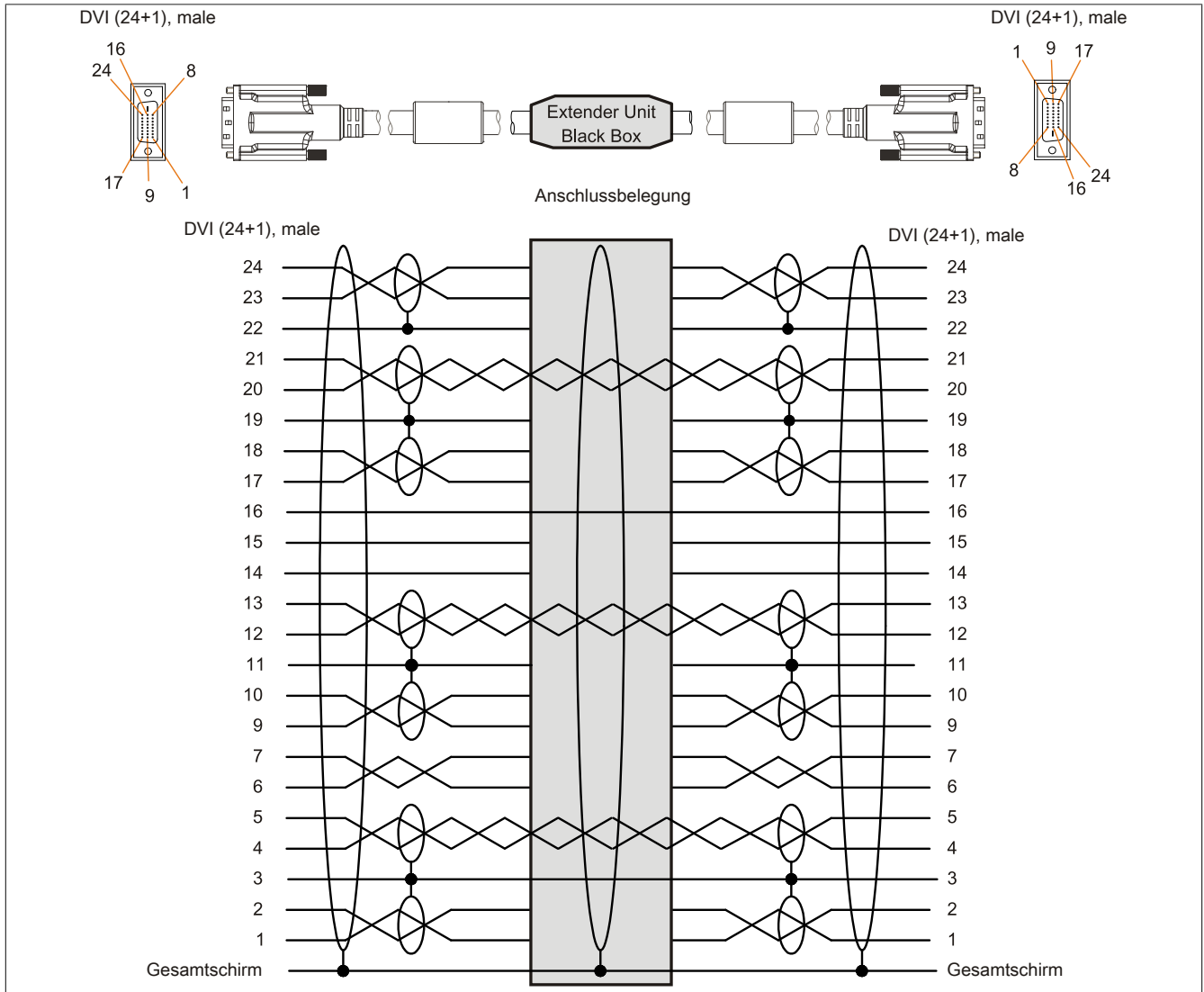


Abbildung 122: 5CASDL.0xx0-13 - Belegung

7.5.1.7 Kabelanschluss

Das SDL Kabel flex mit Extender muss in richtiger Richtung zwischen B&R Industrie PC und Automation Panel Displayeinheit angeschlossen werden. Zu diesem Zweck ist die Signalrichtung auf der Extender Unit abgebildet.

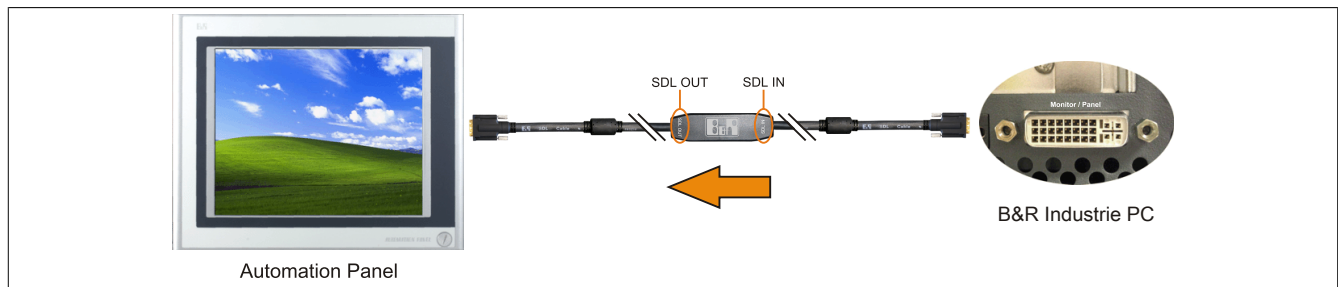


Abbildung 123: Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender

7.6 USB Kabel

7.6.1 5CAUSB.00xx-00

7.6.1.1 Allgemeines

Die USB Kabel sind für eine Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 konzipiert.

7.6.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Kabel	
5CAUSB.0018-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 1,8 m.	
5CAUSB.0050-00	USB 2.0 Verbindungskabel Typ A - Typ B, 5 m.	

Tabelle 216: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten

7.6.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	5CAUSB.0018-00		5CAUSB.0050-00
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE		Ja	
cULus		Ja	
GOST-R		Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 24, 28		
Schirm	Kabel gesamt		
Außenmantel			
Farbe	beige		
Steckverbindung			
Typ	USB Typ A male und USB Typ B male		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±30 mm		5 m ±50 mm
Durchmesser		max. 5 mm	
Biegeradius	min. 100 mm		

Tabelle 217: 5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten

7.6.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

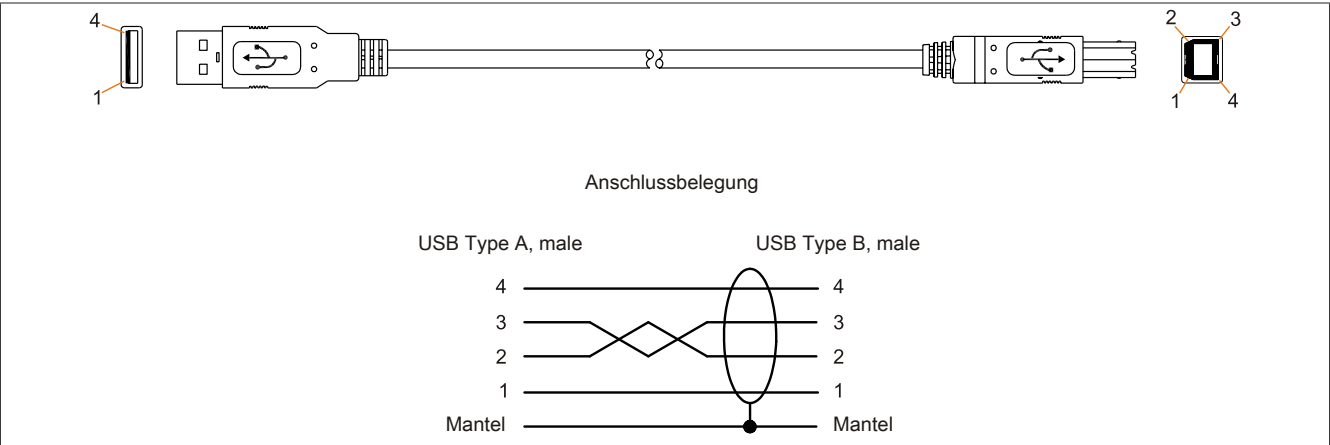


Abbildung 124: 5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel

7.7 RS232 Kabel

7.7.1 9A0014.xx

7.7.1.1 Allgemeines

Die RS232 Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232 Schnittstellen.

7.7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	RS232 Kabel	
9A0014.02	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 1,8 m.	
9A0014.05	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 5 m.	
9A0014.10	RS232 Verlängerungskabel zum Betrieb einer abgesetzten Displayeinheit mit Touch Screen, 10 m.	

Tabelle 218: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten

7.7.1.3 Technische Daten

Produktbezeichnung	9A0014.02	9A0014.05	9A0014.10
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
GOST-R	-	Ja	
Kabelaufbau			
Drahtquerschnitt	AWG 26		
Schirm	Kabel gesamt		
Außenmantel			
Farbe	beige		
Steckverbindung			
Typ	9-polige DSUB Buchse, male / female		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben	max. 0,5 Nm		
Mechanische Eigenschaften			
Abmessungen			
Länge	1,8 m ±50 mm	5 m ±80 mm	10 m ±100 mm
Durchmesser		max. 5 mm	
Biegeradius		min. 70 mm	

Tabelle 219: 9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten

7.7.1.4 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu bauen, so ist ein Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst gebautes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen Kabel wird die Funktion gewährleistet.

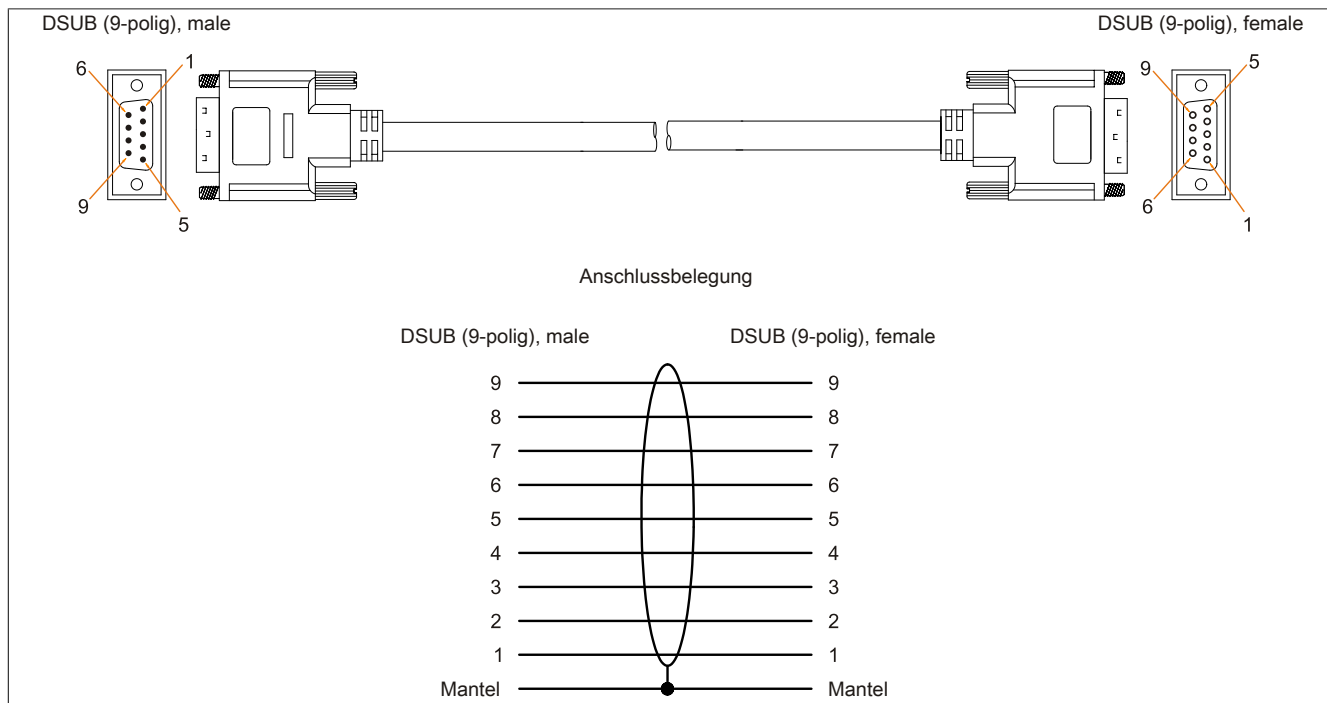


Abbildung 125: 9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel

8 HMI Drivers & Utilities DVD

8.1 5SWHMI.0000-00

8.1.1 Allgemeines

Diese DVD beinhaltet Treiber, Utilities, Softwareupgrades und Anwenderhandbücher für B&R Panel System Produkte (siehe B&R Homepage www.br-automation.com - Bereich Industrie PCs bzw. Visualisieren und Bedienen).

Der Inhalt der DVD ist zum Zeitpunkt der Erstellung mit denen unter dem Downloadbereich auf der B&R Homepage (unter Service - "Produktbezogene Downloads") befindlichen Dateien ident.

8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5SWHMI.0000-00	Sonstiges HMI Drivers & Utilities DVD	

Tabelle 220: 5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten

8.1.3 Inhalt (V2.20)

BIOS Upgrades für die Produkte

- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 815E und 855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board X855GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 945GME BIOS
- Automation PC 620 / Panel PC 700 CPU Board 945GME N270 BIOS
- Automation PC 680
- Automation PC 810 / Automation PC 820 / Panel PC 800 B945GME BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 945GME N270 CPU Board BIOS
- Automation PC 810 / Panel PC 800 GM45 CPU Board BIOS
- Provit 2000 Produktfamilie - IPC2000/2001/2002
- Provit 5000 Produktfamilie - IPC5000/5600/5000C/5600C
- Power Panel 100 BIOS Geräte
- Mobile Panel 100 BIOS Geräte
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 User Boot Logo
- Power Panel 100 / Mobile Panel 100 REMHOST Utility
- Power Panel 300/400 BIOS Geräte
- Power Panel 300/400 BIOS User Boot Logo
- Power Panel 500 / Automation PC 510 / Automation PC 511 BIOS
- Panel PC 310

Treiber für die Geräte

- Automation Device Interface (ADI)
- Audio
- Chipset
- CD-ROM
- LS120

- Grafik
- Netzwerk
- PCI / SATA RAID Controller
- Touch Screen
- Touch Pad
- Schnittstellenkarte

Firmware Upgrades

- Automation PC 620 / Panel PC 700 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 810 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Automation PC 820 (MTCX, SDLR, SDLT)
- Mobile Panel 100 (SMCX)
- Panel PC 300 (MTCX)
- Power Panel 100 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (aPCI)
- Power Panel 300/400 (MTCX)
- Power Panel 500 / Automation PC 510 / Automation PC 511 (MTCX, SDLR, I/O Board)
- Panel PC 800 (MTCX, SDLR, SDLT)
- USV Firmware

Utilities / Tools

- B&R Embedded OS Installer
- Windows CE Tools
- User Boot Logo Konvertierungsprogramm
- SATA RAID Installations Utility
- Automation Device Interface (ADI)
- CompactFlash Lebensdauerrechner (Silicon Systems)
- Miscellaneous
- MTC Utilities
- Key Editor
- MTC & Mkey Utilities
- Mkey Utilities
- USV Konfigurationssoftware
- ICU ISA Konfiguration
- Intel PCI NIC Boot ROM
- Diagnoseprogramme

Windows

- Windows CE 6.0
- Windows CE 5.0
- Windows CE 4.2
- Windows CE 4.1
- Windows CE Tools
- Windows Embedded Standard 2009
- Windows Embedded Standard 7
- Thin Client
- Windows NT Embedded
- Windows XP Embedded
- VNC Viewer

MCAD Vorlagen für

- Industrie PCs

- Visualisieren und Bedienen Geräte
- Einschubstreifenvordrucke
- Kundenspezifische Designs

ECAD Vorlagen für

- Industrie PCs
- Automation PCs
- Automation Panel 900
- Panels (Power Panel)

Dokumentationen für

- Automation PC 511
- Automation PC 620
- Automation PC 680
- Automation PC 810
- Automation PC 820
- Automation Panel 800
- Automation Panel 900
- Panel PC 310
- Panel PC 700
- Panel PC 725
- Panel PC 800
- Power Panel 15/21/35/41
- Power Panel 100/200
- Power Panel 300/400
- Power Panel 500
- Mobile Panel 40/50
- Mobile Panel 100/200
- Mobile Panel Anschlussbox
- Provit 2000
- Provit 3030
- Provit 4000
- Provit 5000
- Provit Benchmark
- Provit Mkey
- Windows CE 5.0 Hilfe
- Windows CE 6.0 Hilfe
- Windows NT Embedded Applikation Guide
- Windows XP Embedded Applikation Guide
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Implementierungsanleitungen
- B&R Hilscher Feldbus Karten (CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET)

Service Tools

- Acrobat Reader 5.0.5 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Power Archiver 6.0 (Freeware in Deutsch, Englisch und Französisch)
- Internet Explorer 5.0 (Deutsch und Englisch)
- Internet Explorer 6.0 (Deutsch und Englisch)

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Batteriewechsel

Die Lithiumbatterie stellt die Pufferung der internen Echtzeituhr (RTC) und der CMOS Daten sicher.

Information:

- Das Design des Produktes gestattet das Wechseln der Batterie sowohl in spannungslosem Zustand als auch bei eingeschaltetem B&R Gerät. In manchen Ländern ist der Wechsel unter Betriebsspannung jedoch nicht erlaubt.
- Beim Wechseln der Batterie in spannungslosem Zustand bleiben vorgenommene BIOS Einstellungen erhalten (werden in einem spannungssicheren EEPROM gespeichert). Datum und Uhrzeit sind nachträglich wieder einzustellen, da diese Daten beim Wechseln verloren gehen.
- Der Batteriewechsel darf nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Warnung!

Die Batterie darf nur durch eine Renata Batterie vom Typ CR2477N ersetzt werden. Die Verwendung einer anderen Batterie kann eine Feuer- oder Explosionsgefahr darstellen.

Die Batterie kann bei falscher Handhabung explodieren. Batterie nicht aufladen, zerlegen oder in einem Feuer entsorgen.

Es sind folgende Lithium Ersatzbatterien verfügbar: 4A0006.00-000 (1 Stk.) und 0AC201.91 (4 Stk.).

1.1 Batteriestatusermittlung

Der Batteriestatus wird sofort nach dem Einschalten des Gerätes und in weiterer Folge alle 24 Stunden vom System ermittelt. Bei der Messung wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) die Batterie belastet und anschließend bewertet. Der ermittelte Batteriestatus wird in den BIOS Setup Seiten (unter Advanced - Baseboard/Panel Features - Baseboard Monitor) und im B&R Control Center (ADI Treiber) angezeigt, kann aber auch in einer Kundenapplikation über die ADI Library ausgelesen werden.

Batteriestatus	Bedeutung
N/A	Es wird eine zu alte Hardware bzw. Firmware verwendet die das Auslesen nicht unterstützt.
GOOD	Pufferung der Daten ist gewährleistet.
BAD	Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als BAD (nicht ausreichend) erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet.

Tabelle 221: Bedeutung Batteriestatus

Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Batteriekapazität als nicht ausreichend erkannt wird, ist eine Pufferung der Daten noch für ca. 500 Stunden gewährleistet. Beim Wechseln der Batterie werden die Daten noch ca. 10 Minuten durch einen Goldfolienkondensator gepuffert.

1.2 Vorgangsweise

- Zuleitung zum B&R Industrie PC spannungslos (Netzkabel abstecken) machen.
- Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Abdeckung des Batteriefaches entfernen und Batterie mittels Ausziehstreifen vorsichtig herausziehen.

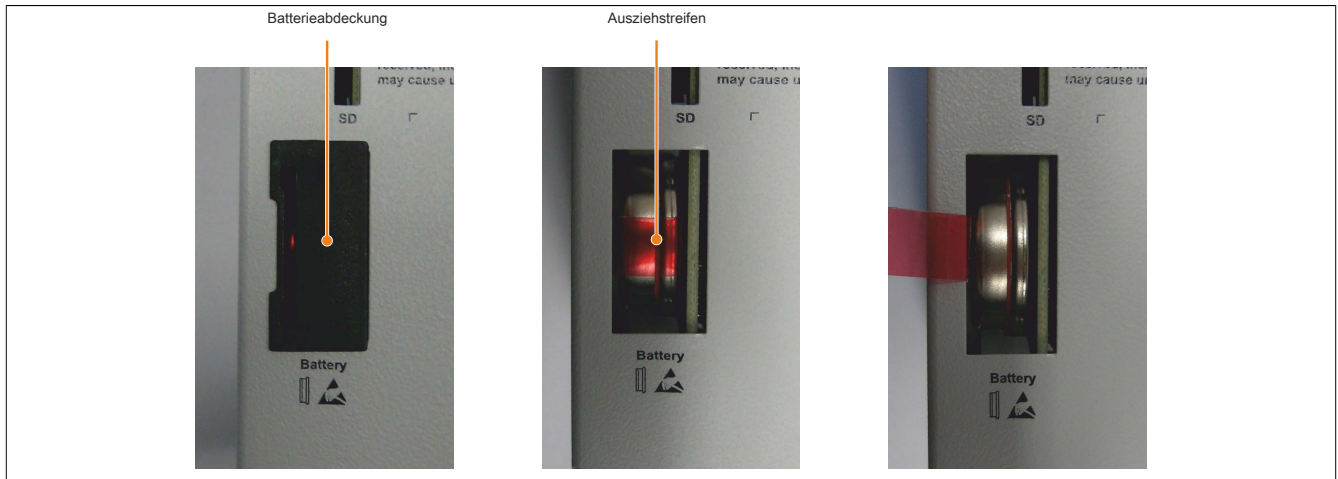


Abbildung 126: Batterie entfernen

- Die Batterie darf mit der Hand nur an den Stirnseiten berührt werden. Zum Einsetzen kann auch eine isolierte Pinzette verwendet werden.

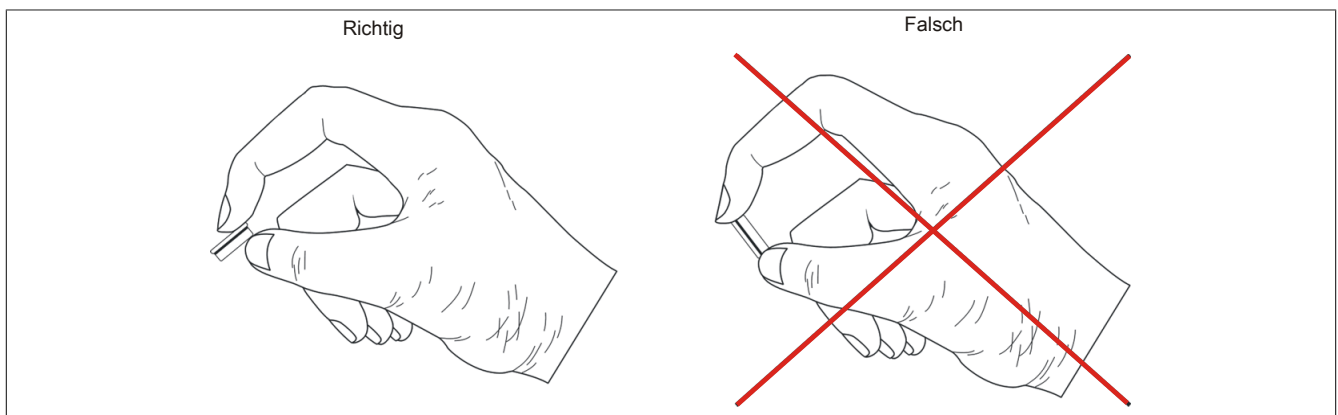


Abbildung 127: Batteriehandhabung

- Neue Batterie in richtiger Polarität einstecken.

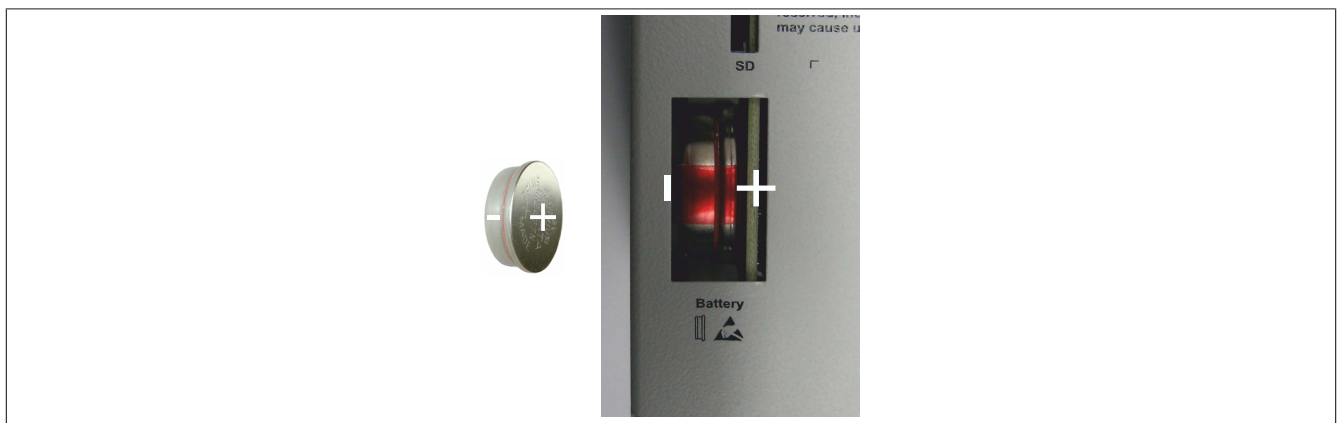


Abbildung 128: Batteriepolartät

- Beim Einstecken auf den korrekten Sitz des Ausziehstreifens achten, damit ein erneuter Tausch einfach zu bewerkstelligen ist!
- Den B&R Industrie PC wieder unter Spannung setzen - Netzstecker anstecken.
- Datum und Uhrzeit im BIOS neu einstellen.

Warnung!

Bei Lithium-Batterien handelt es sich um Sondermüll! Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

2 CompactFlash Tausch

Vorsicht!

Ein Tauschen der CompactFlash Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

Das Tauschen der CompactFlash Karte ist durch Betätigung des Auswerfers (siehe Abbildung) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) schnell und sicher möglich.

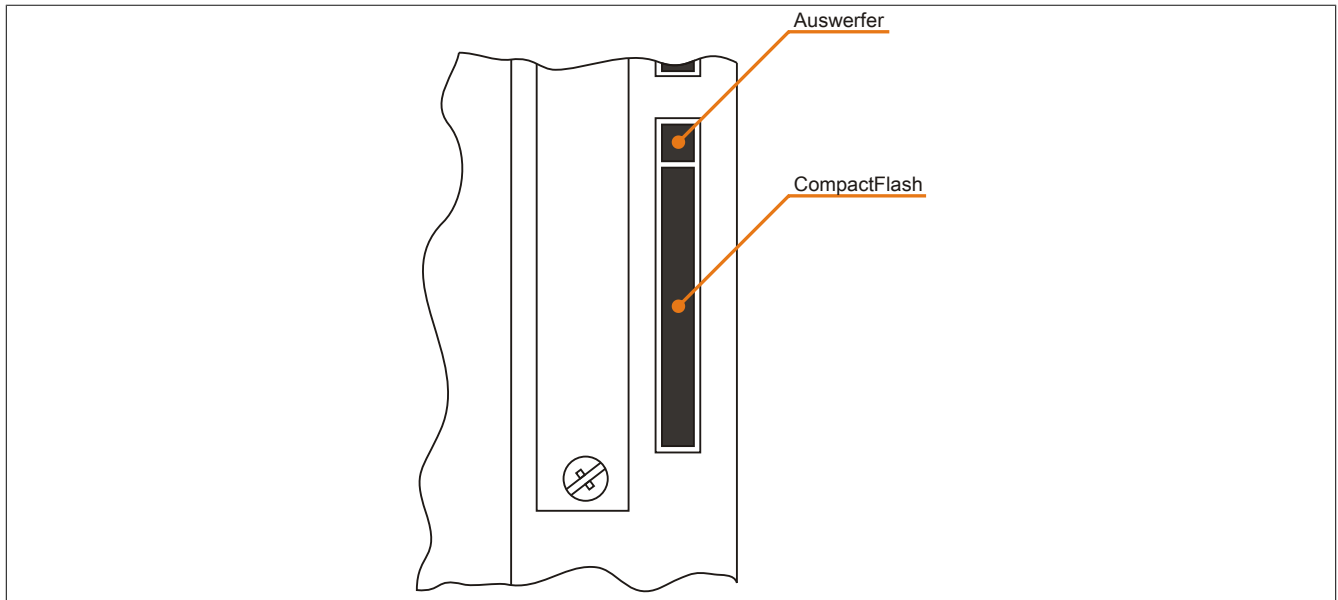


Abbildung 129: CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto)

Anhang A

1 Maintenance Controller Extended (MTCX)

Der MTCX Controller (FPGA-Prozessor) befindet sich auf dem CPU Board des Gerätes.

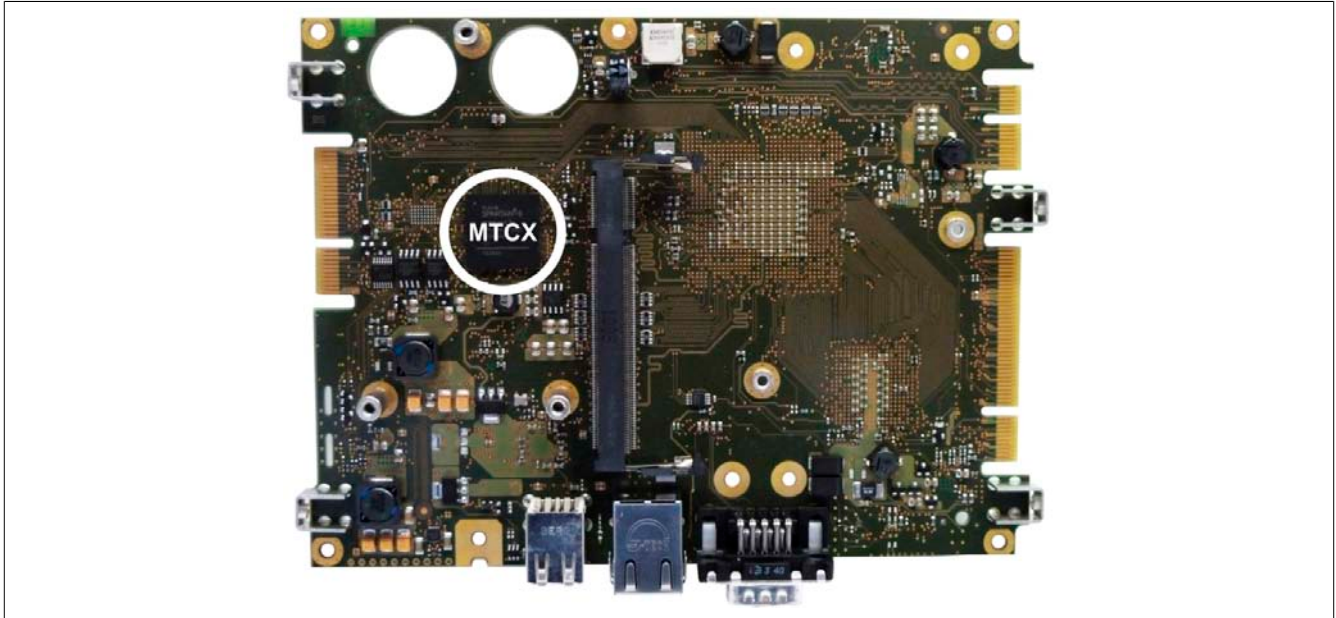


Abbildung 130: Position des MTCX Controllers

Der MTCX ist für folgende Überwachungs- und Steuerfunktionen zuständig:

- Power Fail Logik
- Watch Dog Handling (NMI und Resethandling)
- Temperaturüberwachung (I/O Bereich, Power Supply)
- Tasten und LED Behandlung/Koordination
- Erweiterter Desktop Betrieb (Tasten, USB Weiterleitung)
- Backlight Steuerung des Displays
- Statistikdatenermittlung (Power Cycles - jedes Einschalten und Power On wird ermittelt - jede volle Stunde wird gezählt z.B. 50 Minuten keine Erhöhung)
- Status LEDs (Power, CF, Link, Run)

Die Funktionen des MTCX können per Firmwareupgrade⁵⁾ erweitert werden. Die Version kann im BIOS (Menüpunkt "OEM Features" auf Seite 106) oder unter freigegebenen Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center ausgelesen werden.

⁵⁾ Kann im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) heruntergeladen werden.

2 Abkürzungen

Abkürzung	Steht für	Beschreibung
NC	Normally closed	Steht bei einem Relaiskontakt für Öffner.
	Not connected	Wird bei der Beschreibung von Anschlussbelegungen verwendet, wenn eine Klemme oder ein Pin moduleseitig nicht angeschlossen ist.
ND	Not defined	Steht in den technischen Datentabellen für einen nicht definierten Wert. Z. B. weil es von einem Kabelhersteller zu bestimmten technischen Daten keine Angabe gibt.
NO	Normally open	Steht bei einem Relaiskontakt für Schließer.
TBD	To be defined	Wird in den technischen Datentabellen verwendet, wenn es derzeit zu diesem technischen Datum noch keine Angabe gibt. Der Wert wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.

Tabelle 222: Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen

3 Glossar

ACPI	<i>Advanced Configuration and Power Interface</i> > Konfigurationsschnittstelle, die es dem Betriebssystem gestattet, die Stromversorgung für jedes an den PC angeschlossene Gerät zu kontrollieren. Mit ACPI ist das BIOS des Rechners nur noch für die Details der Kommunikation mit der Hardware verantwortlich.
Adresse	Zeichenfolge zur Kennzeichnung eines Speicherplatzes oder eines Speicherbereichs, wo Daten hinterlegt und wiederholt werden können oder, wie z.B. bei numerischen Steuerungen, ein Symbol zur Kennzeichnung einer Funktionseinheit für die die dem Symbol folgenden Geometrie- oder Technologiedaten bestimmt sind.
Algorithmus	nach DIN 19226: vollständig festgelegte endliche Folge von Vorschriften, nach denen aus zulässigen Eingangsgrößen eines Systems gewünschte Ausgangsgrößen erzeugt werden. Er beschreibt, wie etwas zu tun ist. Um im Sinne der Mathematik als Algorithmus zu gelten, muss ein Verfahren mindestens den folgenden Ansprüchen genügen. <i>Diskretheit</i> > ein Algorithmus besteht aus einer endlichen Folge von Schritten. <i>Determiniertheit</i> > unter gleichen Startbedingungen erzeugt er stets dasselbe Endergebnis. <i>Eindeutigkeit</i> > die Reihenfolge der Schritte ist eindeutig festgelegt. <i>Endlichkeit</i> > er endet nach endlich vielen Schritten. Mengentheoretisch betrachtet ist ein Algorithmus eindeutig bestimmt durch eine Menge von Größen [Eingangs-, Zwischen- und Ausgangsgrößen], eine Menge von Elementaroperationen sowie durch eine Vorschrift, die angibt, in welcher Reihenfolge welche Operationen wann auszuführen sind. Aus funktionaler Sicht überführt er eine Menge von Eingangsgrößen [Eingabemenge] in eine Menge von Ausgangsgrößen [Ausgabemenge]. Seine Darstellung kann textuell in einer natürlichen oder künstlichen formalen Sprache oder mittels grafischer Darstellungen [Graph, Programmablaufplan, Struktogramm, Petri-Netze u.ä.] erfolgen.
ANSI	<i>American National Standards Institute</i> > Amerikanisches Normeninstitut fördert und verwaltet amerikanische Industrienormen.
APC	<i>Automation PC</i>
ASCII	<i>American Standard Code for Information Interchange</i> > amerikanischer Normcode für die Datenübertragung (weltweit angewandt, Ziffern, Buchstaben, Sonder- und Gerätesteuersymbole werden als 7-Bit-Binärkombinationen dargestellt. Der Standard-ASCII-Zeichensatz umfaßt damit insgesamt 27 = 128 Zeichen. Ein achttes Bit dient jeweils als sogenanntes Paritätsbit zur Fehlererkennung bei der Übertragung von ASCII-Dateien. Bei gerader Paritätsprüfung wird dieses Bit auf „0“ gesetzt, wenn die Anzahl der „Einsen“ in den verbleibenden sieben Bits gerade ist, anderenfalls auf „1“. Der erweiterte ASCII-Zeichensatz verzichtet auf die Paritätsprüfung. Hier wird das höchstwertige Bit dazu benutzt, um vom Standardzeichensatz auf die Erweiterung umzuschalten. Dadurch entsteht Platz für länderspezifische Sonderzeichen wie z.B. die Umlaute in der deutschen Sprache. www.asciitable.com
Ausfall	<i>Failure nach IEC 61508</i> > Beendigung der Fähigkeit einer Funktionseinheit, eine geforderte Funktion auszuführen. In bezug auf sicherheitsgerichtete Systeme wird, je nach dem ein Ausfall das System in einen gefährlichen oder ungefährlichen Zustand versetzt, zwischen gefährlichen [dangerous] und ungefährlichen [safe] Ausfällen unterschieden. Die Ausfallsursache kann dabei belastungs- oder alterungsbedingt rein zufälliger Natur sein, man spricht dann von einem zufälligen Ausfall, oder durch einen systemimmanenten Mangel bedingt sein. In diesem Fall spricht man von einem systematischen Ausfall.
Automation Runtime	Einheitliches Laufzeitsystem für alle B&R Automatisierungskomponenten.
B&R Automation Runtime	MS-Windows basiertes Programm zur Erstellung von Installationsdisketten um B&R Automation Runtime™ auf dem Zielsystem zu installieren.
Baudrate	Maß für die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Sie gibt die Anzahl der Zustände eines übertragenen Signals pro Sekunde an und wird in der Einheit Baud gemessen. 1 Baud = 1 Bit/s bzw. 1 bps
BIOS	<i>Basic Input/Output System</i> > zu deutsch »grundlegendes Eingabe-Ausgabe-System«. Kernsoftware bei Computersystemen mit grundlegenden Routinen um Ein- und Ausgabevorgänge an Hardwarekomponenten zu steuern, nach dem Systemstart Tests durchzuführen und das Betriebssystem zu laden. Der Anwender kommt mit dem BIOS gewöhnlich nicht in Berührung, wenngleich es für die Leistung eines Systems mitbestimmend ist.
Bit	<i>Binary Digit</i> > Binärstelle, Binärzeichen, Binärziffer kleinste diskrete Informationseinheit. Ein Bit kann mit dem Wert 0 oder 1 belegt sein.
Byte	Datenformat [1 Byte = 8 Bit] bzw. Einheit zur Charakterisierung von Informationsmengen und Speicherkapazitäten. Geläufige Steigerungsstufen sind: KB, MB, GB.
Cache	<i>Hintergrundspeicher</i> > auch Schattenspeicher oder Schneltpufferspeicher genannt, der den schnellen Hauptspeicher eines Rechners entlastet. Daten, die z.B. vom Arbeitsspeicher an langsamere Komponenten wie Plattenspeicher oder Drucker ausgegeben werden sollen, werden im Cache zwischengelagert und von dort mit einer für die Zielgeräte angemessenen Geschwindigkeit ausgegeben.
CAN	<i>Controller Area Network</i> > Ist ein serielles Bussystem. Aufbau nach ISO 11898; Bus-Medium: verdrahtetes Leiterpaar. Gute Übertragungseigenschaften im Kurzstreckenbereich unterhalb 40 m bei 1 MBit/s Datenübertragungsraten. Maximale Anzahl der Teilnehmer: theoretisch unbegrenzt, praktisch bis zu 64. Echtzeitfähig, d.h. definierte maximale Wartezeiten für Nachrichten hoher Priorität. Hohe Zuverlässigkeit durch Fehlererkennung, Fehlerbehandlung, Fehlereingrenzung, Hamming-Distanz.
CMOS	<i>akkugespeicher Speicher</i> > in ihm werden fundamentale Parameter eines IBM Personal Computers oder eines kompatiblen Computers gespeichert. Die Informationen werden vor allem beim Booten des Computers benötigt und umfassen u.a. den Typ der Festplatte, die Größe des Arbeitsspeichers sowie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum. Der Speicher basiert, wie es der Name andeutet, in aller Regel auf der CMOS-Technologie.
COM	Ist im Betriebssystem MS-DOS ein Gerätenamen, mit dem die seriellen Ports angesprochen werden. Der erste serielle Port ist dabei unter COM1 zu erreichen, der zweite unter COM2 usw. An einem seriellen Port wird typischerweise ein Modem, eine Maus oder ein serieller Drucker angeschlossen.
COM1	Gerätenamen für den ersten seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM1 befindet sich gewöhnlich an der Adresse 03F8H. In der Regel ist dem COM1-Port der IRQ 4 zugewiesen. In vielen Systemen wird an COM1 eine serielle RS232-Maus angeschlossen.
COM2	Gerätenamen für den zweiten seriellen Port in einem PC-System. Der Eingabe-Ausgabe-Bereich von COM2 befindet sich gewöhnlich an der Adresse 02F8H. In der Regel ist dem COM2-Port der IRQ 3 zugewiesen. In vielen Systemen wird an COM2 ein Modem angeschlossen.
Controller	Eine Gerätekomponente, über die andere Geräte auf ein Subsystem des Computers zugreifen. Ein Disk-Controller steuert z.B. den Zugriff auf Festplatten- und Diskettenlaufwerke und ist dabei sowohl für die physikalischen als auch die logischen Laufwerkszugriffe verantwortlich.

CPU	<i>Central Processing Unit</i> > Die Rechen- und Steuereinheit eines Computers; die Einheit, die Befehle interpretiert und ausführt. Wird auch als Zentraleinheit oder Mikroprozessor bezeichnet. Eine CPU besitzt die Fähigkeit, Befehle zu laden, zu dekodieren und auszuführen, sowie Informationen von und zu anderen Ressourcen zu übertragen.
CTS	<i>Clear To Send</i> > zu deutsch »Sendebereitschaft«. Ein Signal bei der seriellen Datenübertragung, das von einem Modem an den angeschlossenen Computer gesendet wird, um damit die Bereitschaft zum Fortsetzen der Übertragung anzuzeigen. CTS ist ein Hardwaresignal, das über die Leitung Nummer 5 nach dem Standard RS-232-C übertragen wird.
DCD	<i>Data Carrier Detected</i> > In der seriellen Kommunikation verwendetes Signal, das ein Modem an den eigenen Computer sendet, um anzuzeigen, dass es für die Übertragung bereit ist.
DIMM	<i>Double In-line Memory Modul</i> > Speichermodul, bestehend aus einem oder mehreren RAM-Chips auf einer kleinen Platine, die über eine Steckverbindung mit dem Motherboard eines Computers verbunden ist.
DMA	<i>Direct Memory Access</i> > Beschleunigter Direktzugriff auf den Arbeitsspeicher eines Rechners unter Umgehung des Zentralprozessors.
DRAM	<i>Dynamic Random Access Memory</i> > Dynamische RAMs stellen integrierte Halbleiterschaltungen dar, die Informationen nach dem Kondensator-Prinzip speichern. Kondensatoren verlieren in relativ kurzer Zeit ihre Ladung. Deshalb müssen dynamische RAM-Platinen eine Logik zum ständigen »Aufrischen« (zum Wiederaufladen) der RAM-Chips enthalten. Da der Prozessor keinen Zugriff auf den dynamischen RAM hat, wenn dieser gerade aufgefrischt wird, können ein oder mehrere Wartezustände beim Lesen oder Schreiben auftreten. Dynamische RAMs werden häufiger eingesetzt als statische RAMs, obwohl sie langsamer sind, da die Schaltung einfacher konstruiert ist und vielmals so viele Daten wie ein statischer RAM-Chip speichern kann.
DSR	<i>Data Set Ready</i> > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Modem an den eigenen Computer gesendet wird um die Arbeitsbereitschaft anzuzeigen. DSR ist ein Hardwaresignal, das in Verbindungen nach dem Standard RS-232-C über die Leitung 6 gesendet wird.
DTR	<i>Data Terminal Ready</i> > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal, das von einem Computer an das angeschlossene Modem gesendet wird, um die Bereitschaft des Computers zur Entgegennahme eingehender Signale anzuzeigen.
DVI	<i>Digital Visual Interface</i> > Ist eine Schnittstelle zur digitalen Übertragung von Videodaten.
DVI-D	nur digital
DVI-I	integrated, d.h. analog und digital
ECAD	<i>Elektrisches CAD</i> > ECAD-Systeme sind Projektierungswerkzeuge, welche die effiziente Erstellung und Bearbeitung elektrischer Schalt- und Schemapläne sowie davon ausgehend die automatische Generierung von Querverweislisten, Kabel- und Klemmenplänen, Stücklisten u.a. Bestell- und Fertigungsunterlagen ermöglichen.
Echtzeit	ein System arbeitet in Echtzeit bzw. ist echtzeitfähig, wenn es Eingangsgrößen (z.B. Signale, Daten) in einer definierten Zeitspanne aufnimmt, verarbeitet und die Ergebnisse rechtzeitig für ein Partnersystem oder die Systemumgebung bereitstellt. Hierzu siehe auch Echtzeitanforderungen und Echtzeitsystem.
Elektromagnetische Verträglichkeit	<i>electromagnetic compatibility</i> > Gemäß EMVG: Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar wären [IEV 161-01-07].
EMV	<i>Elektromagnetische Verträglichkeit</i> > Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar wären [IEV 161-01-07].
EN	<i>Europäische Norm</i> > siehe CENELEC
EPROM	<i>Erasable PROM</i> > (mit ultraviolettem Licht vollständig) löschbarer PROM
Erde	Im Zusammenhang mit elektrotechnischen Sachverhalten versteht man darunter das mehr oder weniger elektrisch gut leitende Erdreich, das ausserhalb des Einflussbereichs von Erden oder anderen elektrischen Phänomenen keine Potentialunterschiede aufweist)
ESD	<i>Electrostatic Discharge</i> > elektrostatische Entladung, (korrekt: Entladung statischer Elektrizität. Vorgang des Ladungsausgleichs zwischen festen, flüssigen oder gasförmigen Medien, die unterschiedlich elektrostatisch aufgeladen sind. Er ist meistens von einer Gleit-, Büschel-, Funken- oder auch blitzähnlichen Entladungserscheinung begleitet, kann aber auch ausschließlich leitungsgeladen über eine Kontaktstelle ablaufen, und zwar dann, wenn die Potentialdifferenz vor der Berührung 330 Volt nicht überschreitet. Bei Funkenbildung können brennbare Gase und Dämpfe oder explosive Gemische gezündet und durch die mit einer Entladung einhergehenden Ströme und Felder elektronische Bauelemente geschädigt, zerstört oder elektronische Betriebsmittel in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die erstgenannten Wirkungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Brand- und Explosionsschutzes bzw. der technischen Sicherheit, die letzteren dagegen in die Bereiche des Schutzes elektrostatisch gefährdeter Bauteile (EGB) und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Von besonderer Bedeutung beim Umgang mit elektronischer Gerätetechnik sind die von Personen auf Schaltkreise, Leiterplatten, Bedienelemente, und Gefäßoberflächen im Rahmen von Transport-, Montage-, Prüf-, Bedien-, Reparatur- und Servicehandlungen möglichen elektrostatischen Körperentladungen. Mit folgenden elektrischen Werten ist dabei zu rechnen: Energieinhalt 10 bis 30 mJ, elektrostatische Spannung 0,1 bis 20 kV, Entladungsstromstärke bis 30 A (Pulsamplitude, Stromänderungsgeschwindigkeit bis 100 A/ns, elektrische Feldstärke 1 bis 4 kV/mmagnetische Feldstärke bis 15 A/m in cm-Nähe der Entladung.
Ethernet	<i>Basisband-Bussystem</i> > von RANK XEROX Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ursprünglich für die Verknüpfung von Minicomputern entwickelt. Es basiert auf dem CSMA/CD-Zugriffsverfahren. Als Übertragungsmedium dienen Koaxialkabel bzw. Twisted-Pair-Leitungen [verdrittelte Kupferdoppeladern], Übertragungsgeschwindigkeiten: 10 Mbps [Ethernet], 100 Mbps [Fast Ethernet] sowie 1 Gbps [Gigabit Ethernet], weit verbreitete Technik zum Vernetzen von Rechnern in einem LAN, seit 1985 genormt [IEEE 802.3 und ISO 8802-3]. Die Ethernet-Technologie hat sich im Bürobereich allgemein durchgesetzt. Nach Ermöglichung auch sehr harter Echtzeitanforderungen und Anpassung der Gerätetechnik [Buskabel, Patchfelder, Anschlussdosen] an die gegenüber den Bürobereichen wesentlich rauheren Einsatzbedingungen des industriellen Umfeldes dringt sie zunehmend in die Feldbereiche der Automatisierungstechnik vor.
Fehler	<i>Fault</i> > nach IEC 61508: nicht normale Bedingung, die eine Verminderung oder den Verlust der Fähigkeit einer Funktionseinheit verursachen kann, eine geforderte Funktion auszuführen.
Feldbus	Bussystem im prozeßnahen Bereich zum direkten Anschluß von Sensoren und Aktuatoren mit eigener Intelligenz. Auf einem Feldbus werden kleinere Datenmengen zwischen Sensorik, Aktorik und Steuereinrichtung in digitaler Form übertragen. Die Übertragung muß dabei möglichst schnell, d.h. echtzeitnah erfolgen. Zudem muß eine feste minimale und maximale Antwortzeit garantiert sein. In modernen Automatisierungssystemen ersetzen zunehmend serielle Feldbusse die konventionelle parallele Feldverkabelung. Die serielle Vernetzung der Komponenten spart Zeiten bei der Planung und Installation, außerdem werden Schaltschrankausmaße reduziert sowie Ausfall- und Wartungszeiten verkürzt und damit eine bessere Anlagenverfügbarkeit erzielt. Systemerweiterungen, -änderungen und -ergänzungen sind einfach zu realisieren.
FIFO	<i>First In First Out</i> > Organisationsprinzip einer Warteschlange, bei dem die Entnahme der Elemente in der gleichen Reihenfolge wie beim Einfügen abläuft - das zuerst hinzugefügte Element wird auch als Erstes wieder entnommen. Eine derartige Anordnung ist typisch für eine Liste von Dokumenten, die auf ihren Ausdruck warten.

Filter	Filter im Sinne der Entstörtechnik sind Bausteine zur Dämpfung leitungsgeführter Störgrößen. Ihre sinnvolle Anwendung setzt voraus, dass sich die spektralen Anteile der Nutz- und Störgrößen hinreichend voneinander unterscheiden. Dies ermöglicht bei geeigneter Auslegung der Filterparameter eine selektive Dämpfung von Störgrößen ohne merkliche Beeinträchtigung der Nutzgrößen. Der eigentliche Dämpfungseffekt wird dabei im wesentlichen durch Spannungsteilung erreicht und die dadurch erzielbare Filterwirkung durch die sogenannte Einfügungsdämpfung beschrieben. Filter können sowohl an einer Störquelle zur Verhinderung der Aussendung leitungsgeführter Störgrößen als auch an einer Störsenke zur Erhöhung der Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störgrößen eingesetzt werden. Neben den hauptsächlich verwendeten passiven Filtern, die sich aus passiven Bauelementen konfigurieren, gibt es auch aktive Filter, in denen Bauelemente eingesetzt werden, die einer Stromversorgung bedürfen. Aktive Filter sind als Signalfilter weit verbreitet. In Stromversorgungsnetzen kommen sie nur in Sonderfällen zur Anwendung.
Firewall	<i>wörtlich: Brandmauer, Feuerschutzwand</i> > Bezeichnet ein elektronisches, hardware- und/oder softwarebasiertes Sicherheitssystem zwischen zwei Netzen, beispielsweise zwischen Intranet und Internet, das die Computer bzw. das interne Netz eines Unternehmens vor unbefugtem Zugriff aus dem Internet schützt. Nur Daten für bestimmte, berechnete Dienste dürfen an einem fest definierten Punkt die Sicherheitsbarriere passieren.
Firmware	Programme, die in Festwertspeichern fest eingebrannt sind, Software für den Betrieb von computergesteuerten Geräten, die im allgemeinen während der Gerätelebensdauer oder über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. z.B. Betriebssysteme für CPUs und Applikationsprogramme für Industrie-PCs und speicherprogrammierbare Steuerungen, beispielsweise die Software in einer Waschmaschinensteuerung. Sie ist in einem Festwertspeicher [ROM, PROM, EPROM] hinterlegt und kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden.
Floppy	<i>Diskette</i> > Eine runde Kunststoffscheibe mit einer Eisenoxid-Beschichtung, die ein Magnetfeld speichern kann. Wenn die Floppy Disk in ein Diskettenlaufwerk eingelegt wird, rotiert sie, sodass die verschiedenen Bereiche (oder Sektoren) der Disk-Oberfläche unter den Schreib-Lese-Kopf gelangen, der die magnetische Orientierung der Partikel verändern und aufzeichnen kann. Die Orientierung in eine Richtung stellt eine binäre 1, die entgegengesetzte Orientierung eine binäre 0 dar.
GB	<i>Gigabyte</i> > 1 GB = 1.024 MB bzw. 1.073.741.824 Bytes
Gerät	Der Begriff „Gerät“ steht umgangssprachlich als Synonym für Apparat, Instrument, Ausrüstungs- bzw. Gebrauchsgegenstand, Vorrichtung, Werkzeug oder Utensil. Dabei handelt es sich in erster Linie um fest installierte oder mobile Einrichtungen relativ kleiner räumlicher Abmessungen, deren spezifische Funktion oder spezieller Einsatzbereich in der Regel durch einen entsprechenden Wortvorsatz gekennzeichnet ist wie z.B. in den Wortverbindungen Sportgerät, Gartengerät, Küchengerät, Hörgerät, Funksprechgerät, Faxgerät, Diktiergerät, Kopiergerät, Messgerät, Steuergerät, Automatisierungsgerät, Peripheriegerät u.v.a. Darüber hinaus gibt es festes und mobiles Großgerät, beispielsweise militärisches [Panzer, Flugzeuge, Schiffe], medizinisches wie Computertomographen, geologisches wie Erdbohrer, Großraumbagger und Förderbrücken und solches für die Forschung wie z.B. Teilchenbeschleuniger. Technisch gesehen [DIN 40150] sind Geräte aus Bauelementen, Bauteilen und Baugruppen zusammengesetzt. Als Geräte im Sinne des EMVG, d.h. in juristischem Sinn, gelten alle elektrischen und elektronischen Apparate, Systeme, Anlagen und Netze, die elektrische oder elektronische Bauteile enthalten. Diese Gerätedefinition steht im Widerspruch zur gewachsenen und auch im DIN-Vorschriftenwerk [siehe oben] manifestierten Vorstellungswelt des Ingenieurs zum Gerätebegriff und ist demzufolge Ursache vieler Mißverständnisse bei der Anwendung des EMVG.
Handshake	Verfahren zur Synchronisation der Datenübertragung bei unregelmäßig anfallenden Daten. Der Sender signalisiert, wenn er neue Daten senden kann und der Empfänger, wenn er für neue Daten aufnahmebereit ist.
HDD	<i>Hard Disk Drive</i> > Nicht wechselbarer magnetischer Massenspeicher mit hoher Kapazität z.B. 120GB.
Host	<i>Gastgeber, Wirt</i> > bei Computersystemen, die über mehrere CPUs und Bus Master verfügen, versteht man darunter diejenige Einheit, die über die Arbitration Unit und die Host-CPU verfügt oder die die Kontrolle über das Gesamtsystem besitzt. Im Zusammenhang mit dem Internet wird ein ständig verfügbarer Netzserver als Host bezeichnet. <i>Hot Swap</i> > Heißes Wechseln (Wechseln von Rechnerkomponenten während des laufenden Betriebs. Es werden drei unterschiedliche Stufen unterschieden: Basic Hot Swap, Full Hot Swap und das High Availability Modell. Beim Basic Hot Swap, der einfachsten Form des „Heißen Wechsels“ muß über die Tastatur des Computers die zu wechselnde Baugruppe zunächst deaktiviert bzw. die Rechnerkonfiguration angepaßt werden. Hierfür sind in der Regel Computerspezialisten erforderlich. Beim Full Hot Swap dagegen übernimmt eine auf der zu ziehenden oder zu steckenden Komponente installierte Software die Aktivierung bzw. Deaktivierung. Über einen integrierten Schalter an der Frontseite der Steckereinheit wird dem Rechner der Beginn des Aushebe- oder das Ende des Einhebevorgangs signalisiert. Im Gegenzug zeigt eine LED an der Frontseite an, daß der Aushebevorgang gestartet werden kann bzw. die eingesetzte Baugruppe eingegliedert ist. Das High Availability Modell kommt in hochverfügbaren Computersystemen zur Anwendung. Hier erfolgt die Hot Swap Softwaresteuerung nicht durch jede einzelne Komponente, sondern zentral über einen separaten Hot Swap Controller [HSC]. Dadurch können ausgefallene Boards automatisch deaktiviert und Rechnerabstürze vermieden werden.
HTML	<i>Hyper Text Markup Language</i> > Programmiersprache mit Hypertextmarken. Sprache in der die meisten Webseiten geschrieben sind. Sie beruht auf der SGML-Definition. Ausführliche Informationen hierzu siehe www.w3.org/MarkUp
HTTP	<i>Hyper Text Transfer Protocol</i> > Datenübertragungsprotokoll für die Übertragung von HTML-Seiten und den daran gekoppelten Dateien aller Art. Es ist das Protokoll, auf dem das gesamte WWW beruht. Das heißt, es regelt das Zusammenspiel zwischen Web-Browser und Web-Server. Es wird bei jedem Mausklick auf einen Hyperlink aktiv und sorgt dafür, dass dem Browser die jeweils nächste gewünschte Information zur Verfügung gestellt wird. www.w3c.org/Protocols
Hub	Steht im Englischen für Radnabe, Mittelpunkt, Zentrum. Hier: zentrales Verbindungsgerät in einem Netz mit sternförmiger Topologie, das ankommende Datenpakete [ähnlich wie eine Mehrfachsteckdose die Spannung] an alle angeschlossenen Endgeräte verteilt.
IDE	<i>Integrated Device Electronics</i> > Schnittstelle für Massenspeicher, wie HDD, bei der sich die Controller-Elektronik im Laufwerk selbst befindet.
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> > Internationale Elektrotechnische Kommission (internationale Normungsorganisation, die alle Nationalen Elektrotechnischen Komitees umfaßt. Sie arbeitet und verabschiedet auf weltweiter Ebene elektrotechnische Normen; Sitz: Genf. www.iec.ch
IEEE	<i>The Institute of Electrical and Electronics Engineers</i> > (amerikanischer) Verband der Elektro- und Elektronik-Ingenieure (1884 gegründet, weit über 300.000 Mitglieder in etwa 150 Ländern). www.ieee.org
Interface	<i>Schnittstelle</i>

Internet	<i>International Network</i> > weltweiter Verbund von Rechnern und Rechnernetzen unterschiedlicher Größe und Architektur, die mit den verschiedensten Betriebssystemen arbeiten. Dabei werden dezentral auf Rechnern [Servern] Informationen hinterlegt, die von jedermann jederzeit mit seinem Rechner [Client] abgerufen werden können. Es entstand schrittweise in den letzten Jahrzehnten und bildet gegenwärtig die Basis für den weltweiten Informations-, Daten- und Dokumentenaustausch z.B. per E-Mail. Populärstes Netz der Welt, zur Zeit schätzungsweise 500 Millionen Nutzer. www.isoc.org
IP	<i>Internet Protocol</i> > Protokoll [Methode, Verfahrensweise] nach der Daten innerhalb eines Netzwerks, z.B. im Internet oder Intranet von einem Computer zu einem anderen gelangen. Jeder im Netz vorhandene Computer ist eindeutig durch seine IP-Adresse gekennzeichnet. Werden Daten von einem Computer zu einem anderen gesendet, werden sie in kleine Informationspakete zerlegt, von denen jedes sowohl die Adresse des Senders wie auch des Empfängers enthält. Diese Pakete können über das Netz auf unterschiedlichen Wegen in von der Sendesequenz abweichender Reihenfolge am Bestimmungsort ankommen. Dort werden sie von einem anderen Protokoll, dem sogenannten Transmission Control Protocol [TCP] wieder in die richtige Reihenfolge gebracht.
ISA	<i>Industry Standard Architecture</i> > Frühes Bussystem für Erweiterungssteckplätze für PC-Einsteckkarten. In modernen PC-Architekturen weitgehend durch PCI-Bus ersetzt.
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> > Internationale Organisation für Normung (weltweite Föderation nationaler Normungsinstitutionen von über 130 Ländern). Die Bezeichnung ISO ist kein Akronym des Namens der Organisation, sondern entspricht den ersten drei Buchstaben des griechischen Wortes isos, was soviel wie „gleich“ im Sinne von Gleichheit bedeutet. www.iso.ch
Jitter	Jitter ist ein Begriff zur Kennzeichnung zeitlicher Schwankungen zyklischer Ereignisse. Soll beispielsweise ein solches Ereignis alle 200µs auftreten und tritt es tatsächlich in den Grenzen von 198 bis 203µs in Erscheinung, dann ist für dieses Beispiel der Jitter 5µs. Jitter hat mannigfaltige Ursachen. Er entsteht in den Komponenten und Übertragungswegen von Netzen durch Rauschen, Übersprechen, elektromagnetische Interferenzen und zahlreiche andere zufällige Vorgänge. Speziell in der Automatisierungstechnik ist Jitter ein Maß für die Qualität von Synchronisation und Timing.
Latenzzeit	Synonym für Verzögerungszeit, Reaktionszeit, Durchlaufzeit bzw. Verweilzeit. Technisch gesehen die Zeitspanne, die ein Gerät benötigt, um auf ein Eingangsereignis am Ausgang zu reagieren oder auch die Zeit, die z.B. ein Datenpaket benötigt, um ein Netzwerk vom Sender zum Empfänger zu durchqueren oder die es in einem Netzwerkgerät verbleibt, ehe es weitergeleitet wird.
Laufzeitsystem	In der Computertechnik: Gesamtheit aller Routinen, die zur Ausführung eines in einer speziellen Programmiersprache geschriebenen Programms auf einer speziellen Plattform erforderlich sind [Interaktionen mit dem Betriebssystem, Speichermanagement, Fehlerbehandlungsroutinen u.v.a.m.]. In der Automatisierungstechnik gibt es zur Zeit praktisch für jeden Steuerungstyp [SPS, CNC, PC-basierte Systeme, Robotersteuerungen u.a.] eine große Zahl an herstellerspezifischen Laufzeitsystemen. In verteilten Automatisierungssystemen sind dadurch Flexibilität, Funktionalität und Leistungsfähigkeit der einzelnen Geräte oft nur eingeschränkt nutzbar. Abhilfe scheint sich hier durch den Einsatz der .Net-Technologie von Microsoft, wozu das CLR-Laufzeitsystem gehört, anzubahnen. In der Nachrichtentechnik bezeichnet ein Laufzeitsystem einen Filter zur Signalentzerrung, der Störungen beseitigt, die dadurch zustande kommen, dass sich, wie z.B. über Funk, Signale über verschiedenen langen Wege mit unterschiedlichen Laufzeiten ausbreiten, was beim Empfänger zu Signalverzerrungen führt.
LCD	<i>Liquid Crystal Display</i> > Flüssigkristallanzeige (LCDs leuchten nicht selbst sondern reflektieren nur das Umgebungslicht oder lassen Licht durchscheinen).
LED	<i>Light Emitting Diode</i> > lichtemittierende Diode (Leuchtdiode, Lumineszenzdiode)
Maschine	Als Maschine wird nach der Maschinenrichtlinie eine Gesamtheit miteinander verbundener Teile verstanden, von denen mindestens eines beweglich ist. Neben den mechanischen Komponenten gehören auch Betätigungs-, Steuer- und Energiekomponenten zu der Maschine. Siehe auch Automatisierungsobjekt.
MB	<i>Megabyte</i> > 1 MB = 220 bzw. 1.048.576 Bytes
Mkey	<i>Module Keypad</i> > Ist ein Sammelbegriff für die auf den Provit-Displayeinheiten befindlichen Tasten. Diese können mit den Mkey-Utilities frei parametrisiert werden.
Motherboard	<i>Mutterplatte</i> > Leiterplatte, auf der die Hauptkomponenten eines Computers wie CPU-Schaltkreis, Co-Prozessor, Arbeitsspeicher, Festwertspeicher für Firmware, Interface-Schaltkreise und Erweiterungs-Slots für Hardware-Erweiterungen untergebracht sind.
MTBF	<i>Mean Time Between Failures</i> > mittlere fehlerfreie Betriebszeit, mittlerer Ausfallabstand (mittlere Zeitspanne zwischen zwei Ausfällen bei reparierbaren Objekten, Zuverlässigkeitskenngröße).
MTC	<i>Maintenance Controller</i> > Eigenständiges Prozessorsystem in B&R-Industrie-PCs, das zusätzliche Funktionen zur Systemüberwachung und Verfügbarkeit zur Verfügung stellt.
MTCX	<i>Maintenance Controller Extended</i> > Der MTCX ist ein eigenständiges Prozessorsystem, das zusätzliche Funktionen, die in einem "normalen" PC nicht vorhanden sind, bei einem B&R-Industrie-PC zur Verfügung stellt. Der MTC kommuniziert mit dem B&R-Industrie-PC über den ISA-Bus (mittels Koppelregister).
Multitasking	Betriebsart in einem Betriebssystem bei der in einem Computer mehrere Aufgaben quasi gleichzeitig parallel ausgeführt werden.
NC	<i>Numerical Control</i> > Numerische Steuerung
Nennstrom	Der Nennstrom ist der Effektivwert des Phasenstroms (Strom in der Motorzuleitung) für die Entwicklung des Nennmoments bei Nenndrehzahl. Bei Einhaltung der Umgebungsbedingungen kann dies beliebig lang abgegeben werden.
Niederspannungsrichtlinie	Ziel der Richtlinie ist es, die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und Unfallgefahren zu minimieren. Betroffen sind alle elektrischen Betriebsmittel zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Umsetzen und Verbrauchen elektrischer Energie wie z.B. Generatoren, Kabel, Schalter, Steckdosen, Akkumulatoren, Transformatoren, Leuchten, Haushaltsgeräte und Motoren zur Verwendung bei einer Nennspannung zwischen 50 und 1000 Volt für Wechselstrom und zwischen 75 und 1500 Volt für Gleichstrom. Ausnahmen sind im Anhang II der Richtlinie geregelt. Solche Betriebsmittel dürfen entsprechend der Richtlinie nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie entsprechend dem in der europäischen Gemeinschaft gegebenen Stand der Sicherheitstechnik hergestellt sind, sie bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung sowie bestimmungsgemäßer Verwendung Menschen, Nutztiere und Sachwerte nicht gefährden, sie seitens des Herstellers einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden, eine entsprechende Konformitätserklärung vorliegt und sie mit der CE-Kennzeichnung versehen sind.
Objekt	Gegenstand oder Sache der realen Welt bzw. Gegenstand, Sache oder Person der/die Ziel einer Handlung ist oder der/die eine solche erduldet. In Verbindung mit Software eine abgeschlossene Einheit, die bestimmte Daten [Attribute] und Funktionen [Operationen] enthält.
OEM	<i>Original Equipment Manufacturer</i> > Unternehmen, das fremd- und eigengefertigte Komponenten in das eigene Erzeugnissortiment integriert und diese Produkte unter eigenem Namen vertreibt.

PnP	<i>Plug and Plug</i> > Ein Satz mit Spezifikationen, die von Intel entwickelt wurden. Der Einsatz von Plug and Play ermöglicht es, dass ein PC sich automatisch selbst konfigurieren kann, um mit Peripheriegeräten (z.B. Bildschirmen, Modems und Druckern) zu kommunizieren. Benutzer können ein Peripheriegerät anschließen (plug) und es anschließend sofort ausführen (play), ohne das System manuell konfigurieren zu müssen. Ein Plug and Play-PC benötigt ein BIOS, das Plug and Play unterstützt, sowie eine entsprechende Expansion Card.
POH	<i>Power On Hours</i> > siehe MTBF.
POST	<i>Power - On Self Test</i> > Ein Satz von Routinen, die im Nur-Lese-Speicher (ROM) des Computers abgelegt sind und verschiedene Systemkomponenten testen, z.B. den RAM, die Diskettenlaufwerke und die Tastatur, um deren ordnungsgemäße Verbindung und Betriebsbereitschaft festzustellen. Bei auftauchenden Problemen alarmieren die POST-Routinen den Benutzer durch mehrere Signaltöne oder Anzeigen einer häufig von einem Diagnosewert begleiteten Meldung auf der Standardausgabe oder dem Standardfehlergerät (in der Regel dem Bildschirm). Verläuft der Post erfolgreich, geht die Steuerung an den Urlader des Systems über.
POWERLINK	siehe ETHERNET Powerlink www.etherlink.org
Power Panel	Geräte dieser B&R Produktfamilie integrieren Visualisierung, Steuerung und Ein-/Ausgabekomponenten kompakt in einem Gerät.
Programmiersprachen	Sind künstliche Sprachen mit strenger Syntax, Semantik, sowie eindeutigen Symbolen und speziellen Wörtern zur Umsetzung [Notation] von Lösungsalgorithmen in ein von einem Computer ausführbares Programm. Seit dem Bau des ersten funktionsfähigen programmgesteuerten Rechners Z3 im Jahre 1941 wurden für die verschiedensten Anwendungsbereiche über tausend Programmiersprachen entwickelt. Eine Übersicht zu Evolution, Stand und Zukunft der Programmiersprachen geben die folgende Websites.
Protokoll	Umgangssprachlich: 1. Synonym für Aufzeichnung, Niederschrift [Sitzungs-, Tagungs-, Verhandlungsbericht], 2. festgeschriebenes Zeremoniell im diplomatischen Verkehr. Fachsprachlich im Bereich der Informationstechnik: Übereinkunft bezüglich der Datenformate und Steuerungsprozeduren für die Kommunikation zwischen zwei Geräten oder Prozessen. Das Protokoll kann hardware- oder softwaremäßig implementiert sein und betrifft im wesentlichen folgende Aspekte: die Art der Fehlererkennung, die angewandt wird, die Datenkompressionsmethode, sofern eine zur Anwendung kommt sowie die Art und Weise wie von der sendenden Einrichtung Sendungsende und von der empfangenden Einrichtung der Erhalt einer Nachricht angezeigt werden.
Provit	<i>Prozessvisualisierung Terminal</i> > Produktfamilienbezeichnung der B&R Industrie- PCs.
Provit 2000	Ist eine Produktfamilienbezeichnung für die B&R Industrie PCs. Wird in folgende Produkte unterteilt: IPC2000, IPC2001, Compact IPC (IPC2002) und dazugehörige Displayeinheiten.
Provit 5000	Ist eine Produktfamilienbezeichnung für die B&R Industrie PCs. Wird in folgende Produkte unterteilt: IPC5000, IPC5600, IPC5000C, IPC5600C und dazugehörige Displayeinheiten.
Prozess	Ablauf, Vorgang oder Verfahren, in dem zeitlich kontinuierlich oder diskontinuierlich quantitative oder qualitative Veränderungen der Parameter bzw. des Zustandes eines realen oder virtuellen Betrachtungsobjekts oder Mediums vollzogen werden. Jeder Prozess hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Je nach dem, was in einem Prozess geschieht bzw. welche Objekte das Prozessgeschehen zu erdulden haben, sind speziell in den Wirtschafts- und Industriebereichen eine Vielzahl von Prozessen zu unterscheiden wie z.B. Wertschöpfungsprozesse [Produktions- und Fertigungsprozesse], Dienstleistungsprozesse [Logistik-, Wartungs- und Instandhaltungsprozesse], Managementprozesse [Planungs- und Lenkungsprozesse] u.v.a.m. Speziell bei technologischen Prozessen unterscheidet man je nach der Kontinuität des Hauptprozessgeschehens kontinuierliche Prozesse, diskontinuierliche Prozesse und Charginprozesse.
RAM	<i>Random Access Memory</i> > Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Ein Halbleiterspeicher, der vom Mikroprozessor oder anderen Hardwarebausteinen gelesen und beschrieben werden kann. Auf die Speicherorte lässt sich in jeder beliebigen Reihenfolge zugreifen. Zwar erlauben auch die verschiedenen ROM-Speichertypen einen wahlfreien Zugriff, diese können aber nicht beschrieben werden. Unter dem Begriff RAM versteht man dagegen im allgemeinen einen flüchtigen Speicher, der sowohl gelesen als auch beschrieben werden kann.
Redundanz	<i>Überfluß, Übermaß, Überschuss</i> > funktionsbereites Vorhandensein von mehr als den zur Funktionserfüllung unbedingt erforderlichen technischen Mitteln, die der Erhöhung der funktionalen Sicherheit von Geräten und Systemen dienen.
Robustheit	<i>Widerstandsfähigkeit</i> > Fähigkeit eines Betrachtungsobjekts, auch bei Verletzung spezifizierter Randbedingungen vereinbarte Funktionen zu erbringen bzw. seine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Qualitativer Begriff, da keine exakten Bewertungskriterien existieren.
ROM	<i>Read Only Memory</i> > Nur-Lese-Speicher, Festwertspeicher, nicht-flüchtiger Speicher. Speicherinhalt wird beim Chiphersteller im letzten Maskenschritt eingeprägt [daher auch maskenprogrammierter ROM]. Er kann nur gelesen werden und bleibt ständig in gleicher Form erhalten.
RS232	<i>Recommended Standard Number 232</i> > älteste und am weitesten verbreitete Schnittstellen-Norm, auch V.24-Schnittstelle genannt; alle Signale sind auf Masse bezogen, so dass es sich um eine erdunsymmetrische Schnittstelle handelt. High-Pegel: -3 ... -30 V, Low-Pegel: +3 ... +30 V; zulässige Kabellänge bis 15 m, Übertragungsraten bis 20 kbit/s; für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen 2 Teilnehmern.
RS422	<i>Recommended Standard Number 422</i> > Schnittstellen-Norm, erdsymmetrischer Betrieb, dadurch höhere Störfestigkeit. High-Pegel: 2 ... -6 V, Low-Pegel: +2 ... +6 V; Vierdrahtverbindung [invertierend/nicht invertierend], zulässige Kabellänge bis 1200 m, Übertragungsraten bis 10 Mbit/s, 1 Sender kann simplex mit bis zu 10 Empfängern verkehren.
RS485	<i>Recommended Standard Number 485</i> > gegenüber RS422 erweiterte Schnittstellen-Norm; High-Pegel: 1,5 ... -6 V, Low-Pegel: +1,5 ... +6 V; Zweidrahtverbindung [Halbduplex-Betrieb] oder Vierdrahtverbindung [Voll duplex-Betrieb]; zulässige Kabellänge bis 1200 m, Übertragungsraten bis 10 Mbit/s. An einem RS485-Bus können bis zu 32 Teilnehmer [Sender/Empfänger] angeschlossen werden.
RTS	<i>Request To Send</i> > Ein in der seriellen Datenübertragung verwendetes Signal zur Anforderung der Sendeerlaubnis. Es wird z.B. von einem Computer an das angeschlossene Modem ausgegeben. Dem Signal RTS ist nach der Hardware-Spezifikation der Norm RS-232- C der Anschluss 4 zugeordnet.
RXD	<i>Receive (RX) Data</i> > Eine Leitung für die Übertragung der empfangenen, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Modem zu einem Computer. Bei Verbindungen nach der Norm RS-232-C wird RXD auf den Anschluss 3 des Steckverbinders geführt.
Schnittstelle	Aus Sicht der Hardware kennzeichnet eine Schnittstelle/Interface die Verbindungsstelle zweier Baugruppen/ Geräte/Systeme. Die beiderseits der Schnittstelle liegenden Einheiten sind über Schnittstellenleitungen miteinander verbunden, über die Daten, Adressen und Steuersignale ausgetauscht werden. Der Begriff Schnittstelle/ Interface umfaßt dabei die Gesamtheit der funktionellen, elektrischen und konstruktiven Bedingungen [Kodierung, Signalpegel, Steckerbelegung], welche die Verbindungsstelle zwischen den Baugruppen, Geräten bzw. Systemen charakterisiert. Je nach Art der Datenübertragung ist zwischen parallelen [z.B. Centronics, IEEE 488] und seriellen Schnittstellen [z.B. V.24, TTY, RS232, RS422, RS485] zu unterscheiden, die für unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten und Übertragungsentfernungen ausgelegt sind. Softwaremäßig gesehen bezeichnet der Begriff Schnittstelle/Interface den Übergang an der Grenze zwischen Programmbausteinen mit den dafür vereinbarten Regeln für die Übergabe von Programmdateien.

SDRAM	<i>Synchronous Dynamic Random Access Memory</i> > Eine Bauform dynamischer RAM Halbleiterbausteine, die mit höheren Taktraten betrieben werden kann.
Sensor	Einrichtung, die eine physikalische Größe auf der Grundlage eines physikalischen Effekts in ein weiterverarbeitbares elektrisches, pneumatisches oder auch hydraulisches Signal umwandelt. In modernen Sensoren ist in vielen Fällen eine Signalvorverarbeitung zur Ausschaltung störender Umgebungseinflüsse oder Nichtlinearitäten integriert. In der Automatisierungstechnik dienen Sensoren der Gewinnung der zur Prozeßführung notwendigen Informationen. Beispielsweise der Erfassung von Aggregat- und Maschinenzuständen oder zur Erfassung von Prozeßdaten wie Temperatur, Druck, Drehzahl, Füllstand, Durchfluß, Wege, Winkel u.ä.
Sicherheit	nach Brockhaus: das Nichtvorhandensein von Gefahr bzw. die Gewißheit eines Einzelnen, einer Gruppe oder eines Gemeinwesens, vor möglichen Gefahren geschützt zu sein. In Verbindung mit technischen Sachverhalten versteht man unter Sicherheit die Eigenschaft eines Betrachtungsobjekts [Komponente, Gerät, Maschine, Anlage] bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine nicht hinnehmbare Gefahr für Menschen, andere Einrichtungen oder die Umgebung darzustellen. Die Behandlung der Sicherheitsproblematik erfolgt unter zwei Gesichtspunkten: erstens unter der Prämisse, dass das Betrachtungsobjekt in beabsichtigter Weise funktioniert und betrieben wird, zweitens unter der Maßgabe, dass das Betrachtungsobjekt nicht ordnungsgemäß arbeitet bzw. einem Vollausfall unterliegt. Der erste Aspekt betrifft in erster Linie den Problembereich des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes und ist Gegenstand zahlreicher einschlägiger Gesetze Verordnungen und Vorschriften. Der zweite Aspekt dagegen ist Gegenstand technischer Sicherheitsbetrachtungen und Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, das Zustandekommen gefährlicher Systemzustände möglichst zu vermeiden bzw. das mit einem Funktionsausfall der Betrachtungseinheit verbundene Risiko, gemessen an Ausfallwahrscheinlichkeit und möglichem Schadensausmaß, so klein wie möglich, mindestens aber unterhalb eines vertretbaren Grenzniveaus zu halten. Diese Problematik wird unter der Überschrift funktionale Sicherheit thematisiert. Für die Automatisierungstechnik sind hier die Normen IEC 61508 bzw. EN 954-1 von Belang. Im übrigen gibt es weder in der Technik noch in der Natur eine absolute Sicherheit ohne jegliches Risiko.
Signal	Zeitlich veränderliche physikalische Größe, z.B. eine Spannung oder ein Strom, die einen Parameter hat [Amplitude, Frequenz, Phasenlage], der konkrete Aussagen über den Werteverlauf einer anderen physikalischen Größe zuläßt. Der entsprechende Parameter wird als Informationsparameter bezeichnet. Beispielsweise kann mit Hilfe eines Tachogenerators die Drehzahl einer mechanischen Welle gemessen, d.h. auf der Amplitude der Generatorausgangsspannung abgebildet werden. Die Amplitude der Ausgangsspannung ist hier der Informationsparameter, der im Sinne der gegebenen Signaldefinition Aussagen über den zeitlichen Werteverlauf der Drehzahl der Maschinenwelle zuläßt. Je nach Wertevorrat, zeitlicher Verfügbarkeit und Anzahl der Informationsparameter lassen sich verschiedene Signal-Grundtypen unterscheiden. Wichtig für die Automatisierungstechnik sind analoge, binäre und digitale Signale.
Software	wörtlich: weiche Ware; konkret: die Gesamtheit aller Programme einschließlich der dazu gehörenden Dokumentationen, die für den Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen, Rechnersystemen sowie computerbasierten Betriebsmitteln und Geräten jeglichen Couleurs zur Verfügung stehen. Die Software ist ergänzend zur Hardware der Träger der nichtapparativen funktionellen Bestandteile eines jeden Rechnersystems. Der Begriff Software als Bezeichnung für Computerprogramme wurde 1958 durch den Mathematiker John Tukey, Princeton University, geprägt. Software gliedert sich in Systemsoftware und Anwendungssoftware.
SPS	<i>Speicherprogrammierbare Steuerung</i> > rechnerbasiertes Steuergerät, dessen Funktionalität durch ein sogenanntes Anwenderprogramm festgelegt wird. Das Anwenderprogramm ist relativ einfach mittels genormter Fachsprachen [AWL, FBS, KOP, AS, ST] zu erstellen. Infolge ihrer seriellen Arbeitsweise sind ihre Reaktionszeiten vergleichsweise langsamer als bei VPS. SPS beherrschen heute in Form von Gerätefamilien mit abgestuften leistungsmäßig aufeinander abgestimmten Komponenten alle Ebenen einer Automatisierungshierarchie.
SRAM	<i>Static Random Access Memory</i> > Ein schneller RAM Halbleiterspeichertyp, der in Computern meist für den Cache-Speicher eingesetzt wird. Mittels Batteriepuffer kann der Inhalt dieses Speichers auch bei Stromausfall erhalten werden.
SVGA	<i>Super Video Graphics Array</i> > Grafikstandard mit einer Auflösung von mindestens 800x600 Bildpunkten [Pixels] und mindestens 256 Farben.
SXGA	<i>Super Extended Graphics Array</i> > Grafikstandard mit einer Bildauflösung von 1280 × 1024 Bildpunkten (Seitenverhältnis 5:4).
Task	Programmeinheit, der vom Echtzeitbetriebssystem eine eigene Priorität zugeteilt wurde. Sie enthält einen abgeschlossenen Prozeß und kann aus mehreren Modulen bestehen.
Touch Screen	Bildschirm mit Berührungssensoren zur Aktivierung eines angebotenen Menüs durch Antippen mit dem Finger.
TXD	<i>Transmit (TX) Data</i> > Eine Leitung für die Übertragung der gesendeten, seriellen Daten von einem Gerät zu einem anderen - z.B. von einem Computer zu einem Modem. Bei Verbindungen nach dem Standard RS-232-C wird TXD auf den Anschluss 2 des Steckverbinders geführt.
UART	<i>Universal Asynchronous Receiver/Transmitter</i> > universeller asynchroner Sende-/Empfangsbaustein
UDMA	<i>Ultra Direct Memory Access</i> > Ein spezieller IDE-Datenübertragungsmodus der hohe Datenübertragungsraten von Laufwerken ermöglicht. Es gibt mittlerweile einige Variationen. Der UDMA33 Modus überträgt 33 Megabyte pro Sekunde. Der UDMA66 Modus überträgt 66 Megabyte pro Sekunde. Der UDMA100 Modus überträgt 100 Megabyte pro Sekunde.
USB	<i>Universal Serial Bus</i> > universeller serieller Bus, preiswerte serielle Schnittstelle für PCs; IBM-Standard unterstützt von Intel, Compaq und Microsoft u.a. bekannten Firmen; bis zu 127 periphere Geräte [Maus, Tastatur, Drucker, Scanner, digitale Kameras, Modems, CDROM-Laufwerke, Telefone u.ä.] können an einen einzigen USB-Port angeschlossen werden. Über das vieradrige Buskabel werden die angeschlossenen Geräte auch mit Strom versorgt. Die seit 2001 auf dem Markt befindliche Version USB 2.0 erlaubt Datentransferraten bis 480 Mbps und ist damit auch zur Übertragung von Videodaten und für schnelle Festplatten geeignet. www.usb.org
USV	<i>unterbrechungsfreie Stromversorgung</i> > USV-Geräte und -Anlagen sind Anordnungen aus Schaltern, Gleich- und Wechselrichtern und insbesondere Batterien, die bei Netzspannungsausfall eine kontinuierliche Versorgung der Verbraucher über eine mehr oder weniger lange Zeit sicherstellen und ggfs. auch die Spannungsqualität verbessern.
UXGA	<i>Ultra Extended Graphics Array</i> > Üblicherweise eine Bildauflösung von 1600 × 1200 Bildpunkten (Seitenverhältnis 4:3, 12:9).
VDE	<i>Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.</i> www.vde.de

Verfügbarkeit	[V] Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich eine Anlage zu einem bestimmten Zeitpunkt in funktionsfähigem Zustand befindet. Zuverlässigkeitskenngröße für reparierbare Systeme. Die stationäre Verfügbarkeit wird durch folgende Formel beschrieben: $V = 1/[1 + \text{MDT}/\text{MTBF}]$. Maßnahmen zur Erzielung möglichst hoher Verfügbarkeitswerte zielen auf die Perfektionierung der Gesamtheit aller Qualitätssicherungsmaßnahmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit. Diese Verfahrensweise hat jedoch unter gegebenen Produktionsbedingungen ihre technischen und ökonomischen Grenzen. Wo sie bei Automatisierungsvorhaben zum Erreichen der geforderten Zuverlässigkeitskennwerte nicht ausreicht, kommt das Prinzip der Fehlertoleranz zur Anwendung, das auf der Basis kürzester Fehlererkennungs- und Rekonfigurationszeiten eine wesentliche Erhöhung der Verfügbarkeitswerte ermöglicht.
VGA	<i>Video Graphics Adapter</i>
Windows CE	Kompaktes 32-Bit-Betriebssystem mit Multitasking und Multithreading, das die Firma Microsoft speziell für den OEM-Markt entwickelt hat. Es ist auf unterschiedliche Prozessorienten portierbar und hat hohe Echtzeitfähigkeit. Die Entwicklungsumgebung verwendet bewährte, weit verbreitete Entwicklungswerkzeuge. Es ist eine offene und skalierbare Windows-Betriebssystem-Plattform für eine Vielzahl von Geräten. Beispiele für solche Geräte sind Handheld-PCs, digitale Funkempfänger, intelligente Handys, Multimediakonsolen u.ä. In embedded systems ist Windows CE hervorragend auch für den Einsatz in der Automatisierungstechnik geeignet.
XGA	<i>eXtended Graphics Array</i> > Ein erweiterter Standard für Grafik-Controller und die Bildschirmdarstellung, der 1990 von IBM eingeführt wurde. Dieser Standard unterstützt die Auflösung 640 * 480 mit 65.536 Farben oder die Auflösung 1024 * 768 mit 256 Farben. Dieser Standard wird hauptsächlich in Workstation-Systemen eingesetzt.
Zeichen	Aus dem Blickwinkel der Linguistik ist ein Zeichen ein [sinnlich wahrnehmbares] „Etwas“ [Anhaltspunkt, Hinweis, Marke, Indikator, Symbol o.ä.], das für „etwas Anderes“ [der realen oder virtuellen Welt] steht. Je nach Bezug zum bezeichneten Objekt spricht man von einem „Index“, wenn sich das Zeichen als Hinweis auf eine Ursache deuten lässt, von einem „Ikon“, wenn das Zeichen zum bezeichneten Objekt eine gewisse bildhafte Ähnlichkeit aufweist und von einem „Symbol“, wenn der Bezug zum bezeichneten Objekt willkürlich festgelegt [definiert] ist. Technisch-fachsprachlich gesehen [vgl. DIN 44300] sind Zeichen Elemente aus einer zur Darstellung von Information vereinbarten endlichen Menge, dem Zeichenvorrat [Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen u.ä.].
Zuverlässigkeit	Repräsentiert sich in technischem Kontext als Verlässlichkeit im Hinblick auf ein kontinuierliches korrektes Erbringen vereinbarter Leistungen innerhalb definierter Wahrscheinlichkeitsgrenzen und Zeitabschnitte. Charakteristische Zuverlässigkeitskennwerte sind: bei Anlagen die Verfügbarkeit V, bei reparierbaren Geräten die mittlere fehlerfreie Betriebszeit MTBF, bei nicht reparierbaren Systemen die mittlere Lebensdauer MTTF und bei Bauelementen bzw. Komponenten die sogenannte Ausfallrate.

Abbildung 1:	Konfiguration - Grundsistem.....	17
Abbildung 2:	Konfiguration - Software, Zubehör.....	18
Abbildung 3:	Temperatursensorpositionen.....	19
Abbildung 4:	Spannungsversorgung für Systemeinheiten.....	21
Abbildung 5:	Schnittstellen Übersicht mit gestecktem I/O Board.....	22
Abbildung 6:	Erdungsanschluss.....	23
Abbildung 7:	5PC510.SX01-00 - Abmessungen.....	34
Abbildung 8:	5PC510.SX01-00 - Bohrschablone.....	35
Abbildung 9:	CAN Terminierungsschalter.....	50
Abbildung 10:	CAN Terminierungsschalter.....	54
Abbildung 11:	RS232/422/485 Interface - Betrieb im RS485 Modus.....	59
Abbildung 12:	Serielle Schnittstelle COM Abschlusswiderstand.....	60
Abbildung 13:	5MMHDD.0250-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	64
Abbildung 14:	5MMHDD.0500-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	67
Abbildung 15:	5MMSSD.0060-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	69
Abbildung 16:	5MMSSD.0060-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	71
Abbildung 17:	5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≤ C0.....	73
Abbildung 18:	5MMSSD.0128-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm Rev. ≥ D0.....	74
Abbildung 19:	5MMSSD.0180-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	76
Abbildung 20:	5MMSSD.0256-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	78
Abbildung 21:	Befestigungslasche.....	79
Abbildung 22:	Einbaulage 0°.....	80
Abbildung 23:	Einbaulagen -90° und +90°.....	80
Abbildung 24:	Einbaulage 180°.....	81
Abbildung 25:	Luftzirkulationsabstände.....	82
Abbildung 26:	Biegeradius Kabelanschluss.....	83
Abbildung 27:	Funktionserdesymbol.....	84
Abbildung 28:	Erdungskonzept.....	84
Abbildung 29:	Einstellungen für Passmark BurnIn Pro V4 anhand eines APC810 2 Slot mit DVD.....	86
Abbildung 30:	Testübersicht eines APC810 2 Slot mit DVD.....	87
Abbildung 31:	Ein Automation Panel 900 über DVI onboard (Symbolfoto).....	90
Abbildung 32:	Ein Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto).....	92
Abbildung 33:	Ein Automation Panel 800 über SDL onboard (Symbolfoto).....	94
Abbildung 34:	Ein AP900 und ein AP800 über SDL onboard (Symbolfoto).....	96
Abbildung 35:	Vier Automation Panel 900 über SDL onboard (Symbolfoto).....	97
Abbildung 36:	Anschluss von USB Peripheriegeräten lokal am APC510.....	99
Abbildung 37:	Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP900 über DVI.....	100
Abbildung 38:	Anschluss von USB Peripheriegeräten remote am AP800/900 über SDL.....	100
Abbildung 39:	Bootscreen.....	103
Abbildung 40:	US15W Main - Menü.....	105
Abbildung 41:	US15W OEM Features - Menü.....	106
Abbildung 42:	US15W OEM Features - CPU Board Features.....	107
Abbildung 43:	US15W OEM Features - CPU Board Features - LPC Devices.....	108
Abbildung 44:	US15W OEM Features - CPU Board Features - Statistical Values.....	109
Abbildung 45:	US15W OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values.....	110
Abbildung 46:	US15W OEM Features - CPU Board Features - CPU Board Monitor.....	111
Abbildung 47:	US15W OEM Features - System Unit Features.....	112
Abbildung 48:	US15W OEM Features - System Unit Features - LPC Devices.....	113
Abbildung 49:	US15W OEM Features - System Unit Features - Statistical Values.....	114
Abbildung 50:	US15W OEM Features - System Unit Features - Temperature Values.....	115
Abbildung 51:	US15W OEM Features - I/O Board Features.....	116
Abbildung 52:	US15W OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices.....	117
Abbildung 53:	US15W OEM Features - I/O Board Features - Statistical Values.....	118
Abbildung 54:	US15W OEM Features - I/O Board Features - Temperature Values.....	119
Abbildung 55:	US15W OEM Features - I/O Board Features - Panel Control.....	120
Abbildung 56:	US15W OEM Features - IF Board Features.....	121
Abbildung 57:	US15W OEM Features - IF Board Features - Statistical Values.....	122

Abbildung 58:	US15W OEM Features - Memory Module Features.....	123
Abbildung 59:	US15W Advanced - Menü.....	124
Abbildung 60:	US15W Advanced - RAM Configuration.....	125
Abbildung 61:	US15W Advanced - Boot Configuration.....	126
Abbildung 62:	US15W Advanced - Peripheral Configuration.....	127
Abbildung 63:	US15W Advanced - IDE Configuration.....	128
Abbildung 64:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master.....	129
Abbildung 65:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave.....	130
Abbildung 66:	US15W Advanced - Video Configuration.....	131
Abbildung 67:	US15W Advanced - USB Configuration.....	132
Abbildung 68:	US15W Advanced - SDIO Configuration.....	133
Abbildung 69:	US15W Advanced - ACPI Table/Features Control.....	134
Abbildung 70:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 1.....	135
Abbildung 71:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 2.....	137
Abbildung 72:	US15W Advanced - Console Redirection.....	139
Abbildung 73:	US15W Security - Menü.....	141
Abbildung 74:	US15W Security - Set Supervisor Password.....	142
Abbildung 75:	US15W Security - Set User Password.....	143
Abbildung 76:	US15W Power - Menü.....	144
Abbildung 77:	US15W Power - Advanced - CPU Control.....	145
Abbildung 78:	US15W Power - Advanced - CPU Control - Thermal Trip Points Settings.....	147
Abbildung 79:	US15W Power - Platform Power Management.....	148
Abbildung 80:	US15W Boot - Menü.....	149
Abbildung 81:	US15W Boot - Legacy.....	150
Abbildung 82:	US15W Boot - Legacy - Boot Type Order.....	151
Abbildung 83:	US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive.....	152
Abbildung 84:	US15W Boot - Legacy - USB.....	152
Abbildung 85:	US15W Boot - Legacy - Others.....	153
Abbildung 86:	US15W Exit - Menü.....	154
Abbildung 87:	Interrupt Routing mit aktiviertem APIC - ab BIOS Version N0.15.....	162
Abbildung 88:	BIOS und MTCX Softwareversionen.....	163
Abbildung 89:	BIOS und MTCX Softwareversionen - Control Center.....	164
Abbildung 90:	ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolfoto).....	180
Abbildung 91:	ADI Development Kit Screenshots (Version 3.60).....	182
Abbildung 92:	ADI .NET SDK Screenshots (Version 2.00).....	184
Abbildung 93:	B&R Key Editor Screenshots Version 3.40 (Symbolfoto).....	186
Abbildung 94:	5CFCRD.xxxx-06 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten.....	198
Abbildung 95:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I.....	198
Abbildung 96:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Lesen - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06... ..	199
Abbildung 97:	ATTO Disk Benchmark v2.34 Vergleich Schreiben - 5CFCRD.xxxx-04 mit 5CFCRD.xxxx-06.....	199
Abbildung 98:	5CFCRD.xxxx-03 - Temperatur Luftfeuchtediagramm CompactFlash Karten.....	202
Abbildung 99:	Abmessungen CompactFlash Karte Typ I.....	202
Abbildung 100:	5MD900.USB2-02 - Schnittstellen.....	204
Abbildung 101:	5MD900.USB2-02 - Abmessungen.....	206
Abbildung 102:	Abmessungen USB Media Drive mit Frontklappe.....	206
Abbildung 103:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe.....	207
Abbildung 104:	5MD900.USB2-02 - Einbaulage	207
Abbildung 105:	5A5003.03 - Abmessungen.....	208
Abbildung 106:	Frontklappenmontage und Klemmdicke.....	209
Abbildung 107:	Einbauausschnitt USB Media Drive mit Frontklappe.....	209
Abbildung 108:	5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm.....	211
Abbildung 109:	Biegeradiusspezifikation.....	213
Abbildung 110:	5CADVI.0xxx-00 - Abmessungen.....	213
Abbildung 111:	5CADVI.0xxx-00 - Belegung.....	214
Abbildung 112:	Biegeradiusspezifikation.....	216
Abbildung 113:	5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen.....	216

Abbildung 114:	5CASDL.0xxx-00 - Belegung.....	217
Abbildung 115:	Biegeradiusspezifikation.....	219
Abbildung 116:	5CASDL.0xxx-01 - Abmessungen.....	219
Abbildung 117:	5CASDL.0xxx-01 - Belegung.....	220
Abbildung 118:	Biegeradiusspezifikation.....	222
Abbildung 119:	5CASDL.0xxx-03 - Abmessungen.....	222
Abbildung 120:	5CASDL.0xxx-03 - Belegung.....	223
Abbildung 121:	Biegeradiusspezifikation mit Extender.....	225
Abbildung 122:	5CASDL.0xx0-13 - Abmessungen.....	225
Abbildung 123:	5CASDL.0xx0-13 - Belegung.....	226
Abbildung 124:	Beispiel für die Signalrichtung für das SDL Kabel flex mit Extender.....	227
Abbildung 125:	5CAUSB.00xx-00 - Belegung USB Kabel.....	228
Abbildung 126:	9A0014.xx - Belegung RS232 Kabel	230
Abbildung 127:	Batterie entfernen.....	235
Abbildung 128:	Batteriehandhabung.....	235
Abbildung 129:	Batteriepolarität.....	235
Abbildung 130:	CompactFlash + Auswerfer (Symbolfoto).....	236
Abbildung 131:	Position des MTCX Controllers.....	237

Tabelle 1:	Umweltgerechte Werkstofftrennung.....	12
Tabelle 2:	Beschreibung der verwendeten Sicherheitshinweise.....	13
Tabelle 3:	Nennmaßbereiche.....	13
Tabelle 4:	Temperatursensorpositionen.....	19
Tabelle 5:	Übersicht Luftfeuchtigkeitsangaben der Einzelkomponenten.....	20
Tabelle 6:	Spannungsversorgungsanschluss Power 24 VDC.....	23
Tabelle 7:	Pinbelegung COM1.....	24
Tabelle 8:	Ethernet Anschluss (ETH).....	24
Tabelle 9:	USB1, USB2 Anschluss.....	25
Tabelle 10:	Batterie.....	26
Tabelle 11:	Bedeutung Batteriestatus.....	26
Tabelle 12:	CompactFlash Slot.....	27
Tabelle 13:	SD Memory Card Slot.....	27
Tabelle 14:	Power Taster.....	28
Tabelle 15:	Reset Taster.....	28
Tabelle 16:	Daten Status LEDs.....	29
Tabelle 17:	Interface Board Einschub.....	30
Tabelle 18:	5PC510.SX01-00 - Bestelldaten.....	31
Tabelle 19:	5PC510.SX01-00 - Technische Daten.....	32
Tabelle 20:	5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Bestelldaten.....	36
Tabelle 21:	5PP5CP.US15-00, 5PP5CP.US15-01, 5PP5CP.US15-02 - Technische Daten.....	36
Tabelle 22:	5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Bestelldaten.....	38
Tabelle 23:	5MMDDR.0512-01, 5MMDDR.1024-01, 5MMDDR.2048-01 - Technische Daten.....	38
Tabelle 24:	5PP5IF.CETH-00 - Bestelldaten.....	39
Tabelle 25:	5PP5IF.CETH-00 - Technische Daten.....	39
Tabelle 26:	5PP5IF.CETH-00 - Ethernet Anschluss.....	40
Tabelle 27:	5PP5IF.CHDA-00 - Bestelldaten.....	41
Tabelle 28:	5PP5IF.CHDA-00 - Technische Daten.....	41
Tabelle 29:	MIC, Line IN, Line OUT.....	42
Tabelle 30:	5PP5IF.FETH-00 - Bestelldaten.....	43
Tabelle 31:	5PP5IF.FETH-00 - Technische Daten.....	43
Tabelle 32:	5PP5IF.FETH-00 - Ethernet Anschluss.....	44
Tabelle 33:	5PP5IF.FPLM-00 - Bestelldaten.....	45
Tabelle 34:	5PP5IF.FPLM-00 - Technische Daten.....	45
Tabelle 35:	POWERLINK Interface Board 2port Anschluss.....	46
Tabelle 36:	Status/Error LED - Betriebsmodus Ethernet TCP/IP.....	46
Tabelle 37:	Status/Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V1.....	46
Tabelle 38:	Status/Error LED als Error LED - Betriebsmodus POWERLINK V2.....	47
Tabelle 39:	Status/Error LED als Status LED - Betriebsmodus POWERLINK.....	47
Tabelle 40:	Status/Error LED als Error LED - System Stopp Fehlercodes.....	48
Tabelle 41:	5PP5IF.FCAN-00 - Bestelldaten.....	49
Tabelle 42:	5PP5IF.FCAN-00 - Technische Daten.....	49
Tabelle 43:	5PP5IF.FCAN-00 - CAN Schnittstelle.....	50
Tabelle 44:	5PP5IF.FCAN-00 - Status LEDs.....	50
Tabelle 45:	5PP5IF.FX2X-00 - Bestelldaten.....	51
Tabelle 46:	5PP5IF.FX2X-00 - Technische Daten.....	51
Tabelle 47:	5PP5IF.FX2X-00 - X2X Schnittstelle.....	52
Tabelle 48:	5PP5IF.FX2X-00 - Status LEDs.....	52
Tabelle 49:	5PP5IF.FXCM-00 - Bestelldaten.....	53
Tabelle 50:	5PP5IF.FXCM-00 - Technische Daten.....	53
Tabelle 51:	5PP5IF.FCAN-00 - CAN Schnittstelle.....	54
Tabelle 52:	5PP5IF.FX2X-00 - X2X Schnittstelle.....	54
Tabelle 53:	5PP5IF.FXCM-00 - Status LEDs.....	54
Tabelle 54:	5PP5IO.GMAC-00 - Bestelldaten.....	55
Tabelle 55:	5PP5IO.GMAC-00 - Technische Daten.....	55
Tabelle 56:	Panel Anschluss - DVI, SDL.....	56
Tabelle 57:	Pinbelegung DVI Anschluss.....	56

Tabelle 58:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	57
Tabelle 59:	Kabellängen und Auflösungen bei DVI Übertragung.....	57
Tabelle 60:	Pinbelegung COM2.....	57
Tabelle 61:	RS232/422/485 - I/O Adresse und IRQ.....	57
Tabelle 62:	RS232 Buslänge und Übertragungsrate.....	58
Tabelle 63:	RS232 Kabel Anforderungen.....	58
Tabelle 64:	RS422 Buslänge und Übertragungsrate.....	58
Tabelle 65:	RS422 Kabel Anforderungen.....	58
Tabelle 66:	RS485 Buslänge und Übertragungsrate.....	58
Tabelle 67:	RS485 Kabel Anforderungen.....	59
Tabelle 68:	RS485 Buslänge und Übertragungsrate.....	59
Tabelle 69:	RS485 Kabel Anforderungen.....	59
Tabelle 70:	USB3, USB4 Anschluss.....	60
Tabelle 71:	MIC, Line IN, Line OUT.....	60
Tabelle 72:	Optionaler SATA Anschluss.....	61
Tabelle 73:	5MMHDD.0250-00 - Bestelldaten.....	62
Tabelle 74:	5MMHDD.0250-00 - Technische Daten.....	62
Tabelle 75:	5MMHDD.0500-00 - Bestelldaten.....	65
Tabelle 76:	5MMHDD.0500-00 - Technische Daten.....	65
Tabelle 77:	5MMSSD.0060-00 - Bestelldaten.....	68
Tabelle 78:	5MMSSD.0060-00 - Technische Daten.....	68
Tabelle 79:	5MMSSD.0060-01 - Bestelldaten.....	70
Tabelle 80:	5MMSSD.0060-01 - Technische Daten.....	70
Tabelle 81:	5MMSSD.0128-01 - Bestelldaten.....	72
Tabelle 82:	5MMSSD.0128-01, 5MMSSD.0128-01 - Technische Daten.....	72
Tabelle 83:	5MMSSD.0180-00 - Bestelldaten.....	75
Tabelle 84:	5MMSSD.0180-00 - Technische Daten.....	75
Tabelle 85:	5MMSSD.0256-00 - Bestelldaten.....	77
Tabelle 86:	5MMSSD.0256-00 - Technische Daten.....	77
Tabelle 87:	Auswertungsbeispiel anhand eines APC810 2 Slot.....	88
Tabelle 88:	Auswahl der Displayeinheiten.....	89
Tabelle 89:	Linkbaugruppen.....	90
Tabelle 90:	Kabel für DVI Konfigurationen.....	90
Tabelle 91:	Mögliche Automation Panel Geräte, Auflösungen und Segmentlängen.....	91
Tabelle 92:	Linkbaugruppen.....	92
Tabelle 93:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	92
Tabelle 94:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	93
Tabelle 95:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	94
Tabelle 96:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	94
Tabelle 97:	Linkbaugruppen.....	96
Tabelle 98:	Linkbaugruppen.....	97
Tabelle 99:	Kabel für SDL Konfigurationen.....	97
Tabelle 100:	Kabellängen und Auflösungen bei SDL Übertragung.....	98
Tabelle 101:	Biosrelevante Tasten beim POST.....	104
Tabelle 102:	Biosrelevante Tasten im BIOS Menü.....	104
Tabelle 103:	US15W Main - Menü Einstellmöglichkeiten.....	105
Tabelle 104:	US15W OEM Features - Menü Einstellmöglichkeiten.....	106
Tabelle 105:	US15W OEM Features - CPU Board Features Einstellmöglichkeiten.....	107
Tabelle 106:	US15W OEM Features - CPU Board Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten.....	108
Tabelle 107:	US15W OEM Features - CPU Board Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten.....	109
Tabelle 108:	US15W OEM Features - CPU Board Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten...	110
Tabelle 109:	US15W OEM Features - CPU Board Features - CPU Board Monitor Einstellmöglichkeiten....	111
Tabelle 110:	US15W OEM Features - System Unit Features Einstellmöglichkeiten.....	112
Tabelle 111:	US15W OEM Features - System Unit Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten.....	113
Tabelle 112:	US15W OEM Features - System Unit Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten.....	114
Tabelle 113:	US15W OEM Features - System Unit Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten...	115
Tabelle 114:	US15W OEM Features - I/O Board Features Einstellmöglichkeiten.....	116

Tabelle 115:	US15W OEM Features - I/O Board Features - LPC Devices Einstellmöglichkeiten.....	117
Tabelle 116:	US15W OEM Features - I/O Board Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten.....	118
Tabelle 117:	US15W OEM Features - I/O Board Features - Temperature Values Einstellmöglichkeiten.....	119
Tabelle 118:	US15W OEM Features - I/O Board Features - Panel Control Einstellmöglichkeiten.....	120
Tabelle 119:	US15W OEM Features - IF Board Features Einstellmöglichkeiten.....	121
Tabelle 120:	US15W OEM Features - IF Board Features - Statistical Values Einstellmöglichkeiten.....	122
Tabelle 121:	US15W OEM Features - Memory Module Features Einstellmöglichkeiten.....	123
Tabelle 122:	US15W Advanced - Menü Einstellmöglichkeiten.....	124
Tabelle 123:	US15W Advanced - RAM Configuration Einstellmöglichkeiten.....	125
Tabelle 124:	US15W Advanced - Boot Configuration Einstellmöglichkeiten.....	126
Tabelle 125:	US15W Advanced - Peripheral Configuration Einstellmöglichkeiten.....	127
Tabelle 126:	US15W Advanced - IDE Configuration Einstellmöglichkeiten.....	128
Tabelle 127:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Master Einstellmöglichkeiten.....	129
Tabelle 128:	US15W Advanced - IDE Configuration - Channel 1 Slave Einstellmöglichkeiten.....	130
Tabelle 129:	US15W Advanced - Video Configuration Einstellmöglichkeiten.....	131
Tabelle 130:	US15W Advanced - USB Configuration Einstellmöglichkeiten.....	132
Tabelle 131:	US15W Advanced - SDIO Configuration Einstellmöglichkeiten.....	133
Tabelle 132:	US15W Advanced - ACPI Table/Features Control Einstellmöglichkeiten.....	134
Tabelle 133:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 1 Einstellmöglichkeiten.....	135
Tabelle 134:	US15W Advanced - PCI Express Root Port 2 Einstellmöglichkeiten.....	137
Tabelle 135:	US15W Advanced - Console Redirection Einstellmöglichkeiten.....	139
Tabelle 136:	US15W Security - Menü Einstellmöglichkeiten.....	141
Tabelle 137:	US15W Security - Set Supervisor Password Einstellmöglichkeiten.....	142
Tabelle 138:	US15W Security - Set User Password Einstellmöglichkeiten.....	143
Tabelle 139:	US15W Power - Menü Einstellmöglichkeiten.....	144
Tabelle 140:	US15W Power - Advanced CPU Control Einstellmöglichkeiten.....	145
Tabelle 141:	US15W Power - Advanced CPU Control - Thermal Trip Points Settings Einstellmöglichkeiten.....	147
Tabelle 142:	US15W Power - Platform Power Management Einstellmöglichkeiten.....	148
Tabelle 143:	US15W Boot - Menü Einstellmöglichkeiten.....	149
Tabelle 144:	US15W Boot - Legacy Einstellmöglichkeiten.....	150
Tabelle 145:	US15W Boot - Legacy - Boot Type Order Einstellmöglichkeiten.....	151
Tabelle 146:	US15W Boot - Legacy - Hard Disk Drive Einstellmöglichkeiten.....	152
Tabelle 147:	US15W Boot - Legacy - USB Einstellmöglichkeiten.....	153
Tabelle 148:	US15W Boot - Legacy - Others Einstellmöglichkeiten.....	153
Tabelle 149:	US15W Exit - Menü Einstellmöglichkeiten.....	154
Tabelle 150:	US15W - Main Profileinstellungsübersicht.....	155
Tabelle 151:	US15W - OEM Features Profileinstellungsübersicht.....	155
Tabelle 152:	US15W - CPU Board Features Profileinstellungsübersicht.....	155
Tabelle 153:	US15W - System Unit Features Profileinstellungsübersicht.....	156
Tabelle 154:	US15W - I/O Board Features Profileinstellungsübersicht.....	156
Tabelle 155:	US15W - IF Board Features Profileinstellungsübersicht.....	156
Tabelle 156:	US15W - Memory Module Features Profileinstellungsübersicht.....	157
Tabelle 157:	US15W - RAM Configuration Profileinstellungsübersicht.....	157
Tabelle 158:	US15W - Boot Configuration Profileinstellungsübersicht.....	157
Tabelle 159:	US15W - Peripheral Configuration Profileinstellungsübersicht.....	157
Tabelle 160:	US15W - IDE Configuration Profileinstellungsübersicht.....	157
Tabelle 161:	US15W - Video Configuration Profileinstellungsübersicht.....	158
Tabelle 162:	US15W - USB Configuration Profileinstellungsübersicht.....	158
Tabelle 163:	US15W - SDIO Configuration Profileinstellungsübersicht.....	158
Tabelle 164:	US15W - ACPI Table/Features Control Profileinstellungsübersicht.....	158
Tabelle 165:	US15W - PCI Express Root Port 1 Profileinstellungsübersicht.....	158
Tabelle 166:	US15W - PCI Express Root Port 2 Profileinstellungsübersicht.....	159
Tabelle 167:	US15W - Console Redirection Profileinstellungsübersicht.....	159
Tabelle 168:	US15W - Power Profileinstellungsübersicht.....	159
Tabelle 169:	US15W - Advanced CPU Control Profileinstellungsübersicht.....	159
Tabelle 170:	US15W - Platform Power Management Profileinstellungsübersicht.....	160
Tabelle 171:	US15W - Boot Profileinstellungsübersicht.....	160

Tabelle 172:	RAM-Adressbelegung.....	161
Tabelle 173:	I/O-Adressbelegung.....	161
Tabelle 174:	IRQ Interrupt Zuweisungen PIC Mode.....	161
Tabelle 175:	IRQ Interrupt Zuweisungen APIC Mode.....	162
Tabelle 176:	5SWWI7.0100-ENG, 5SWWI7.1100-ENG, 5SWWI7.0100-GER, 5SWWI7.1100-GER, 5SWWI7.0300-MUL, 5SWWI7.1300-MUL - Bestelldaten.....	166
Tabelle 177:	5SWWI7.0537-ENG, 5SWWI7.1537-ENG, 5SWWI7.0737-MUL, 5SWWI7.1737-MUL - Bestelldaten.....	168
Tabelle 178:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 7.....	169
Tabelle 179:	5SWWXP.0600-ENG, 5SWWXP.0600-GER, 5SWWXP.0600-MUL - Bestelldaten.....	171
Tabelle 180:	5SWWXP.0737-ENG - Bestelldaten.....	173
Tabelle 181:	Gerätefunktionen unter Windows Embedded Standard 2009.....	173
Tabelle 182:	5SWWCE.0837-ENG - Bestelldaten.....	175
Tabelle 183:	Eigenschaften Windows CE 6.0.....	175
Tabelle 184:	1A4600.10-5, 1A4601.06-5, 1A4601.06-T - Bestelldaten.....	177
Tabelle 185:	5SWLIN.0137-MUL - Bestelldaten.....	178
Tabelle 186:	Auflösungen Debian.....	178
Tabelle 187:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Bestelldaten.....	190
Tabelle 188:	0AC201.91, 4A0006.00-000 - Technische Daten.....	190
Tabelle 189:	0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten.....	192
Tabelle 190:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten.....	192
Tabelle 191:	0TB1208.3100 - Bestelldaten.....	193
Tabelle 192:	0TB1208.3100 - Technische Daten.....	193
Tabelle 193:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Bestelldaten.....	196
Tabelle 194:	5CFCRD.0512-06, 5CFCRD.1024-06, 5CFCRD.2048-06, 5CFCRD.4096-06, 5CFCRD.8192-06, 5CFCRD.016G-06, 5CFCRD.032G-06 - Technische Daten.....	196
Tabelle 195:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Bestelldaten.....	200
Tabelle 196:	5CFCRD.0064-03, 5CFCRD.0128-03, 5CFCRD.0256-03, 5CFCRD.0512-03, 5CFCRD.1024-03, 5CFCRD.2048-03, 5CFCRD.4096-03, 5CFCRD.8192-03 - Technische Daten.....	201
Tabelle 197:	5MD900.USB2-02 - Bestelldaten.....	204
Tabelle 198:	5MD900.USB2-02 - Technische Daten.....	204
Tabelle 199:	5MD900.USB2-02 - Lieferumfang.....	207
Tabelle 200:	5A5003.03 - Bestelldaten.....	208
Tabelle 201:	5A5003.03 - Technische Daten.....	208
Tabelle 202:	5A5003.03 - Lieferumfang.....	208
Tabelle 203:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten.....	210
Tabelle 204:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten.....	210
Tabelle 205:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Bestelldaten.....	212
Tabelle 206:	5CADVI.0018-00, 5CADVI.0050-00, 5CADVI.0100-00 - Technische Daten.....	212
Tabelle 207:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten.....	215
Tabelle 208:	5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten.....	215
Tabelle 209:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Bestelldaten.....	218
Tabelle 210:	5CASDL.0018-01, 5CASDL.0050-01, 5CASDL.0100-01, 5CASDL.0150-01 - Technische Daten.....	218
Tabelle 211:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Bestelldaten.....	221
Tabelle 212:	5CASDL.0018-03, 5CASDL.0050-03, 5CASDL.0100-03, 5CASDL.0150-03, 5CASDL.0200-03, 5CASDL.0250-03, 5CASDL.0300-03 - Technische Daten.....	221
Tabelle 213:	Aufbau SDL Kabel flex 5CASDL.0xxx-03.....	223
Tabelle 214:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Bestelldaten.....	224
Tabelle 215:	5CASDL.0300-13, 5CASDL.0400-13, 5CASDL.0430-13 - Technische Daten.....	224
Tabelle 216:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Bestelldaten.....	228
Tabelle 217:	5CAUSB.0018-00, 5CAUSB.0050-00 - Technische Daten.....	228
Tabelle 218:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Bestelldaten.....	229

Tabelle 219:	9A0014.02, 9A0014.05, 9A0014.10 - Technische Daten.....	229
Tabelle 220:	5SWHMI.0000-00 - Bestelldaten.....	231
Tabelle 221:	Bedeutung Batteriestatus.....	234
Tabelle 222:	Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen.....	238

0AC201.91.....	190
0TB103.9.....	192
0TB103.91.....	192
0TB1208.3100.....	193
1A4600.10-5.....	177
1A4601.06-5.....	177
1A4601.06-T.....	177
4A0006.00-000.....	190
5A5003.03.....	208
5CADVI.0018-00.....	212
5CADVI.0050-00.....	212
5CADVI.0100-00.....	212
5CASDL.0018-00.....	215
5CASDL.0018-01.....	218
5CASDL.0018-03.....	221
5CASDL.0050-00.....	215
5CASDL.0050-01.....	218
5CASDL.0050-03.....	221
5CASDL.0100-00.....	215
5CASDL.0100-01.....	218
5CASDL.0100-03.....	221
5CASDL.0150-00.....	215
5CASDL.0150-01.....	218
5CASDL.0150-03.....	221
5CASDL.0200-00.....	215
5CASDL.0200-03.....	221
5CASDL.0250-00.....	215
5CASDL.0250-03.....	221
5CASDL.0300-00.....	215
5CASDL.0300-03.....	221
5CASDL.0300-13.....	224
5CASDL.0400-13.....	224
5CASDL.0430-13.....	224
5CAUSB.0018-00.....	228
5CAUSB.0050-00.....	228
5CFCRD.0064-03.....	200
5CFCRD.0128-03.....	200
5CFCRD.016G-06.....	196
5CFCRD.0256-03.....	200
5CFCRD.032G-06.....	196
5CFCRD.0512-03.....	200
5CFCRD.0512-06.....	196
5CFCRD.1024-03.....	200
5CFCRD.1024-06.....	196
5CFCRD.2048-03.....	200
5CFCRD.2048-06.....	196
5CFCRD.4096-03.....	200
5CFCRD.4096-06.....	196
5CFCRD.8192-03.....	200
5CFCRD.8192-06.....	196
5MD900.USB2-02.....	204
5MMDDR.0512-01.....	38
5MMDDR.1024-01.....	38
5MMDDR.2048-01.....	38
5MMHDD.0250-00.....	62
5MMHDD.0500-00.....	65
5MMSSD.0060-00.....	68
5MMSSD.0060-01.....	70
5MMSSD.0128-01.....	72
5MMSSD.0180-00.....	75
5MMSSD.0256-00.....	77
5MMUSB.2048-01.....	210

5MMUSB.4096-01.....	210
5PC510.SX01-00.....	31
5PP5CP.US15-00.....	36
5PP5CP.US15-01.....	36
5PP5CP.US15-02.....	36
5PP5IF.CETH-00.....	39
5PP5IF.CHDA-00.....	41
5PP5IF.FCAN-00.....	49
5PP5IF.FETH-00.....	43
5PP5IF.FPLM-00.....	45
5PP5IF.FX2X-00.....	51
5PP5IF.FXCM-00.....	53
5PP5IO.GMAC-00.....	55
5SWHMI.0000-00.....	231
5SWLIN.0137-MUL.....	178
5SWWCE.0837-ENG.....	175
5SWWI7.0100-ENG.....	166
5SWWI7.0100-GER.....	166
5SWWI7.0300-MUL.....	166
5SWWI7.0537-ENG.....	168
5SWWI7.0737-MUL.....	168
5SWWI7.1100-ENG.....	166
5SWWI7.1100-GER.....	166
5SWWI7.1300-MUL.....	166
5SWWI7.1537-ENG.....	168
5SWWI7.1737-MUL.....	168
5SWWXP.0600-ENG.....	171
5SWWXP.0600-GER.....	171
5SWWXP.0600-MUL.....	171
5SWWXP.0737-ENG.....	173
9A0014.02.....	229
9A0014.05.....	229
9A0014.10.....	229

A

Abmessungen.....	34
5A5003.03.....	208
5MD900.USB2-02.....	206
Abschlusswiderstand.....	50, 54
ACPI.....	161, 162
ADI.....	180
.NET SDK.....	184
Development Kit.....	182
Allgemeintoleranz.....	13
Anleitung Temperaturtest.....	85
Anschluss von Kabeln.....	83
ARemb.....	177
ARwin.....	145, 177
Auflösung DVI.....	57
Auflösung SDL.....	56, 93, 98
Auswertung Temperaturen.....	85
Automation Runtime.....	177
Automation Runtime Embedded.....	177
Automation Runtime Windows.....	177

B

B&R Automation Device Interface.....	180
B&R Control Center.....	180
B&R Embedded OS Installer.....	176
B&R Key Editor.....	186
Backup BIOS.....	106
Batterie.....	26
Batteriestatusermittlung.....	26, 234
Batteriewechsel.....	234
Befestigungslasche.....	79
Beispielprogramme.....	88
Bemaßungsnorm.....	13
Betriebssystem	
Windows 7.....	166
Windows CE.....	175
Windows Embedded Standard 2009.....	173
Windows Embedded Standard 7.....	168
Windows XP Professional.....	171
Biegeradius.....	83
Biegeradiusspezifikation.....	83
BIOS	
ACPI Table/Features Control.....	134
Advanced.....	124
Advanced CPU Control.....	145
Boot.....	149
Boot Configuration.....	126
Boot Type Order.....	151
Channel 1 Master.....	129
Channel 1 Slave.....	130
Console Redirection.....	139
CPU Board Features.....	107
CPU Board Monitor.....	111
Exit.....	154
Hard Disk Drive.....	152
I/O Board Features.....	116
IDE Configuration.....	128
IF Board Features.....	121
Legacy.....	150
LPC Devices.....	108, 113, 117

Main.....	105
Memory Module Features.....	123
OEM Features.....	106
Others.....	153
Panel Control.....	120
PCI Express Root Port 1.....	134
PCI Express Root Port 2.....	137
Peripheral Configuration.....	127
Platform Power Management.....	148
Power.....	144
RAM Configuration.....	125
SDIO Configuration.....	133
Security.....	141
Set Supervisor Password.....	142
Set User Password.....	143
Statistical Values.....	109, 114, 118, 122
System Unit Features.....	112
Temperature Values.....	110, 115, 119
Thermal Trip Points Settings.....	147
USB.....	152
USB Configuration.....	132
Video Configuration.....	131
BIOS Defaulteinstellungen.....	155
BIOS Setup.....	102
BIOS Setup Tasten.....	104
BIOS Upgrade.....	163
Blinkcode.....	29
Bohrschablone.....	35
Boot Reihenfolge.....	149

C

CAN Master Schnittstelle.....	49, 53
CAN Schnittstelle.....	50, 54
CAN Terminierungsschalter.....	50, 54
CE- Kennzeichnung.....	188
COM1.....	24
COM2.....	57
CompactFlash.....	27
CompactFlash Karten.....	194
CompactFlash Tausch.....	236
Control Center.....	85, 180

D

DVI.....	56
DVI Kabel.....	212
Dynamic Wear Leveling.....	194

E

Einbaulage	
0°.....	80
180°.....	81
90°.....	80
Einschübe.....	22
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	188
EMV-Richtlinie.....	188
Entsorgung.....	12, 12
Erdung.....	23
Erdungsanschluss.....	84
ESD.....	10

Einzelbauteile.....	10
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse.....	10
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse.....	10
gerechte Handhabung.....	10
Verpackung.....	10
ETH.....	24
Ethernet.....	24
Ethernet Schnittstelle.....	40, 44

F

Features Windows CE 6.0.....	175
Firmwareupgrade.....	165
Freiraum.....	82
Funktionserde.....	84

G

Geräteschnittstellen und Einschübe.....	22
Gesamtgerät.....	19
GOST-R.....	189
Gosudarstwenny Standart.....	189

H

Hard Disk.....	55
Hauptspeicher.....	38
HDA.....	41
HDA Sound.....	55
HMI Drivers & Utilities DVD.....	231

I

I/O-Adressbelegung.....	161
Implementierungsanleitung.....	88
Interface Board.....	30, 39
CAN Schnittstelle.....	50, 54
Ethernet Schnittstelle.....	40, 44
MIC, Line IN, Line OUT.....	42
POWERLINK Schnittstelle.....	46
Status LEDs.....	50, 52, 54
X2X Schnittstelle.....	52, 54
Interrupt- Zuweisung.....	161

K

Kabel.....	212
DVI Kabel.....	212
SDL Kabel.....	215
SDL Kabel flex.....	221
SDL Kabel flex mit Extender.....	224
SDL Kabel mit 45° Stecker.....	218
USB Kabel.....	228
Key Editor.....	186
Klimakammer.....	88

L

Laufwerke.....	62
LED.....	29
LED-Anzeige.....	29

Leistungshaushalt.....	21
Leistungskalkulation.....	21
Loopback Adapter.....	87
Luftfeuchtigkeitsangaben.....	20
Luftzirkulation.....	82

M

MIC, Line IN, Line OUT.....	42, 60
Montage.....	79
Einbaulagen.....	80

N

Niederspannungsrichtlinie.....	188
--------------------------------	-----

P

Panel Anschluss.....	56
Power Fail Logik.....	237
Power LED.....	29
POWERLINK.....	45
LED STATUS.....	46
Link LED.....	46
Speed LED.....	46
System Stopp Fehlercodes.....	48
POWERLINK Schnittstelle.....	46
Power Taster.....	28

R

RAM-Adressbelegung.....	161
Relative Luftfeuchtigkeit.....	20
Reporterstellung.....	180
Reset Taster.....	28
Ressourcenaufteilung	
I/O-Adressbelegung.....	161
Richtlinien.....	13
Richtlinien und Erklärungen.....	188
RS232	
Buslänge.....	57
Kabeltyp.....	58
RS232 Kabel.....	229
RS422	
Buslänge.....	58
Kabeltyp.....	58
RS485	
Buslänge.....	58, 59
Kabeltyp.....	58, 59
RS485-Schnittstelle.....	59

S

Schnittstellen.....	22
SDL.....	56
SDL Kabel.....	215
SDL Kabel flex.....	221
SDL Kabel flex mit Extender.....	224
SDL Kabel mit 45° Stecker.....	218
SD Memory Card Slot.....	27
Serielle Schnittstelle.....	24, 57

Sicherheitshinweise.....	10
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	10
Betrieb.....	11
Montage.....	11
Schutz vor elektrostatischen Entladungen.....	10
Transport und Lagerung.....	11
Umgebungsbedingungen.....	11
Umweltgerechte Entsorgung.....	12
Vorschriften und Maßnahmen.....	10
Werkstofftrennung.....	12
Smart Display Link.....	56
Smart Display Link/DVI Buchse.....	55
Softwareversionen.....	180
Solid State Disk.....	55
Spannungsversorgung.....	23, 84
Spannungsversorgungsstecker.....	192
Static Wear Leveling.....	194
Status LEDs.....	29, 50, 52, 54
Störfestigkeit.....	84
Störungsableitung.....	84

T

Temperaturangaben.....	19
Temperaturauswertung.....	86
Temperatursensorpositionen.....	19
Temperaturtest.....	85
Temperaturüberwachung.....	237

U

UL Zulassung.....	189
Umgebungstemperatur.....	80
Upgrade	
BIOS.....	163
Firmware.....	165
Upgradeinformationen.....	163
Upgradeprobleme.....	165
USB.....	25, 60
USB Kabel.....	228
USB Media Drive.....	204
USB Memory Stick.....	210
USB Peripheriegeräte.....	99
User Serial ID.....	181

V

Vorgehensweise Temperaturtest.....	85
------------------------------------	----

W

WES2009.....	173
WES7.....	169
Windows 7.....	166
Windows CE.....	175
Windows Embedded Standard 2009.....	173
Windows Embedded Standard 7.....	168
Windows XP Professional.....	171

X

X2X Link Master Schnittstelle.....	51, 53
X2X Schnittstelle.....	52, 54

Z

Zubehör.....	190
Zulassungen.....	189
GOST-R.....	189
UL.....	189